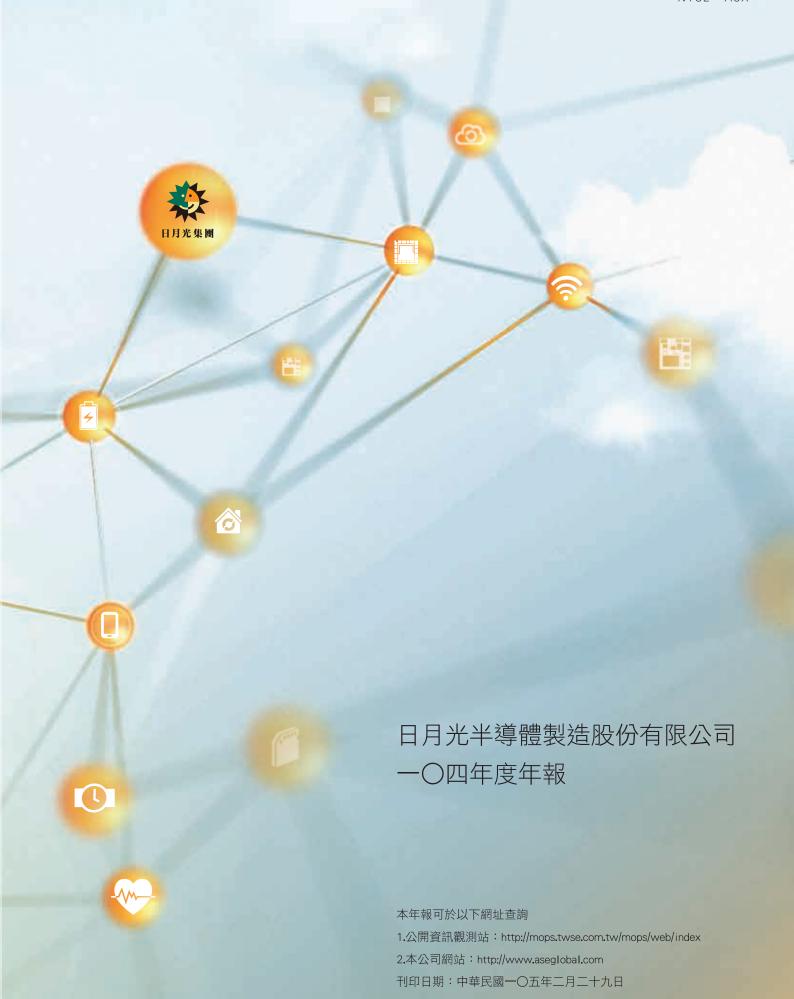
股票代碼:2311 NYSE:ASX



本公司發言人

吳田玉 職稱 | 營運長

代理發言人

董宏思 職稱 財務長

電話 | (02) 87805489

電子郵件信箱 | ir@aseglobal.com

總公司

地址 | 高雄市楠梓加工出口區經三路26號

台北辦公室

地址 | 台北市基隆路一段333號19樓1901室

中壢分公司

地址 | 桃園市中壢區中華路一段550號

南投分公司

地址 | 南投縣草屯鎮太平路一段351巷135號

高雄工廠

地址 | 高雄市楠梓加工出口區經三路26號

電話 | (07)3617131

中壢工廠

地址 | 桃園市中壢區中華路一段550號

電話 (03)4527121

南投工廠

地址 | 南投縣草屯鎮太平路一段351巷135號

電話 | (049)2350876

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓

網址 | http://www.uni-psg.com

電話 | (02)27463797

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱|勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名|陳珍麗會計師、江佳玲會計師

地址 | 高雄市前鎮區成功二路88號3樓

網址 | http://www.deloitte.com.tw

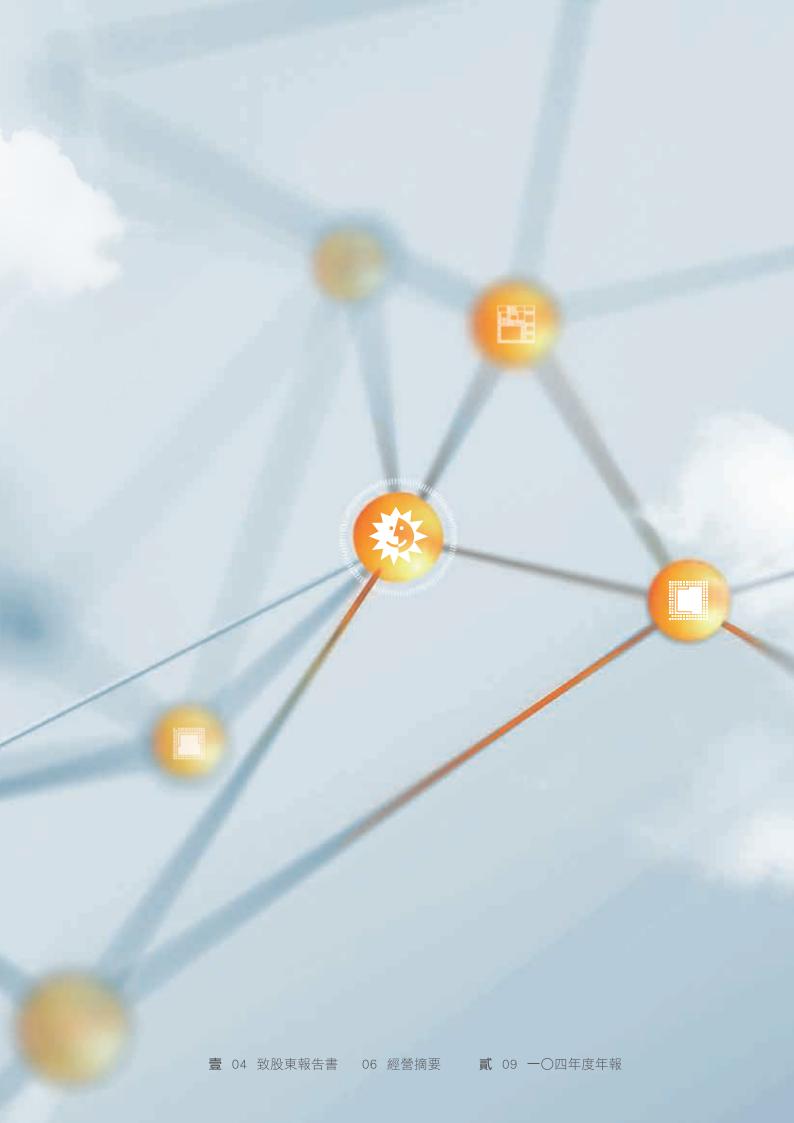
電話 | (07)5301888

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

紐約證券交易所(NYSE)

查詢該海外有價證券資訊之方式及公司網址

http://www.aseglobal.com







致股東報告書

各位股東女士、先生:

2015年又是充滿挑戰的一年,全球景氣未能延續2014年復甦的態勢,而在2015年初急凍後,連帶半導體市場也因中國市場趨緩、智慧型手機需求減少及電腦產業大幅衰退的影響而表現持平,所幸台灣半導體產業在此波景氣寒冬中的表現仍優於全球。根據Gartner'的統計,2015年半導體市場銷售值為3,337億美元,較2014年衰退1.9%,封裝測試產業因市場波動、產業庫存調整及產業競爭加劇的因素而呈現微幅衰退的趨勢。2016年Gartner預測全球半導體銷售值將達3,401億美元,較2015年成長1.9%,本公司將以保守穩健,審慎樂觀的態度面對來年的景氣趨勢,持續努力。

根據工研院IEK ITIS計畫之統計,2015年台灣IC封裝測試業產值為新台幣4,413億元,較2014年衰退約2.8%。封裝業產值為新台幣3,099億元,較2014年衰退1.9%;測試業產值為新台幣1,314億元,較2014年衰退4.7%。茲將本公司過去一年來的營運狀況報告如下:

「2015年營業結果」

- 1. 2015年營業計畫實施成果 | 本公司2015年集團合併營收為新台幣2,833億元,較2014年增加約267億元,成長10.4%。就半導體封裝測試業務來看,2015年度合併營收為新台幣1,545億元(含部門間收入新台幣94億元),較2014年減少約52億元,衰退3.2%,主要肇因於另一陣營手機新產品對消費者而言缺乏購買誘因而影響到客戶出貨。另就集團電子代工服務業方面,2015年合併營收為新台幣1,384億元(含部門間收入新台幣2億元),較2014年增加約326億元,成長30.75%,穿戴市場將會是未來主要的成長動能。
- 2. 預算執行情形 | 本公司於2015年並未公開財務預測。
- 3. 財務收支及獲利能力分析 | 本公司2015年度合併財務報告顯示實收資本額為新台幣792億元,歸屬於本公司業主之權 益總計為新台幣1,569億元,佔總資產3,653億元之43%,長期資金佔固定資產比率為156%,流動比率為130%,本年

上年度減少約15.8%,主要因為產品結構的調整及客戶庫存修正的因素。合 併税前息前折舊攤銷前純益較2014年僅下降約1%,在2015年艱辛的經營環 境中,誠屬可貴。 4. 研究發展狀況 | 全球電子產業經歷後PC與行動運算時代, 人類智能生活 (Smart & Better Life)中運算與連結需求,將帶動智慧產品數倍成長;單晶片系 統(SoC)與系統級封裝(SiP)並肩合作,創造更高效能及價值的系統整合(System Integration);智能產品(Smart Appliance)將更倚重先進半導體封測產業鏈,邁向 異質整合模組。本公司持續布局三大核心技術與產品:先進封裝/模組、銅銲 線/覆晶凸塊及中低腳數封裝。本公司2015年成功開發之重點產品與技術歸類 如下:(1)覆晶封裝:16奈米銅製程/超低介電係數無鉛覆晶封裝、雙面封膠技 術、高密度高頻寬堆疊封裝技術及多層細線路內埋無芯載板,並擴展20/28奈 米覆晶技術應用認證。(2)銲線封裝:內埋線路基板應用開發、高階四方平面 無引腳封裝測試、超細間距與線徑銅/金銲線技術,並延伸20/28奈米技術應 用認證。(3)晶圓級封裝: 2.5D矽穿導孔堆疊量產、先進扇出封裝、晶圓級系 統封裝、感測器矽穿導孔、整合被動元件、40um微間距錫銀/銅柱電鍍晶圓凸 塊等。(4)先進封裝與模組:高密度SiP封裝通訊模組、高整合多模多頻3G通訊

董事長 張虔生



模組、無線感測模組封裝、分段式電磁干擾遮蔽等。

度財務比率與上年度相較略微衰退。本年度營業利益為新台幣249億元,較 2014年減少新台幣48億元,衰退約16.1%;稅後純益為新台幣204億元,較



「2016年營業計畫概要」

- 1. 經營方針 | (1) 提供客戶「至高品質」的服務
 - (2) 為公司及客戶創造長期且穩定的利潤
 - (3)與協力廠商攜手共創榮景
 - (4)訓練員工成為各領域之專業菁英
- (5)「公平且合理」地對待所有員工
- (6)提供員工「和諧、愉快、開放」的工作環境
- (7)在營運中儘可能地保持彈性。
- 2. 預期銷售數量及其依據 | 依據產業景氣、未來市場需求及本公司之產能狀況,本公司2016年預計銷售量如下: 封裝:預計銷售數量 約163億個 測試:預計銷售數量 約22億個
- 3. 重要產銷政策 | 市場波動及庫存修正都讓我們一路走來戰戰兢兢如履薄冰,過去一年對本公司而言,是充滿挑戰的一年。隨著2016年到來,縱使市場因仍存在不確定的經濟因素而保守看待來年市場,但我們相信庫存修正已經進入尾聲,將溫和且逐季成長。其次,本公司的成長動能依然是系統級封裝(SiP)。過去三年本公司深耕SiP領域,不斷地在客戶與市場間學習及成長,目前SiP集團營收已將近20億美元,未來五到十年間,相信SiP仍會是讓本公司持續成長的焦點。同時,根據近年的發展經驗,我們也體認到並非所有的SiP產品都是獲利的,未來本公司將會重新調整與檢討SiP的產品結構,在各種SiP產品與市場中嘗試提供更多樣化的選擇與資源配置以達到最適切的獲利與效率。再者,藉由參與客戶設計研發製程的經驗中發現本公司在光學、異質整合、扇出型晶圓級封裝(Fan-out)等技術上尚有持續努力精進的空間,尤其是在系統設計、軟體及韌體的領域,未來我們將朝往技術精進與資源整合的方向持續努力,希望在2017年就可以看到初步成果。

「未來公司發展策略」

本公司SiP技術具有領先地位,能夠滿足國際頂尖企業對物聯網(IOE)、以及穿戴式裝置等3C產品輕薄短小、又省電的需求,在SiP蔚為風潮之後,本公司將持續投資,並期許營收能盡快倍增。SiP是大勢所趨,無論是產品的產能、設計、或是垂直整合,SiP將走在科技前端,成為國際大廠很好的選項。此外,企業整併是現在的潮流也是趨勢,如安華高科技

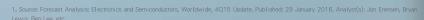
(Avago)宣布併購IC設計大廠博通(Broadcom),英特爾(Intel)也宣布併購邏輯晶片大廠Altera,封測業中如江蘇長電併購STATS ChipPAC,中國南通富士通購入IDM業者AMD之封測廠及Amkor併購J-Devices等。面對中國大陸半導體業崛起,台灣同業間應積極合作整合資源,以進一步提升台灣封測業之競爭優勢,團結因此更顯重要。台灣的內需有限,要和全球對手一爭短長,憑藉的不是便宜的資金,不是終端市場的通行證,靠的是兢兢業業的努力與全世界認可差異化的創新與服務。

「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」

展望2016年,主要研究預測機構多半保守以對。美國及其他主要國家對貨幣政策的態度、升息的速度與幅度都深刻的影響未來國際金融的走向。再者,國際原油因伊朗將重返市場而拉長低油價時間,如此一來,對新興市場中石油輸出國如俄羅斯等的經濟無疑是雪上加霜。況且中國大陸在2015年剛剛經歷了二十幾年來最低經濟成長率的衝擊之後,大陸官方如何在兼顧經濟成長與經濟結構改革上有所取捨及「紅色供應鏈」在地化與大陸半導體產業挾豐沛資金積極向全球併購等動作,更完全牽動了台灣經濟發展。大陸建構半導體的垂直產業供應鏈,藉由併購國外大廠,迅速擴大經濟規模。本公司將更加強研發能力,提升高階封測產品比重創造公司競爭優勢。而台灣也應該順應潮流更積極地參與國際間區域整合,我們充滿信心做好準備,來面對未來快速的改變。

副董事長 張洪本

WELLS &

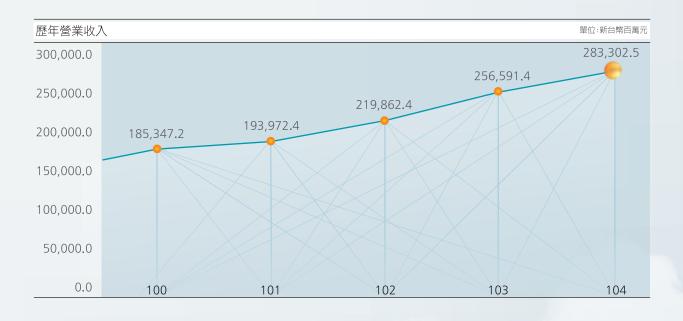


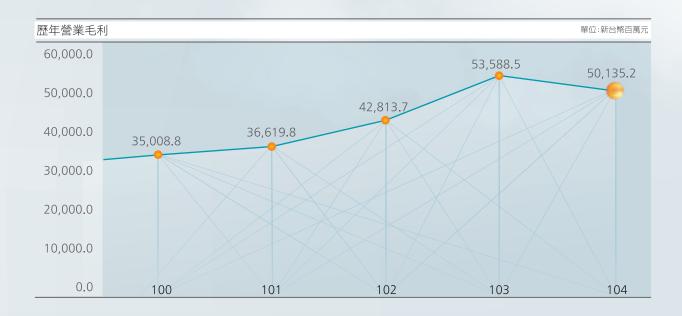
經營摘要

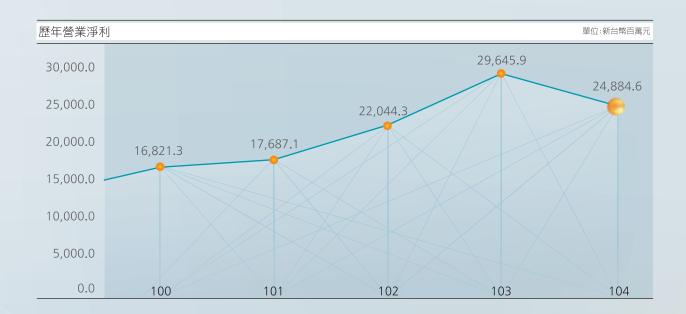
單.	位	:新	台	- 四文	白	萬	刀

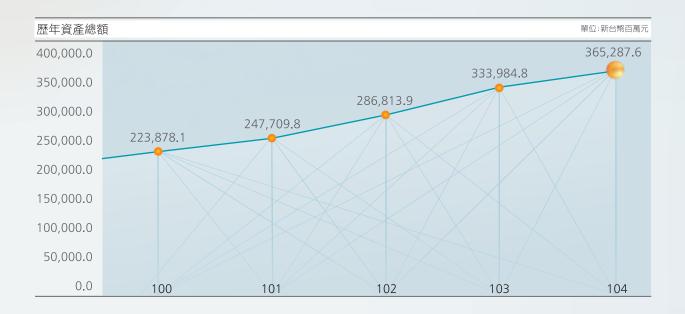
經營摘要(合併)	100 (ROC)	101 (2010年版IFRSs)	102 (2010年版IFRSs)	103 (2013年版IFRSs)	104 (2013年版IFRSs)
營業收入	185,347.2	193,972.4	219,862.4	256,591 . 4	283,302.5
營業毛利	35,008.8	36,619.8	42,813.7	53,588 . 5	50,135.2
營業淨利	16,821.3	17,687.1	22,044.3	29,645.9	24,884 . 6
税前淨利	16,997.2	16,584.3	19,356.7	28,548.2	25,288.3
税後淨利	13,978.9	13,523.6	16,155.0	24,281 . 6	20,449.0
每股盈餘(元/股,追溯調整後之稀釋每股盈餘)	1.78	1.71	2 . 03	2.96	2.44
現金股利 (元/股)	0.64945235	1.04945018	1.29411842	2.00379984	(註1)
股票股利 (元/股)	1.39882046	_	_	_	_
固定資產淨額 (不動產、廠房及設備)	111,779 . 0	127,197 . 8	131,497.3	151,587 . 1	149,997.1
股東權益淨額 (權益合計)	102,282.5	110,951.8	127,165.0	158,438.0	168,419.9
資產總額	223,878.1	247,709.8	286,813.9	333,984.8	365,287.6
員工總數(人)	51,411	57,259	60,199	68,100	65,789
日月光總市值(註2)	172,238.4	191,577.8	215,704.3	299,484.7	300,570.2

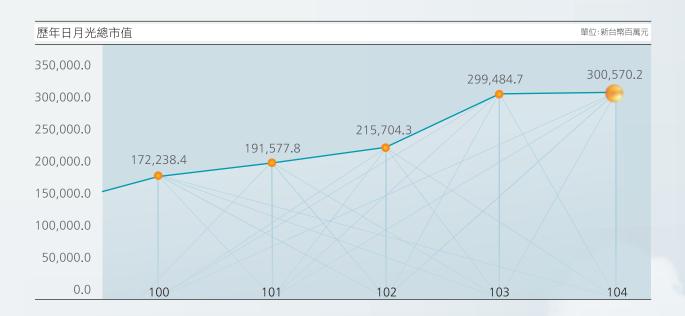
註1:俟股東會決議後定案。 註2:總市值=年底收盤價*流通在外股數。











日月光半導體製造股份有限公司 一〇四年度年報

目錄 一〇四年度年報

壹、致股東報告書及經營摘要

2 貳、公司簡介

參、公司治理報告

- 6 一、組織系統
- 8 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
- 13 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
- 17 四、公司治理運作情形
- 28 五、會計師公費資訊
- 29 六、更換會計師資訊
- 30 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形
- 30 八、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 31 九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以内之親屬關係之資訊
- 31 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

肆、募資情形

- 32 一、資本及股份
- 40 二、公司債辦理情形
- 41 三、特別股辦理情形
- 41 四、海外存託憑證辦理情形
- 42 五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股)
- 44 七、資金運用計畫執行情形

伍、營運概況

- 45 一、業務内容
- 53 二、市場及產銷概況
- 60 三、從業員工資料
- 61 四、環保支出資訊
- 64 五、勞資關係
- 67 六、重要契約

陸、財務概況

- 68 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
- 72 二、最近五年度財務分析
- 76 三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告
- 77 四、最近年度財務報告
- 177 五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告
- 224 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難之情事

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 225 一、財務狀況
- 225 二、財務績效
- 225 三、現金流量
- 226 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 226 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
- 226 六、風險事項分析評估
- 231 七、其他重要事項

捌、特別記載事項

- 232 一、關係企業相關資料
- 245 二、私募有價證券辦理情形
- 245 三、子公司持有或處分本公司股票情形

四、其他必要補充說明事項

245

246 玖、其他事項

1 、公司簡介

一、設立日期:民國七十三年三月二十三日

二、公司沿革:

本公司之創立係由歸國學人張虔生及張洪本基於工業報國之精神,並配合政府發展高科技政策,以現金及專門技術作價集 資所創建,所營事業為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售等。

本公司記事如下:

- 73年03月 公司正式成立。
- 73年07月 工廠開工。
- 73年08月 塑膠立體型積體電路(PDIP),開始外銷歐美及日本。
- 74年02月 陶瓷立體型積體電路(CDIP),開始外銷日本及歐美。
- 74年10月 高品質塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC)開始外銷美國。
- 76年05月 高品質多腳型針格排列積體電路(PGA)及塑膠多腳型針格排列積體電路(PPGA) 開始外銷歐美。
- 78年5-7月 78年5月25日經證期會(78)台財證(一)字第24594號函核准並經臺灣證券交易所(78)上字第4461號函核覆股權分散符合標準,並於同年7月19日正式在臺灣證券交易所上市掛牌買賣。
- 79年03月 收購台灣福雷電子股份有限公司股權百分之九十九點九,計支付價金新台幣105,006,183元,以併購方式進入半導體測試業務市場。
- 80年03月 轉投資設立日月光電子(馬來西亞)股份有限公司,從事各型積體電路之製造、加工、組合、測試及外銷,另轉投資設立日月光半導體貿易(香港)股份有限公司,以便利轉接海外(馬來西亞)生產基地訂單及服務客戶。
- 80年08月 新產品平面型塑膠晶粒承載器積體電路(EQFP)開始量產。
- 80年11月 本公司產品榮獲MOTOROLA公司頒發品質優良獎(Award of Excellence for Quality)。
- 81年04月 榮獲國際標準組織(ISO 9002)品質認證合格。
- 84年07月 在亞洲、美國及歐洲等地發行海外存託憑證8,600仟單位,每單位表彰本公司普通股5股,計發行43,000仟股,每股面額10元,售價每單位美金15.25元溢價發行,募集資金折合新台幣33.9億元。
- 85年06月 本公司之子公司「ASE Test Limited」在美國NASDAO證券市場掛牌買賣。
- 86年09月 本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。
- 86年11月 通過SAC(Semiconductor Assembly Council)認證。
- 87年01月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)以1,500,000股普通股發行120,000,000單位之台灣存 託憑證(TDR),並於台灣證券交易所掛牌買賣。
- 87年03月 榮獲國際標準組織(QS 9000)品質認證合格。
- 87年09月 榮獲ISO14001環境品質認證合格。
- 88年03月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)第二次以2,500,000股普通股發行台灣存託憑證 (TDR),並於台灣證券交易所掛牌買賣。
- 88年05月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)收購ISE LAB七成股權。
- 88年07月 日月光集團收購摩托羅拉台灣中壢及南韓PAJU兩廠,藉此更能與摩托羅拉公司進行長期之策略聯盟,強化日月光集團垂直整合的力量,並可擴大產品涵蓋範圍。
- 88年2-7月 為提昇日月光集團電子專業代工之領域,進一步增加對客戶之服務項目,進而擴大客戶群,遂於88年度自集中交易市場買入環隆電氣股份有限公司股票,參與經營權,持股比率20.67%。
- 89年09月 為提昇本公司於全球半導體市場之競爭力,進而強化公司形象及國際知名度,於美國時間9月25日完成美國存託憑證(ADR)發行作業,本次發行數量計20,000,000單位,每單位表彰本公司普通股5股,計發行普通股100.000,000股面額10元,發行價格每單位美金7元,募集資金折合新台幣計43.8億元。
- 91年09月 榮獲「第十屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。
- 92年09月 本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。
- 92年10月 本公司董事會決議合併子公司日月欣半導體股份有限公司與日月宏科技股份有限公司,本公司發行 282,315,437股以進行合併換股事宜。

- 93年02月 日月光集團與NEC簽立股權買賣合約,併購該公司位於山形縣之封裝測試廠。
- 93年07月 本公司於93年6月經董事會決議通過投資設立日月光半導體(昆山)有限公司,投資金額美金壹仟貳佰萬元,並 於93年7月23日經投審會核准在案。
- 93年08月 本公司與子公司日月欣半導體股份有限公司及日月宏科技股份有限公司正式辦理合併,以本公司為存續公司,並設立中壢分公司。

本公司概括承受原由子公司日月欣半導體股份有限公司投資Omniquest Industrial Limited在大陸地區設立之日月光半導體(上海)(股)公司,並於93年8月10日經投審會核准在案。

本公司於93年7月經董事會決議通過投資設立日月光電子元器件(上海)有限公司,投資金額美金壹仟貳佰萬元,並於93年8月20日經投審會核准在案。

- 93年11月 本公司於93年9月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司,並於93年11月25日經投審會核准在案。
- 94年06月 本公司於94年5月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司,並於94年6月30日經投審會核准在案。
- 94年10月 榮獲「第十三屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。
- 94年11月 本公司於94年8月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司,並於94年11月2 日經投審會核准在案。

本公司於94年11月在菲國總統「國際優良廠商頒獎典禮」頒獎之夜獲頒最高獎項「菲律賓總統獎」。

- 94年12月 本公司於94年11月經董事會決議通過投資設立日月光高新科技(上海)有限公司,投資金額美金壹仟伍佰萬元,並於94年12月21日經投審會核准在案。
- 95年03月 本公司以新台幣參仟萬元投資設立「日月光電子股份有限公司」,持股比率為100%。
- 95年05月 本公司經董事會決議通過將材料事業部分割予子公司日月光電子股份有限公司,換股比例為被分割之材料事業部營業價值每新台幣十元換取日月光電子股份有限公司普通股一股。
- 95年08月 本公司正式將材料事業部分割予日月光電子股份有限公司,本公司計取得日月光電子股份有限公司普通股 294,929,700股。

本公司於95年6月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(昆山)有限公司,並於95年8月1日經投審會核准在案。

- 95年09月 本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量,將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股 147,500,000股及147,429,700股,分別轉讓予子公司ASE Labuan Inc.及ASE Mauritius Inc.。
- 95年12月 本公司於95年11月經董事會決議通過透過子公司J&R Holding Limited以其自有資金美金陸仟萬元,受讓中國大陸地區之現有事業威宇科技測試封裝有限公司100%股權,並於95年12月29日經投審會核准在案。 為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量,本公司之子公司ASE Mauritius Inc.將其持有之日月光電子股份有限公司普通股147,429,700股,轉讓予本公司另一子公司ASE Labuan Inc.。
- 96年06月 本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量,將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股 3,000,000股,轉讓予子公司ASE Labuan Inc.。
- 96年07月 本公司於96年3月經董事會決議以海外自有資金美金21,600,000元,透過子公司J&R Holding Limited購買 NXP B.V.所持有中國大陸之恩智浦半導體蘇州有限公司60%股權,並於96年7月2日經投審會核准在案。(另 於97年3月7日核准更名為蘇州日月新半導體有限公司)
- 96年08月 本公司為整合集團名稱,將大陸地區投資事業威宇科技測試封裝有限公司名稱更名為「日月光封裝測試(上海)有限公司」,並於96年8月29日經投審會核准在案。
- 97年02月 本公司於96年10月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司,並於97年2 月20日經投審會核准在案。

本公司於97年01月經董事會決議通過以自有資金美金柒佰萬元,透過子公司J&R Holding Limited受讓中國大陸地區之現有事業威海愛一和一電子有限公司100%股權,並於97年2月15日經投審會核准在案。(另於97年5月22日核准更名為日月光半導體(威海)有限公司)。

97年05月 本公司於97年03月經董事會決議通過增資美金玖仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司,並於97年5月16 日經投審會核准在案。

> 本公司於97年04月經董事會決議通過增資金額美金壹仟參佰萬元於日月光半導體(威海)有限公司,並於97年 5月22日經投審會核准在案。

- 97年08月 本公司於97年07月經董事會決議通過增資美金陸佰萬元於日月光電子元器件(昆山)有限公司,並於97年8月7日經投審會核准在案。
- 98年02月 本公司於97年12月經董事會決議通過增資美金貳仟萬元於日月光半導體(威海)有限公司,並於98年2月4日經投審會核准在案。
- 98年07月 本公司於98年06月經董事會決議通過增資美金參仟貳佰萬元於日月光半導體(昆山)有限公司,並於98年7月 31日經投審會核准在案。
- 98年11月 本公司於98年11月經董事會決議通過,以現金及子公司J&R Holding Limited及新加坡福雷電子股份有限公司所分別持有之本公司普通股107,308,600股及199,287,400股合計306,596,000股作為對價,對環隆電氣股份有限公司(下稱環隆電氣)之股份進行公開收購。
- 99年02月 前述共同公開收購案已於99年2月9日完成,本次共收購環隆電氣普通股股份641,669,316股,加計收購前集團原持有普通股股份192,944,213股,完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額78.1%。
- 99年08月 本公司於99年4月經董事會決議通過同意環隆電氣之股票終止上市申請案,同時承諾收購環隆電氣之股票。 本公司已於99年8月5日完成該公開收購案,共收購環隆電氣流通在外股份222,243,661股,加計收購前集團原持有環隆電氣股份834,613,529股,完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額98.9%。
- 99年11月 本公司為配合主管機關之政策,於99年11月26日將本公司發行之股票轉換為全面無實體發行。
- 100年01月 本公司為配合集團營運策略之考量,於100年1月經董事會決議通過設立南投分公司以承接子公司環隆電氣之 微電子構裝業務。
- 100年03月 本公司於99年11月經董事會決議通過透過子公司ASE (Korea) Inc.以其自有資金美金陸仟萬元增資日月光半導體(威海)有限公司,並於100年3月1日經投審會核准在案。
- 100年11月 本公司為強化與子公司日月鴻科技股份有限公司(以下簡稱「日月鴻」)其資源、人力及技術整合效益之目的,於2011年11月8日經董事會決議通過以每股現金新臺幣18.5元為對價,透過公開收購方式收購除本公司外其他股東所持有之日月鴻普通股,本公司並已於2011年11月18日完成該公開收購案,共收購日月鴻普通股股份105,697,703股,收購金額約新台幣19.6億元,若加計本公司原持有日月鴻55.7%股權計算,本公司持有日月鴻之股權已達99.2%。
- 100年12月 本公司於100年12月榮獲經濟部頒發「一百年國家發明創作獎之貢獻獎」殊榮。
- 101年05月 本公司為整合整體資源,提昇營運效益及競爭力於101年3月經董事會決議通過同意以現金合併日月鴻。以本公司為合併後存續公司,日月鴻科技為消滅公司,本合併案之合併基準日為101年5月1日。
- 101年11月 本公司2011 CSR Report於101年11月榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續報告獎—銅獎」之肯定。
- 101年12月 本公司於101年12月榮獲經濟部頒發「智慧財產經營管理優質獎:企業組-優質獎及最佳智財報告書」二項殊 榮。

本公司K12自2009年建廠規劃導入綠建築標準,以台灣綠建築EEWH"鑽石級"與美國LEED"金級"為設計準則,歷經規劃設計、施工、成效驗證、書面審查及現場查核等過程,順利於2012年12月通過内政部審核並榮獲台灣EEWH 最高等級之鑽石級標章。

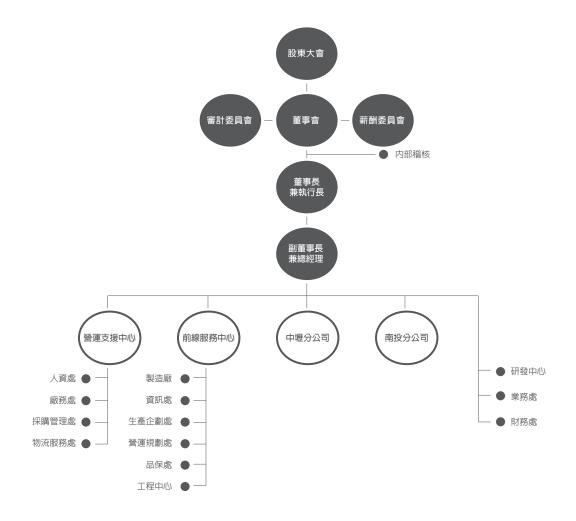
- 102年07月 本公司兩家大陸子公司日月光半導體(昆山)有限公司及日月光電子元器件(昆山)有限公司,鑑於集團資源整合及產業規模經濟之考量,由日月光半導體(昆山)有限公司辦理吸收合併日月光電子元器件(昆山)有限公司,日月光電子元器件(昆山)有限公司為消滅公司,合併完成後日月光電子元器件(昆山)有限公司辦理清算,日月光半導體(昆山)有限公司收回/註銷美金2,400萬元之投資。
- 102年08月 本公司為整合整體資源,提昇營運效益及競爭力於102年7月經董事會決議通過同意與本公司持股比例達 100%之子公司洋鼎科技,依企業併購法及其他相關法令之規定進行簡易合併,以本公司為合併後存續公司,洋鼎科技為消滅公司,本合併案之合併基準日為102年8月30日。

- 102年09月 本公司發行美金4億元之海外第三次無擔保轉換公司債(Zero Coupon Convertible Bonds)。 本公司辦理現金增資發行普诵股130,000仟股。
- 102年10月 本公司於102年08月經董事會決議通過經由海外子公司ASE (Korea) Inc.以債作股,以美金貳仟伍佰萬元增資日月光半導體(威海)有限公司,並於102年10月29日經投審會核准在案。
- 103年07月 本公司於103年07月經董事會決議通過透過子公司ASE (Korea) Inc.以其自有資金美金貳仟萬元增資日月光半導體(威海)有限公司,並於103年08月18日經投審會核准在案。
- 103年09月 本公司於103年09月榮獲富比世(Forbes)雜誌評選為亞洲企業五十強(Fab 50), 亦是2014年台灣唯一上榜之上市公司。
- 103年10月 本公司於103年10月再次向關務署高雄關重新申請安全認證優質企業認證(Authorized Economic Operator,簡稱AEO),結果通過實地驗證,再次取得AEO資格。
- 104年01月 本公司集團董事長暨執行長張虔生先生與營運長吳田玉博士於美國加州舉行的2015 SEMI產業技術論壇 (Industry Strategy Symposium, ISS)獲頒2014 SEMI Award,此獎項認可日月光在封裝製程上的努力開發與研究能突破傳統金打線技術,導入銅打線技術的表現。
- 104年05月 本公司與日商TDK Corporation簽署合資協議,共同設立日月陽電子(股)公司合資金額共美金39,490,000元之等值新台幣,本公司取得約51%之股權,TDK Corporation取得約49%之股權。
 - 本公司之中壢分公司通過海關AEO安全認證優質企業(Authorized Economic Operator,簡稱AEO)。
- 104年07月 本公司發行美金2億元之海外第四次無擔保轉換公司債(Currency Linked Zero Coupon Convertible Bonds due 2018)。
 - 榮獲經濟部國際貿易局頒發金貿獎「最佳貿易貢獻獎」之殊榮。
- 104年10月 本公司於104年8月經董事會決議通過第一次收購矽品精密工業(股)公司之普通股股份。本公司已於104年10 月完成該公開收購案,共收購矽品精密工業(股)公司流通在外普通股股份779,000,000股,占其已發行有表決權股份總額之24.99%。
 - 本公司高雄廠K11、K12廠通過經濟部工業局「綠色工廠標章認證」,正式成為綠色工廠,並榮獲「綠色工廠」標章。
- 104年11月 本公司於台灣永續能源研究基金會評選2015 TCSA台灣企業永續獎,本公司榮獲「台灣TOP 50企業永續報告獎-電子資訊製造業」銀獎。
 - 本公司高雄廠K4、K7、K8、K10、K11、K12共6棟廠榮獲德國聯邦資訊安全局(Germany Federal Office for Information Security, BSI)ISO 15408安全認證EAL6現場驗證(Site Certification)證書,為全球唯一獲此認證之半導體晶圓封測代工廠。
- 104年12月 惠譽國際信用評等股份有限公司於104年12月16日公布本公司國内長期信用評等等級為A+(twn)。
 - 本公司兩家大陸子公司日月光半導體(上海)有限公司及日月光電子元器件(上海)有限公司,鑑於集團資源整合及產業規模經濟之考量,於104年12完成合併。
 - 本公司為善盡企業社會責任,以永續發展為目標邁進,自101年開始,連續四年榮獲BSI(英國標準協會)肯定,得到「包容性綠色成長獎」及「GRC管理典範獎」之獎項,104年更於12月23日獲頒「綠色企業典範獎」之殊榮,彰顯本公司在綠色企業面向的努力。
 - 本公司高雄廠K3與K5廠於104年12月再度通過經濟部工業局綠色工廠認證。
 - 本公司高雄廠K9於102年2月1日通過清潔生產認證,並於104年12月取得經濟部工業局清潔生產展延認證。
- 105年01月 本公司高雄廠K8已於102年2月1日取得清潔生產認證,並於105年1月取得經濟部工業局清潔生產展延認證。
- 105年03月 本公司於104年12月經董事會決議通過第二次收購矽品精密工業(股)公司之普通股股份。擬將共收購矽品精密工業(股)公司流通在外普通股股份770,000,000股,占其已發行有表決權股份總額之24.71%,惟本案因公平交易委員會未於收購期間屆滿前審理完成,故宣布收購條件無法成就。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構:



(二)主要部門所營業務

〈營運支援中心〉

人 資 處:人力資源管理及組織發展

- 人資營運服務處:提供員工服務、制定 人力需求計畫及人員招募、薪酬、福利 及績效制度規畫及管理、中央安防管理
- 人資營運發展處:組織發展規劃及策略 規劃、強化員工關懷與員工照顧、CSR 社會責任與公益活動參與

廠 務 處:廠房及行政區環境保護、庶務管理及工安管制

- 新建工程處:規劃廠區擴建計畫、新建 廠監造及驗收管理、營運發展
- 企業職安處:整合廠區廠務組織、強化 法令與規範鑑別及標準化作為、負責職 安環境管理及永續發展
- 廠務技術整合處:整合與強化廠務系統 之供應品質與可靠度、廠房安全維護之 整合運作、新技術與設備引進規劃

採購管理處:機台、產品投料之採購、管理及控制

- 採購管理一處:整合生產原物料採購及 供應商資源管理
- 採購管理二處:修繕總務採購專業分工、跨部門資源整合管理
- 採購管理三處:整合機器設備採購資源、跨單位制度訂定與推動

物流服務處: 倉儲、進出口業務及保稅帳務管理

〈前線服務中心〉

製 造 廠:半導體封裝之代工、掌理產品之生產計 劃、產品製造、進度管理、現場管理、設 備維修等相關事宜

資 訊 處:公司資訊系統建構、推動e化經營策略及系統服務

- 自動化及工程資訊處:自動化及工程資 訊系統策略發展、創新、架構規劃、系 統整合、系統設計及維護
- 技術資訊處:公司資訊系統軟硬體評估、導入、建置及維運服務
- 營運及客戶資訊處:公司營運管理及客 戶資訊服務 IT 應用系統之發展規劃、開發、及維護管理
- 製造資訊處:製造執行資訊系統策略發展、創新、架構規劃、系統整合、系統設計及維護

生產企劃處:生產企劃及營運效率管理

營 **運 規 劃 處**: 規劃營運及專案計畫、行政資源規劃整合 與執行

品 保 處:產品品質檢驗及品質確保

- 品質保證處:確保品質管理機制、確保 產品品質
- 品質系統處:建立產品可靠度、保證測 量儀器精確度
- 品質工程處:客戶溝通與協調、建立品質檢驗流程、監控及品質確保

工程中心:基板設計及生產技術開發

- 設計工程處:新技術與新材料開發及系 統流程整合與自動化,提供全球客戶在 地支援設計服務
- 封裝工程處:新設備與新材料開發及導 入評估、工程執行系統整合

〈其他〉

研 發 中 心: 先進技術研究發展與生產技術導入、設計 與製造規格之制定、新產品與新技術之研 究發展與評估

業 務 處:亞洲、美洲、歐洲等地區業務開拓推廣與 產品銷售之執行

財 務 處: 財務及會計,包括資金管理、資產管理、 成本與管理會計、租稅規劃及股務作業

内部稽核:内部政策、流程及標準稽核、評估内部控制制度之合理及各部門有效性

〈中壢分公司〉

包括行政、人資暨公共關係、財務、品保、生產運籌管理、資訊、工程發展中心、封裝測試製造廠、晶圓級凸塊作業暨 封裝製程、策略資材及客戶關係管理等單位業務。

〈 南投分公司 〉

包括人資暨總務、財務會計、品管、營業、產品工程、資訊、製造、生管、物管、資材、工程及環安等單位業務。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料:

(一)董事資料(年報刊印日 105.02.29)

單位:股

											単位·胶
職稱	國籍或 註冊地	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有	有股份	現在持有股	數(註1)	配偶、未成年子女 現在持有股份(註1)	
	عدراااته				口知	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
董事本人	香港	張洪本 (副董事長)	104.06.23	三年	73.03.11	104,414,941	1.32%	104,414,941	1.32%	121,729,346	1.54%
董事本人	美國	張能傑	104.06.23	三年	98.06.25	1,779,708	0.02%	1,779,708	0.02%	_	_
董事本人	香港	香港商微電子 國際公司	104.06.23	三年	80.03.30	1,327,202,773	16.82%	1,327,202,773 (註2)	16.77%	_	_
	新加坡	張虔生 (董事長)									
董事之法人	中華民國	吳田玉									
代表人	中華民國	董宏思									
10茲人	中華民國	羅瑞榮									
	中華民國	陳昌益									
	中華民國	陳天賜									
獨立董事	中華民國	游勝福	104.06.23	三年	98.06.25	_	_	_	_	4,632	0.00%
獨立董事	美國	徐大麟	104.06.23	三年	98.06.25	_	_	_	_	_	_
獨立董事	中華民國	何美玥	104.06.23	三年	104.06.23	_	_	_	_	_	_

職稱	姓名	利用他人名義	持有股份(註1)	主要經(學)歷	具配偶或二親等以	以内關係之其他主管	
期以 作	姓石	股數	持股比率	目前兼任本公司及其他公司之職務(註3)	職稱	姓名	關係
董事本人	張洪本 (副董事長)	_	-	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣(股)公司董事長	董事長	張虔生	兄
董事本人	張能傑	-	_	美國衛斯理大學心理系學士	董事長	張虔生	父
董事本人	香港商微電子 國際公司	_	_				
	張虔生			台灣大學電機工程系畢	副董事長	張洪本	弟
	(董事長)			美國伊利諾理工學院碩士	董事	張能傑	子
	吳田玉			美國賓州大學應用機械博士	_	_	_
董事之法人	董宏思			美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	_	_	_
代表人	羅瑞榮			交通大學電子物理系畢	-		_
	陳昌益			加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁	-	-	-
	陳天賜			中原大學工業工程與管理系	-	_	-
獨立董事	游勝福	_	-	台灣大學商學系會計組 政大會計研究所碩士	-	-	-
獨立董事	徐大麟	_	_	台灣大學物理學學士 美國紐約州布魯克林理工學院電子物理學 碩士 美國加州柏克萊分校電機工程博士	_	_	_
獨立董事	何美玥	-	_	台灣大學農化系學士	_	_	-

註1:截至年報刊印日止實際持有股數。 註2:截至年報刊印日止質押股數為248,471,522股。

註3:本公司董事(含經理人)目前擔任本公司及兼任其他公司之職務如下表:

張虔生

日月光半導體製造(股)公司-執行長、董事長及董事(代表人)

日日瑞(股)公司-董事長及董事(代表人)

ASE Japan Co., Ltd.-董事

台灣福雷電子(股)公司-董事長及董事(代表人)

ASE Test Holding, Ltd.-董事

ASE (Korea) Inc.-董事

ISE Labs, Inc.-董事

A.S.E. Holding Ltd. (Bermuda)-董事

J&R Holding Ltd. (Bermuda)-董事

Innosource I td - 董事

日月光半導體(昆山)有限公司-董事

ASE Test Limited (Singapore)-董事長

日月光半導體(上海)有限公司-董事長

日月光電子元器件(上海)有限公司-董事

日月光投資(昆山)有限公司-董事長

日月光電子(股)公司-董事長及董事(代表人)

ASE Mauritius Inc.-董事

ASE Corporation - 董事

蘇州日月新半導體有限公司-董事長

ASE Labuan Inc.-董事

日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事

ASE Singapore Pte. Ltd.-董事

Alto Enterprises Ltd.-董事

Super Zone Holdings Ltd.-董事

Anstock Limited -董事

Anstock II Limited -董事

環旭雷子(股)公司-董事

環隆電氣(股)公司-董事 環雷(股)公司-董事

Sino Horizon Holdings Limited-董事

Wealthy Joy Co. Ltd.-董事

北京鼎固鼎好實業有限公司-董事

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事

上海鼎莘置業有限公司-董事

昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事

上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事

上海鼎通房地產開發有限公司-監事

上海鴻翔置業有限公司-監事

上海名龍建設發展有限公司-監事 上海鼎湍房地產開發有限公司-董事

True Elite Holdings Limited-董事

温州宏德建設開發有限公司-董事

ASE Enterprises-董事

鼎昌投資(股)公司-董事

鼎固投資(股)公司-董事

萬昌投資(股)公司-董事長

萬亞投資(股)公司-董事

偉東投資(股)公司-董事

瑞昌投資(股)公司-董事

紹昌投資(股)公司-董事 嘉慶投資(股)公司-董事長

嘉瑩投資(股)公司-董事長

明通投資(股)公司-董事

明祥投資(股)公司-董事

啓昌投資(股)公司-董事

吳田玉

日月光半導體製造(股)公司-營運長及董事(代表人)

ISE Labs, Inc.-董事

ASE Japan Co., Ltd.-董事

ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-董事

GAPT-Cayman-董事

日月光封裝測試(上海)有限公司-董事

蘇州日月新半導體有限公司-董事

日月光半導體(威海)有限公司-董事

無錫通芝微電子有限公司-董事

環隆電氣(股)公司-董事(代表人)

環電(股)公司-董事(代表人)

張洪本

日月光半導體製造(股)公司-總經理及副董事長

日月瑞(股)公司-董事(代表人)

Innosource Ltd.-董事

日月光半導體(上海)有限公司-董事

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

Omniquest Industrial Ltd.-董事

ASE Test Limited (Singapore) -董事

ASE (Korea) Inc.-董事

ASE Electronics (Malaysia) Sdn, Bhd.-董事

A.S.E. Holding Ltd. (Bermuda) -董事

J&R Holding Ltd. (Bermuda) -董事

日日光半道體(昆川)有限公司-董事長

日月光電子元器件(上海)有限公司-董事長

GAPT-Cayman-董事

日月光封裝測試(上海)有限公司-董事

ASE Japan Co., Ltd.-董事

日月光半導體(香港)有限公司-董事長

日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事

Alto Enterprises Ltd.-董事

Super Zone Holdings Ltd.-董事

Anstock Limited -董事

RTH公司-董事

環旭電子(股)公司-董事長

環銓電子(昆山)公司-董事長

環勝電子(深圳)公司-董事長

環鴻電子(股)公司-董事長

環旭科技有限公司-董事

環鴻科技(股)公司-董事(代表人)

USI Enterprise Limited-董事

環鴻電子(昆山)有限公司-董事長

環隆電氣(股)公司-董事

環電(股)公司-董事

環維電子(上海)有限公司-董事長

環豪電子(上海)有限公司-董事長

Sino Horizon Holdings Limited-董事長

Wealthy Joy Co. Ltd.-董事

Peak Vision International Limited-董事

Peak Paramount International Limited-董事

Great Sino Development Ltd. -董事

北京鼎固鼎好實業有限公司-董事長 上海鼎固置業有限公司-董事長

上海鼎南直来有限公司-里争校 上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長

上海鼎通房地產開發有限公司-董事長

上海鴻翔置業有限公司-董事長

上海名龍建設發展有限公司-董事長

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長

上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長

上海鼎莘置業有限公司-董事長

昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長

上海日月光百貨有限公司-董事 重慶鼎固物業管理有限公司-總經理

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長

無錫鼎固房地產開發有限公司-執行董事 上海麥墾餐飲有限公司-執行董事

上海麥聖寶飲有限公司-執行重事 溫州宏德建設開發有限公司-董事

ASE Enterprises-董事

溫地發展有限公司-董事

嘉瑩投資(股)公司-董事 明祥投資(股)公司-董事長

明通投資(股)公司-董事

瑞昌投資(股)公司-監事

嘉慶投資(股)公司-董事

偉東投資(股)公司-董事長 紹昌投資(股)公司-董事

啓昌投資(股)公司-監事

鼎昌投資(股)公司-董事長

萬昌投資(股)公司-董事

萬亞投資(股)公司-董事鼎固投資(股)公司-監事

董宏思

日月光半導體製造(股)公司-財務長及董事(代表人)

日月瑞(股)公司-董事(代表人)

ASE Japan Co., Ltd.-監察人

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-監察人

Innosource Ltd.-董事

J&R Holding Ltd. (Bermuda) -董事

ASE Investment (Labuan) Inc.-董事

A.S.E. Holding Ltd. (Bermuda) -董事

Omniquest Industrial Ltd - 董事

ASE Test Holding, Ltd.-董事

ASE (Korea) Inc - 蓄事

ASE Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.-董事

ASF Mauritius Inc.-董事

日月光電子(股)公司-董事(代表人)

ASE Labuan Inc. -董事

ASE Corporation-董事

Alto Enterprises I td - 蓄事

Anstock Limited -董事

環隆雷氣(股)公司-監察人

環電(股)公司-監察人

環旭電子(股)公司-監事

環鴻科技(股)公司-監察人(代表人)

陸竹開發(股)公司-董事(代表人)

無錫通芝微電子有限公司-監事

日月光貿易(上海)有限公司-董事

H.R.SILVINE-CMC Co., Ltd.-董事

大衆商業銀行-獨立董事

元隆電子(股)公司-董事(代表人)

笛林傑國際科技(股)公司-董事

亞太新興產業創業投資(股)公司-董事(代表人)

陳天賜

日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及中壢分公司總經理

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

陸竹開發(股)公司-董事(代表人)

蘇州日月新半導體有限公司-監事

日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)及高雄廠區總經理

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)及總經理

日月光半導體製造(股)公司-董事

日月光半導體(上海)有限公司-董事

日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)

日月光封裝測試(上海)有限公司-董事

日月光半導體(昆山)有限公司-監事 日月光半導體(威海)有限公司-董事

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事

上海鼎威房地產開發有限公司-董事

上海鼎裕房地產開發有限公司-董事

昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事

昆山鼎悦房地產開發有限公司-董事

環旭電子(股)公司-董事

環隆電氣(股)公司-董事(代表人)

環電(股)公司-董事(代表人)

無錫通芝微電子有限公司-董事

北京鼎固鼎好實業有限公司-董事

日月光投資(昆山)有限公司-董事

陳昌益

日月光半導體製造(股)公司-董事(代表人)

台灣福雷雷子(股)公司-董事(代表人)

日月光半導體(昆山)有限公司-董事

ASE Test Limited (Singapore)-董事 ASE Test Holdings Ltd.-董事

Omniquest Industrial Ltd.-董事

ISE Labs, Inc.-董事

ASE Investment (Labuan) Inc.-董事

日月光電子元器件(上海)有限公司-董事

日月光封裝測試(上海)有限公司-監事

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長

日日光雪子(股)公司-蓄事(代表人)

日月光半導體(香港)有限公司-董事

蘇州日月新半導體有限公司-董事

上海鼎威房地產開發有限公司-董事長

上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長

昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長

昆山鼎悦房地產開發有限公司-董事長

上海鼎祺物業有限公司-董事長

日月光貿易(上海)有限公司-董事

Super Zone Holdings Ltd.-董事

環降電氣(股)公司-監察人

環電(股)公司-監察人

HHI公司-董事

三商投資控股(股)公司-獨立董事及薪資報酬委員會委員

江蘇榮成環保科技(股)公司-董事

游勝福

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

華信光雷科技股份有限公司-董事

裕隆汽車製造股份有限公司-獨立董事及薪資報酬委員會委員

順達科技股份有限公司-監察人

三福化工股份有限公司-監察人

華冠通訊股份有限公司-監察人

裕融企業股份有限公司-薪資報酬委員會委員

台光電子材料股份有限公司-薪資報酬委員會委員

徐大麟

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

漢鼎亞太公司-總裁暨創辦人

漢鼎股份有限公司-董事長

何美玥

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事及審計委員會成員

友達光電股份有限公司-獨立董事、審計委員會成員

高雄銀行股份有限公司-獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

金寶電子工業股份有限公司-獨立董事及薪資報酬委員會委員

Ausnutria Dairy Corporation Ltd. -獨立董事

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事

上海県威房地産盟發有限公司-蓄事

上海鼎裕房地產開發有限公司-董事

昆川県泓房地產開發有限公司-董事 昆山鼎悦房地產開發有限公司-董事

►海鼎祺物業有限公司-董事

環隆電氣(股)公司-監察人 環雷(股)公司-監察人

陸竹開發(股)有限公司-監察人

郭宏銘

台灣福雷電子(股)公司-監察人(代表人)

ASE Singapore Pte. Ltd.-董事

Anstock II Limited -董事

陸竹開發(股)有限公司-董事(代表人)

1.1 董事為法人股東其主要股東

105年02月29日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
香港商微電子國際公司	Aintree Limited	100.00%

1.2 董事為法人股東其主要股東為法人者其上一層主要股東

105年02月29日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
Aintree Limited	JC Holdings Limited	100.00%

1.3 董事所具專業知識及獨立性之情形(105.02.29)

條件	是否具有五年以	以上工作經驗及下	列專業資格	符合獨立性情形								
姓 名	商務、法務、 財務、富計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上	法官 計 公	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	01. 非為以 或企業 僱人	02. 非係事(但母司接有股分子立不之之察公司接有股分子立不之之。) 人名	03. 非本人人民工工作,不是不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不	04. 非前三員款 列人、列人、親 國以內親等或內 直屬	05. 非自持持 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
張虔生			V									
張洪本			V									
吳田玉			V				V	V				
董宏思			V				V	V				
羅瑞榮			V			V	V	V				
陳昌益			V			V	V	V				
陳天賜			V			V	V	V				
張能傑			V			V		V				
游勝福	V	V	V	V	V	V	V	V				
徐大麟			V	V	V	V	V	V				
何美玥			V	V	V	V	V	V				

條件		符合獨立性情	 形			
姓名	06. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東	07. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶	08. 未與其他董 事間具有親 偶或二親 以内之親 關係	09. 未有公司法 第30條各款 情事之一	10. 未有公司法 第27條規定 以政府、法 人或其代表 人當選	兼任其他公開發行公 司獨立董事家數
張虔生		V		V		0
張洪本		V		V	V	0
吳田玉	V	V	V	V		0
董宏思		V	V	V		1
羅瑞榮	V	V	V	V		0
陳昌益		V	V	V		1
陳天賜	V	V	V	V		0
張能傑	V	V		V	V	0
游勝福	V	V	V	V	V	1
徐大麟	V	V	V	V	V	0
何美玥	V	V	V	V	V	3

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位:股(截至年報刊印日止實際持有股數)

1000年至	F77 7 75	₩-<	おけつ地	持有	股份	配偶、未成年	子女持有股份
職稱	國籍	姓名	就任日期	股數	持股比率	股數	持股比率
執行長	新加坡	張虔生	92.05	85,070,931	1.07%	-	_
總經理	香港	張洪本	92.02	104,414,941	1.32%	121,729,346	1.54%
營運長	中華民國	吳田玉	96.02	3,853,386	0.05%	-	_
財務長	中華民國	董宏思	83.12	3,951,908	0.05%	274,915	0.00%
高雄廠區總經理	中華民國	羅瑞榮	95.04	2,565,643	0.03%	1,182	0.00%
副總經理	中華民國	俞旭濬	88.08	519,259	0.01%	-	_
副總經理	中華民國	陳道有	93.01	402,127	0.01%	-	-
副總經理	中華民國	李世文	93.01	636,234	0.01%	-	-
副總經理	中華民國	周光春	103.01	82,203	0.00%	-	-
副總經理	中華民國	林國堂	93.08	2,037,773	0.03%	3,242	0.00%
副總經理	中華民國	莫煥華	93.08	109,858	0.00%	-	-
副總經理	中華民國	葉清昆	93.08	216,622	0.00%	-	=
中壢分公司總經理	中華民國	陳天賜	104.08	592,054	0.01%	-	=
副總經理	中華民國	鄭楨銘	95.07	120,416	0.00%	-	=
副總經理	中華民國	洪松井	100.01	553,275	0.01%	-	=
副總經理	中華民國	曹燕傑	101.12	0	-	-	_
副總經理	中華民國	洪志斌	103.03	304,000	0.00%	25,000	0.00%
副總經理暨會計長	中華民國	郭宏銘	103.08	46,000	0.00%	-	-

職稱	姓名	利用他人名義	持有股份	→ 西朗/柳/庭	目前兼任其他公	具配偶或二	親等以内關	係之經理人
取件	姓名	股數	持股比率	主要學(經)歷	司之職務	職稱	姓名	關係
執行長	張虔生	1,658,908,250 (註)	20.97%	台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士	請參閱第9頁	副董事長 董事	張洪本 張能傑	弟 子
總經理	張洪本	_	-	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣(股)公司董事長	請參閱第9頁	董事長	張虔生	兄
營運長	吳田玉	_	-	美國賓州大學應用機械博士	請參閱第9頁	_	-	_
財務長	董宏思	_	-	美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	請參閱第10頁	_	_	_
高雄廠區總經理	羅瑞榮	_	-	交通大學電子物理系畢	請參閱第10頁	_	-	_
副總經理	俞旭濬	_	-	國立藝專廣播電視科 東森傳播公司副總經理 鑫凱傳播公司總經理	請參閱第10頁	_	-	_
副總經理	陳道有	_	-	成功大學機械系畢	無	_	_	_
副總經理	李世文	_	-	成功大學物理系畢	無	_	_	_
副總經理	周光春	_	-	成功大學機械系畢	無	_	_	_
副總經理	林國堂	_	-	崑山工專電子科畢	無	_	_	_
副總經理	莫煥華	_	_	伯明罕大學機械工程所	無	_	_	_
副總經理	葉清昆	_	-	東吳大學物理系	無	_	_	_
中壢分公司總經理	陳天賜	_	_	中原大學工業工程與管理系	請參閱第10頁	_	_	_
副總經理	鄭楨銘	_	-	淡江大學機械工程系	無	-	-	_
副總經理	洪松井	_	_	德州大學機械博士	無	_	_	_
副總經理	曹燕傑	_	_	文化大學物理系	無	_	_	_
副總經理	洪志斌	_	_	英國PAISLEY大學電子博士	無	_	_	_
副總經理暨會計長	郭宏銘	_		美國波士頓大學企管碩士	請參閱第10頁	_	_	_

註:其中設質股數為248,471,522股。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事之酬金

104年12月31日 單位:仟股:新台幣仟元

					董事	酬金				A、B、C) 總額占稅		兼任員 取相關			
職稱	姓名	報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)		比		薪資、 特支費等			
		本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司		
董事本人	張洪本 (副董事長)														
董事本人	張能傑														
董事本人	香港商微電 子國際公司														
	張虔生 (董事長)														
	吳田玉	6,000	6,000	_	_	140,000	140,000	_	_	0.75%	0.75%	104,550	210,938		
董事之法 人代表人	董宏思												,		
/// \122//	羅瑞榮														
	陳昌益														
	陳天賜														
獨立董事	游勝福														
獨立董事	徐大麟														
獨立董事	何美玥														

					·····································		取相關酬	 金					C \ D \											
			休金(F) ±2)	員工酬勞(G)(註1)			員工認股權憑證 得認購股數(H)		取得限制員工權利新股股數(I)		E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自											
職稱	姓名	本公司	財務報告内所	本位	23司	財務幸 所有		本公司	財務報告内所	本公司	財務報告内所	本公司	財務報告内所	子公司以外轉 投資事業酬金										
			有公司	現金紅 利金額	股票紅 利金額	現金紅 利金額	股票紅 利金額	4.79	有公司	725	有公司	7-25	有公司											
董事本人	張洪本 (副董事長)																							
董事本人	張能傑																							
董事本人	香港商微電 子國際公司																							
	張虔生 (董事長)																							
	吳田玉	585	909	200.057	_	232,259	_	34,970	48,570	_	_	2.32%	3.03%	無										
董事之法 人代表人	董宏思	303	303	200,037		252,255		仟股	仟股			2.52.70	3.0370	7111										
八1\衣八	羅瑞榮																							
	陳昌益																							
	陳天賜																							
獨立董事	游勝福																							
獨立董事	徐大麟																							
獨立董事	何美玥																							

註1:本公司董事會於105年4月1日決議,擬訂分派104年度董事酬勞為新台幣140,000仟元,員工酬勞新台幣2,033,800仟元(全部以現金發放),惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定,茲以去年員工酬勞之實際分派比例估算擬議分派數如上,上述酬勞分派内容俟本年度股東會決議通過後才確定。

註2: 本公司104年度實際給付退職退休金金額為0元:該欄退職退休金金額全數屬退職退休金費用化之提列(提撥)數。

註3: 本欄位未包含本公司及財務報告所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣8,565仟元及新台幣15,532仟元。

酬金級距表

	董事姓名						
給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金網	思額(A+B+C+D)	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)			
	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司J			
低於2,000,000元	_	-	_	_			
2,000,000元(含)~5,000,000元	游勝福、徐大麟、何美玥	游勝福、徐大麟、何美玥	游勝福、徐大麟、何美玥	游勝福、徐大麟、何美玥			
5,000,000元(含)~10,000,000元	_	-	-	_			
10,000,000元(含)~15,000,000元	_	-	-	_			
15,000,000元(含)~30,000,000元	張虔生、張洪本、吳田玉、 董宏思、羅瑞榮、陳昌益、 陳天賜、張能傑	張虔生、張洪本、吳田玉、 董宏思、羅瑞榮、陳昌益、 陳天賜、張能傑	陳昌益	_			
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-	張洪本、羅瑞榮、陳天賜、 張能傑	陳天賜、張能傑			
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	-	吳田玉、董宏思	張洪本、吳田玉、董宏思、 羅瑞榮、陳昌益			
100,000,000元以上	_	_	張虔生	張虔生			
總計	_	-	_	_			

(二) 監察人之酬金

本公司於104年6月23日召開股東常會全面改選董事,選任之三位獨立董事於104年6月24日就任組成審計委員會取代監察人。

監察人之酬金:無。

(三) 總經理及副總經理之酬金

104年12月31日 單位:仟股:新台幣仟元

		薪資(A	ນ)(註2)	退職退	休金(B)	獎金及特	支費等(C)			学金額(D) E1)	
職稱	姓名	+	財務報	+	財務報		財務報	本位			内所有公司
		本公司	告内所 有公司	本公司	告内所 有公司	本公司	告内所 有公司	現金紅利 金額	股票紅利 金額	現金紅利 金額	股票紅利 金額
執行長	張虔生										
總經理	張洪本										
營運長	吳田玉										
財務長	董宏思										
高雄廠區總經理	羅瑞榮										
中壢分公司總經理	陳天賜										
副總經理	俞旭濬										
副總經理	陳道有										
副總經理	李世文	99,959	167,449	1,665	1,881	70,042	87,029	210,128	_	219,128	_
副總經理	周光春	33,333	107,443	1,005	1,001	70,042	67,029	210,120		219,120	
副總經理	林國堂										
副總經理	莫煥華										
副總經理	葉清昆										
副總經理	鄭楨銘										
副總經理	洪松井										
副總經理	曹燕傑										
副總經理	洪志斌										
副總經理暨會計長	郭宏銘										

職稱	姓名	A、B、C及D等 純益之b	四項總額占稅後 比例(%) 取得員工認股權憑語		父權憑證 數額	取得限制員工權利新股		有無領取來 自子公司以
янх 1 113	XITI	本公司	財務報告内 所有公司	本公司	財務報告内 所有公司	本公司	財務報告内 所有公司	外轉投資事 業酬金
執行長	張虔生							
總經理	張洪本							
營運長	吳田玉							
財務長	董宏思							
高雄廠區總經理	羅瑞榮							
中壢分公司總經理	陳天賜							
副總經理	俞旭濬				27.200 / 197	_		
副總經理	陳道有							
副總經理	李世文	1.96%	2.44%	37,269 仟股				無
副總經理	周光春	1.96%	2.44%	37,269 11版	50,519 仟股		_	////
副總經理	林國堂							
副總經理	莫煥華							
副總經理	葉清昆							
副總經理	鄭楨銘							
副總經理	洪松井							
副總經理	曹燕傑							
副總經理	洪志斌							
副總經理暨會計長	郭宏銘							

註1:詳第13頁註1及註2之說明。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及	總經理	總經理及副總經理姓名					
副總經理酬金級距	本公司	財務報告内所有公司					
低於2,000,000元	-	-					
2,000,000元(含)~5,000,000元	葉清昆	葉清昆					
5,000,000元(含)~10,000,000元	莫煥華、俞旭濬、周光春、陳道有、鄭楨銘、林國堂、 曹燕傑、郭宏銘、洪志斌、李世文	莫煥華、周光春、陳道有、鄭楨銘、林國堂、郭宏銘、洪志斌、 李世文					
10,000,000元(含)~15,000,000元	洪松井	俞旭濬、曹燕傑、洪松 井					
15,000,000元(含)~30,000,000元	張洪本、陳天賜	_					
30,000,000元(含)~50,000,000元	董宏思、羅瑞榮	張洪本、陳天賜					
50,000,000元(含)~100,000,000元	張虔生、吳田玉	張虔生、吳田玉、董宏思、羅瑞榮					
100,000,000元以上	_	_					
總計	_	-					

註2:本欄位未包含本公司及財務報告所有公司員工認股權費用化之金額分別為新台幣9,086仟元及新台幣15,834仟元。

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

104年12月31日 單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額(註1)	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例%
	執行長	張虔生				
	總經理	張洪本				
	營運長	吳田玉				
	財務長	董宏思				
	高雄廠區總經理	羅瑞榮				
	中壢分公司總經理	陳天賜				
	副總經理	俞旭濬		240.429	210 120	1.08%
	副總經理	陳道有				
經理人	副總經理	李世文				
程连八	副總經理	周光春		1.00%		
	副總經理	林國堂				
	副總經理	莫煥華				
	副總經理	葉清昆				
	副總經理	鄭楨銘				
	副總經理	洪松井				
	副總經理	曹燕傑				
	副總經理	洪志斌				
	副總經理暨會計長	郭宏銘				

註1:詳第13頁註1之說明。

(五) 分別比較說明本公司及財務報告内所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

年度 占稅後損益比例	104年度		103年度	
項目	本公司	財務報告内所有公司	本公司	財務報告内所有公司
董事酬金總額(註2)	2.32%	3.03%	2.42%	2.94%
總經理及副總經理酬金總額(註2)	1.96%	2.44%	2.02%	2.27%

本公司執行長及總經理之薪資係經本公司董事會決議通過,另副總經理之酬金則參照同業水準訂定支付之,每年定期檢視 與同業人才競爭廠商比較,確保薪酬的競爭性,其獎金之給付則視本公司盈餘多寡、個人經營績效優劣以達求才與留才之 目的。

董事酬勞之擬訂,係依有純益年度之分配順序,將酬勞明訂於本公司章程中。

註2:本公司董事會於105年4月1日決議,擬訂104年度提撥員工酬勞新台幣2,033,800仟元,全部以現金發放,惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定,故酬金總額之計算員 工酬勞金額係以去年實際分派比例估算擬議分派數。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形:

董事會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止董事會開會19(A)次,董事出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註1)	備註
董事本人	張洪本(副董事長)	10	7	53%	
董事本人	張能傑	0	2	0%	
	張虔生(董事長)	6	10	32%	
	吳田玉	14	1	74%	
董事之法人	董宏思	19	0	100%	
(香港商微電子國際公司) 代表人	羅瑞榮	17	1	89%	
	陳昌益	17	1	89%	
	陳天賜	12	0	92%	新任(註2)
獨立董事	游勝福	19	0	100%	
獨立董事	徐大麟	8	11	42%	
獨立董事	何美玥	13	0	100%	新任(註2)

註1: 實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項:董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案内容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

董事會日期期別	議案内容	董事會決議結果	公司對獨立董事陳述意見之處理
104.09.08	為擬訂定本公司一〇三年度盈餘分配之經理人員工紅利分配明細	經其餘四席無利害關係之出	不適用。
104年度第12次董事會議	議案。	席董事陳昌益董事、游勝福	
	董事對利害關係議案迴避之情形:董宏思董事發言摘要-因本人	董事(含代理徐大麟董事)及何	
	董宏思與張虔生董事、張洪本董事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、	美玥董事全體無異議照案通	
	陳天賜董事均為本公司之經理人,明顯與本案討論有關訂定本公	過。	
	司一〇三年度盈餘分配其經理人員工紅利分配明細之會議内容有		
	自身利害關係,為避冤利益衝突,本人(含代理張虔生董事) 、吳		
	田玉董事、羅瑞榮董事(含代理張洪本董事)及陳天賜董事均迴避不		
	參與討論及表決本議案,請其餘出席董事自行討論。		
104.09.08	為擬訂定本公司一〇三年度盈餘分配之董監事酬勞分配明細議	經其餘三席無利害關係之出	不適用。
104年度第12次董事會議	案。	席董事游勝福董事(含代理徐	
	董事對利害關係議案迴避之情形:董宏思董事發言摘要-因本人	大麟董事)及何美玥董事全體	
	董宏思及張虔生董事、吳田玉董事、羅瑞榮董事、陳天賜董事、	無異議照案通過。	
	陳昌益董事所代表之法人香港商微電子國際公司與張洪本董事均		
	為本公司一〇三年度盈餘分配其董監事酬勞擬配發之對象,明顯		
	與本案之會議内容有利害關係,為避免利益衝突,本人(含代理張		
	虔生董事)、吳田玉董事、羅瑞榮董事(含代理張洪本董事)、陳天		
	賜董事及陳昌益董事均迴避不參與討論及表決本議案,請其餘出		
	席董事自行討論。		

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:

本公司為建立良好審計委員會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰於民國104年6月24日依證券交易法第十四條之四設立審計委員會。目前該委員會成員人數為三人,由全體獨立董事組成,並由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席,對外代表該委員會。

註2:104.06.24新上任董事,最近年度截至年報刊印日止可出席董事會開會次數為13次。

審計委員會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止審計委員會開會8次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出列席次數B	委託出席次數	實際列席率(%)(B/A)(註)	備註
獨立董事	游勝福	8	0	100%	
獨立董事	徐大麟	4	4	50%	
獨立董事	何美玥	8	0	100%	

註:實際列席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。

其他應記載事項:

一、證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案内容、審計委員會決議結果以 及公司對審計委員會意見之處理:

董事會日期期別	議案内容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
104.07.02	為擬委任本公司第三屆薪資	經主席徵詢出席獨立董事全體無異議通過將該案	鑑於審計委員會因二分之一以上成員就該議
104年度第8次董事會議	報酬委員會之委員。	依本公司「審計委員會組織規程」第九條規定,	案相關事項有自身利害關係而迴避,致審計
		向董事會報告並由董事會決議該案。	委員會無法作成決議,審計委員會爰依本公
			司「審計委員會組織規程」第九條規定,向
			董事會報告並由董事會決議該案。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案内容、應利益迴避原因以及參與表決情形:

屆次	議案内容	獨立董事姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
第1屆第1次審計委員會	為擬委任本公司第三屆薪	游勝福	因游勝福及徐大麟兩位獨立董事就該案	游勝福獨立董事(含代理徐大麟獨立董事)迴避
	資報酬委員會之委員。	徐大麟	皆為擬被委任為薪資報酬委員會委員之	不參與討論及表決該議案。
			當事人,與該案有自身利害關係。	

- 三、獨立董事與内部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)。
 - (一)每月月底前,本公司内部稽核部門會將當月份之稽核報告及缺失回應彙總報告e-mail予各獨立董事參閱,同時内部稽核主管會定期於每季與獨立董事溝通稽核報告結果,並每季於董事會中作內部稽核報告。此外,平時若有特殊狀況時,稽核主管亦會即時向獨立董事報告,惟民國104年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況尚屬良好。
 - (二) 本公司簽證會計師均定期於每季向獨立董事報告當季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。此外,平時若有特殊狀況時,簽證會計師亦會即時向獨立董事報告,惟民國104年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況尚屬良好。

監察人參與董事會運作情形資訊

104年上半年度原監察人董事會開會6次(A), 監察人列席情形如下:

本公司於104年6月23日召開股東常會全面改選董事,選任之三位獨立董事於104年6月24日就任組成審計委員會取代監察人。

職稱	姓名	實際出列席次數B	實際列席率(%)(B/A)(註)	備註
監察人本人	張能超	1	17%	
監察人之法人代表人	曾元一	2	33%	
(宏璟建設股份有限公司)	潘士華	0	0%	
	陳天賜	1	17%	
	李俊哲	2	33%	

註:實際列席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。

其他應記載事項:

- 一、監察人之組成及職責:
 - (一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形(如溝通管道、方式等):本公司網站設有發言人等對外公開信箱,如員工及股東需與監察人接洽,可透此一管道聯繫:此外 監察人會參與股東會,達到直接溝通效益。
 - (二) 監察人與内部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務、業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等):
 - 1. 每月月底前,内部稽核部門會將當月份之稽核報告及缺失回應彙總報告e-mail予各監察人參閱,並於每季度結束後彙總上一季度所查核的稽核事項及缺失列入定期董事會議案,由内部稽核主管或其代理人於會中報告,公司於董事會後將其相關資料併同董事會議紀錄e-mail予全體董監事參閱。
 - 2. 根據公司法第219條監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊應予查核,本公司監察人若對於財務報表有疑問會直接與會計師聯繫並溝通。
- 二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案内容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:不適用。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

				與上市上櫃公司治理	
	評估項目		否	摘要說明	實務守則差異情形及 原因
- \	公司是否依據「上市上櫃公司治理 實務守則」訂定並揭露公司治理實 務守則?	V		本公司於104年參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之公司治理實務守則,經董事會通過頒布並揭露於公司網站,請詳http://www.aseglobal.com。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
= \	公司股權結構及股東權益				
	(一) 公司是否訂定内部作業程序處 理股東建議、疑義、糾紛及訴 訟事宜,並依程序實施?	V		本公司設有法人關係、公共關係及法務等相關部門專人負責處理股務等相關事宜。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
	(二) 公司是否掌握實際控制公司之 主要股東及主要股東之最終控 制者名單?	V		本公司每月均經由董監事及持股10%以上大股東之持股變動申報書,以確實掌握實際控制公司之主要股東之名單,並經由與主要股東保持密切聯繫,以掌握其最終控制者之名單。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
	(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?	V		本公司透過内部控制制度與相關辦法之制定執行控管,同時稽核單位定期監督執行情形。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
	(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?	V		本公司已訂定「防範內線交易之管理作業程序」,以避免公司内部人因未諳法規規範誤觸内線交易,同時降低内部人無心之過或故意之誘因,達到促進證券交易市場之公平性,進而維護投資大衆權益。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
≡、	董事會之組成及職責				
	(一) 董事會是否就成員組成擬訂多 元化方針及落實執行?	V		本公司於公司治理實務守則中訂定董事會成員組成多元化方針並據以執行。 本公司董事會由11位董事組成,包括3席獨立董事,其中1席獨立董事為女性。董事所具備之專業知識技能涵蓋:工業工程、電子工程、機械工程、電腦工程、物理學、財務學、經濟學、會計學、企管學及心理學等不同領域,充分落實董事會成員多元化之理念。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
	(二) 公司除依法設置薪資報酬委員 會及審計委員會外,是否自願 設置其他各類功能性委員會?	V		本公司業已依法設置審計委員會,由董事會指派符合1934年美國證交法規則10A-3規定之 沙賓法案及臺灣證券交易所上市規章定義具備會計或相關財務管理專長之獨立董事擔任本 公司審計委員會之委員。 董事會依中華民國證券交易法設置薪資報酬委員會。根據中華民國證券法規,薪資報酬委 員會應至少包含一席符合中華民國證券法規定義之獨立董事。該委員會目前有三位成員, 其中包含兩席獨立董事。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
	(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?	V		本公司每年於年度盈餘分派發放董事酬勞時,薪資報酬委員會會依據公司董事績效進行評量,擬定董事酬勞分配明細。本公司已於104年董事會通過頒布之公司治理實務守則中訂定董事會績效評估辦法及評估方式,預計於105年起每年定期進行績效評估。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
	(四) 公司是否定期評估簽證會計師 獨立性 ?	V		本公司審計委員會每年定期取得會計師出具之獨立聲明書並評估簽證會計師之獨立性,再將評估結果提報董事會。 (一) 評估機制如下: (1) 本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 (2) 本公司依照美國沙賓法案規定,簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前,均需取得審計委員會的事先核准。 (3) 本公司依照美國沙賓法案規定,簽證會計師每季向審計委員會彙報執行覆核/查核内容及獨立性等遵守情形。 (4) 本公司遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 (二) 評估結果如下: (1) 簽證會計師與本公司間之獨立性符合美國SEC及PCAOB暨中華民國會計師法及會計師職業道德規範等相關規定。 (2) 本公司未連續五年委任同一會計師簽證。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
四、	公司是否建立與利害關係人溝通管 道,及於公司網站設置利害關係人 專區,並妥適回應利害關係人所關 切之重要企業社會責任議題?	V		本公司責成相關單位專責處理債權人、客戶及供應商等利害關係人之溝通事宜,亦設有企業工會及總經理信箱,以暢通員工意見溝通管道。本公司於公司網站設有利害關係人專區,提供利害關係人表達意見的管道,有利本公司瞭解利害關係人所關切之議題與做適度回應,並透過年度企業社會責任報告書及公司網站公開揭露相關利害關係人溝通資訊。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
五、	公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
六、	資訊公開				
	(一) 公司是否架設網站,揭露財務 業務及公司治理資訊?	V		本公司已架設網站,並責成相關部門負責公司財務業務及公司治理資訊之揭露與更新,請詳 $http://www.aseglobal.com \circ$	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。
	(二)公司是否採行其他資訊揭露之 方式(如架設英文網站、指定 專人負責公司資訊之蒐集及揭 露、落實發言人制度、法人說 明會過程放置公司網站等)?	V		本公司已架設中英文網站,設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露,亦依規定設有發言人及代理發言人制度,以及專責聯絡窗口回覆股東之意見。相關資訊請詳 http://www.aseglobal.com。 本公司指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊並依相關規定發佈重大訊息。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。

			運作情形	與上市上櫃公司治理
評估項目	是	否	摘要說明	實務守則差異情形及 原因
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治 理運作情形之重要資訊(包括但不限 於員工權益、僱員關懷、投資者關 係、供應商關係、利害關係人之權 利、董事及監察人進修之情形、風 險管理政策及風險衡量標準之執行 情形、客戶政策之執行情形、公司 為董事及監察人購買責任保險之情 形等)?	V		 (一) 員工權益及僱員關懷:請參閱本年報「勞資關係」說明以及參考本公司企業社會責任報告書http://www.aseglobal.com。 (二) 投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利:請參考本公司網站之投資人關係以及利害關係人專區http://www.aseglobal.com。 (三) 董事、監察人及經理人進修之情形:本公司104年董事、監察人及經理人進修情形如下的表1及附表2。 (四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:請參閱本年報「風險事項分析評估」說明及參考本公司企業社會責任報告書http://www.aseglobal.com。 (五) 客戶政策之執行情形:請參閱本年報「市場及產銷概況」說明。 (六) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已為董事及監察人購買責任保險(104年保險金額約為新台幣8億2仟萬元)。 (七) 本公司會與供應商簽訂供應商保密條款/供應與承攬商社會責任承諾書,採購合約中明定具法律效力的權利與義務,且明定供應商遙選制度,確保供應商能符合本公司的品質政策、環境政策,並訂定供應商稽核制度以確保執行。為此本公司體認與社會上利害關係各方進行長期對話之必要性。此方式能增進企業對社會的瞭解,做出最佳決策,還能減少企業與社會之衝突。 	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
八、公司是否有公司治理自評報告或委 託其他專業機構之公司治理評鑑報 告?(若有,請敘明其董事會意見、 自評或委外評鑑結果、主要缺失或 建議事項及改善情形)	V		本公司參與臺灣證券交易所辦理之公司治理評鑑並依其所建置之「公司治理評鑑系統」進行公司治理自評。本公司已完成第二屆公司治理評鑑自評報告,相關公司治理評鑑結果將公布於臺灣證券交易所網站供社會大衆查詢。	與上市上櫃公司治理實 務守則無重大差異。

附表1:最近年度截至年報刊印日止之董事及監察人進修情形

This said	=	進修	日期) #I#RR (+		14. (W. I = 0 = 1 = 4 = 1
職稱	姓名	起	迄	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事 (兼經理人)	張洪本	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
董事	張能傑	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
法人董事代表人 (兼經理人)	張虔生	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
法人董事代表人 (兼經理人)	吳田玉	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
法人董事代表人	董宏思	104/07/23	104/07/23	財團法人臺灣金融研訓院	公司治理下之董事監察人法律責任	3	是
(兼經理人)	里么心	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
法人董事代表人 (兼經理人)	羅瑞榮	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
法人董事代表人	陳昌益	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
法人董事代表人 (兼經理人)	陳天賜	104/12/17	104/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理、企業風險管理	6	是
X四六基 青	****	104/01/22	104/01/22	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	企業社會責任報告書-展現永續經營價值研 討會	3	是
獨立董事	游勝福	104/07/15	104/07/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與基業長青之道;企業決策與董事 會功能	6	是
		104/12/15	104/12/15	財團法人臺灣金融研訓院	公司治理論壇-稅務治理藍圖	3	是
獨立董事	徐大麟	104/12/23	104/12/23	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	董事、監察人解讀財務資訊之技巧	3	是
		104/08/10	104/08/10	社團法人中華公司治理協會	企業風險管理暨舞弊風險預防與偵測	3	是
獨立董事	何美玥	104/08/18	104/08/18	社團法人中華公司治理協會	美國反托拉斯法與台灣企業-為何您應該關心與您所該知道的	3	是
		104/11/13	104/11/13	社團法人中華公司治理協會	Global CEO Outlook 2015:重要審計準則 及法令更新	3	是

附表2:最近年度截至年報刊印日止之經理人進修情形

Heb ToT3	44.67	進修	 日期	- Mice /-	=#1D4710	`# \#Tn+#\	進修是否符合規定
職稱	姓名	起	迄	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否付合規定
副總經理暨會計長	計長 郭宏銘	104/08/07	104/08/11	財團法人中華民國會計研究	發行人證券商證券交易所會計主管持續進	12	是
即秘程连直百八文	乳心型	104/06/07	104/06/11	發展基金會	修班	12	Æ

(四) 薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形:

本公司為落實公司治理,並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,於民國100年9月29日爰依證券交易法第十四條之六及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法設立薪資報酬委員會,本委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中至少一人為本公司獨立董事,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席,對外代表本委員會。本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權:

- · 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- · 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本屆薪資報酬委員會成員資料:

	條件	是召	S具有五年以上工作 及下列專業資格	徑驗			符	合獨立中	性情形(註)			兼任其	
身份別	姓名		注印	公司業務所需之	1	2	3	4	5	6	7	8	他發司報員員 公行薪酬會家 數	備註
獨立董事	游勝福	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	3	
獨立董事	徐大麟			V	V	V	V	V	V	V	V	V	_	
其他	谷小瑛			V	V	V	V	V	V	V	V	V	_	

- 註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打勾。
 - (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
 - (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
 - (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 - (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以内親屬或三親等以内直系血親。
 - (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
 - (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人 及其配偶。
 - (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

委員會成員參與薪資報酬委員會運作情形資訊

本屆委員會任期:104年06月24日至107年06月23日,截至105年02月29日,已開會3次,委員出列席情形如下:

職稱	身份別	姓名	實際出席次數	實際出席率(%)
召集人	獨立董事	游勝福	3	100%
委員	獨立董事	徐大麟	1	33%
委員	其他	谷小瑛	3	100%

(五)履行社會責任情形:(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。)

			運作情形	與上市上櫃公司
評估項目	是	否	摘要說明	企業社會責任實 務守則差異情形 及原因
一、落實公司治理				
(一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度・以及檢討實施成效?	V		本公司訂有「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」及「企業社會責任實務守則」,揭露於公司網站企業社會責任專區及企業社會責任報告書,並將依據政策而開展之企業社會責任推動計畫與實施成效,詳實揭露於此表中「二、發展永續環境」、「三、維護社會公益」及「六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」,由董事會定期督促公司實踐社會責任及檢討實施成效。 詳細之本公司企業社會責任政策、制度或管理方針及具體推動計畫與實施成效之資訊,均揭露於日月光集團企業社會責任報告書,請詳http://www.aseglobal.com。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練?	V		本公司每年度制定相關社會責任訓練計畫,依計畫針對新進員工及在職人員定期提供社會責任相關教育訓練,協助員工了解企業社會責任之精神與做法。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(三) 公司是否設置推動企業社會責任專(兼) 職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形?	V		本公司成立由公司高階管理階層組成的「集團永續發展委員會」,負責指引及督導日月光集團在全球經濟、環境及社會策略上的發展,定期向董事會報告,並設置「集團企業永續中心」作為負責推動企業社會責任之專職單位,負責評估全集團的永續議題與永續績效、協調及促動集團目標之擬訂以及推動永續發展行動計畫之執行,並直接向該委員會報告。主要永續發展推動計畫分為六大主軸,分別為公司治理、環境永續、人力資本、供應鏈發展、企業公民與社會參與及利害關係人議合與資訊揭露,具體執行情形及實施成效如此表中「二、發展永續環境」、「三、維護社會公益」以及「六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」所述。本公司之企業社會責任報告書係揭露本公司企業社會責任專職單位推動社會責任之執行績效,亦說明該專職單位之治理架構及執行運作情形。詳細之本公司企業社會責任專職單位之運作及執行資訊,請詳http://www.aseglobal.com。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制度?	V		本公司定期依據當地法令與市場狀況調整薪資結構與福利,薪資絕不因性別、種族、國籍或年齡等因素而有差別待遇。 本公司依循性別平等法,對員工之任用、考績或升遷等,不會因性別而有差別待遇。 為維持員工高標準的工作紀律,我們制定了員工管理須知,設立明確之獎勵與懲處辦法,作為公司員工應遵循的最高道德標準及承諾。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
、發展永續環境				
(一) 公司是否致力於提升各項資源 之利用效率,並使用對環境負 荷衝擊低之再生物料?	V		本公司規劃了電力、水資源與耗用材料的管理機制,並持續進行供應設施效率提升或模組最佳化的改善,以遵守「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」以及「企業社會責任實務守則」及達到減少資源消耗的目標,包含:空調節能、照明節能、製程節能…等節能作為。本公司之包裝材料均為可回收之材料且符合歐盟包裝材料之規範,並透過內部的管理程序將廢棄物分類及資源回收,減少自然資源的浪費,降低對環境之衝擊。本公司依據「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」以及「企業社會責任實務守則」建立管理系統,有計劃地執行各項能資源使用管理,對於能源、水資源進行最佳化利用與持續改善。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(二) 公司是否依其產業特性建立合 適之環境管理制度?	V		本公司於環境保護業務上的執行,除了符合法令及相關規範的規定外,同時並建立ISO14001 環境管理系統。除定期查核符合法令要求外,每年訂定污染防治與設備改善推動計劃,以有效 降低污染排放並適時檢討環境管理制度。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(三) 公司是否注意氣候變遷對營運 活動之影響,並執行溫室氣體 盤查、制定公司節能減碳及溫 室氣體減量策略?	٧		本公司注意氣候變遷對營運活動之影響,推行ISO 14064溫室氣體管理系統,每年進行溫室氣體盤查,並訂定溫室氣體減量目標,進行溫室氣體排放減量。本公司亦已通過ISO 50001認證,且為回應客戶及全球消費大衆對低碳產品的期待,導入產品碳足跡盤查,以減少產品碳足跡為目標。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
三、維護社會公益				
(一)公司是否依照相關法規及國際 人權公約,制定相關之管理政 策與程序?	V		本公司導入SA 8000社會責任管理制度及EICC認證、訂定「日月光集團企業永續發展與企業公民政策」及「企業社會責任實務守則」,並尊重基本勞動人權、遵守政府勞動法規、保障員工工作環境、健康安全等相關權益。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適處理?	V		本公司重視和諧的勞資關係,並訂定溝通與申訴管理政策,提供員工暢通、多元化的溝通管道,包括勞資會議,總經理信箱、員工意見箱、座談會、信函投書、公佈欄、內部公告、教育訓練、電子佈告欄、員工諮商專人及電子郵件等,傾聽員工的心聲和建議,並給予必要的回覆及處理。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康 之工作環境,並對員工定期實 施安全與健康教育?	V		本公司訂有安全衛生業務之執行,導入OHSAS 18001與TOSHMS職業安全衛生管理系統,提供員工一個符合安衛法規且健康的最佳作業場所,定期進行風險鑑別及評估,並採取適當的改善措施降低工作環境的風險,並舉辦員工工作安全衛生教育訓練與健康促進活動。本公司亦設有員工診所,定期安排所有員工進行各單位所需之健康檢查。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。

			運作情形	與上市上櫃公司
評估項目		否	摘要說明	企業社會責任實 務守則差異情形 及原因
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動?	V		本公司依據新進人員、在職員工、部門別及勞工代表等類別,分別定期舉辦座談會或相關會議,透過定期的溝通交流,提供員工暢通的溝通管道。若任何工作有重大異動(如營運據點調動等),皆事先與員工溝通並至少於2週前通知,且無任何強迫勞動情況發生。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(五) 公司是否為員工建立有效之職 涯能力發展培訓計畫?	V		本公司依照各職務訓練需求及職涯能力發展需求進行年度訓練課程規劃,並依規畫進行課程舉辦:包括新人訓練、通識教育、專業培訓、基層管理、中階管理及人才發展等。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序?	V		本公司為確保客戶的意見能有效的傳達與處理,以及促進與客戶的即時互動,制定設立客戶溝通的管理程序,設有客戶服務專業專責團隊,定期檢視客戶的滿意度,提供相關客戶的意見反應與溝通服務,並以網際網路為基礎,建置客戶線上服務平台,整合客戶簡易的服務網路,提供高效率服務。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(七) 對產品與服務之行銷及標示, 公司是否遵循相關法規及國際 準則?	V		本公司遵循台灣貿易法相關條文包括輸出入戰略性高科技貨品之規定,對於服務之行銷及標示,均依照客戶需求與法規運作。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去有無影響環境與 社會之記錄?	V		本公司於新供應商導入前的遴選機制中即針對供應商是否有影響環境與社會之紀錄進行評估與 審查,爾後每年定期進行供應商「永續發展問卷」調查,並透過現場或文件稽核確保供應商符 合本公司的要求。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
(九)公司與其主要供應商之契約是 否包含供應商如涉及違反其企 業社會責任政策,且對環境與 社會有顯著影響時,得隨時終 止或解除契約之條款?	V		本公司對主要供應商的合約中訂定供應商須遵守當地法規及符合本公司社會責任暨行為準則,若察覺有違反環境與社會之具體事證,將立即展開調查處置,如情節重大即終止合作。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊 觀測站等處揭露具攸關性及可 靠性之企業社會責任相關資 訊?	V		本公司為讓社會大衆瞭解本公司在因應永續發展趨勢的思維與承諾,以及本公司在各項永續的相關議題上的努力與堅持,每年均定期公開發行企業社會責任報告書(中、英文版本),提供PDF檔刊載於本公司網站(http://www.aseglobal.com),並同時揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊於公開資訊觀測站。	與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則無重大差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司於104年參酌「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定本公司企業社會責任實務守則,經本公司董事會通過頒布並揭露於公司網站(http://www.aseglobal.com),實際運作與守則規定並無重大差異。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:

- · 其他企業社會責任運作情形之資訊,請詳閱本公司企業社會責任報告書(http://www.aseglobal.com)。
- · 本公司長期致力於回饋社會,透過「日月之光慈善事業基金會」與「日月光文教基金會」,投入社區及參與各項社會公益活動。我們的員工慷慨地奉獻出時間、善款及專業技能,協助解決急難救助、學童教育等問題,是我們履行社會參與承諾的最大支柱。我們期望與廠區週邊的鄰居及社會大衆,藉由長期的合作及溝通,產生信任、互助及融洽的關係,創造積極正面並對社會有益的商業環境。
- · 積極投入環保公益活動:本公司於102年12月20日已承諾並履行持續30年每年至少投入新台幣一億元,以長期規劃及多面向推動的角度,持續穩定地投入台灣環保相關工作。目前,已透過「日月光文教基金會」規劃並執行諸多環保公益活動,其中重要的規劃與執行項目如下:
- 1. 推動環境教育(綠色教室建構暨環保理念宣導計畫/環境教育影音旗艦計畫/南區環境教育方案/環境技術之學術研究計畫/環保學術碩、博士論文獎助)。
- 2. 提升環境品質(環願山林造林方案/楠梓加工區景觀綠圍籬)。
- 3. 降低環境衝擊(校園LED方案/楠梓加工區資源再生利用模型廠操作維護/綠色供應鏈推動方案/環境衛生登革熱防治)。
- 4. 推廣環保藝文(草間彌生環境藝文推廣/環保主題親子劇場-海底歷險記等)。
- · 愛心參與慈善關懷活動:104年仍持續集結日月光集團員工們的愛心,投入超過新台幣1,000萬元‧透過「日月之光慈善事業基金會」,關懷弱勢家庭兒童‧並 擴大對社區的關懷,提供急難救助的服務‧其中參與地區性公益主要活動如下:
 - 1. 弱勢家庭兒少照顧中心(學童課後安親照顧/課業輔導/品格教育/家庭訪視輔導/親職教育講座等服務)。
 - 2. 清寒學子補助(提供補助營養午餐/助學獎勵金於高雄廠與中壢廠鄰近國小、國中及高中生)。
 - 3. 急難救助金(對於高雄廠與中壢廠服務區域遭遇特殊急難或意外事故,致生活造成困境者提供救助金)。
 - 4. 贊助公益單位救助金(104年共贊助20個公益機構,包括弱勢醫療基金捐助及協辦公益活動)。
- · 促進產學合作專案:與諸多大學(清大/東南科大/中原/元智/中山/成大/高師大/第一科大/高應用科大/海科大/屏科大/高苑科大等校)合作。不僅增加公司招募管道,亦促進在地學生就業機會、活絡公司與學校合作關係、精進學術研究與產業實務技術的提升。專案成果豐碩,104年將會持續進行擴大此產學合作專案,達到一贏后面。
- · 本公司中壢廠設立員工托育中心,聘請優良的師資,關心及照顧員工孩童托育問題,並能即時掌握孩童在校狀況,作為員工工作的後盾。

七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:

本公司於2010年至2014年,每年均發行企業社會責任報告書,其內容係以全球永續性報告協會(GRI)指導網領及AA1000 APS當責性原則標準撰寫,並自願取得第 三方(BSI)查證聲明書,符合G3.1 A+ 應用等級(application level)。本公司於2015年發行的企業社會責任報告書,其內容是依循GRI G4 永續性報告指南的核心選項 進行編纂,並且自願取得勤業衆信聯合會計師事務所(Deloitte)確信聲明,其係依國際審計與認證準則 ISAE 3000進行獨立有限確信(limited assurance)。

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施:

落實誠信經營情形

ᇒᄼᅼᅙᄆ			運作情形	與上市上櫃公司
評估項目	是	否	摘要說明	誠信經營守則差 異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠 信經營之政策、作法,以及董事會與 管理階層積極落實經營政策之承諾?	V		本公司董事會已通過頒布誠信經營相關規章,即「日月光集團商業道德及行為準則(ASE Group Code of Business Conduct and Ethics) 」以及「誠信經營守則」,並已於公司網站揭露,請詳http://www.aseglobal.com。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案, 並於各方案内明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?	V		本公司擬於105年訂定方案内之作業程序、行為指南、及申訴制度,而在工作紀律倫理中 已訂定道德規範及違規之懲戒辦法,督促所有員工應確實遵守。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍内具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?	V		本公司於誠信經營守則明定嚴格禁止董事、經理人及受僱人等進行下列行為,並透過内 部稽核程序查核及監控,藉以建立誠信之營業行為: 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信記錄, 並於其與往來交易對象簽訂之契約中 明訂誠信行為條款?	V		本公司於商業往來前,會先對商業往來對象進行徵信,排除有不誠信行為記錄之對象,並於商業契約中明訂誠信行為條款。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業 誠信經營專(兼)職單位,並定期向董 事會報告其執行情形?		V	本公司已將誠信與道德價值融入公司經營策略,針對公司新進員工及在職員工推動誠信宣導。本公司擬於105年度設置推動企業誠信經營之專職(兼)單位,並定期向董事會報告其執行情形。	公司持續改善中。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道・並落實執行?	V		本公司董事秉持高度自律,對董事會議案與其自身有利害關係,致有害於公司利益之虞者,討論及表決時應予迴避,董事間亦不得不當相互支援。 本公司亦定期執行防範内線交易之查核。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?	V		本公司設有健全之會計制度及內部控制制度,不允許有外帳或保留秘密帳戶,為確保該制度之設計及執行持續有效,內部稽核人員不定期查核前項制度遵循情形。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之内、外部之教育訓練?	V		本公司每年不定期舉辦對高階管理階層之誠信相關教育訓練以及對供應商之誠信商業行為進行宣導。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
三、公司檢舉制度之運作情形。				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度, 並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉 對象指派適當之受理專責人員?	V		本公司已設置檢舉管道(包括總經理信箱、反舞弊舉報信箱等),並於誠信經營守則中訂定 檢舉制度。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?		V	本公司擬於105年度建置檢舉制度後,訂定對檢舉事項之標準作業程序及相關保密機制。	公司持續改善中。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而 遭受不當處置之措施?		V	本公司擬於105年度訂定且採取保護檢舉人之保護措施。	公司持續改善中。
四、加強資訊揭露				
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測 站,揭露其所訂誠信經營守則內容及 推動成效?	V		本公司已於公司網站揭露與誠信經營相關規章,即「日月光集團商業道德及行為準則 (ASE Group Code of Business Conduct and Ethics) 」以及「誠信經營守則」,並於年報 揭露誠信經營運作情形,未來將規劃於公司網站設置推動成效相關訊息。	與上市上櫃公司誠 信經營守則無重大 差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司於104年參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司誠信經營守則,經董事會通過頒布並揭露於公司網站(http://www.aseglobal.com),實際運作與守則 規定並無重大差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守 則等情形):無。

- (七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:本公司訂有「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」等之相關規章,揭露於公司網站(http://www.aseglobal.com)。
- (八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:無。

(九)内部控制制度執行狀況

1. 内部控制聲明書



日期:一〇五年三月十六日

本公司民國一〇四年度之内部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在 對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令 規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
- 二、内部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之内部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保:而且,由於環境、情況之改變,内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之内部控制制度有效性之判 斷項目,判斷内部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之内部控制制度判斷項目,係為依管理控 制之過程,將内部控制制度劃分為五個組成要素: 1.控制環境,2風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督作 業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述内部控制制度判斷項目,評估内部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國一〇四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理), 包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要内容,並對外公開。上述公開之内容如有虛偽、隱匿等不法情事,將 涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇五年三月十六日董事會通過,出席董事十人中,有〇人持反對意見,餘均同意本聲明書 之内容,併此聲明。

日月光半導體製造股份有限公司

董事長: 張虔生



總經理: 張洪本



2. 委託會計師專案審查内部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其内部人員依法被處罰、公司對其内部人員違反内部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

股東會之重要決議

召開日期	重要決議	執行情形
104.06.23	1. 通過承認本公司一〇三年度決算表冊案。	1. 不適用。
召開104年股東常會	2. 通過承認本公司一〇三年度盈餘分派案。	2. 訂定104年8月16日為除息基準日,104年9月11日為現金股利發放日。
	 通過提請股東會授權董事會以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。 	
	4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	4. 已依修訂後之處理程序執行相關作業並公告於公開資 訊觀測站。
	5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	5. 已依修訂後之作業程序執行相關作業並公告於公開資 訊觀測站。
	6. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。	6. 已依修訂後之作業程序執行相關作業並公告於公開資 訊觀測站。
	7. 通過修訂本公司「公司章程」案。	7. 於104年7月8日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
	8. 改選董事案 選舉結果 個人董事:張洪本:張能傑。 法人董事:香港商微電子國際公司;法人董事代表人:張虔生、吳田玉、董宏 思、羅瑞榮、陳昌益、陳天賜。 獨立董事:游勝福、徐大麟、何美玥。	8. 新任董事已於104年6月24日就任。
	9. 通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 解除新任董事競業禁止之名單為 個人董事: 張洪本(本公司總經理)、張能傑。 法人董事(香港商微電子國際公司)代表人: 張虔生(本公司執行長)、吳田玉(本公司營運長)、董宏思(本公司財務長)、羅瑞榮 (本公司高雄廠區總經理)、陳昌益、陳天賜(本公司中壢分公司總經理)。 獨立董事:游勝福、徐大麟、何美玥。	9. 依決議結果執行。

董事會之重要決議

董事會之	重要決議							
開會日期	重要決議							
104.01.15	1. 決議通過本公司擬提撥新台幣1億元交由財團法人日月光文教基金會執行環保公益之捐贈作業案。							
	2. 決議通過本公司為進行集團内部組織調整,擬促使子公司環隆電氣股份有限公司進行分割及分割減資案。							
104.02.26	1. 決議通過承認本公司民國103年度合併財務報告暨個體財務報告。							
	2. 決議通過本公司擬依相關法令規定於有價證券集中交易市場買回本公司股份。							
104.03.30	1. 決議通過承認本公司民國103年度營業報告書。							
	2. 決議通過本公司截至民國103年12月31日止之背書保證總額及資金貸與他人金額。							
	3. 決議通過本公司民國103年股東常會通過之海外私募轉換公司債,於剩餘期間内擬不繼續辦理。							
	4. 決議通過本公司民國103年度盈餘分配之董監事酬勞。							
	5. 決議通過承認本公司民國103年度盈餘分派議案,提請監察人查核,並提報民國104年股東常會案。							
	6. 決議通過本公司以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國内現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債							
	案。							
	7. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。							
	8. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。							
	9. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。							
	10. 決議通過修訂本公司盈餘分配董事酬勞之提撥比率案。							
	11. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。							
	12. 決議通過改選本公司董事案。							
	13. 決議通過提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。							
	14. 決議通過本公司民國104年股東常會召開之日期、地點及議程。							

開會日期	重要決議
104.05.08	1. 決議修訂本公司「第五次員工認股權憑證發行及認股辦法」,提請追認案。
	2. 決議通過本公司擬發行海外第四次無擔保轉換公司債案。
	3. 決議通過與日商TDK Corporation簽署合資協議,共同設立日月陽電子股份有限公司,並擬由合資公司與TDK公司簽署智慧財產及授權合約,以取得
	TDK公司關於SESUB技術之授權案。
	4. 決議通過本公司持股1%以上股東提名獨立董事候選人名單。
104.06.04	1. 決議通過本公司為因應未來產能擴充之需求及提升對客戶之服務效能,以新台幣2,466,000,000(未稅)元,擬向關係企業宏璟建設股份有限公司購入新
	建廠辦大樓案。
	2. 決議通過變更本公司「第五次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
104.06.24	1. 選任本公司董事長及副董事長案。
	2. 決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
104.07.02	1. 決議委任本公司第三屆薪資報酬委員會之委員案。
	2. 決議通過本公司發放現金股利之除息基準日案。
104.08.05	決議通過本公司中壢分公司經理人異動案。
104.08.21	決議通過本公司公開收購矽品精密工業股份有限公司普通股股份及美國存託憑證案。
104.09.08	1. 決議通過訂定本公司103年度盈餘分配之經理人員工紅利分配明細案。
	2. 決議通過訂定本公司103年度盈餘分配之董監事酬勞分配明細案。
104.09.24	決議通過本公司將所持有之環隆電氣股份有限公司普通股39,603,222股,按每股新台幣20元之價格出售予子公司環鴻科技股份有限公司,總交易金額為新
	台幣792,064,440元案。
104.12.14	決議通過向矽品精密工業股份有限公司董事會提出簽訂股份轉換契約之提議案。
104.12.22	決議通過公開收購矽品精密工業股份有限公司普通股股份及美國存託憑證案。
104.12.28	1. 決議通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
	2. 決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」案。
	3. 決議通過訂定本公司一〇五年度稽核計畫案。
	4. 決議通過本公司擬發行一〇四年度無擔保普通公司債案。
	5. 決議通過本公司擬辦理五年期本金最高總額度不逾新台幣參佰億元之新台幣聯合貸款案。
105.01.14	1. 決議通過修訂本公司董事其薪資報酬政策中有關董事酬勞之提撥基礎及提撥比率
	2. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
	3. 決議通過本公司擬提撥新台幣1億元交由財團法人日月光文教基金會執行環保公益之捐贈作業案。

- (十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者, 其主要内容:無。
- (十三) 最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、内部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:無。

五、會計師公費資訊:

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計	†師姓名	查核期間	備註
勤業衆信聯合會計師事務所	陳珍麗	江佳玲	104.01.01~104.12.31	無

單位:新台幣仟元

				1 2 37 4 31 1 3 1 3 1
金額級	公費項目	審計公費	非審計公費	合 計
1	低於2,000千元	-	_	_
2	2,000千元(含)~4,000千元	_	_	_
3	4,000千元(含)~6,000千元	_	_	_
4	6,000千元(含)~8,000千元	_	_	_
5	8,000干元(含)~10,000干元	_	_	_
6	10,000千元(含)以上	38,982	16,606	55,588
	合計	38,982	16,606	55,588

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務内容。

單位:新台幣仟元

會計師 事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費				會計師查核期間	備註	
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小 計	智可即且核期间	川田古土
勤業衆信聯合 會計師事務所	陳珍麗/江佳玲	\$38,982	-	\$166	-	\$16,440	\$16,606	104.01.01~104.12.31	非審計公費之其他服務 内容,包括稅務諮詢及 其他等。

註:非審計公費按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者,應於備註欄列示其服務內容。

- (\Box) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭露更換前後審計公費減少金額及原因:不適用。
- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:不適用。

六、更換會計師資訊:

(一)關於前任會計師

更換日期	一〇三年二月二十日				
更換原因及說明	本公司簽證會計師原委由勤業衆信聯合會計師事務所陳珍麗及龔俊吉兩位會計師為之,因該事務所 計師之獨立性,並落實內部輪調之機制,故改委由該所之陳珍麗及江佳玲兩位會計師續為之。				
2000 (C.Z./T. - + - - - - -	當事人 情 況	會計師	委任人		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	主動終止委任		(不適用)		
	不再接受(繼續)委任		(小週月)		
最近兩年内簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無				
			會計原則或實務		
	有		財務報告之揭露		
的 <i>处</i> 上 左枷了同类日	有		查核範圍或步驟		
與發行人有無不同意見			其他		
	無				
	説明:不適用				
其他揭露事項 (依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第六款第一 目第四點應加以揭露者)	— — — —				

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業衆信聯合會計師事務所
會計師姓名	陳珍麗、江佳玲
委任之日期	一〇三年二月二十日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之第三點事項復函:無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬 事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之 期間:不適用。

八、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

1. 持股及設質股數變動情形

職稱	姓名	—OP		一〇五年截至二月底止		
邦以作	姓 石	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	
董事本人及大股東	香港商微電子國際公司	-	-	-	-	
董事本人	張洪本(副董事長兼總經理)	-	_	-	-	
董事本人	張能傑	-	_	-	-	
	張虔生(董事長及執行長)	-	_	-	_	
	吳田玉(營運長)	-	_	-	-	
要素ウオールキー	董宏思(財務長)	_	-	-	-	
董事之法人代表人	羅瑞榮(高雄廠區總經理)	-	_	-	_	
	陳昌益	-	-	-	-	
	陳天賜(中壢分公司總經理)(註)	(530,000)	-	-	-	
獨立董事	游勝福	-	-	-	-	
獨立董事	徐大麟	-	-	-	-	
獨立董事	何美玥	-	-	-	-	
副總經理		(9,000)	_	100,000	_	
副總經理	陳道有	100,000	_	(400,000)	_	
副總經理	李世文	-	_	-	_	
副總經理	周光春	40,000	_	-	-	
副總經理	林國堂	100,000	_	100,000	_	
副總經理	莫煥華	100,000	-	-	_	
副總經理	葉清昆	25,000	_	(9,000)	-	
副總經理	鄭楨銘	(60,000)	-	-	-	
副總經理	洪松井	100,000	_	_	-	
副總經理	曹燕傑	_	_	_	-	
副總經理	洪志斌	95,000	_	_	-	
副總經理暨會計長	郭宏銘	18,000	_	-	-	

註:係104年8月新上任之經理人。

2.股權移轉之相對人為關係人資訊:無。

3.股權質押之相對人為關係人資訊:無。

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以内之親屬關係之資訊:

持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

105年1月20日(註1) 單位:股:%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或 為配偶、三親等以内之親屬關係 者,其名稱或姓名及關係。		
	股數	持股 比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係	
香港商微電子國際公司	1,327,202,773	16.779	_	_	_	_	馮美珍	馮美珍為該公司 董事之配偶	
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	595,639,920	7.530	-	_	-	-	-	-	_
匯豐商業銀行受託保管價值投資公 司投資專戶	321,454,196	4.064	_	-	-	_	_	-	_
國泰人壽保險股份有限公司	217,519,000	2.750	-	_	-	-	_	_	_
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投 資專戶	122,698,869	1.551	-	-	-	_	_	-	_
馮美珍	121,729,346	1.539	-	-	-	-	香港商微電子 國際公司	馮美珍為該公司 董事之配偶	_
富邦人壽股份有限公司	118,400,000	1.497	=	_	-	-	-	_	-
南山人壽股份有限公司	115,486,000	1.460	_	_	-	_	-	_	_
新制勞工退休基金	113,533,204	1.436	-	-	1	_	_	_	_
中華郵政股份有限公司	108,281,482	1.369	-	_	-	_	_	_	

註1:持股比率總股數之計算基礎係以截至104年12月31日止計入本公司員工因行使員工認股權增加之股數(即105年1月20日辦理變更登記後之流通在外股數)。

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

綜合持股比例

104年12月31日 單位:股:%

104年12月31日 早世・版・%							
轉投資事業(註2)	本公司投資		董事、監察人、經 控制事業	理人及直接或間接 美之投資	綜合投資		
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股數	持股比例	
J&R Holding Ltd.(Bermuda)	435,128	100.00%			435,128	100.00%	
A.S.E. Holding Ltd.(Bermuda)	243,966	100.00%			243,966	100.00%	
Omniquest Industrial Limited	250,504,067	70.63%	104,200,000	29.37%	354,704,067	100.00%	
Innosource Limited	86,000,000	100.00%			86,000,000	100.00%	
ASE MS Japan Co., Ltd.	1,200	100.00%			1,200	100.00%	
台灣福雷電子(股)公司	851,997,366	100.00%			851,997,366	100.00%	
環隆電氣(股)公司	39,603,222	99.01%			39,603,222	99.01%	
環電(股)公司	990,080,566	99.17%			990,080,566	99.17%	
宏璟建設(股)公司	68,629,782	26.22%	63,580,900	24.29%	132,210,682	50.51%	
宏錦光(股)公司	35,497,273	27.31%	82, 494,545	63.46%	117,991,818	90.77%	
陸竹開發(股)公司	131,961,457	67.11%	37,250,448	18.94%	169,211,905	86.05%	
元隆電子(股)公司	33,308,452	18.24%			33,308,452	18.24%	
矽品精密工業(股)公司	779,000,000	24.99%			779,000,000	24.99%	
日月陽電子(股)公司	61,809,660	51.00%			61,809,660	51.00%	

註2:係公司採用權益法之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

股份種類

104.12.31

股份種類		流通在外股份		未發行股份	合計	轉換公司債可轉換 股份總數	保留員工認股權憑證總數
	已上市	未上市	合計	本级11股历			
普通股	7,909,741,896股	0股	7,909,741,896股	2,090,258,104股	10,000,000,000股	600,000,000股	800,000,000股

(一)股本來源

	單位:股/新台幣元							
	發行	核定	股本	實收	股本	備註		<u> </u>
年月	價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號
73.03	_	17,200,000	172,000,000	10,000,000	100,000,000	設立(現金)	無	民國73年3月23日 經加處(73)設字第414號
73.05	_	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	現金增資100,000,000	無	民國73年5月10日 經加處(73)商字第3956號
73.06	_	23,520,000	235,200,000	23,520,000	235,200,000	現金增資35,200,000	技術股 35,200,000	民國73年6月20日 經加處(73)商字第5246號
75.08	_	33,121,625	331,216,250	33,121,625	331,216,250	現金增資96,016,250	無	民國75年8月12日 經加處(75)商字第7725號
77.06	_	39,495,000	394,950,000	39,495,000	394,950,000	盈餘增資63,733,750	無	民國77年6月14日 經加處(77)商字第5457號
77.09	_	50,000,000	500,000,000	50,000,000	500,000,000	盈餘增資105,050,000	無	民國77年9月20日 經加處(77)商字第8760號
79.01	_	62,000,000	620,000,000	62,000,000	620,000,000	盈餘增資120,000,000	無	民國79年1月31日 經加處(79)商字第0184號
80.01	_	75,024,000	750,240,000	75,024,000	750,240,000	盈餘及員工紅利增資 117,840,000 資本公積轉增資 12,400,000	無	民國80年1月7日 經加處(80)商字第000046號
80.08	_	125,000,000	1,250,000,000	105,607,373	1,056,073,730	盈餘及員工紅利增資 80,761,730 資本公積轉增資 225,072,000	無	民國80年8月15日 經加處(80)商字第006582號
81.05	38	125,000,000	1,250,000,000	125,000,000	1,250,000,000	現金增資193,926,270	無	民國81年5月18日 經加處(81)商字第004195號
81.10	_	150,600,000	1,506,000,000	150,600,000	1,506,000,000	盈餘及員工紅利增資 68,500,000 資本公積轉增資 187,500,000	無	民國81年10月24日 經加處(81)商字第009364號
82.09	_	165,660,000	1,656,600,000	165,660,000	1,656,600,000	資本公積轉增資 150,600,000	無	民國82年9月10日 經加處(82)商字第007782號
83.05	_	260,000,000	2,600,000,000	233,824,000	2,338,240,000	盈餘及員工紅利增資 491,131,000 資本公積轉增資 190,509,000	無	民國83年5月30日 經加處(83)商字第4655號
84.02	60	260,000,000	2,600,000,000	260,000,000	2,600,000,000	現金增資261,760,000	無	民國84年2月6日 經加處(84)商字第000907號
84.05	_	500,000,000	5,000,000,000	356,800,000	3,568,000,000	盈餘及員工紅利增資 760,000,000 資本公積轉增資 208,000,000	無	民國84年5月26日 經加處(84)商字第4553號

	25/=	核定	股本	實收				±
年月	發行 價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號
84.07	79.7	500,000,000	5,000,000,000	399,800,000	3,998,000,000	現金增資430,000,000	無	民國84年7月29日 經加處(84)商字第6711號
85.06	-	1,000,000,000	10,000,000,000	729,000,000	7,290,000,000	盈餘及員工紅利增資 2,092,600,000 資本公積轉增資 1,199,400,000	無	民國85年6月14日 經加處(85)商字第5658號
86.06	_	1,400,000,000	14,000,000,000	1,017,000,000	10,170,000,000	盈餘及員工紅利增資 1,640,700,000 資本公積轉增資 1,239,300,000	無	民國86年6月11日 經加處(86)商字第005745號
87.05	_	2,200,000,000	22,000,000,000	1,780,000,000	17,800,000,000	盈餘及員工紅利增資 6,409,600,000 資本公積轉增資 1,220,400,000	無	民國87年5月8日 經加處(87)商字第4310號
88.08	_	2,200,000,000	22,000,000,000	1,980,000,000	19,800,000,000	盈餘及員工紅利增資 1,483,800,000 資本公積轉增資 516,200,000	無	民國88年8月11日 經加處(88)三商字第8494號
89.06	-	2,400,000,000	24,000,000,000	1,980,355,086	19,803,550,860	海外可轉換公司債轉換 普通股本3,550,860	無	民國89年6月1日 經加處(89)三商字第005552號
89.09	_	3,200,000,000	32,000,000,000	2,652,000,000	26,520,000,000	盈餘及員工紅利增資 6,716,449,140	無	民國89年9月17日 經加處(89)三資字第09740號
89.10	43.81	3,200,000,000	32,000,000,000	2,752,000,000	27,520,000,000	現金增資發行海外存託 憑證1,000,000,000	無	民國89年10月23日 經加處(89)三商字第011577號
90.08	-	4,150,000,000	41,500,000,000	3,254,800,000	32,548,000,000	盈餘及員工紅利增資 5,028,000,000	無	民國90年8月10日 經加三資字第0900007451號
92.09	_	5,150,000,000	51,500,000,000	3,580,280,000	35,802,800,000	密餘轉增資 97,644,000 資本公積轉增資 3,157,156,000	無	民國92年9月18日 經加三商字第09200088290號
93.09	_	5,150,000,000	51,500,000,000	3,862,595,437	38,625,954,370	合併增資 2,823,154,370	無	民國93年9月3日 經加三商字第09301027080號
93.09	_	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,000,000	41,000,000,000	盈餘轉增資 2,219,773,600 員工紅利轉增資 154,272,030	無	民國93年9月15日 經加三商字第09300078780號
94.01	_	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,660,600	41,006,606,000	員工認股權憑證轉換 6,606,000	無	民國94年1月 31 日 經加三商字第09400004370號
94.04	-	5,150,000,000	51,500,000,000	4,111,728,800	41,117,288,000	員工認股權憑證轉換 110,682,000	無	民國94年4月 21 日 經加三商字第09400032410號
94.07	-	5,150,000,000	51,500,000,000	4,113,744,200	41,137,442,000	員工認股權憑證轉換 20,154,000	無	民國94年7月 21 日 經加三商字第09400059920號
94.09	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,550,532,800	45,505,328,000	盈餘轉增資 2,878,547,980 員工紅利轉增資 255,674,600 資本公積轉增資 1,233,663,420	無	民國94年9月 29 日 經加三商字第09400084400號
94.10	-	6,300,000,000	63,000,000,000	4,557,372,300	45,573,723,000	員工認股權憑證轉換 68,395,000	無	民國94年10月 21 日 經加三商字第09400091660號
95.01	-	6,300,000,000	63,000,000,000	4,563,877,540	45,638,775,400	員工認股權憑證轉換 65,052,400	無	民國95年01月 19 日 經加三商字第09500005220號
95.04	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,573,895,020	45,738,950,200	員工認股權憑證轉換 100,174,800	無	民國95年04月 24 日 經加三商字第09500030630號

	25/=	核定	2股本	實收			備	<u> </u>
年月	發行 價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號
95.07	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,577,568,780	45,775,687,800	員工認股權憑證轉換 36,737,600	無	民國95年07月 19 日 經加三商字第09500059250號
95.10	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,592,508,620	45,925,086,200	員工認股權憑證轉換 149,398,400	無	民國95年10月 17 日 經加三商字第09500088730號
96.01	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,611,311,450	46,113,114,500	員工認股權憑證轉換 188,028,300	無	民國96年01月 18 日 經加三商字第09600005130號
96.04	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,629,639,544	46,296,395,440	海外無擔保可轉換公 司債轉換39,956,440 員工認股權憑證轉換 143,324,500	無	民國96年04月 20 日 經加三商字第09600034690號
96.07	_	6,300,000,000	63,000,000,000	4,645,295,431	46,452,954,310	海外無擔保可轉換公 司債轉換85,688,270 員工認股權憑證轉換 70,870,600	無	民國96年07月 23 日 經加三商字第09600063120號
96.09	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,392,899,352	53,928,993,520	盈餘轉增資 6,941,010,710 員工紅利轉增資 535,028,500	無	民國96年09月 12 日 經加三商字第09600079950號
96.10	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,447,558,879	54,475,588,790	海外無擔保可轉換公司 債轉換251,542,070 員工認股權憑證轉換 295,053,200	無	民國96年10月 23 日 經加三商字第09600090450號
97.01	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,466,030,849	54,660,308,490	海外無擔保可轉換公司 債轉換145,603,600 員工認股權憑證轉換 39,116,100	無	民國97年01月 22 日 經加三商字第09700004950號
97.04	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,476,949,209	54,769,492,090	海外無擔保可轉換公 司債轉換19,863,200 員工認股權憑證轉換 89,320,400	無	民國97年04月 22 日 經加三商字第09700033570號
97.07	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,484,848,118	54,848,481,180	海外無擔保可轉換公 司債轉換61,524,590 員工認股權憑證轉換 17,464,500	無	民國97年07月 24 日 經加三商字第09700063360號
97.08	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,681,934,764	56,819,347,640	資本公積轉增資 1,094,938,940 員工紅利轉增資 383,205,000 盈餘轉增資 492,722,520	無	民國97年08月 28 日 經加三商字第09700077400號
97.10	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,427,734	56,904,277,340	海外無擔保可轉換公 司債轉換32,763,800 員工認股權憑證轉換 52,165,900	無	民國97年10月 21 日 經加三商字第09700094250號
98.01	-	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,742,134	56,907,421,340	員工認股權憑證轉換 3,144,000	無	民國98年01月 19 日 經加三商字第09800005500號
98.03	-	8,000,000,000	80,000,000,000	5,546,705,134	55,467,051,340	註銷庫藏股 1,440,370,000	無	民國98年03月 16 日 經加三商字第09800023510號
98.04	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,547,064,694	55,470,646,940	員工認股權憑證轉換 3,595,600	無	民國98年04月 22 日 經加三商字第09800037010號
98.07	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,127,694	54,731,276,940	註銷庫藏股 739,370,000	無	民國98年07月 14 日 經加三商字第09800065960號
98.07	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,529,914	54,735,299,140	員工認股權憑證轉換 4,022,200	無	民國98年07月 21 日 經加三商字第09800068350號

	2%/ =	核定	?股本	實收				<u> </u>
年月	發行 價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號
98.10	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,479,878,254	54,798,782,540	員工認股權憑證轉換 63,483,400	無	民國98年10月 20 日 經加三商字第09800103260號
99.01	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,488,458,214	54,884,582,140	員工認股權憑證轉換 85,799,600	無	民國99年01月 25 日 經加三商字第09900005410號
99.04	_	8,000,000,000	80,000,000,000	5,495,212,494	54,952,124,940	員工認股權憑證轉換 67,542,800	無	民國99年04月 23 日 經加三商字第09900039480號
99.07	-	8,000,000,000	80,000,000,000	5,499,659,994	54,996,599,940	員工認股權憑證轉換 44,475,000	無	民國99年07月 19 日 經加三商字第09900075180號
99.08	_	8,000,000,000	80,000,000,000	6,049,157,072	60,491,570,720	資本公積轉增資 879,195,320 股東股息紅利轉增資 4,615,775,460	無	民國99年08月 09 日 經加三商字第09900084320號
99.10	_	8,000,000,000	80,000,000,000	6,051,987,182	60,519,871,820	員工認股權憑證轉換 28,301,100	無	民國99年10月 22 日 經加三商字第09900113120號
100.01	_	8,000,000,000	80,000,000,000	6,029,118,452	60,291,184,520	員工認股權憑證轉換 141,312,700 註銷庫藏股 370,000,000	無	民國100年01月 19 日 經加三商字第10000006520號
100.04	-	8,000,000,000	80,000,000,000	6,050,060,512	60,500,605,120	員工認股權憑證轉換 209,420,600	無	民國100年04月 21 日 經加三商字第10000043460號
100.07	-	8,000,000,000	80,000,000,000	6,052,219,212	60,522,192,120	員工認股權憑證轉換 21,587,000	無	民國100年07月 21 日 經加三商字第10000083030號
100.08	-	9,500,000,000	95,000,000,000	6,747,954,872	67,479,548,720	股東股息紅利轉增資 6,957,356,600	無	民國100年08月 30 日 經加三商字第10000101280號
100.10	-	9,500,000,000	95,000,000,000	6,753,563,242	67,535,632,420	員工認股權憑證轉換 56,083,700	無	民國100年10月 19 日 經加三商字第10000124020號
101.01	_	9,500,000,000	95,000,000,000	6,650,130,772	66,501,307,720	員工認股權憑證轉換 20,425,300 註銷庫藏股 1,054,750,000	無	民國101年01月 19 日 經加三商字第10100007740號
101.04	-	9,500,000,000	95,000,000,000	6,654,716,832	66,547,168,320	員工認股權憑證轉換 45,860,600	無	民國101年04月 20 日 經加三商字第10100043500號
101.07	-	9,500,000,000	95,000,000,000	6,657,855,052	66,578,550,520	員工認股權憑證轉換 31,382,200	無	民國101年07月 24 日 經加三商字第10100081100號
101.09	_	9,500,000,000	95,000,000,000	7,589,454,606	75,894,546,060	股東股息紅利轉增資 9,315,995,540	無	民國101年09月 04 日 經加三商字第10100099460號
101.10	-	9,500,000,000	95,000,000,000	7,594,149,626	75,941,496,260	員工認股權憑證轉換 46,950,200	無	民國101年10月 18 日 經加三商字第10100117650號
102.01	-	9,500,000,000	95,000,000,000	7,602,121,666	76,021,216,660	員工認股權憑證轉換 79,720,400	無	民國102年01月 18 日 經加三商字第10200007680號
102.04	-	9,500,000,000	95,000,000,000	7,607,502,906	76,075,029,060	員工認股權憑證轉換 53,812,400	無	民國102年04月17日 經加三商字第10200044490號
102.07	-	9,600,000,000	96,000,000,000	7,609,816,206	76,098,162,060	員工認股權憑證轉換 23,133,000	無	民國102年07月17日 經加三商字第10200082280號
102.10	26.1	9,600,000,000	96,000,000,000	7,756,003,946	77,560,039,460	現金增資 1,300,000,000 員工認股權憑證轉換 161,877,400	無	民國102年10月17日 經加三商字第10200118400號
103.01	_	9,600,000,000	96,000,000,000	7,787,159,546	77,871,595,460	員工認股權憑證轉換 311,556,000	無	民國103年01月21日 經加三商字第10300007950號
103.04	_	9,600,000,000	96,000,000,000	7,810,454,946	78,104,549,460	員工認股權憑證轉換 232,954,000	無	民國103年04月22日 經加三商字第10300046040號
103.07	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,824,220,046	78,242,200,460	員工認股權憑證轉換 137,651,000	無	民國103年07月18日 經加三商字第10300085480號

	發行	核定	股本	實收	實收股本		備註		
年月	價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	核准日期與文號	
103.10	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,852,537,846	78,525,378,460	員工認股權憑證轉換 283,178,000	無	民國103年10月24日 經加三商字第10300125920號	
104.01	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,860,491,546	78,604,915,460	員工認股權憑證轉換 79,537,000	無	民國104年01月20日 經加三商字第10400006750號	
104.04	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,887,881,546	78,878,815,460	員工認股權憑證轉換 27,390,000	無	民國104年04月21日 經加三商字第10400040900號	
104.07	-	10,000,000,000	100,000,000,000	7,893,157,596	78,931,575,960	員工認股權憑證轉換 5,276,050	無	民國104年07月16日 經加三商字第10400076760號	
104.10	ı	10,000,000,000	100,000,000,000	7,902,928,996	79,029,289,960	員工認股權憑證轉換 9,771,400	無	民國104年10月19日 經加三商字第10400114270號	
105.01	_	10,000,000,000	100,000,000,000	7,909,741,896	79,097,418,960	員工認股權憑證轉換 6,812,900	無	民國105年01月20日 經加三商字第10500008440號	

(二)股東結構

105年01月20日(註1)

股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計(註2)
人數(人)	4	1	379	173,389	1,465	175,238
持有股數(股)	227,017,398	115,486,000	1,170,065,337	864,184,940	5,532,988,221	7,909,741,896
持股比例(%)	2. 870	1.460	14.793	10.926	69.951(註3)	100.000

- 註1:係股務代理公司所提供最近期之資料。 註2:包含一〇四年十二月三十一日止,因員工行使認股權於一〇五年一月二十日辦理變更登記後所發行之股數。 註3:其中陸資持股比例為0.250%

(三)股權分散情形

1. 普通股股權分散情形

每股面額十元:105年01月20日(註4)

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1~999	83,079	23,483,069	0.297
1,000~5,000	59,804	141,459,860	1.789
5,001~10,000	15,322	112,519,153	1.423
10,001~15,000	5,682	70,112,303	0.886
15,001~20,000	3,183	56,231,732	0.711
20,001~30,000	2,671	65,850,878	0.833
30,001~40,000	1,449	50,158,984	0.634
40,001~50,000	770	34,775,060	0.440
50,001~100,000	1,460	102,786,750	1.299
100,001~200,000	639	90,121,631	1.139
200,001~400,000	362	101,708,439	1.286
400,001~600,000	154	76,112,591	0.962
600,001~800,000	96	67,191,414	0.849
800,001~1,000,000	75	66,873,637	0.845
1,000,001以上	492	6,850,356,395	86.607
合計	175,238	7,909,741,896	100.000

註4:係股務代理公司所提供最近期之資料。

2. 特別股股權分散情形:不適用。

(四)主要股東名單

105年01月20日(註)

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
香港商微電子國際公司	1,327,202,773	16.779
	1,527,202,775	10.779
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	595,639,920	7.530
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶	321,454,196	4.064
國泰人壽保險股份有限公司	217,519,000	2.750
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	122,698,869	1.551
馮美珍	121,729,346	1.539
富邦人壽股份有限公司	118,400,000	1.497
南山人壽股份有限公司	115,486,000	1.460
新制勞工退休基金	113,533,204	1.436
中華郵政股份有限公司	108,281,482	1.369

註:持股比例總股數之基礎係依本公司員工截至104年12月31日止因行使員工認股權增加之股數(即以105年1月20日辦理變更登記後之流通在外股數)。

(五)每股市價、淨值、盈餘及股利

單位:新台幣元

項目		年度	一〇三年度	一〇四年度	 一○五年截至年報刊印日止
	追溯前	最高	42.15	48.05	38.30
	1年/朔刊	最低	26.60	29.75	33.20
每股市價	沪洲 %	最高	42.15	註1	註1
	追溯後	最低	26.60	註1	註1
	平均		35.06	39.22	35.42
与 则必结	分配前		19.47	20.21	註5
每股淨值	分配後		17.45	註1	註5
	加權平均股數		8,220,694,389股	8,250,064,481股	8,296,184,263股
每股盈餘	C00.77.60.43.599	追溯前	2.96	2.44	註5
	每股盈餘(稀釋)	追溯後	2.96	註1	註5
	現金股利		2.00379984	註1	-
⊆ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	dur (dd ∓⊃ DD.	盈餘配股	-	註1	-
每股股利	無償配股	資本公積配股	-	註1	-
	累積未付股利		-	-	-
	本益比(註2)		11.88	16.07	註5
投資報酬分析	本利比(註3)		17.50	註1	-
	現金股利殖利率(註4)		0.06	註1	-

註1: 俟股東會決議後定案。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 公司之股利政策:

本公司於民國九十八年六月二十五日經股東會通過修訂之股利政策如下:

本公司正處於企業穩定成長階段,為因應目前及未來業務擴展之資金需求,並滿足股東對現金流入之需求,本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利,其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十,餘額則配發股票股利,並由董事會擬具盈餘分派案,經股東會決議後辦理。

註2:本益比=當年度平均收盤價/每股盈餘。

註3:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註5:尚未完成盈餘結算。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形:

- (1) 本公司董事會於105年4月1日提議本次分派股東紅利新台幣12,476,779,033元,全部以現金發放,每股配發現金股利1.6元。有關上項股東紅利之配息率係依據本公司105年3月23日之股東名簿所記載之股數扣除本公司已買回之庫藏股後之股數7,797,986,896股計算,嗣後如因本公司發行海外可轉換公司債之債權人行使轉換、或因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股、或因本公司辦理現金增資發行新股、或因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷等因素,影響本公司可參與分配股利之股數,致股東之配息率發生變動而需修正時,擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。
- (2) 為配合兩稅合一實施,本次盈餘分派案優先分配最近年度盈餘。
- (3) 本次股東會擬議股利分配之情形俟股東常會通過並報請主管機關核准增資後,授權由董事會另訂除息基準日,屆時 將另行公告。
- 3. 預期股利政策將有重大變動時,應加以說明分配之情形:不適用。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:

不適用。(依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無需公開民國一〇五年度財務預測資訊。)

(八) 員工、董事及監察人酬勞

1. 本公司公司章程經民國一〇五年一月十四日董事會決議通過,預計於民國一〇五年六月二十八日股東常會決議後所載員工、董事酬勞之成數或範圍如下:

依本公司章程第二十三條規定,本公司年度如有獲利,應提撥百分之五點二五(含)以上,百分之八點二五(含)以下為員工酬勞,並提撥百分之零點七五(含)以下為董事酬勞;但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

前項提撥之員工酬勞,其中百分之五點二五部份係按員工酬勞發放辦法分配予全體員工,另其超過百分之五點二五部份 則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。

員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東 會。

前三項所稱之員工,其對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件由董事會訂定之。

依本公司章程第二十三條之一規定,本公司每屆決算所得純益,依下列順序分派之。

- (1) 彌補虧損。
- (2) 提存百分之十為法定盈餘公積。
- (3) 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (4) 加計或減除保留盈餘中屬已實現之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益。

其餘併同以前年度未分配盈餘,由董事會擬定盈餘分派案,提請股東會決議之。

 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列 數有差異時之會計處理。

一〇四年度應付員工酬勞及董事酬勞之估列金額分別為新台幣2,033,937,757元及184,903,432元,分別按稅後淨利(已扣除員工酬勞及董事酬勞之金額)之8.25%及0.75%計算。其差異金額之處理:差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若董事會決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原提列年度費用,財務報告通過日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形:

本公司105年4月1日董事會決議通過104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下:

- (1) 擬議分派員工酬勞新台幣2,033,800,000元(全數以現金發放)及董事酬勞金額新台幣140,000,000元。上述擬配發金額 與原已費用化之員工酬勞2,033,937,757元及董事酬勞184,903,432元,差異數共計45,041,189元。差異金額之處理: 差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若董事會決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原提列年 度費用,財務報告通過日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。
- (2) 以股票分派之員工酬勞金額為0元,占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例為0%。
- 4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

本公司104年6月23日股東常會通過103年度盈餘分派案及實際配發情形:

- (1) 實際配發員工酬勞新台幣2,335,600,000元及董事監察人酬勞金額新台幣211,200,000元。
- (2) 上述實際配發金額與原已費用化之員工酬勞2,335,785,851元,董事監察人酬勞212,344,171元,差異數共計 1,330,022元。

差異原因:會計估計調整。

處理情形:差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。

(九)公司買回本公司股份情形:

公司最近年度及截止年報刊印日止買回本公司股份情形如下:

105年截至年報刊印日止

買回期次	第七次
買回目的	作為股權轉換之用
買回期間(實際)	104/03/03~104/03/27
買回區間價格	新台幣32~55元
已買回股份種類及數量	普通股12,000,000股
已買回股份金額	新台幣5,333,405,737元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股
累積持有本公司股份數量	12,000,000股
累積持有本公司股份數量占買回當時已發行股份總數比率(%)	1.53%

二、公司債辦理情形:

(一)公司債發行情形

105年截至年報刊印日止

		○○ 左左右 (□共立□□	105年截至年報刊印日止	
	公司債種類 	一〇〇年度有擔保普通公司債	一〇四年度第1期無擔保普通公司債	
發行	日期	民國100年8月19日	民國105年1月12日	
面額		新台幣5,000萬元	新台幣100萬元	
發行.	及交易地點	中華民國櫃檯買賣中心	中華民國櫃檯買賣中心	
發行	價格	依票面金額十足發行	依票面金額十足發行	
總額		新台幣80億元	新台幣90億元	
利率		固定年利率1.45%	甲類: 固定年利率1.30% 乙類: 固定年利率1.50%	
期限		5年期,到期日:民國105年8月19日	甲類5年期,到期日:110年1月12日 乙類7年期,到期日:112年1月12日	
保證	機構	本公司債甲券委由臺灣銀行股份有限公司、乙券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、內券委由合作金庫商業銀行股份有限公司、丁券委由第一商業銀行股份有限公司、戊券委由華南商業銀行股份有限公司共五家銀行依履行公司債保證契約保證。(註1)	無	
受託		台北富邦商業銀行股份有限公司	台北富邦商業銀行股份有限公司	
承銷	機構	無	元大證券股份有限公司	
簽證		現代法律事務所	一誠聯合法律事務所	
簽證	會計師	勤業衆信聯合會計師事務所	勤業衆信聯合會計師事務所	
償還		各券均為五年到期乙次還本	甲乙類均為到期一次還本	
未償		新台幣80億元	新台幣90億元	
	或提前 之條款	本公司與各保證銀行及受託人分別簽訂「委任保證契約」及「受託 契約」並依各保證銀行及受託人所規定之違約事件發生時,各保證 銀行得向公司債持有人(或受託人)提前償付全部公司債。(即違約事 件發生時,本公司債即視為全部到期)	無	
限制	條款	一般限制條款	僅僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理 規則所定之專業投資人。	
	評等機構名稱、評等日 公司債評等結果	註2	澳州商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期:104年12月16日 評等等級:A+	
附其他權	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無	
租利	發行及轉換(交換或認股) 辦法	無	無	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋 情形及對現有股東權益影響		無	無	
交換	標的委託保管機構名稱	無	無	

註1: 一〇〇年度有擔保普通公司債各券券別及發行金額如下:

幣別:新台幣元

	11333 - 701 1137
券別	發行金額
甲券	參拾億
乙券	貳拾億
丙券	拾億
丁券	拾億
戊券	拾億

註2: 一〇〇年度有擔保普通公司債各券信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果

評等機構名稱	券別	保證機構	評等日期	評等等級
	甲券	臺灣銀行股份有限公司	104/10/26	twAAA
	乙券	兆豐國際商業銀行股份有限公司	104/10/15	twAA+
中華信評	丙券	合作金庫商業銀行股份有限公司	105/02/22	twAA
	丁券	第一商業銀行股份有限公司	104/10/05	twAA+
	戊券	華南商業銀行股份有限公司	104/06/18	twAA

(二)轉換公司債資料

單位:新台幣元

公司債種類		海外第三次無擔保轉換公司	司債(發行總額美金四億元)	海外第四次無擔保轉換公	司債(發行總額美金二億元)	
年底項目		104年度	105年截至年報刊印日	104年度	105年截至年報刊印日	
	最高	_	-	_	_	
轉換公司債市價	最低	_	-	_	_	
	平均	_	-	_	_	
轉換價格		30.	28	51.73		
發行(辦理)日期及		發行日期: 102年9月5日		發行日期: 104年7月2日		
5又13(机)上/口州7人	71.141.441.141.141.141.141.141.141.141.1	發行時轉換價格: 33.085		發行時轉換價格: 54.5465		
		公司債持有人行使轉換權者,發行公司將於受理轉換請求日後五		公司債持有人行使轉換權者,發行公司將於受理轉換請求日後五		
		個營業日内,透過臺灣證券集中	保管股份有限公司之帳簿劃撥方	個營業日内,透過臺灣證券集中保管股份有限公司之帳簿劃撥方		
履行轉換義務方式		式交付新股。如請求轉換之本公	司債持有人尚未開立海外公司債	式交付普通股。如請求轉換之本公司債持有人尚未開立海外公司		
		轉換集保專戶,發行公司將俟持	有人完成相關開戶手續後,再以	債轉換集保專戶,發行公司將俟持有人完成相關開戶手續後,再		
		帳簿劃撥方式交付新股。		以帳簿劃撥方式交付普通股。		

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存託憑證辦理情形:

105年截至年報刊印日止 單位:美金元

		 里)日期			
項目			89 年 9月	92 年 6 月	
發行(辦理)日期			民國89年9月	民國92年6月	
發行及交易地	也點		美國紐約證券交易所	美國紐約證券交易所	
發行總金額			美金140,000仟元	美金86,808仟元	
單位發行價格	ă.		每單位美金7元	每單位美金2.65元	
發行單位總數	数		20,000,000單位,每單位表彰本公司普通股5股	32,757,600單位,每單位表彰本公司普通股5股	
表彰有價證券	等之來源		本公司現金增資發行之普通股	本公司股東所持有本公司已發行之普通股	
表彰有價證券	等之數額		本公司普通股100,000,000股,每股面額新台幣壹拾元整	本公司普通股163,788,000股,每股面額新台幣壹拾元整	
存託憑證持有	三人之權利與義務		享有與本公司普通股股東相同之權利義務		
受託人			無		
存託機構			花旗銀行		
保管機構			花旗銀行台北分行		
未兌回餘額			迄年報刊印日止,海外存託憑證流通在外餘額為118,238,089單位,表彰本公司普通股591,190,450股。		
發行及存續期	阴間相關費用之分攤方式		無		
存託契約及係	呆管契約之重要約定事項		無		
		最高	8.12		
104年度 最低		最低	4.54		
每單位市價 平均		平均	5.97		
		最高	5.71		
	105年截至年報刊印日止	最低	4.89		
		平均	5.49		

五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股):

- (一)本公司為吸引並留任公司所需之專業人才,激勵員工及提昇員工向心力,業經主管機關於九十六年十一月、九十九年四月及一〇四年四月分別核准發行第三次員工認股權憑證200,000,000單位、第四次員工認股權憑證200,000,000單位及第五次員工認股權憑證100,000,000單位,每單位得認購本公司普通股一股,並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。(第一、二次員工認股權憑證已到期)。
- 1. 尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響:

105年截至年報刊印日止

	第三次員工	第四次員工		105年截至年報刊印日止 第五次員工
員工認股權憑證種類	認股權憑證	第一次發行	第二次發行	認股權憑證
申報生效日期	96/11/22	99/	04/20	104/04/17
發行(辦理)曰期	96/12/19	99/05/06	100/04/15	104/09/10
董事會決定發行單位數	200,000,000單位	200,000,	,000單位	100,000,000單位
發行得認購股數占發行時已發行股份總數比率	3.66%	3.41%	0.20%	1.19%
認股存續期間	本認股權憑證之存續期間為一股權人不得再行主張其認股權	十年,不得轉讓,但因繼承者不 霍利。	下在此限。存續期間屆滿後,ラ	
履約方式	由本公司發行普通股新股交付	j •		
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權 認股權憑證授予期間 屆滿2年 屆滿2.5年 屆滿3.5年	建憑證屆滿二年後,可按下列時 累積最高可行使認股比例 40% 50% 60% 70%	程及比例行使認股。	
	屆滿4年 屆滿4.5年 屆滿5年	80% 90% 100%		
已執行取得股數	99,043,500股	83,016,450股	2,914,000股	0股
已執行認股金額	2,220,710,050元	1,694,359,760元	65,856,400元	0元
未執行認股數量	86,762,500股	104,703,050股	9,366,000股	94,270,000股
未執行認股者其每股認購價格(目前執行價格)	新台幣21.1元	新台幣20.4元	新台幣22.6元	新台幣36.5元
未執行認股數量占年報刊印日已發行股份總數 比率(%)	1.10%	1.32%	0.12%	1.19%
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二		權益逐年稀釋,其稀釋效果尚	屬有限。

2. 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

105年02月29日

-					取得認						未 未幸		05年02月29日
	職稱	姓名	發行日	取得 占证 認股數量 行服	股數量 占已發 行股份 總數比 率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率
	執行長	張虔生											
	總經理	張洪本											
	營運長	吳田玉											
	財務長	董宏思											
	高雄廠區 總經理	羅瑞榮											
	中壢分公司總經理	陳天賜											
	副總經理	俞旭濬											
經	副總經理	陳道有	94.05.23										
理	副總經理	李世文	96.12.19	38,835,000	0.49%	1,766,000	21.52	38,003,900	0.02%	37,069,000	20.85	772,839,600	0.47%
人	副總經理	周光春	99.05.06	04.15									
	副總經理	林國堂	104.09.10										
	副總經理	洪松井											
	副總經理	洪志斌											
	副總經理	莫煥華											
	副總經理	葉清昆											
	副總經理	鄭楨銘											
	副總經理	曹燕傑											
	副總經理 暨會計長	郭宏銘											
		張能傑											
	取得	李俊哲											
	認股	張項青萍											
	權 憑	陳昌益	94.05.23										
	取得認股權憑證可認股數前十大員工	潘士華	96.12.19	10,800,000	0.14%	4,540,000	23.12	104,976,000	0.06%	6,260,000	20.70	129,566,000	0.08%
	設股	張能超	99.05.06	.0,000,000	0.1470	1,540,000	23.12	. 54,570,000	0.0070	5,250,000	25.70	.25,550,000	0.0070
	割前	李石松	100.04.15										
	大昌	米瑞奇	154.65.10										
	Ī	李貴文											
		張淡寧											

(二) 限制員工權利新股辦理情形:

- 1. 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響:無。
- 2. 取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大員工姓名及取得情形:無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股:無。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者:無。

七、資金運用計畫執行情形:

截至年報刊印日止已募集完成但尚未執行完畢之計畫:

104年度第四次海外可轉換公司債執行情形:

發行計畫	第四次海外可轉換公司債							
發行金額	美金200,000仟元(約折	美金200,000仟元(約折合新台幣6,886,000仟元)						
資金用途	購置機器設備							
		執行狀況						
			104年第三季	104年第四季	105年第一季	合計		
截至年報刊印日止之執行	支用金額	預定	2,443,935	3,563,036	879,029	6,886,000		
進度		實際	1,368,154	615,640	-	1,983,794		
	執行進度	預定	35.49%	51.74%	12.77%	100.00%		
		實際	19.86%	8.94%	_	28.80%		
輸入公開資訊觀測站日期	104.06.03							
效益及財務結構分析	本公司發行公司債係支應營運成長之購置機器所需外幣資金,以降低向金融機構外幣融資之倚賴,減少向金融機構外幣借款所造成之利息 負擔,並可以挹注營運所需之中長期資金外,更有助於本公司未來營運成長,增加企業獲利能力。							

伍、營運概況

一、業務内容

(一) 業務範圍

1. 本集團所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售

本集團主要提供客戶IC服務、電子製造服務及其他等三大類的業務範圍,包括:

• IC服務

封裝: 封裝及模組設計、IC封裝、多晶片封裝、微型及混合型模組、記憶體封裝。

測試:前段測試、晶圓針測、成品測試。

材料:基板設計、製造。

• 電子製造服務(EMS)

模組及主機板設計、產品及系統設計、系統整合、後勤管理。

其他

房地產開發、建設、房屋銷售物業管理及商場出租業務。

2. 目前產品項目及其營業比重:

單位:新台幣仟元

↑·邢玄□	104	
主要產品項目	營收金額	營業比重
	103,735,586	36.62%
測試業務產品	24,136,399	8.52%
電子製造代工服務產品	137,347,359	48.48%
其他	18,083,192	6.38%
總計	283,302,536	100.00%

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

在總體經濟部分,從年初到年尾持續下修,目前總體經濟預測各家看法一致,即2015年的成長力道小幅滑落,2016年回穩。IMF估2015年GDP成長率為3.1%,WB估2.8%,IC Insights估2.5%,均較2014年轉弱。

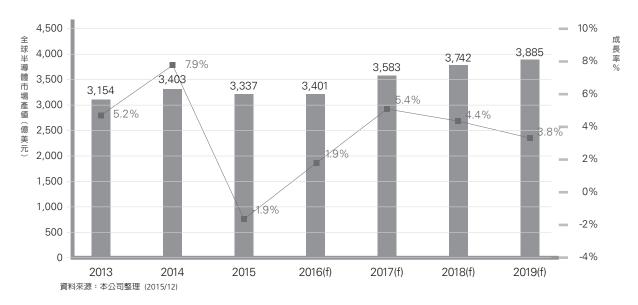
從2015上半年全球經濟表現不佳、GDP成長率下跌,及新興市場對於智慧手機需求成長幅度下滑等影響,半導體市場整體成長呈現下滑的態勢。2015年全球整體半導體產業成長率,一路從年初持續下修至年尾,預估2015年全球半導體市場成長率衰退1.9%,而台灣半導體產業產值逆勢成長1.9%,優於全球。

面臨全球經濟數據不佳及中國面臨轉型,新興市場因人均所得偏低與硬體建設不足等因素,尚無法有力推升需求,而呈現成長趨緩現象,而業界普遍看好的趨勢產業-物聯網(Internet of Things,IoT),尚未出現殺手級應用,導致終端市場處於缺乏成長動能的狀態。

全球經濟數據降速,內需市場需求減緩,市場雖出現物聯網相關應用,與穿戴式裝置(Wearable Devices)等終端產品,提升市場對高階封裝技術的需求,但目前看來,相關產品仍無法激勵消費者需求,所以市場仍需等待殺手級應用產品的開發。

全球半導體市場預測





台灣半導體產業景氣之動向:台灣半導體產業產值表現,2015年台灣IC產業產值(含設計、製造、封測)達新台幣22,640億元,較2014年成長2.8%。其中IC設計業產值為新台幣5,927億元,較2014年成長2.8%。IC製造業為新台幣12,300億元,較2014年成長4.9%。在次產業的表現,晶圓代工方面,受到客戶推出新產品帶動成長,但終端產品銷售普遍不佳,及中國市場需求低迷影響之下,晶圓代工產值達新台幣10,093億元,較2014年成長10.4%;記憶體製造方面,受到2014年記憶體基期過高、DRAM市場價格下跌及母廠銷售營運狀況不穩而影響出貨需求,也讓DRAM市場震盪循環週期再現,記憶體製造產值達新台幣2,207億元,較2014年衰退14.8%。

IC封裝業為新台幣3.099億元,較2014年衰退1.9%; IC測試業為新台幣1.314億元,較2014年衰退4.7%。

展望2016年,台灣半導體產業產值預估為新台幣23,191億元,其中設計業產值為新台幣6,202億元,製造業為新台幣12,459億元。在次產業方面,預估晶圓代工產值為新台幣10,744億元,記憶體製造產值為新台幣1,715億元。封測業預估為新台幣4,530億元,其中封裝業為新台幣3,170億元,測試業為新台幣1,360億元。

以下係 2015 年我國 IC 設計、製造、封測業及 2016 年預估營運表現,表列如下:

2016年台灣半導體產業產值預估

單位:新台幣億元

	2012	2013	2014	2015	2016(e)
台灣IC產業產值	16,342	18,886	22,033	22,640	23,191
台灣IC設計業	4,115	4,811	5,763	5,927	6,202
台灣IC製造業	8,292	9,965	11,731	12,300	12,459
晶圓代工	6,483	7,592	9,140	10,093	10,744
記憶體製造	1,809	2,373	2,591	2,207	1,715
台灣IC封測業	3,935	4,110	4,539	4,413	4,530
IC封裝業	2,720	2,844	3,160	3,099	3,170
IC測試業	1,215	1,266	1,379	1,314	1,360

資料來源: TSIA: 工研院IEK (2016/02)

2. 產業上、中、下游之關連性

近年來全球半導體產業在各種整合與併購的運作下,可以看到各個國家或企業都在積極尋求突破,也牽動版圖變化及競爭態勢。

中國對於發展半導體產業的企圖心,尤其透過政策與市場的優勢,加上身為電子產品的組裝生產重鎮,更使得中國已成為全球半導體最大區域市場。新崛起的中國在政府及大基金支持下推動半導體產業時,也是採取齊頭並進的做法,包括清華紫光併購美國影像感測大廠豪威科(OmniVision)、江蘇長電購併新加坡的星科金朋(STATS ChipPAC),另還傳出不同機構有意收購超微半導體(AMD)、矽成(ISSI)、格羅方德(Global Foundries)、美光(Micron)等消息,另外還有英特爾(Intel)入股清華紫光等。

台灣擁有完整的半導體產業鏈,從上游的 IC 設計到後段的 IC 製造與 IC 封測,專業分工模式獨步全球。目前政府也意識到維護台灣半導體產業的優勢已是國安問題,並提出與產業合作培育人才,以及透過擴張出口推動經濟成長等策略。而產業在智慧化的趨勢下,更需要掌握物聯網等商機的興起,並就台灣半導體產業的特有型態,運用平台或產業鏈的整合方式,針對不同需求提供產品及服務,甚至是建立新的商業模式,才能更有效地創造優勢。目前台灣相較中國半導體仍有市場佔有率及技術領先地位,雖競爭加劇,但從系統生態鏈上下游切入,仍有很大合作機會。

在半導體產業供應鏈中,本公司之業務主要負責中游之封裝測試和下游之封裝材料供應。本公司提供客戶晶片封裝及測試之半導體製造服務,主要晶圓大都為國際知名半導體公司所提供,長期與本公司保持良好的業務關係。本公司並透過 策略聯盟與合作夥伴藉由垂直及水平分工,進而提昇彼此的競爭實力。

設備儀器 資金人力資源 服務支援 CAD CAE 光置 製浩 封裝 設計 貨運 245 3 16 37 基板 材料 化學品 晶圓 11 導線架

我國半導體產業結構圖

註:圖中數字代表台灣主要廠商家數

CAD: Computer Aided Design CAE: Computer Aided Engineering

資料來源: 工研院 IEK (2015/05)

3. 產品之發展趨勢

電子終端產品從過去的個人電腦(PC)到智慧手機(Smartphone)的大量普及,致使成長力道放緩。下一波的殺手級應用,業界普遍認為是物聯網會是下一個五至十年的大趨勢,而其所帶動的智慧電子,也會是未來的商機所在。

相較於電腦或手機裝置內約上億到數十億的半導體需求量,物聯網的半導體需求更多達上百億個,市場預估到2020年全球將有300億台連網裝置,而物聯網整體與帶來的附加價值,預估將於2020年達到1.9兆美元,其龐大商機吸引全球廠商競相爭取一席之地。從智慧城市、智慧汽車(車聯網)、智慧家庭、智慧醫療(遠距照護)、智慧個人(健康與健身)、智慧工廠與智慧製造等應用,因此未來IC產業的挑戰在於,如何從PC及手機延伸至其他智慧電子應用需要的新產品、新技術及新市場。

物聯網與過去單一殺手級終端應用市場不同,無法僅專注於單一製程或產品,其產業特點講求多樣性,在半導體技術上著重先進、成熟製程技術及整合能力並進,因此將為全球IC產業發展帶來革新。

物聯網的興起帶動半導體元件技術走向製程微縮、次世代通訊、感測器融合與高階多視覺運算、記憶體內運算等,由此歸納出半導體產業在物聯網的大趨勢下,未來關鍵技術與新興應用走向。在物聯網的產品需求方面,必須具備多功能異

質整合(Heterogonous Integration)及超低功耗特性,此特性可拆解體積輕薄、電池續航力長、低功耗連線等元件整合趨勢。

高規低價的行動裝置已成趨勢,其多元化功能的高度整合已是基本配備,因此市場對SiP需求將會持續,計2016年會吸引更多廠商投入研發,以SiP技術逐步建構物聯網時代。

硬體方面須透過半導體元件及感測通訊介面為基礎,來改善人類生活。元件包含處理器(Processor)、類比IC(Analog IC)、通訊IC(Communication IC)、記憶體(Memory)、感測器(Sensor)整合,相關技術包含超低功耗(Ultra Low Power)、系統級封裝(System-in-Package,SiP)等。於是能夠整合不同功能晶片於單一微小化封裝體中的系統級封裝便順勢崛起。為了要提升效能及降低功耗,市場傾向在封裝時將處理器與記憶體堆疊,這樣可以達到較少面積、較低功耗(路徑短阻抗小)及較高傳輸速度(電子傳輸路徑變短),因此3D IC及TSV技術便應運而生,其中的目的之一,便是為了連接堆疊的IC,進而達到垂直堆疊的異質整合。

在物聯網及穿戴裝置等終端產品的趨動下,硬體系統由過去的大型體積裝置如PC走向中型的手機,再到更小的穿戴裝置,如智慧型手錶,系統微縮的趨勢下,使得硬體封裝的空間利用受到更多限制,多功能及受限的空間帶動系統級封裝應用興起,如Apple Watch的S1晶片便是一例,其中基板內埋晶片或被動元件的封裝技術(Embedded Technology)型態,因為可以達到節省面積、良好的散熱、減少雜訊等優點,故可成為SiP時基板附加功能利用時的重要利器。

除了將晶片埋入基板内,以節省面積外,其上仍可放置被動元件,以達到良好的空間配置,例如TDK的 SESUB(Semiconductor Embedded in Substrate)技術便是一例,也因此本公司為了將SiP技術向內埋式封裝推進,在 2015年與日本廠TDK合資成立日月暘公司,目標就是要將SiP及內埋式載板技術結合並提高良率,內埋式載板因其優異的空間節省、電性、散熱等表現,成為未來物聯網系統級封裝的絕佳載板首選,能為未來物聯網終端產品所需封裝型態 鋪路。

展望未來,半導體產業的下一個機會在哪裡?從2016年CES大展可窺見,仍以物聯網(IoT)貫穿全場,並聚焦在科技如何改變生活?實際應用較往年大幅增加,下一波潮流是IoT已經確定趨勢,而2016年更是將之推升至Smart IoT等級,各大廠皆強調Internet of Everything(萬物相連),並往Internet of Life目標邁進。國際半導體大廠從過去僅強調其高效能的晶片硬體技術,轉換為強調創新的生活應用和美好的使用者體驗,其產品應用聚焦在智慧汽車(自動駕駛、無人車等概念)、無人機、智慧家庭、穿戴裝置、虛擬實境、機器人等。而各大廠的技術佈局方向將以自有優勢技術為核心,鎖定IoT所需要的三大技術方向發展,即智慧運算、智慧感測、智慧傳輸。並嘗試建構更開放式的產業生態,更互通性的平台,並尋求強而有力的合作夥伴。

值得一提的是汽車產業,汽車未來走向智慧化、自動化、電動化、共享化,汽車也將更安全可靠(例如自動駕駛系統、主動式安全系統)、更舒適便捷(例如車載資通訊系統、智慧手機能與汽車溝通、汽車專屬Apps、抬頭顯示、創新人機介面)、更節能環保(例如電動車)等。

若從智慧家庭角度思考與智慧汽車的聯結角色,將重新翻轉汽車定位,因為未來汽車會是居家的延伸,並激盪出新的產業合作契機與物聯網商機。電動車雖佔整體汽車產業出貨量仍低,但有雙位數的年增率,電動車除了電源管理IC相對複雜外,整體設計的構思是朝向連網汽車(Connected Car)及車聯網(Internet of Vehicle, IoV)的概念邁進,整體對IC需求較傳統汽車高出許多。汽車電子市場未來成長力道最佳,2019年市場規模達1,680億美元。隨著汽車越來越智慧化,汽車電子成本的比重越來越重,平均每台汽車的半導體內含量金額也越來越高。

4. 競爭情形

綜觀全球半導體市場受到新興市場,與終端產品飽和的影響,整體正處於營收低迷的情況,台灣半導體產業也受到很大的影響。以IC製造商來看,雖然營運上不比2014年的榮景,但許多廠商趁此機會重新調整公司營運方向、發展策略及持續投資技術與國際合作。

然而面對中國大陸政府以投資干億人民幣投資基金,並積極推動半導體產業,致使紅色半導體供應鏈迅速崛起。韓國亦提出半導體產業再跳躍計畫,具IDM垂直整合優勢。日歐策略往高附加價值和差異化的醫療用、工業用、農業用、汽車用的半導體技術發展,結合應用強項汽車與機械人,並邁向航太和宇宙。

隨著經濟環境變化快速及產業競爭加劇,台灣固本不易。而美國遙遙領先,台灣攻頂惟艱。近期半導體產業間的併購動 作頻仍,台灣廠商也應要有固本攻頂策略以加速升級轉型。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用:

單位:新台幣仟元

年度項目	103年度	104年度	105年截至2月底	
營業收入	256,591,447	283,302,536	38,821,318	
研發支出金額	10,289,684	10,937,566	1,681,594	
研發支出佔營業收入之比率	4.01%	3.86%	4.33%	

2. 開發成功之技術或產品:

A. 開發成功之新產品

封奘技術

	New Package
3D系統封裝 (3D SiP)	 2.5D晶圓穿導孔矽材基板系統封裝(2.5D Through Silicon Via Interposer System in Package) 3D晶圓穿導孔堆疊系統封裝(3D Through Silicon Via Stacking System in Package) Panel Level覆晶PoP(aMAP Flip Chip PoP) Panel Level銲線PoP(aMAP Wire Bond PoP) 整合被動元件QFN封裝(Integrated Passive Device Integrated QFN Package) 基板内埋主被動元件技術(Embedded Active/ Passive Laminate Substrate) 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology)
光電封裝 (OEP)	 晶圓級微機電/影像感測器封裝(Wafer Level MEMS / CIS Package) 裸晶封膠之指紋感應器封裝技術(Exposed Die Molding Solution for Finger Print Sensor) 微光機電微顯示器封裝(Optical MEMS Microdisplay Package) 高功率LED構裝(High Power LED Package) 電子羅盤磁感應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor Package)
晶圓級封裝 (WLCSP)	 7. 砂晶圓間層封裝(Si Interposer Package) 2. 整合電阻被動元件技術(Integrated Resistor Passive Device) 3. 雙層PI晶圓RDL電線鋼技術(2-layer PI, Cu-Plated RDL Technology) 4. 疊層晶圓之薄化技術(Bonded Wafer Thinning Technology) 5. 線路重部製程與保護層疊層技術開發(BOT aCSP) 6. 線路重佈製程線寬線距5um/5um技術開發(RDL 5/5um)
覆晶封裝 (Flip Chip)	 20奈米銅製程/超低介電係數晶圖之無鉛覆晶封裝(20 nm Cu/ELK Lead Free FC Solution) 40微米微間距覆晶及銲線混合堆疊(40 um Fine Pitch FC & WB Hybrid Stacked Chips Package) 超高密度條狀基板排列製程(Ultra High Density Substrate Strip) 覆晶封裝之封膠Only產品(Flip Chip Package with Mold Only Process) 覆晶封裝之穿越封膠層孔產品(Flip Chip Through Mold Via Package) 單層板内嵌式線路基版封裝研發(1 Layer Embedded Trace Package)
桿線封裝 (Wire Bond Package)	 20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(20 nm Cu/ULK Wafer Wire Bond Package) 銅線BGA/ Lead Frame封裝開發(Cu Wire Bond BGA/ Lead Frame Package) 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding) 低成本、高效能aS3 / aQFN封裝方案(Low Cost & High Performance aS3 / aQFN) 四方平面無引腳產品於車用電子(FC QFN For ATV) 高散熱材料評估(High Thermal HS Evaluation)
微機電封裝 (MEMS Packaging) 無線射頻模組 (Wireless Module)	晶圓級微機電封裝技術(Wafer Level MEMS Packaging) 1. 低功耗監芽系統與加速度模組完整方案(BTLE+Accelerator SiP Module Application Solution) 2. 高頻寬Wi-Fi系統模組完整方案(Wi-Fi 11n 2x2 Channel SiP Module Total Solution) 3. 非圓柱覆晶式功率放大器封裝結構(Irregular FC Cu-Pillar PA SiP Module Solution) 4. Advanced Conformal /Compartment式電磁干擾遮敝方案(Conformal / Compartment EMI Shielding Solution)
無線通訊模組 (Wireless Communication Module)	 Advanced Combinary Compartment Livil Shielding Solution) 高整合度多模多頻3G通訊模組完整方案(Highly Integrated Multi – Modes Multi-Bands Communication Module Solution) 高整合度SiP封裝通訊LTE模組方案(Highly Integrated SiP Module Packaged LTE Module Solution)
	Bumping
電鍍製程 (Plating)	低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology)

新測試產品

	New Test Product					
	1. 高通道密度4線式VI source模組(High Channel Density 4-wire VI Source Module)					
	2. 數位I/O & per-pin可程式化量測模組(Digital I/O & PPMU Module)					
晶圓測試	3. 光纖模組控制卡(Fiber Module Control Card)					
(Wafer Probing)	4. 低壓高速基板Open/Short測試機(Low Voltage & High Speed Substrate Oper/Short Tester)					
	5. 崁入式元件基板Open/Short測試機(Embedded-die Substrate Open/Short Tester)					
	6. 多片晶圓堆疊測試分佈地圖分析軟體(Multiple Wafer Stacked Map Analysis Tool)					
後段測試 (Final Testing)	1. 測試資料分析軟體系統(Test Data Analysis System)					
	2. 測試良率監控軟體系統(Yield Monitor System)					
	3. Gage Repeatability Reproducibility分析軟體(GRR Analysis Tool)					

測試技術

	New Test Technology					
	1. 濕度感測器(RH Sensor)					
	2. 胎壓感測器(Tier Pressure Monitoring Sensor)					
	3. 加速器(G-Sensor)					
後段測試	4. 陀螺儀(Guiro Scope Senor)					
(Final Testing)	5. 麥克風晶片(Microphone Device)					
	6. 光感控制元件(ALS+Prox.Sensor)					
	7. 生物感測元件(Biometric Sensor)					
	8. 微機電震盪器元件(MEMS Oscillator)					

IGBT標準模組封裝製程技術

EMS製程技術 (New Process Technology)		
晶片焊錫組裝 (Solder Die Bond)	1. 13mm以下晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH 2. 焊錫介面空隙小於3%	
晶片錫線LF焊錫組裝 (Soft Solder Die Bond to Lead Frame)	1. 5mm以上晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH 2. 焊錫介面孔洞單個小於2%	
晶片銀膠LF組裝 (Epoxy Die Bond to Lead Frame)	3mm以上晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH	
銅打線LF組裝 (Cu Wire Bonding to Lead Frame)	5um 銅打線In-Line 組裝能力提高UPH	
相變導熱材料印刷 (PCM Printing)	印刷圖案之間距小於0.6mm	
自動點膠製程 (Automation Glue Dispense)	1. 可程式自動偵測Housing高度並塗佈均匀 2. 可程式設定各區間之塗佈速度以符合不同設計之Housing	
真空灌膠製程 (Vacuum Gel Potting)	 灌注面積33mmx40mm,一次生產32pcs,不會有Void 膠量控制可在+/-0.17g内 	

IGBT標準模組產品全自動Pick & Place測試技術

New Test Technology		
靜態測試技術 (Static Tests Technology)	測試電壓能力:3KV;電流能力:600A	
動態測試技術 (Dynamic Tests Technology)	VD 電壓能力10V~1200V: ID電流能力20A~1200A	

B. 開發成功之新技術

封裝技術

	Advanced Technology
	1. 2.5維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(2.5D TSV Stacking)
	2. 3維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(3DTSV Stacking)
	3. 整合被動元件封裝技術(Integrated Passive Device)
3D系統封裝	4. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology)
(3D SiP)	5. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology)
	6. 65奈米SRAM晶圓穿孔功能驗證(65 nm SRAMTSV Qualification)
	7. 分段式屏蔽技術(Compartment Shielding Technology)
	8. 選擇性區域封膠技術(Selective Molding Solution)
無線通訊模組	
(Wireless Communication	1. 電磁屏蔽線層技術(EMI Conformal Shielding)
Module)	2. 雙面模組封裝結構技術(Double Sided molding SiP Module)
V=++#	1. 微型投影機顯示器功能驗證(Pico Projector Microdisplay Qualification)
光電封裝	2. 高深寬比晶圓穿孔電鍍技術(High Aspect Ratio TSV Plating Technology)
(OEP)	3. 低成本矽晶圓穿孔技術(Low Cost TSV Technology)
	1. FC PoP雷射燒結技術(FC PoP w/ Laser Ablation Technology)
	2. 雙面RDL電鍍厚銅技術(Double-sided Thick Cu Plated RDL Technology)
	3. 矽材基板内埋主動元件技術(Embedded Active Si Substrate)
	4. 200mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(50 um Wafer CMP Grind Technology for 200mm TSV Wafer)
	5. 200mm穿導孔晶圓50微米厚度分離載具技術(50 um Wafer Carrier Release Technology for 200mmTSV Wafer)
晶圓級封裝	6. 大尺寸(8x8毫米)晶圓級晶片尺寸封裝之可靠度研究與優化
(WLCSP)	7. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程疊層技術開發(RDL LF Bump)
	8. 線路重佈製程和銅柱製程疊層技術開發(RD Cu pillar)
	9. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL)
	10. 薄片晶背貼合能力技術開發(Advanced BSL)
	11. 降低切割製程風險技術開發(Advanced Laser Dicing)
	1. 微間距非導電覆晶薄膜底材(Fine Pitch NCF Under-Fill Technology)
	2. 28奈米超低介電係數晶圓, 40 um Bump Pitch之覆晶封裝(40 um Pitch FC Solution for 28 nm ELK Wafer)
	3. 300mm晶圓50微米厚度研磨技術(300mm Wafer 50um Backgrind Technology)
覆晶封裝	4. 壓合式晶圓級覆晶封裝技術(Laminated FC CSP)
(Flip Chip)	5. 28奈米超低介電系數晶圓與基板內埋式線路封裝產品(28nm Wafer Tech with Embedded Pattern Plating)
	6. 高頻寬層疊封裝技術
	7. 晶圓級覆晶封裝產品凸塊間距細微化結構發展研究計畫
	8. 2.5D先進封裝製程(2.5D Advanced IC Assembly)
	1. 20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(20 nm Ultra Low K Cu Wafer Wire Bond Package)
	2. 18微米線徑銅線打線封裝技術(18 um Cu Wire Bond Technology)
20/4	3. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding)
銲線封裝	4. 銅銲線封裝技術(Cu Wire Bond Packaging Technology)
(Wire Bond Package)	5. 内埋式線路之基板其開發與應用
	6. 高階四方平面無引腳封裝與測試技術
	7. 細微間距銲線技術
緑色封裝	1. QC080000 緑色環保系統認證(QC080000 Green System Certification)
(Green Package)	2. 化學實驗室通過TAF認證(RoHS Certification on Chemical Lab)
-	Bumping
	1. 40微米微間距銅柱凸塊技術(40 um Fine Pitch Cu Pillar Bumping)
電鍍製程	2. 高深寬比銅柱電鍍凸塊技術(High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping Plating)
(Plating)	2. 同床見比剛生电級口%政例(IIgh Aspect Natio Cu Filial Bulliping Flating) 3. 15微米穿導孔填孔技術(15um TSV Filling Plating)
	ייין וווואן דו דו און אַנוראַיאַרפר פּיין אַאַראַר פּיין אַנאַ אַנוראַאַר פּיין אַנאַ אַנוראַאַריאַר פּיין אַנאַ אַנוראַאַריין אַנאַ אַנראַייין אַנאַ אַנראַייין אַנאַ אַנראַייין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַייין אַנראַייין אַנראַייין אַנראַייין אַנראַייין אַנראַייין אַנראַיין אַנראַין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַיין אַנראַין אַיראַין אַנראַין אייין אַנראַין אַנראַין אַנראַין אַייין אַנראַין אַנראַין אַנראַין אַנראַין אַנראַין אַייין אַנראַין אַנראַין אַנראַין אַייין אַנראַין אַנראַין אַנראיין איייין איייין אייייין אַנראיין איייין אַנראיין אייייין אייין אייין איייין אייייין איייין איייין אייייין אי

測試技術

New Test Technology		
晶圓測試 (Wafer Probing)	1. 濕度感測器瓣切帶狀底座測試方法(RHSensor Half Cut Test Method)	
	2. 低成本觸控感應元件測試轉換解決方案(Low Cost Touch Sensor Test Conversion)	
	3. WLCSP RF-Switch 高效率多工通道阻抗量測技術(High Efficiency Parallel Test of Multi-Channels' Resistance of WLCSP RF-	
	Switch)	
	4. 低成本電源管理元件晶圓測試技術(Low Cost PMIC Wafer Probing Testing Technology)	

·	1. 低成本觸控感應元件測試轉換解決方案(Low Cost Touch Sensor Test Conversion)
	2. 微小封裝元件測試技術(Tiny Package Testing Solutions)
	3. 濕度感測器解決方法(RH Sensor Test Solution)
	4. 氣壓感測器測試解決方案(Pressure Sensor Test Solution)
	5. 加速器測試解決方案(G-Sensor Test Solution)
後段測試	6. 光感控制元件測試方案(ALS+Prox.SensorTest Solution)
(Final Testing)	7. 微機電震盪器元件測試方案(MEMS Oscillator)
	8. 802.11ac射頻收發器最佳測試解決方案(Test Optimization of 802.11ac Transceiver)
	9. ADSL類比前端IC之混波多工平行測試技術(Mixed Signal Concurrent Test Solution of ADSL Analog Front End)
	10. 觸控感測試晶片高產出及低成本開斷路測試解決方法(Touch Sensor IC High UPH and Low Cost O/S Test Solution)
	11. 自動學習崁入式元件產生開短路測試程式技術(Auto-Lean Embedded IC & Generate the Open/Short Test Program Technology)
	12. 電源管理元件高產出平行測試方法(PMIC High UPHTest Methodology)

IGBT標準模組封裝製程技術

EMS製程技術 (New Process Technology)		
晶片焊錫組裝	1. 13mm以下晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH	
(Solder Die Bond)	2. 焊錫介面空隙小於3%	
晶片錫線LF焊錫組裝	 1. 5mm以上晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH	
(Soft Solder Die Bond to Lead	1. SITTINA	
Frame)		
晶片銀膠LF組裝	3mm以上晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH	
(Epoxy Die Bond to Lead Frame)	3川川火工用/7)汗洌川上川也社交形/J定向UFロ	
銅打線LF組裝	Sum 銅打線In-Line 組裝能力提高UPH	
(Cu Wire Bonding to Lead Frame)	JOHN MUTACHIO MEASHE/JIKE向OTTI	
相變導熱材料印刷	印刷圖案之間距小於0.6mm	
(PCM Printing)	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	
自動點膠製程	1. 可程式自動偵測Housing高度並塗佈均匀	
(Automation Glue Dispense)	2. 可程式設定各區間之塗佈速度以符合不同設計之Housing	
真空灌膠製程	1. 灌注面積33mmx40mm,一次生產32pcs,不會有Void	
(Vacuum Gel Potting)	2. 膠量控制可在+/-0.17g内	

IGBT標準模組產品全自動Pick &Place測試技術

New Test Technology		
靜態測試技術	測試電壓能力:3KV:電流能力:600A	
(Static Tests Technology)	州叫电座比/J・5NV・电川比/J・000A	
動態測試技術		
(Dynamic Tests Technology)	VD 電壓能力10V~1200V : ID電流能力20A~1200A	

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期計畫

- 鞏固既有客戶,並爭取更多IDM客戶
- 落實集團生產策略,取得最具優勢之配置
- 争取高階封裝訂單,提昇實質獲利
- 提昇資源運用率並減少資源耗用與浪費
- 提昇環保產品之生產技術,加速產品轉換速度,以提昇市場機會
- 藉由試製開發達到量產

2. 長期計畫

- 整合集團資源,提供客戶更趨完整之服務
- 改善成本結構,提供客戶更具競爭力之價格
- 落實客戶區隔,強化客戶滿意擴大整體生產規模,追求成本優勢,讓價格更具競爭力
- 確保技術領先以提高市佔率

二、市場及產銷槪況

(一) 市場分析

1. 一〇四年度本公司主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

銷售地區	銷售金額	%
美國	205,730,670	72.62
台灣	32,631,149	11.52
圖文洲	20,577,069	7.26
亞洲及其他	24,363,648	8.60
合計	283,302,536	100.00

2. 全球五大主要封測廠-半導體委外封測服務市占率2014-2015

	市場占有率(%)(以半導體營收計算)		
全球五大封測廠(註)	2014年	2015年	
ASE	19.1	18.7	
AmkorTechnology	11.5	11.3	
SPIL	10.1	10.2	
Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET)	3.6	6.6	
Powertech Technology	4.9	5.2	

資料來源: 本公司根據Gartner 研究報告自行製表: Market Share: Semiconductor Assembly and Test Services, Worldwide, 2015 Published: 12 April 2016, Analyst(s): Maria Valenzuela, Jim Walker and Masatsune Yamaji.

The Gartner Report(s) described herein, (the "Gartner Report(s)") represent(s) data, research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Each Gartner Report speaks as of its original publication date (and not as of the date of this Annual Report) and the opinions expressed in the Gartner Report(s) are subject to change without notice.

註:依照Gartner對全球半導體委外封測業者營收之估算, Amkor之2014年及2015年營收數字,皆未包含J-Devices。而JCET之2015年營收數字,則包含STATS ChipPAC 2015年8~12 月之營收。

2015年全球半導體整體委外封測服務市場受到景氣影響,營收呈小幅衰退。ASE市場占有率略為下滑至18.7%,但仍位居於龍頭地位。Amkor維持排名第二,其市場占有率約為11.3%,然市場預期Amkor將在正式合併J-Devices後,縮小與前一名的差距。矽品在2015年仍位居第三,其占有率約為10.2%。JCET則因於2015年8月完成STATS ChipPAC之合併,取得6.6%市占率,而進入排行第四名。力成則以5.2%占有率,位居全球第五名。面對競爭對手採取整併收購方式擴大市佔規模,本公司將持續致力開發各種先進製程及強化本身封測實力並結合系統級封測能力,在技術上將可再拉大與競爭者的差距。當前封裝技術發展趨勢主要配合電子元件朝高密度、高I/O數、低操作功率、表面元件模組化、複合結構化等方向發展,使封裝技術朝高集積化、多腳/細微化、薄型化、多晶模組封裝化及低成本方向進行,包括因應腳數增加的細間距銲線技術、覆晶封裝、2.5D & 3D堆疊式封裝、晶圓級構裝、多晶模組(Multi-chip Module, MCM)、系統整合型封裝(SiP)技術、銅製程以及晶圓穿導孔(TSV)技術等。有鑒於產業對高階封測產能的需求不斷成長,本集團過去在技術與產能的投資已為這成長趨勢作好準備。展望未來,我們將持續製程的精進,同時致力於提昇獲利率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

根據Gartner¹ 近期的研究報告 "Forecast: Semiconductor Assembly and Testing Services, Worldwide, 4Q15 Update",2015年封裝及測試市場,因受全球景氣影響,整體規模51,347.1百萬美元,較2014年下跌3.5%,預估2016年可微幅成長至52,292.2百萬美元,預測2019年整體營收提升至61,742百萬美元。其中,IDM封裝及測試整體規模2015年達24,912.6百萬美元,佔封裝及測試市場整體規模比率為48.5%,預估2016年營收為25,118.2百萬美元,預測2019年將提升至28,676.9百萬美元,佔市場整體規模比率降為46.4%。專業代工封裝及測試市場規模(SATS)方面,封裝及測試市場整體規模2015年達26,434.5百萬美元,佔封裝及測試市場整體規模比率為51.5%,預估2016年將小幅上升至27,174

¹ Source: Forecast: Semiconductor Assembly and Test Services, Worldwide, 4Q15 Update, Published: 17 December 2015, Analyst(s): Jim Walker, Maria Valenzuela and Barbara Van.Source: Forecast: Semiconductor Assembly and Test Services, Worldwide, 4Q15 Update, Published: December 2015, A

The Gartner Report(s) described herein, (the "Gartner Report(s)") represent(s) data, research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Each Gartner Report speaks as of its original publication date (and not as of the date of this Annual Report) and the opinions expressed in the Gartner Report(s) are subject to change without notice.

百萬美元,預測2019年將持續提升至33,065百萬美元,佔市場整體規模比率將高達53.6%。由此數據顯示,國際性IDM廠的封裝及測試委外代工的比率正逐年增加,主要影響因素為消費性電子化所帶來的產品多樣化,使得客製化的封測設計越來越複雜:系統電路板微縮的速度無法與越來越精細的製程同步,而兩者之間僅能靠封裝技術做為橋樑:再加上封裝與測試技術成本及技術層次越來越高,促使封測研發費用隨著上升,因此晶片製造商為了降低成本,更加使得封測外包需求逐漸增加。同時也突顯出IDM大廠越來越不可能自行投入高階封測設備,委外代工趨勢勢必越來越明顯。

全球封裝營收市場預測(美金百萬元)2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
IDM封裝及測試市場規模*	24,912.6	25,118.2	25,955.1	27,231.4	28,676.9
IDM封裝市場規模	19,863.7	19,992.2	20,566.9	21,676.7	22,828.3
IDM測試市場規模	5,048.9	5,126.0	5,388.2	5,554.7	5,848.6
專業代工封測市場規模 (SATS)	26,434.5	27,174.0	28,948.1	31,126.3	33,065.0
專業代工封裝市場規模	20,638.7	21,074.1	22,398.0	24,210.6	25,790.7
專業代工測試市場規模	5,795.8	6,099.9	6,550.1	6,915.7	7,274.3
全球封裝及測試市場整體規模	51,347.1	52,292.2	54,903.2	58,357.7	61,742.0
封裝及測試市場整體規模成長率	-3.5%	1.8%	5.0%	6.3%	5.8%
全球封裝市場整體規模	40,502.4	41,066.3	42,964.9	45,887.3	48,619.0
專業代工比率(封裝)	51.0%	51.3%	52.1%	52.8%	53.0%
全球測試市場整體規模	10,844.7	11,225.9	11,938.3	12,470.4	13,122.9
專業代工比率(測試)	53.4%	54.3%	54.9%	55.5%	55.4%
專業代工比率(封裝及測試)	51.5%	52.0%	52.7%	53.3%	53.6%
專業代工市場成長率	-2.6%	2.8%	6.5%	7.5%	6.2%

^{*} Equivalent market value if 100% of IDM/OEM in-house packaging and test were outsourced

Note: Numbers may not add to totals shown because of rounding.

Source: Gartner (December 2015)

此外,近年來隨著工業電器電子技術及數據產業的發展,以及分布式供電系統的推廣。工業電器DC-DC轉換器的應用越來越廣,面對新世代的電子器件和負載,電源業要面對重大的挑戰,產品除了能在工業電器低電壓輸出大電流外,還要做到體積小、重量輕、動態反應快,噪聲小和價錢相宜。

DC-DC轉換器模組市場之發展驅力與DC-DC轉換器IC市場不同。前者為中高功率工業應用,如工具機。後者為低功率消費性產品應用。此兩種產品有其個別之應用範圍,全球DC-DC轉換器模組市場預計於2016年將可達43億美金規模。

IGBT下游應用領域非常廣闊,從IGBT的耐壓範圍上來分,600V-1200V的IGBT主要用於電磁爐、壓縮機、馬達、變頻家電等產品,現階段這部分市場的IGBT用量最大:低於600V的IGBT主要用於數位相機閃光燈和汽車點火器上:電壓大於1200V的IGBT主要以1700V的IGBT為主,這部分產品主要用在高壓變頻器等工業產品上。

未來推動IGBT市場增長的最主要領域是變頻器、變頻家電、軌道交通產業、太陽能及風能可再生能源、混合動力車和純電動車。

變頻器產業:變頻器對電機轉速和轉矩進行實時調節,由此可以節約不必要的能源浪費。應用變頻器的電動機節能效果明顯,一般節能率在20%-30%,較高的可以超過50%,節能潛力巨大。由於變頻器廣泛應用到機械、油氣鑽採、冶金、石化、電力和市政等領域,具有廣泛的下遊應用需求,未來市場將有望保持持續增長,其中,我們預計高壓變頻器未來三年將保持40%以上的增速,而中低壓變頻器未來三年也將保持20%以上的增速。變頻器市場快速的增長,將保證作為變頻器主要原材料的IGBT的需求快速增長。

4. 競爭利基

2016年整體市場將會有小幅下滑的趨勢,本集團在此同時也更重視内部營運機制,也更著重於提升技術開發能力,期許在全球性經濟景氣循環中再創佳績,我們所依賴之各項競爭優勢分析如下:

A. 持續技術研發, 高階產品技術及品質居領導地位

隨著半導體專業代工產業鏈模式,日月光也跟著台積電、聯電等主要晶圓代工不斷往高階產品研發,在技術上能夠日月精進,創造多贏之局面。為了因應產品應用的功能越趨繁多、尺寸越來越小及最佳成本效益等市場需求,本公司在高階封測技術2.5D & 3D IC 、 SiP、CSP、Flip Chip、Bumping、Optical Package及WLP等領域研究多有著墨。

在原有技術精進及先進產品研發方向,本集團每年提撥3~5%的營收在技術研發上,每年獲得超過百項專利,期許保持產業之領先地位及競爭優勢,除了在市佔率領先業界,也必須在技術研發上維持領先同業。

B. 積極佈局, 適時掌握IDM大廠委外代工之商機

目前國際性IDM大廠為維持半導體經營之效率,降低成本,必須朝向Fab Lite型態發展,奠定委外代工比例增加的趨勢。本集團為迎合不斷升溫的半導體委外代工趨勢,多年來的營運策略更為積極,西進大陸佈局,接近客戶,接近市場,以爭取潛在商機。所有的國際大廠都想在中國大陸佔有一席之地,又無法找到較具規模的合作夥伴。如今本公司的佈局,將可能使更多大廠陸續將封測業務外包,不僅不會影響到台灣的基礎,還將帶進更多的商機。

5. 發展遠景之有利/不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 市場對新產品、新技術的需求逐漸增加,對一向在研發創新具備優勢的本公司而言是一大利多機會。
- IDM廠商的經營趨勢,持續釋出封測訂單,未來將持續帶給IC封裝測試產業更大的發揮空間與更多商機。
- 因應未來產品輕薄短小、高性能及高效率的需求,2.5D & 3D IC是非常重要的技術,而本公司早在幾年前已投入非常多的資源進行研發,相關的封裝技術更是領先同業。
- 身為台灣擁有基板產線的封測廠,擁有高階基板穩健的製造能力,不但可掌握高階封裝材料之關鍵,更可有效降低IC的整體製造成本,提高獲利能力。
- 除傳統之BGA、QFP、QFN封裝產品外,更多高階產品如晶片組、繪圖晶片、光電產品、無線通訊模組等相關晶片,以及潛在顧客等皆具有更大更深之市場可供開發。
- 未來幾年中國大陸對積體電路的需求仍會有大幅成長,基於群聚效應、供應鏈原則,本公司已在地理位置及資源運用方面之佈局作好準備,迎接這波成長及搶先商機。
- 卓越的研發技術:卓越的研發技術攸關高科技公司未來之發展,有鑑於此,本公司致力於研發人員之培育,引進先 進技術並累積多年經驗,使其研發成果符合客戶的期許;本公司並已取得ISO 9001 品質系統認證及美國軍規認證 (MIL-PRF-38534)。
- 管理系統完善:本公司從訂單處理、物料管理、生產管制、現場管理、倉儲系統、出貨作業皆已納入電腦化管理, 充分掌握各項製程數據,並大量採用自動化設備來提升產量,降低生產成本,增加產品競爭力。

(2) 不利因素

- 本土同業競爭者對爭取本公司的客戶相當積極:另外,競爭者的聯盟機制亦有可能對本公司產生影響。
- 新技術的門檻逐漸下降,競爭者的模仿能力逐漸提升且產品的獲利週期逐漸縮短,對一向以技術取得優勢的本公司 是一項外在威脅:由於新技術的研發需投入大量的資金與人力,因此在後續價格上的變動彈性相對較弱,在微利時 代下,實為一項挑戰。
- 客戶端對於IC後段封裝、測試之要求水準日益嚴苛,本公司業務成長如要有顯著的表現就必須超越競爭對手及客戶的期待。
- 半導體後段的封裝、測試屬高資本密集產業,因而受到半導體市場景氣影響甚巨,營運的優劣易受景氣所影響;IC 封裝與測試產業需審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃,以彈性因應景氣繁榮時所帶來大量的訂單 以及不景氣時訂單減少的衝擊。
- 功率電子領域主要負責DC-DC轉換、AC-DC轉換、電機驅動等工作,需要更輕更小更高效率更便宜,目前 有4種技術來對應這些要求,分別是SiliconIGBT、SuperJunction(SJ)MOSFETs、GalliumNitride(GaN) and SiliconCarbide(SiC)-baseddevices.
- GaN和SiC對功率電子市場來說還不成熟,前者要求在製造技術上做技術改進,特別是外延厚度;而後者,目前是一種品貴的材料,不適合在消費類市場使用。故於2015年之前IGBT還是主流。
- 由於大量熱錢進入市場,也促成不少GaN新進業者冒出頭來搶市,積極切入市場。一般來說,發展與測試一種新半導體材料的時間相當長,但隨著世界各地大廠紛紛投入,很有可能在未來2~3年內就大量出現商用化的GaN產品。
- IGBT功率芯片模組競爭者多且競爭激烈,易形成削價競爭,毛利日益薄利化的趨勢。為減緩因競爭增加所造成公司 獲利下滑的影響,首要增加合作客戶分散風險,並加強成本控制及擴大生產經濟規模為當務之策。

(3) 因應對策

- 利用整合優勢以提供一元化服務、整合集團資源、技術互享以創造更多附加價值及更大的經濟效益,強化競爭優勢以爭取未來市場蓬勃時更多商機。
- 藉由本公司特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線,滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 穩健的財務結構對於發展新技術、新產品所需的資金提供穩定及充足的資源。
- 利用技術優勢改進設計缺失,建立最佳化製程,提升製程穩定性,強化本公司在成本和品質方面的競爭力,爭取最大的市場契機。
- 憑藉本公司先進技術的優勢、資本優勢、資源整合優勢來深耕現有客戶以及爭取更多潛在客源,擴大業務版圖。
- 確切發揮跨廠區先進技術交流及跨部門協調之功能,提高綜效。
- 本公司在材料、封裝、測試及系統方面的垂直整合及橫向鏈結合作,除可鞏固競爭力、提供更完善的服務外,更具備最佳彈性以隨時調整與迎接外在多變的挑戰。
- 持續強化技術優勢,依客戶不同特性提供與滿足客戶多元的需求,提升服務品質的競爭力,同時建立專利防護網, 鞏固競爭利基。
- 提升客戶對本公司一元化服務的訂單比例,加快解決方案整合速度,以最完整的架構提供客戶最快速與滿意的服 務。
- 客製化之行銷服務系統,加強與客戶間策略聯盟之依存關係,以公司現有的研發實力、產品產銷開拓能力,積極架構更具競爭優勢的產、銷、研專業分工之供應鏈體,使公司常保產業關鍵優勢之地位。
- 積極透過製程及設計之改良來提昇品質,滿足客戶多樣化需求,縮短交期,提昇產品競爭力,同時對新市場之客戶 積極開發。
- 除持續深耕於功率芯片模組封裝測試開發,並堅持以高標之技術及產品品質構築同業競爭門檻,以長駐優勢並維持 獲利。
- 供應商(鏈)管理的改善規劃與落實,希望藉由整合上、下游產業價值鏈和合作廠商共同分攤資訊成本,以達成利益 共享,利潤分享,來降低相關產銷成本,提升產品競價力。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途:

封裝技術

主要產品	重要用途
● 塑膠立體型積體電路(PDIP)	• 主要用途在於家電用品、通訊設備、汽車元件、飛機、武器和太空梭等電腦遙控資訊系統、導航
	設備。
● 塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC)	• 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、智慧手機、平板電腦、智慧型手持
• 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP)	式裝置等。
• 凸塊晶片承載器積體電路(BCC)	● 無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。
• 覆晶(Flip Chip)封裝技術	● 個人電腦與筆記型電腦等。
• 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路 (LQFP、TQFP)	● 電視遊樂器、DVD、機上盒等。
• 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA)	● 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與智慧手機、智慧型手持式
• 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、 HFC BGA)	裝置等。
• 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA)	● 電腦—繪圖/晶片卡、雲端運算伺服器、PCS & 伺服器微處理器、電壓調節器、快速記憶卡、硬
• 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA)	碟等週邊產品。
• 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA)	● 網路通訊產品一廣域(WAN)與區域網路(LAN)伺服器、轉換器、交換器、路由器、蜂巢式基地台。
 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) 	● 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、數位電視機上盒、PDA、MID。
● 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路(HSBGA)	其他產品一自動汽車元件、Telematics。
• 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN)	
• 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP)	
• 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ)	• 主要用途在於記憶體積體電路。
• 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP)	● 個人電腦與週邊裝備等。
晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	• 主要用途在於記憶體積體電路。

主要產品	重要用途
立體式晶片模組承載器積體電路(3D Package)	• 主要用途在於各種可移動式的資訊產品,例如:手機、PDA、數位相機等。
• 立體式晶片模組承載器積體電路(2.5D Package)	• 主要用途在於高階與雲端運算伺服器,例如:圖形處理器、網路處理器等。
• 晶片堆疊式球狀陣格承載器積體電路(Stacked BGA)	• 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。
多晶片模組球狀陣格承載器積體電路(MCM BGA)	
晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Level CSP)	• 主要應用手機、PDA、數位相機等。
• 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP)	• 主要應用手機、NB、數位相機等。
• 晶圓穿導孔技術(TSV Technology)	• 主要應用手機、NB/Network、數位相機等。
• 整合被動元件(IPD)	• 主要應用穿戴式/可攜式消費性電子,NB/IOT
	• 主要應用在可攜式消費電子。
● 晶圓級微機電(Wafer level MEMS)	• 主要應用在手機、NB、Network Server。
• 微間距晶片堆疊系統技術(Fine Pitch 3D Chip Stacking	• 主要應用在可攜式消費電子。
Technology)	• 主要應用在NB、Server、生醫照護。
異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP)	• 主要應用在手機、Game Console遊戲機。
• 微間距面對面堆疊系統封裝(Fine Pitch CoC SiP Solution)	• 主要應用在可攜式消費電子。
• 基板内埋主、被動元件技術(Embedded Active / Passive	
Substrate)	
• 電子羅盤磁感應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor	
Package)	
● 微機電型微顯示器(MEMS-based Micro Display)	• 主要應用在投影機 (Projector)、高解析數位電視(HDTV)。
• 安控感測元件	• 主要應用在個人電腦、筆記型電腦、網路商業等安全辨識裝置。
• DDR2 800 記憶體(DDR2 800 Memory)	• 主要應用在3C產品之記憶體。
 外引腳式Map PoP堆疊技術(Fan-out Map PoP Technology) 	• 主要應用在3C產品之系統封裝產品(ASIC + MCP Memory、BB+SDRAM)。
• 外引腳式WLP (Fan-out WLP)	• 主要應用在可攜式消費電子。
• 無線通訊模組(Wireless Connectivity SiP Module)	• 主要應用在3C產品之無線通訊模組包括BT、WiFi、GPS、DVB-H/T。
• 無線通訊模組(Wireless Communication SiP Module)	• 主要應用在筆記型電腦、個人平板、網通產品、IoT工業產品裝置之通訊應用。
• 光通訊模組	• 主要應用在光收發模組、雲端伺服器、資料中心及高速運算伺服器之通訊應用。

測試技術

主要產品	重要用途
● 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP)	• 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、手持式通訊模組、晶片組等。
• 凸塊晶片承載器積體電路(BCC)	• 無線通訊網路、數位相機、資訊家電、液晶電視與智慧型行動電話等。
• 覆晶(Flip Chip)封裝技術	● 個人電腦與筆記型電腦等。
● 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路 (LQFP、TQFP)	● 電視遊樂器、DVD、機上盒等。
● 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA)	● 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、數位相機、資訊家電與智慧型行動電話等。
● 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA)	● 手機晶片組、MP3 Processor。
● 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA)	● 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、機上盒、PDA、MID。
● 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA)	● 智慧型手機。
● 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA)	● 穿戴式隨身產品。
● 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP)	● 平板電腦。
● 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路(HSBGA)	健康管理系統,醫療應用。
● 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN)	● 商務應用、IoT 物聯網相關產品。
● 進階陣格扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(aQFN)	● 車用安全系統。
● 單層基板(Advance Single Sided Substrate)	● 工業感測元件。
• 系統級封裝(System In Package)	
• 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ)	• 主要用途在於記憶體積體電路。
● 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP)	● 個人電腦與週邊裝備等。
晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	Power Management IC & Portable Device

電子構裝應用

主要產品	重要用途
DC/DC Converter Module	• 用於軍事用途的航空器或載具上之電力系統,對於產品品質及可靠度上有較高的要求;產製
• IGBT、IPM標準模組封裝	過程則以Die bond & Wire bond之電子構裝應用為主。
	• 用於電動車,智能家電產業,產製過程則以SMT、Die Bond、Wire Bond、PressFIT
	Insertion及灌膠之封裝技術為主。

2. 產製過程:

封裝技術

• 釘架類產品:

晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→外腳成型→外觀檢驗→包裝

• 球陣列類產品:

晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→植錫球→切割成型→外觀檢驗→包裝

• 覆晶類產品:

晶圓凸塊→晶圓切割→覆晶式粘晶粒→底膠充填→正印→植錫球→外觀檢驗→包裝

• 晶圓穿導孔類產品:

晶圓穿導孔→穿導孔絶緣層→穿導孔銅電鍍充填→穿孔晶圓薄化→雙面佈銅導線→植錫球→堆疊→外觀檢驗→包裝

無線通訊模組 (Wireless Connectivity SiP Module):

錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→封膠製程→雷射正印→切割成型→抗電磁鍍膜→外觀檢驗→包裝

測試技術

• 釘架類產品/球陣列類產品:

IC測試→產品老化測試(依客戶需求)→烘烤→產品外觀檢驗→捲帶包裝→成品包裝

• 高頻模組產品/電源管理模組產品:

測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

電子構裝應用

• DC/DC converter模組

材料準備→錫膏/銀膠印刷→晶片黏著→基片黏著(回銲)→打線→零件置放→手銲→清洗→雷射修整→上蓋材料準備→外 觀檢驗→銲封→高低溫循環→離心測試→異物測試→功能測試→燒機→浸錫→包裝出貨

• IGBT標準模組

材料準備→晶片貼合→晶片切割→錫膏印刷(Reflow)→晶粒置放→零件置放(Soldering)→真空回銲→清洗→打線→中間 測試→插端子Preparation →外蓋組裝→烘烤→注膠→烘烤→最後測試Detection (PIND) TEST →散熱膏印刷→烘烤→包 裝出貨

• IPM標準模組

材料準備→晶片貼合→晶片切割→晶粒置放(Solder Die)→晶粒置放(Epoxy Die)→烘烤→銅打線→灌膠→烘烤→最後測試→烘烤→包裝出貨

(三)主要原料之供應狀況

本公司係代客封裝之半導體製造業,主要晶圓由客戶提供,客戶大都為國際知名半導體公司,長期與本公司保持良好的業務關係。

主要封裝材料如: 釘架、基板、金線、銅線、膠餅等,供應商皆為本公司品管審查合格之績優廠商,尤其基板的主要供應來源為子公司日月光半導體(上海)有限公司(ASEMTLSH)及日月光電子(股)公司(ASEE),使得材料的取得可完全掌握。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	ASEMTLSH/ ASEE /A公司/B公司/C公司	供需平衡	長期配合廠商
釘架 Lead Frame	D公司/E公司/F公司	供需平衡	長期配合廠商
金線 Gold Wire	G公司/H公司/I公司	供需平衡	長期配合廠商
銅線 Copper Wire	J公司/I公司	供需平衡	長期配合廠商
膠餅 Compound	D公司/K公司/L公司	供需平衡	長期配合廠商

南投分公司係代客組裝之電子產品製造業,90%以上的材料均由客戶提供,主要客戶為M公司、N公司及O公司,長期與本公司保持良好的業務關係。

- M公司主要組裝材料如下:
- 1.90%以上主要材料:金屬封裝盒、基板、DICE、CHIP C、CHIP R等材料由客戶提供,物料供應則為客戶直接供應,使得材料的交期及品質可完全掌握。
- 2. 10%自購料:膠材、包裝材料、金線,金額由本公司視客戶訂單需求採購。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	客戶自製	良好	由客戶自行備料
金屬盒Metal Package	M公司	良好	由客戶自行備料
DICE	M公司	良好	由客戶自行備料
CHIP C \ CHIP R	M公司	良好	由客戶自行備料

• N公司主要組裝材料如下:

99%以上主要材料: 基板、LCP substrate、 Flex PCB、膠材、塑膠件等材料均由客戶直接供應,使得材料的交期及品質可完全掌握。包材部份由本公司視客戶需求購買。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板LCP Substrate	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
膠材Die Attach Film	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
DICE	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
Flex PCB	N公司	供需平衡	由客戶自行備料
Plastic Parts	N公司	供需平衡	由客戶自行備料

- O公司主要組裝材料如下:
- 1. 20%以上主要材料:晶圓包括DICE、CHIP、IGBT材料由客戶直接供應,使得材料的交期及品質可完全掌握。
- 2.80%自購料:陶瓷基板、塑膠殼、金屬端子、銅柱、錫膏、膠材、鋁線、包裝材料,供應商乃客戶指定,由本公司視客戶訂單需求採購。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
晶圓 Wafer	0公司	良好	由客戶自行備料
陶瓷基板 DBC	P公司	良好	長期配合廠商
塑膠殼Case	Q公司	良好	長期配合廠商
鋁線Al wire	R公司	良好	長期配合廠商
膠材Silicone gel	S公司	良好	長期配合廠商

(四)最近二年度任一年度曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 佔銷貨百分之十以上之客戶名稱

單位:新台幣仟元

	104年度					103年度			
排名	名稱	金額	佔全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人之關係	
1	甲公司	88,311,697	31.2	無	甲公司	54,431,222	21.2	無	
	其他	194,990,839	68.8		其他	202,160,225	78.8		
	銷貨淨額	283,302,536	100.0		銷貨淨額	256,591,447	100.0		

增減變動原因:銷貨金額與比率變動主要隨客戶市佔率變化而異。

2. 佔進貨百分之十以上之進貨廠商

單位:新台幣仟元

	104年度					103年度		
排名	名稱	金額	佔全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人之關係	與發行人之關係 名稱		佔全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人之關係
1	AA公司	22,842,407	14.5	無	AA公司	16,360,849	11.9	無
	其他	135,158,159	85.5		其他	120,563,319	88.1	
	進貨淨額	158,000,566	100.0		進貨淨額	136,924,168	100.0	

(五)最近二年度生產量值表

單位:仟個/新台幣仟元

年度	104年度			103年度		
生產量值主要商品	產能	產量	產値	產能	產量	產値
先進封裝及積體電路	36,603,997	27,604,076	76,764,334	32,937,997	28,656,057	78,903,847
測試服務(註1)	-	-	15,495,568	-	_	15,772,864
電子產品構裝技術暨製造服務	708,773	595,142	128,007,739	500,805	465,749	95,882,672
其他(註2)	_	-	12,899,667	_	_	12,443,535
合計	37,312,730	28,199,218	233,167,308	33,438,802	29,121,806	203,002,918

註1:係以測試時間為計價基礎,故擬不揭露數量。

註2:因數量單位不一致,亦不揭露數量。

(六)最近二年度銷售量值表

單位:仟個/新台幣仟元

							- 市瓜・	
年度	104年度					103	年度	
銷售量値	内 銷		外 銷		内 銷		外 銷	
主要商品	量	値		値	量	値	旱	値
先進封裝及積體電路打線服務	4,494,130	22,859,220	23,109,946	80,876,366	5,370,470	24,917,658	23,285,587	83,466,747
測試服務(註1)	_	1,650,805	ı	22,485,594	_	1,684,804	П	23,431,222
電子產品構裝技術暨製造服務	56,610	7,350,445	538,532	129,996,914	63,882	9,083,466	401,867	95,820,989
其他(註2)	_	770,679	-	17,312,513	_	1,061,771	-	17,124,790
合計	4,550,740	32,631,149	23,648,478	250,671,387	5,434,352	36,747,699	23,687,454	219,843,748

三、從業員工資料

(一)組織

本集團基於能維持有利的競爭市場,培育優秀的工程人力資源,健全集團組織職能制度、確定組織功能及培養職務生涯等 是刻不容緩的首要策略。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料:

年度		103年度	104年度	105年2月29日
	技術職人員	16,420	17,198	16,732
	管理職人員	3,496	3,698	3,686
員工人數	事務職人員	6,008	6,201	6,764
	作業員	42,176	38,692	37,431
	合計	68,100	65,789	64,613
平均年歲		30.6	31.1	32.0
平均服務年資		4.8	5.2	5.4
	博士	0.2	0.2	0.2
	碩士	7.0	6.8	6.9
學歷分布比率	大專	44.9	46.3	46.9
	高中	40.1	38.9	37.2
	高中以下	7.8	7.8	8.8

四、環保支出資訊

- (一)說明最近年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額、未來因應對策及可能之支出。
 - 105年度:截至年報刊印日止,本公司無重大環境污染事件發生。
 - 104年度:

A.高雄總公司

高雄K8廠:

於104年12月14日因高雄市政府環保局於104年11月10日依違反水汙染防治法第21條第2項之規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣1萬元整。未來因應對策:建立專責人員系統管制,確保人員離職或勞保異動皆能即時掌握。

高雄K11廠

於105年2月26日因高雄市政府環保局於104年12月18日依違反毒性化學物質許可登記核可管理辦法第8條第2項之規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣6萬元整。未來因應對策:建立基本資料確認標準化流程,並透過系統管制,確保基本資料異動皆能即時掌握及辦理。

B.中壢分公司

中壢分公司:

於104年9月4日因桃園縣政府環保局於104年9月3日函文,封測五廠因依違反廢棄物清理法第31條第1項第一款規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣1萬元整。未來因應對策: 1. 將水措水量重新調整。2. 廢棄物清理計畫書依水措水量進行變更作業。

於104年9月4日因桃園縣政府環保局於104年9月3日函文,封測六廠因依違反廢棄物清理法第31條第1項第一款規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣1萬元整。未來因應對策:1. 將水措水量重新調整。2. 廢棄物清理計畫書依水措水量進行變更作業。

於104年11月24日因桃園縣政府環保局於104年11月23日函文,依違反廢棄物清理法第38條第1項規定,茲依法裁罰罰鍰新臺幣6萬元整。未來因應對策: 1. 與客戶溝通本國報廢品處理方式。2. 所有須返還客戶之報廢品,皆以defect IC/wafer名稱出貨,不再破壞。

104年度處分之總額計15萬元。

(二) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來年度預計之重大環保資本支出。 $^{\circ}$

• 南投分公司:為承租「環鴻科技股份有限公司」4樓及1樓局部區域,污染防治等相關設備皆使用環鴻科技之設施,南投分公司並無自設相關污染防制設備,因此並無重大環保設備等維護、保養費用支出。

項目	一〇五年度	一〇六年度
擬採行改善措施部分		
擬採行改善措施部分 (1) 改善計劃	1. ISO14001環境管理系統持續驗證 2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作,進行溫室氣體減量 3. 推動本公司產品生態化設計(eco-design) 4. 持續推行 ISO 50001 能源管理系統 5. 持續推行產品碳足跡及水足跡之盤查及查證 6. 結合台灣永續創新論壇,持續致力推動本公司永續發展 7. 持續推動搭乘大衆捷運系統減少耗能與CO2減量 8. 節能產品導入與節能工程改善 9. 廢水防治設備清理與改善,並強化廢水回收量與效益 10. 提升中水回收廠回收率及回收 11. 廢水處理砂塔、活性碳塔慮料更換 12. 高效率污染防制設施建置 13. 集塵設備應材更換 14. 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量 15. 廢棄物減廢、減量與回收再利用 16. 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 17. 化學品使用量最佳化 18. 周界臭味防範 19. 緊急應變訓練與演練 20. 噪音防制強化 21. 2015年工安環保月活動 22. 新設廢棄洗滌塔 23. 新設集塵機 24. 既設高級氧化處理設備保養 25. 考量新設空汙防制最佳可行處理設備 26. 既設沸石轉輸設備保養 27. 新設製程廢水回收系統	1. ISO14001環境管理系統持續驗證 2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作,進行溫室氣體減量 3. 推動本公司產品生態化設計(eco-design) 4. 持續推行 ISO 50001 能源管理系統 5. 持續推行產品碳足跡及水足跡之盤查及查證 6. 結合台灣永續創新論壇,持續致力推動本公司永續發展 7. 持續推動搭乘大衆捷運系統減少耗能與CO2減量 8. 節能產品導入與節能工程改善 9. 廢水防治設備清理與改善,並強化廢水回收量與效益 10. 提升中水回収廠回收率及回收 11. 廢水處理砂塔、活性碳塔慮料更換 12. 高效率污染防制設施建置 13. 集塵設備應材更換 14. 廢氣防制設備填充料更換與VOC減量 15. 廢棄物減廢、減量與回收再利用 16. 污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 17. 化學品使用量最佳化 18. 周界臭味防範 19. 緊急應變訓練與演練 20. 噪音防制強化 21. 2016年工安環保月活動 22. 新設廢棄洗滌塔 23. 新設集塵機 24. 既設高級氧化處理設備保養 25. 考量新設空汙防制最佳可行處理設備 26. 既設沸石轉輸設備保養 27. 新設製程廢水回收系統
(2) 未來二年預計環保資本 支出擬購置之污染設備 或支出内容	30. 汙水収集系統 31. 排氣収集系統 32. 污泥減量計劃導入 1. 各部門自發性改善方案推動 2. 廢水/廢氣防治設備新增與改善 3. 低頻噪音防制工程 4. 環保設備流換 5. 週遭環境線美化 6. 廢棄物回收推動及減量設備建置 7. 使用省電燈具及綠色能源導入 8. 能源管理監控系統設置 9. 中水回收系統改善及擴充 10. 廢氣洗滌塔 11. 高級氧化處理設備 12. 既設沸石轉輸設備保養 13. 最佳空汙防制可行處理設備 14. 集塵機 15. 廢水回收、過濾、蒸餾設備 16. 污泥乾燥設備	30. 汙水收集系統 31. 排氣收集系統 32. 污泥減量計劃導入 1. 各部門自發性改善方案推動 2. 廢水廢氣防治設備新增與改善 3. 低頻噪音防制工程 4. 環保設備流換 5. 週遭環境線美化 6. 廢棄物回收推動及減量設備建置 7. 使用省電燈具及綠色能源導入 8. 能源管理監控系統設置 9. 中水回收系統改善及擴充 10. 廢氣洗滌塔 11. 高級氧化處理設備 12. 既設沸石轉輸設備保養 13. 最佳空汙防制可行處理設備 14. 集塵機 15. 廢水回收、過濾、蒸餾設備 16. 污泥乾燥設備

項目	一〇五年度	一〇六年度
	1. 減少耗能與CO2減量	1. 減少耗能與CO2減量
	2. 防範周界臭味	2. 防範周界臭味
	3. 延長設備使用壽命	3. 延長設備使用壽命
預計改善情形	4. 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收	4. 廢水/廢棄物/空污污染減量及資源回收
が	5. 降低周界噪音	5. 降低周界噪音
	6. 減少能源耗用	6. 減少能源耗用
	7. 提昇作業環境舒適度	7. 提昇作業環境舒適度
	8. 水資源回收/減少用水量	8. 水資源回收/減少用水量
	9. 污染預防及監控	9. 污染預防及監控
支出金額	NT\$581,315仟元	NT\$1,242,715仟元
(3) 改善後之影響		
對淨利之影響	約增加NT\$65,335仟元	約增加NT\$101,855仟元
*++++/八-1-b-/	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業
對競爭地位之影響	形象,符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。	形象,符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。
未採取因應對策部分	不適用	不適用

(三)環境與綠色產品政策

環境保護是我們責無旁貸的重要責任,本公司承諾做好環境污染預防、綠色產品設計與製造及持續改善之工作,以響應全球環保運動。

本公司環境政策如下:

- 符合政府環保法規及綠色產品相關法規規定。
- 教育員工,提昇全體員工環境保護及綠色產品意識。
- 在環境保護上,加強廢水、廢氣、廢棄物、噪音、毒化物等對環境的衝擊污染控制、改善,並注重污染預防工作。在綠色產品上,逐步採用綠色設計、綠色材料、綠色製程與生產,減少產品對環境的衝擊,提昇客戶滿意度。
- 節約能源及資源,進行資源回收。
- 在環境保護的相關議題上與大衆及相關團體做密切的溝通與合作。
- 承諾持續改善,確保永續經營。
- 傳達本政策,使大衆和相關團體了解日月光集團於環境保護與綠色產品管理上的企圖心。

(四)安全衛生政策

本公司承諾提供員工一個符合安衛法規的最佳作業場所。

本公司的承諾如下:

- 致力符合適用之安衛法令及公司所簽訂關於安衛危害之其他規章或要求事項。
- 持續改善安衛管理與績效,預防傷害事故與疾病的發生,並且確信災害的損失可經由完善管理系統的運作達到控制。
- 提供完整的教育訓練,以提昇員工的安全知能,並與員工及其代表進行諮詢,以確保安衛管理系統所有的活動可以成功 地運作。
- 分級輔導供應商與承攬商符合安衛法令及相關要求。
- 對所有為組織或代表組織工作的人、大衆及相關團體傳達我們致力於工作環境安全衛生改善的決心。

日月光半導體製造股份有限公司南投廠,對於所提供之產品、活動或服務,除了不斷追求高品質外,為了保護環境及員工安全健康並善盡社會責任,在環安衛管理系統之準則下,公司將以有限資源做最合理之利用,並承諾公司之活動、產品或服務,其性質及規模對環境衝擊及員工安全衛生之危害風險是合宜的,且要求公司每一份子遵守下列行動方案:

- 遵守法令、響應環保 承諾持續遵守政府環境安全衛生法令規章及其他相關規定要求,並響應全球環保運動。
- 危害預防、溝通訓練 持續對員工、供應商、承攬商進行環境安全衛生政策、知識與要求之溝通、參與及諮詢,並進行相關之訓練與演練,以降低安全衛生之危害風險與事件之發生。

- 污染預防、持續改善-致力污染預防、提升產品環境績效,落實持續改善。
- 節能減廢、有效使用-透過節約能源、工業減廢、資源回收,以提高資源之有效使用。
- 建立目標、永續經營-遵照ISO14001 & OHSAS18001之規定,建立環安衛管理系統,以設定及符合環境安全衛生目標 與標的,並審查其績效以達永續經營。

五、勞資關係

(一)員工福利措施

本公司體認勞資一體的關係,於民國105年1月14日業經董事會決議通過預計修訂並擬提請民國105年6月28日股東會決議,除自每年所得盈餘中提撥5.25%~8.25%作為員工酬勞外,另全面改善福利文康設施,舉凡圖書館、社團活動、年度旅遊、文康競賽等,使得全廠員工均有調劑身心的機會,並加強有關員工福利及勞資關係的措施如下:

- 全面改善廠房的安全衛生以保持清潔舒適的環境。
- 定期或不定期勞資溝通會議。
- 成立廠區環境安全衛生委員會。
- 成立福利委員會辦理各項員工福利。
- 自助餐廳及福利社。
- 結婚禮金、喪葬津貼、住院慰問金及獎助學金。
- 完善的退休制度。
- 員工健康檢查。
- 股票及現金紅利。
- 三節福利金發放。
- 員工旅遊及多元商品選購。
- 因公出差員工享有旅行平安保險1,500萬元。
- 國定假日至費供餐。
- 設有職工休閒健身中心。
- 設有員工健康診所及健檢中心。
- 員工認股權憑證。

(二)員工進修及其實施情形

- 員工在職進修取得相關科系學歷者,可參加學歷升級考試,並予以實質調薪鼓勵。
- 提供員工建教合作學校管道,辦理「職訓局」雙軌訓練旗艦計劃。

(三)員工訓練及其實施情形

- 提供新進員工職前引導訓練、專業訓練及新人評鑑。
- 設計與執行主管管理技能訓練與職能發展。
- 設計與執行工程師專業技術訓練。
- 提供在職人員專業技能與第二專長訓練(OJT)。
- 培育公司内部專業講師與訓練師。
- 設計與執行工安環保相關訓練。
- 提供員工參與外訓或研討會。

- 為有效整合公司資源,本公司訂定「外訓暨證照補助管理辦法」,此辦法分為兩大項目:外訓(部門派外受訓)以及證照補助(個人自主學習補助)。為提高員工素質且鼓勵員工自主學習,工作之餘進修培養專業技術,強化個人專業職能,充實業務相關技能,利用外部訓練培養專業技術以彌補企業內訓之不足,並設立公司統一審核與課後回饋機制,以利公司外訓制度之推行,結合外訓與出差電子系統以利主管管控。
- 自主學習補助每人兩年內依職等補助金額最多2~10萬元,採課後補助原則,由員工先行自費報名,於課程結束取得證 照後檢具附件向訓練部門進行補助申請。
- 日月光於104年正式加入電子產業公民聯盟(Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC),公司秉持著EICC準則及 永續經營的理念,也為推動日月光與供應商共創永續供應鏈,104年度執行內部人員與供應鏈教育訓練落實EICC準則。 目前日月光高雄廠區受過EICC訓練之人員已超過2萬人,並建立每年至少複訓一次的機制,定期更新最新法規訊息予員工。
- 日月光於104年成立第一屆企業大學結合了各領域頂尖專家與教授,提供高階主管一流的教學團隊,其管理系列課程時數為78小時,訓練課程包含策略發展、經營管理、團隊管理等等方向,總訓練人時積達到3,744小時。
- 本公司一〇四年度員工訓練費用合計新台幣17,150,359元。
- 本公司與財務資訊透明有關人員,其取得主管機關指明之相關證照情形如下:本公司内部稽核人員取得國際内部稽核師協會所核發之國際内部稽核師證書者計有一人。
- 本公司104年度舉辦之課堂訓練開班數達1,500班次以上(含數位課程),參與訓練總人次約120,500人,訓練總時數 450,000小時。
- 本公司104年度提供之訓練課程類別如下:

新進人員訓練:包括新進人員到職前之訓練、基礎訓練及到職引導。

通識性訓練:係指政府法令規定、公司政策要求等之訓練課程。

職能別訓練:係指公司各單位所需之專業技能之訓練。

(四)退休制度及實施情形

- 本公司自民國七十五年十一月起即遵照勞動基準法訂定勞工退休辦法,並設立勞工退休準備金監督委員會,按月提撥勞工退休準備金存入臺灣銀行,勞工退休時可請領退休金。
- 本公司自民國九十四年七月起即遵照勞工退休金條例訂定之勞工新制退休辦法,每月提撥薪資之6%存入勞保局退休金專戶,勞工於年滿60歲即可於個人退休金專戶請領退休金。
- 退休條件:工作滿十五年以上,年齡與工作年資合計滿七十以上者,得自請退休。

(五)勞資協議情形

● 本公司設有書面及電子化員工溝通管道,且各廠均定期召開員工座談會,溝通良好,無重大勞資糾紛之情事。

(六)各項員工權益維護措施

- 依勞動基準法,保障員工權益。
- 依性別工作平等法,提供性別平權及無性騷擾的工作環境。
- 本公司較前一年具體提升員工福利或權益之措施:

104年初年度調薪。

依公司營運績效,每月提撥營運利潤獎金較前一年度增加。

員工團保項目與員工診所健康檢查項目内容增加。

員工可參與之社團數量增加。

舉辦都會公園植樹/參與社會公益/員工聯誼/球類、書法...等各項活動競賽及各項增進社會關懷與員工身心健康活動。

• 本公司104年度平均薪酬調整情形:本公司政策為每年持續穩定地為直間接員工年度調薪。

(七)工作環境與員工人身安全之保護措施(本公司為保護員工免於受職業傷害所做之措施)

- OHSAS 18001及TOSHMS台灣職安衛管理系統持續驗證。
- 持續運作廠區安全衛生績效評核,辦理年度安全衛生優良廠區頒獎。
- 持續強化承攬商協議組織會議運作,結合承攬商安全衛生評核機制,辦理年度安全衛生優良承攬商頒獎。
- 廠區健康風險評估模式建立及健康管理制度推動。
- 落實各部門危害鑑別與風險評估及強化各部門安全衛生改善方案。
- 機台安全防護改善持續推動。
- 新建廠消防系統設計導入NFPA(National Fire Protection Association,美國國家防火協會)規定,強化消防安全設施。
- 輔導主要承攬商建立自主安全衛生管理系統。
- 持續推動承攬商自主職業安全衛生管理系統OHSAS 18001建構與查證。
- 建構承攬安全管理團隊。
- 參與行政院勞工委員會舉辦之國家工安獎選拔。
- 參與行政院勞工委員會舉辦之全國勞工安全衛生優良單位選拔。
- 廠區高風險區域現場指揮官應變演練。
- 持續推動廠區機台及加藥系統作業安全防護強化。
- 持續進行廠區週界風險評估及改善,強化廠區消防安全。
- 持續推動EICC電子電機產業社會行為準則管理規範並完成查證。
- 持續推動廠區安全文化評量系統,強化提升廠區安全文化水平。
- 舉辦健康&安全文化月活動。

(八)各項員工工作守則及倫理原則

- 與主管有不同看法時,以「對事不對人」的態度,選擇適當時間、地點,與主管誠懇的溝通,勿在訪客或他人面前強烈的表示不同的意見。
- 會議須準時參加,不克出席應事先請代理人出席,並說明需準備之文件資料,並同時知會會議主持人。
- 與廠商開會若有跨越中晚餐時間,可以幫廠商代訂便當,再向公司報帳,勿與廠商外出交際應酬。
- 嚴禁私自攜帶公司產品、零件、貨品出加工區,出廠區物品務須配合保稅放行單,未依規定辦理者,經查獲依相關法令 處理。
- 尊重公司名譽,凡涉及公司任何事項,未經許可,不得擅自對外發佈個人意見。
- 培養誠實與負責任的文化,在公司所有的營業活動上應遵循最高道德標準的承諾。
- (九)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括目前及未來可能發生之估計金額及因應措施):無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要内容	限制條款
聯貸契約	花旗銀行等16家銀行	2013.07-2018.07	美金長借契約	財務比率限制等
聯貸契約	The Hongkong and Shanhai Banking Corporation Limited等8家銀行	2012.04~2017.04	美金長借契約	財務比率限制等
專利契約	FUJITSU LIMITED	1998.04.13-2016.04.12 (Annually renew)	專利授權	於合約終止或取消五年內,不得洩露本合約條款和 條件予第三者(保密條款)
專利契約	FLIP CHIP INTERNATIONAL, LLC. (FOC/RDL)(ULCSP)	2008.03.07-所授權專利技術屆期為止	專利授權	於合約期滿前,不得洩露本合約條款和條件予第三 者(保密條款)
專利契約	Mitsui High-tec, Inc.	2007.06.25-2016.06.24 (Annually renew)	專利授權	於合約期滿前,不得洩露本合約條款和條件予第三 者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2007.11.06-2017.11.05 (Annually renew)	專利授權	於合約期滿前,不得洩露本合約條款和條件予第三 者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2013.04.11-所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	矽品精密工業股份有限公司暨其關係 企業	2009.05.10-所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	STATs Chippac Ltd.	2012.01.01-2016.12.31	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
土地租賃契約	經濟部加工出口區管理處	2013.02.01-2035.06.30	土地租賃	於租約有效期間內,不得轉作與業務不相關之用, 且依約執行付款

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

1. 簡明資產負債表及綜合損益表資料-IFRSs

(1)合併簡明資產負債表

單位:新台幣仟元

	左 麻		最近四年度財務資料(註1)					
項目	年度	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)			
流動資產		156,732,840	159,955,190	132,176,482	97,495,577			
備供出售金融資產-非	流動	924,362	941,105	1,140,329	1,096,709			
採權益法之投資		37,422,909	1,492,441	1,216,201	1,177,871			
不動產、廠房及設備		149,997,075	151,587,115	131,497,331	127,197,774			
無形資產		11,888,612	11,913,286	11,953,644	12,361,269			
其他資產		8,321,759	8,095,630	8,829,919	8,380,569			
資產總額		365,287,557	333,984,767	286,813,906	247,709,769			
流動負債	分配前	120,502,072	111,199,467	100,835,276	84,668,133			
加勤兵債	分配後	(註2)	126,789,292	110,991,281	92,656,107			
非流動負債		76,365,603	64,347,296 58,813,671		52,089,877			
負債總額	分配前	196,867,675	175,546,763	159,648,947	136,758,010			
兵 使 極 能	分配後	(註2)	191,136,588	169,804,952	144,745,984			
歸屬於母公司業主之	權益	156,916,004	150,218,907	123,020,621	107,430,340			
股本		79,185,660	78,715,179	78,180,258	76,047,667			
資本公積		23,757,099	16,013,058	7,908,870	5,262,129			
保留盈餘	分配前	56,184,069	52,381,238	38,993,154	30,938,400			
水田皿助 	分配後	(註2)	36,791,413	28,837,149	22,950,426			
其他權益		5,081,689	5,068,539	(102,554)	(2,858,749)			
庫藏股票		(7,292,513)	(1,959,107)	(1,959,107)	(1,959,107)			
非控制權益		11,503,878	8,219,097	4,144,338	3,521,419			
權益總額	分配前	168,419,882	158,438,004	127,164,959	110,951,759			
7年11江祁心合只	分配後	(註2)	142,848,179	117,008,954	102,963,785			

註1:a.最近四年度財務報表均由會計師查核簽證。

(2)個體簡明資產負債表

年度	最近四年度財務資料(註1)					
項目	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)		
流動資產	32,132,019	41,483,018	37,009,050	17,849,645		
備供出售金融資產-非流動	473,107	542,147	592,557	521,999		
採權益法之投資	189,994,170	139,053,527	117,942,583	109,255,920		
不動產、廠房及設備	80,375,695	77,640,995	63,122,172	58,271,665		
無形資產	1,614,309	1,444,812	1,352,379	1,338,972		
其他資產	1,353,638	1,562,646	1,327,293	1,629,169		
資產總額	305,942,938	261,727,145	221,346,034	188,867,370		

b.最近四年度均未曾辦理資產重估。

註2:截至年報刊印日止,本公司一〇五年股東常會尚未召開,是以分配後金額暫不填列。

年度			最近四年度財務資料(註1)						
項目	4.6	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)				
·	分配前	91,305,117	68,567,745	49,159,136	42,827,937				
流動負債	分配後	(註2)	84,157,570	59,315,141	50,815,911				
非流動負債		57,721,817	42,940,493	49,242,041	38,609,093				
会 /丰/南郊	分配前	149,026,934	111,508,238	98,401,177	81,437,030				
負債總額	分配後	(註2)	127,098,063	108,557,182	89,425,004				
歸屬於母公司業主之	2權益	156,916,004	150,218,907	122,944,857	107,430,340				
股本		79,185,660	79,185,660 78,715,179 78,180,258		76,047,667				
資本公積		23,757,099	23,757,099 16,013,058 7,920,2		5,262,129				
伊切西於	分配前	56,184,069	52,381,238	38,906,102	30,938,400				
保留盈餘	分配後	(註2)	36,791,413	28,750,097	22,950,426				
其他權益		5,081,689	5,068,539	(102,616)	(2,858,749)				
庫藏股票		(7,292,513)	(1,959,107)	(1,959,107)	(1,959,107)				
135 24 Artacha	分配前	156,916,004	150,218,907	122,944,857	107,430,340				
權益總額	分配後	(註2)	134,629,082	102,788,852	99,442,366				

註1:a.最近四年度財務報表均由會計師查核簽證。

(3)合併簡明綜合損益表

單位:新台幣仟元

左府	最近四年度財務資料(註)						
項目	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)			
營業收入	283,302,536	256,591,447	219,862,446	193,972,392			
營業毛利	50,135,228	53,588,529	42,813,744	36,619,812			
營業損益	24,884,622	29,645,869	22,044,323	17,687,085			
營業外收入及支出	403,631	(1,097,658)	(2,687,631)	(1,102,770)			
稅前淨利	25,288,253	28,548,211	19,356,692	16,584,315			
繼續營業單位本期淨利	20,449,007	24,281,585	16,155,040	13,523,583			
本期淨利	20,449,007	24,281,585	16,155,040	13,523,583			
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(147,547)	5,503,510	3,238,026	(3,823,690)			
本期綜合損益總額	20,301,460	29,785,095	19,393,066	9,699,893			
淨利歸屬於母公司業主	19,478,873	23,636,522	15,689,074	13,066,075			
淨利歸屬於非控制權益	970,134	645,063	465,966	457,508			
綜合損益總額歸屬於母公司業主	19,405,806	28,802,296	18,798,923	9,301,863			
綜合損益總額歸屬於非控制權益	895,654	982,799	594,143	398,030			
每股盈餘(稀釋)	2.44	2.96	2.03	1.71			

註: a.最近四年度財務報表均由會計師查核簽證。

(4)個體簡明綜合損益表

				単位・利口幣仕儿		
年度	最近四年度財務資料(註)					
項目	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)		
營業收入	94,206,807	96,678,100	82,329,117	72,926,652		
營業毛利	25,147,806	29,376,669	22,264,748	18,324,545		
營業損益	13,892,786	18,278,988	12,936,797	10,653,147		

b.最近四年度均未曾辦理資產重估。

註2:截至年報刊印日止,本公司一〇五年股東常會尚未召開,是以分配後金額暫不填列。

b.最近四年度均未曾辦理資產重估。

年度	最近四年度財務資料(註)					
項目	104年 (2013年版IFRSs)	103年 (2013年版IFRSs)	102年 (2010年版IFRSs)	101年 (2010年版IFRSs)		
營業外收入及支出	8,540,566	7,882,138	4,458,346	3,906,755		
稅前淨利	22,433,352	26,161,126	17,395,143	14,559,902		
繼續營業單位本期淨利	19,478,873	23,636,522	15,689,074	13,066,075		
本期淨利	19,478,873	23,636,522	15,689,074	13,066,075		
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(73,067)	5,165,774	3,109,849	(3,764,212)		
本期綜合損益總額	19,405,806	28,802,296	18,798,923	9,301,863		
每股盈餘(稀釋)	2.44	2.96	2.03	1.71		

註: a.最近四年度財務報表均由會計師查核簽證。

最近五年度會計師查核意見

年度	會計師姓名	會計師姓名	查核意見
一○四	陳珍麗	江佳玲	修正式無保留意見
-0≡	陳珍麗	江佳玲	無保留意見
-0=	陳珍麗	龔俊吉	無保留意見
-0-	陳珍麗	龔俊吉	無保留意見
-00	龔俊吉	邱慧吟	無保留意見

2. 簡明資產負債表及損益表資料-我國財務會計準則

(1)合併簡明資產負債表

	年度			最近五年度財務資料(註)		
項目		101年ROC	100年ROC	99年ROC	98年ROC	97年ROC
流動資產		98,042,323	90,131,690	85,598,925	61,398,745	46,366,851
基金及投資		2,365,931	2,220,728	2,400,084	5,159,990	4,327,038
固定資產		126,150,296	111,779,036	99,853,912	79,363,860	84,757,984
無形資產		15,801,845	15,772,415	15,248,120	12,232,698	12,592,049
其他資產		4,143,720	3,974,226	5,038,724	3,819,502	4,146,065
資產總額		246,504,115	223,878,095	208,139,765	161,974,795	152,189,987
· 大手4名/唐	分配前	84,703,409	66,761,885	59,734,502	34,574,089	25,270,694
流動負債	分配後	92,691,383	71,087,169	63,666,921	36,552,279	28,007,262
長期負債		44,591,685	50,425,156	52,533,779	49,306,013	51,622,187
其他負債		4,749,953	4,408,560	4,032,159	3,380,000	3,336,364
負債總額	分配前	134,045,047	121,595,601	116,300,440	87,261,101	80,229,245
貝頂総領	分配後	142,033,021	125,920,885	120,232,859	89,239,291	82,965,813
股本		76,047,667	67,571,325	60,819,570	54,933,988	56,907,665
資本公積		8,767,134	7,397,481	7,180,585	6,333,755	6,373,287
保留盈餘	分配前	26,969,183	27,809,126	24,972,944	13,229,409	9,221,404
休留盆跡	分配後	18,981,209	23,483,842	21,040,525	11,251,219	6,484,836
金融商品未實現(損)益		401,938	235,088	246,303	25,498	(439,438)
累積換算調整數		119,987	3,353,938	(1,120,618)	3,276,508	4,873,957
未認列為退休金成本之淨損失		(831,917)	(465,681)	(398,103)	(248,641)	(230,401)
股東權益總額	分配前	112,459,068	102,282,494	91,839,325	74,713,694	71,960,742
汉米惟 血総領	分配後	104,471,094	97,957,210	87,906,906	72,735,504	69,224,174

註:a.最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

b.最近四年度均未曾辦理資產重估。

b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

(2)個體簡明資產負債表

單位:新台幣仟元

	年度			最近五年度財務資料(註)		
項目		101年ROC	100年ROC	99年ROC	98年ROC	97年ROC
流動資產		18,147,566	17,147,117	16,752,587	17,591,613	11,426,119
基金及投資		110,891,285	106,619,178	101,583,798	80,340,959	77,506,660
固定資產		57,233,865	44,897,565	38,809,576	30,383,071	29,296,724
無形資產		1,222,757	1,023,803	1,044,022	1,069,754	1,095,651
其他資產		1,505,088	1,390,944	3,436,477	3,887,601	4,606,092
資產總額		189,000,561	171,078,607	161,626,460	133,272,998	123,931,246
流動負債	分配前	42,712,691	31,159,171	24,443,453	18,104,951	8,550,167
/// 別貝頂	分配後	50,700,665	35,484,455	28,375,872	20,083,141	11,286,735
長期負債		34,625,670	37,453,501	47,373,743	42,479,131	44,707,225
其他負債		2,147,315	1,296,399	1,252,895	1,072,890	1,001,860
負債總額	分配前	79,485,676	69,909,071	73,070,091	61,656,972	54,259,252
只良秘创	分配後	87,473,650	74,234,355	77,002,510	63,635,162	56,995,820
股本		76,047,667	67,571,325	60,819,570	54,933,988	56,907,665
資本公積		8,767,134	7,397,481	7,180,585	6,333,755	6,373,287
保留盈餘	分配前	26,969,183	27,809,126	24,972,944	13,229,409	9,221,404
休田	分配後	18,981,209	14,167,847	14,083,168	6,635,443	6,484,836
金融商品未實現(損)益		401,938	235,088	246,303	25,498	(439,438)
累積換算調整數		119,987	3,353,938	(1,120,618)	3,276,508	4,873,957
未認列為退休金成	本之淨損失	(831,917)	(465,681)	(398,103)	(248,641)	(230,401)
股東權益總額	分配前	109,514,885	101,169,536	88,556,369	71,616,026	69,671,994
以宋惟 <u></u>	分配後	101,526,911	96,844,252	84,623,950	69,637,836	66,935,426

註:a.最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

(3)合併簡明損益表

					単位・利口帯けん
年度			最近五年度財務資料(註)		
項目	101年ROC	100年ROC	99年ROC	98年ROC	97年ROC
營業收入	193,972,392	185,347,206	188,742,797	85,775,314	94,430,912
營業毛利	36,623,770	35,008,803	40,544,573	18,341,670	21,769,474
營業淨利	17,761,382	16,821,251	24,099,006	9,209,829	11,245,409
營業外收入及利益	2,435,229	3,058,708	2,556,947	2,063,322	1,958,503
營業外費用及損失	3,606,075	2,883,798	3,832,324	2,884,761	3,728,147
繼續營業部門稅前損益	16,590,536	16,997,161	22,823,629	8,388,390	9,475,765
繼續營業部門損益	13,548,908	13,978,949	19,194,889	6,903,468	7,207,483
本期淨利	13,548,908	13,978,949	19,194,889	6,903,468	7,207,483
每股盈餘(元/股)					
(追溯調整後)					
基本每股盈餘	1.76	1.83	2.44	0.94	0.82
稀釋每股盈餘	1.71	1.78	2.39	0.92	0.80

註:a.最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

(4)個體簡明損益表

單位:新台幣仟元

年度		Ē	最近五年度財務資料(註1)	_
項目	101年ROC	100年ROC	99年ROC	98年ROC	97年ROC
營業收入	72,926,652	69,439,165	67,339,406	46,134,314	48,451,017
營業毛利	18,365,510	17,720,164	16,705,791	10,579,841	10,538,763
營業淨利	10,732,774	10,859,132	10,361,203	5,818,771	5,487,648
營業外收入及利益	5,659,159	6,298,044	11,237,285	4,052,832	4,059,355
營業外費用及損失	1,806,747	2,104,588	2,565,899	2,203,912	2,205,500
繼續營業部門稅前損益	14,585,186	15,052,588	19,032,589	7,667,691	7,341,503
繼續營業部門損益	13,091,359	13,725,958	18,337,500	6,744,546	6,160,052
本期淨利	13,091,359	13,725,958	18,337,500	6,744,546	6,160,052
每股盈餘(元/股)					
(追溯調整後)					
基本每股盈餘	1.76	1.83	2.44	0.94	0.82
稀釋每股盈餘	1.71	1.78	2.39	0.92	0.80

註1:a.最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。 b.最近五年度均未曾辦理資產重估。

二、最近五年度財務分析

1. 最近四年度合併及個體財務分析-IFRSs

(1)合併財務分析

	年度	最近四年度合併財務分析(註2)								
分析項目	平	104年度 (2013年版IFRSs)	103年度 (2013年版IFRSs)	102年度 (2010年版IFRSs)	101年度 (2010年版IFRSs)					
D+274+++(0/)	負債占資產比率	53.89	52.56	55.66	55.21					
財務結構(%)	長期資金占不動產、廠房及設備比率	156.44	141.05	141.43	128.18					
	流動比率	130.07	143.85	131.08	115.15					
償債能力(%)	速動比率	87.09	101.06	93.47	73.86					
	利息保障倍數	12.15	13.28	9.58	9.27					
	應收款項週轉率(次)	5.79	5.34	5.45	5.70					
	平均收現日數	63	68	67	64					
	存貨週轉率(次)	5.01	5.14	5.29	5.06					
經營能力	應付款項週轉率(次)	6.71	6.30	6.65	6.93					
	平均銷貨日數	73	71	69	72					
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.88	1.81	1.70	1.62					
	總資產週轉率(次)	0.81	0.83	0.82	0.82					
	資產報酬率(%)	6.39	8.44	6.75	6.42					
	權益報酬率(%)	12.51	17.01	13.57	12.76					
獲利能力	税前純益占實收資本比率(%)	31.94	36.27	24.76	21.81					
	純益率(%)	7.22	9.46	7.35	6.97					
	每股盈餘(元)(稀釋)	2.44	2.96	2.03	1.71					
	現金流量比率	47.76	41.25	40.95	39.02					
現金流量(%)	現金流量允當比率	90.08	84.73	84.88	85.05					
	現金再投資比率	9.39	8.80	9.56	9.27					
持担府	營運槓桿度	2.24	1.94	2.21	2.38					
槓桿度	財務槓桿度	1.10	1.09	1.11	1.13					

說明最近二年度各項財務比率變動原因:本公司資產報酬率、股東權益報酬率及純益率減少:主要係因本年度電子製造代工服務產品獲利下降致使比率減少。

註2:請詳P74~75之註1~註7。

(2)個體財務分析

	年度	最近四年度個體財務分析(註)								
分析項目	平	104年度 (2013年版IFRSs)	103年度 (2013年版IFRSs)	102年度 (2010年版IFRSs)	101年度 (2010年版IFRSs)					
D+274+++(0/)	負債占資產比率	48.71	42.60	44.44	43.12					
財務結構(%)	長期資金占不動產、廠房及設備比率	259.13	241.94	264.50	243.78					
	流動比率	35.19	60.50	75.28	41.68					
償債能力(%)	速動比率	30.70	53.66	67.45	32.89					
	利息保障倍數	20.73	27.36	22.64	21.29					
	應收款項週轉率(次)	4.98	5.37	6.48	7.05					
	平均收現日數	73	68	56	52					
	存貨週轉率(次)	17.07	16.90	16.73	15.99					
經營能力	應付款項週轉率(次)	8.69	8.68	8.06	7.43					
	平均銷貨日數	21	22	22	23					
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.17	1.25	1.30	1.25					
	總資產週轉率(次)	0.31	0.37	0.37	0.39					
	資產報酬率(%)	7.2	10.13	7.97	7.60					
	權益報酬率(%)	12.68	17.31	13.62	12.63					
獲利能力	税前純益占實收資本額比率(%)	28.33	33.24	22.25	19.15					
	純益率(%)	20.68	24.45	19.06	17.92					
	每股盈餘(元)(稀釋)	2.44	2.96	2.03	1.71					
	現金流量比率	32.26	36.53	40.73	49.20					
現金流量(%)	現金流量允當比率	89.33	89.77	100.88	108.02					
	現金再投資比率	5.80	5.54	5.06	8.20					
槓桿度	營運槓桿度	2.11	1.73	1.86	1.85					
1月1千/支	財務槓桿度	1.09	1.06	1.07	1.07					

註:請詳P74~75之註1~註7。

2. 最近五年度合併及個體財務分析-我國財務會計準則

(1)最折五年度合併財務分析

		年度		最近	五年度合併財務分析(註)	
分析項目			101年ROC	100年ROC	99年ROC	98年ROC	97年ROC
ロナマケッナナ非(ロイ)	負債占資產比率		54.38	54.31	55.88	53.87	52.72
財務結構(%)	長期資金占固定資產比率		124.49	136.62	144.58	156.27	145.81
	流動比率		115.75	135.00	143.30	177.59	183.48
償債能力(%)	速動比率		73.46	84.53	99.70	134.79	155.96
	利息保障倍數		9.28	11.20	17.47	6.56	6.23
	應收款項週轉率(次)		5.73	5.81	7.37	5.88	6.27
	平均收現日數		64	63	50	62	58
	存貨週轉率(次)		5.06	5.63	8.35	7.94	14.01
經營能力	應付款項週轉率(次)		6.93	6.60	8.89	9.55	10.09
	平均銷貨日數		72	65	44	46	26
	固定資產週轉率(次)		1.54	1.66	1.89	1.08	1.11
	總資產週轉率(次)		0.79	0.83	0.91	0.53	0.62
	資產報酬率(%)		6.47	7.11	10.99	5.11	5.63
	股東權益報酬率(%)		12.62	14.40	23.05	9.41	8.91
	占實收資本比率(%)	營業利益	23.36	24.89	39.62	16.77	19.76
獲利能力	口負収負平比率(70)	稅前純益	21.82	25.15	37.53	15.27	16.65
	純益率(%)		6.98	7.54	10.17	8.05	7.63
	每股盈餘(純損)	基本	1.76	1.83	2.44	0.94	0.82
	元/股(追溯調整後)	稀釋	1.71	1.78	2.39	0.92	0.80
	現金流量比率		34.26	47.84	61.88	44.88	121.60
現金流量(%)	現金流量允當比率		82.60	93.95	112.66	122.06	113.26
	現金再投資比率		8.53	10.07	13.69	5.77	10.29
槓桿度	營運槓桿度		2.37	2.42	1.87	2.95	2.69
頂作反	財務槓桿度		1.13	1.11	1.06	1.20	1.19

註:請詳P74~75之註1~註7。

(2)最近五年度個體財務分析

		年度		最近五年度個體財務分析(註1)								
分析項目			101年ROC	100年ROC	99年ROC	98年ROC	97年ROC					
日→3欠 4±+±/0/)	負債占資產比率		42.06	40.86	45.21	46.29	43.78					
財務結構(%)	長期資金占固定資產	比率	251.84	308.75	350.25	375.75	390.42					
	流動比率		42.49	55.03	68.54	97.16	133.64					
償債能力(%)	速動比率		32.72	41.72	54.26	80.43	105.10					
	利息保障倍數		21.33	17.85	18.95	8.16	9.62					
	應收款項週轉率(次)		7.10	7.13	7.08	6.51	6.64					
	平均收現日數		51	51	52	56	55					
	存貨週轉率(次)		15.98	16.68	20.27	19.81	19.73					
經營能力	應付款項週轉率(次)		7.42	7.17	7.43	7.23	7.52					
	平均銷貨日數		23	22	18	18	18					
	固定資產週轉率(次)		1.27	1.55	1.74	1.52	1.65					
	總資產週轉率(次)		0.39	0.41	0.42	0.35	0.39					
	資產報酬率(%)		7.60	8.70	8.70 13.03		6.02					
	股東權益報酬率(%)		12.43	14.47	22.90	9.55	8.51					
	 占實收資本比率(%)	營業利益	14.11	16.07	17.04	10.28	10.46					
獲利能力	口負权負本比率(70)	稅前純益	19.18	22.28	31.29	13.96	12.90					
	純益率(%)		17.95	19.77	27.23	14.62	12.71					
	每股盈餘(純損)	基本	1.76	1.83	2.44	0.94	0.82					
	元/股(追溯調整後)	稀釋	1.71	1.78	2.39	0.92	0.80					
	現金流量比率		49.27	75.82	80.59	57.85	185.34					
現金流量(%)	現金流量允當比率		121.40	134.49	131.81	145.21	124.31					
	現金再投資比率		8.24	10.17	9.54	4.76	4.10					
槓桿度	營運槓桿度		3.34	3.10	3.04	3.95	4.50					
191+12	財務槓桿度		1.07	1.09	1.11	1.23	1.17					

註1:最近年度財務報表均由會計師查核簽證。

註2: 財務分析項目之計算公式如下:

計算公式:

- 1. 財務結構
 - (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
 - (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。
- 2. 償債能力
 - (1)流動比率=流動資產/流動負債。
 - (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
 - (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
- 3. 經營能力
 - (1)應收款頁(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
 - (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
 - (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
 - (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
 - (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
 - (6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
- (7)總資產週轉率=銷貨淨額 / 平均資產總額。
- 4. 獲利能力
 - (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
 - (2)權益報酬率=稅後損益 / 平均權益總額。
 - (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
 - (4)每股盈餘=(歸屬與母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註4)
- 5. 現金流量
 - (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
 - (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
 - (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。(註5)
- 6. 槓桿度:
 - (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。
 - (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

註3:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

- 1. 以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
- 2. 凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
- 3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
- 4. 若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。

- 註4:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
 - 1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
 - 2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
 - 3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
 - 4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
 - 5 .不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
- 註5:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。
- 註6:公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
- 註7:依我國財務會計準則財務分析項目之計算公式與採IFRSs之計算公式不同者列示如下:
 - a. 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。
 - b. 固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。
 - c. 股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
 - d. 每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。
 - e. 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。

三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤業衆信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上,敬請鑒核。

日月光半導體製造股份有限公司

審計委員會召集人





四、最近年度財務報告:

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒:

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司民國104年12月31日暨103年12月31日及1月1日之合併資產負債表,暨民國104及103年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告中,有關採用權益法之被投資公司矽品精密工業公司(矽品)之財務報告係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關矽品財務報告所列金額及揭露資訊,係依據其他會計師之查核報告。民國104年12月31日對矽品採用權益法之投資餘額為新台幣35,423,058千元,占合併資產總額之10%,民國104年度對矽品採用權益法認列之關聯企業損益份額為新台幣410,937千元,占該年度稅前淨利之2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達日月光半導體製造股份有限公司及其子公司民國104年12月31日暨103年12月31日及1月1日之合併財務狀況,暨民國104及103年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

如合併財務報告附註三所述,日月光半導體製造股份有限公司及其子公司自民國104年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之2013年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告,因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期合併財務報告受影響之項目。

日月光半導體製造股份有限公司業已編製民國104及103年度之個體財務報告,並經本會計師出具修正式無保留意見之 查核報告在案,備供參考。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 陳珍麗





行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1010028123號

會計師 江佳玲





財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年12月31日暨103年12月31日及1月

		104年12月31	日	103年12月31日(調整後)			103年1月1日(調整後)		
代碼	資產	金額	%		金額	%		金額	%
	流動資產								
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 55,251,181	15	\$	51,694,410	16	\$	45,026,371	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動								
	(附註四、五及七)	3,833,701	1		4,988,843	2		2,764,269	1
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及八)	30,344	_		1,533,265	_		2,376,970	1
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	44,931,487	13		52,920,810	16		43,235,573	15
1200	其他應收款(附註四)	429,541	_		537,122	_		422,345	-
1220	本期所得稅資產(附註四)	168,717	_		65,312	_		150,596	_
1310	存貨(附註四、五及十)	23,258,279	6		20,163,093	6		16,281,236	6
1320	存貨-營建房地								
	(附註四、五、十一、二二及三二)	25,713,538	7		23,986,478	7		18,589,255	6
1476	其他金融資產-流動(附註四及三二)	301,999	_		638,592	_		278,375	_
1479	其他流動資產	2,814,053	1		3,427,265	1		3,051,492	1
11XX	流動資產合計	156,732,840	43		159,955,190	48		132,176,482	46
	非流動資產								
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)	924,362	_		941,105	_		1,140,329	_
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	37,422,909	10		1,492,441	1		1,216,201	1
1600	不動產、廠房及設備								
	(附註四、五、十三、二二、三一及三三)	149,997,075	41		151,587,115	45		131,497,331	46
1805	商譽(附註四、五及十四)	10,506,519	3		10,445,415	3		10,347,820	4
1821	其他無形資產(附註四、五、十五及二二)	1,382,093	_		1,467,871	1		1,605,824	1
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	5,156,515	2		4,506,971	1		3,783,265	1
1980	其他金融資產-非流動(附註四及三二)	345,672	_		367,345	_		354,993	_
1985	長期預付租金(附註十六)	2,556,156	1		2,585,964	1		4,072,281	1
1990	其他非流動資產	 263,416			635,350			637,163	
15XX	非流動資產合計	208,554,717	57		174,029,577	52		154,655,207	54

 1XXX
 資產總計
 \$ 365,287,557
 100
 \$ 333,984,767
 100
 \$ 286,831,689
 100

單位:新台幣干元

		104年12月3	1日	103年12月31日(調整後)	103年1月1日(調整後)		
代碼	負債及權益	金額	%	金額	%	金額	%	
2100	短期借款(附註十七)	\$ 32,635,321	9	\$ 41,176,033	12	\$ 44,618,195	16	
2110	應付短期票券(附註十七)	4,348,054	1	_	_	_	_	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動							
	(附註四、五及七)	3,005,726	1	2,651,352	1	1,853,304	1	
2125	避險之衍生金融負債-流動(附註四及五)	_	=	_	_	3,310	_	
2170	應付帳款	34,138,564	9	35,411,281	11	28,988,976	10	
2200	其他應付款(附註十九)	19,194,818	5	22,364,516	7	14,758,553	5	
2230	本期所得稅負債(附註四)	4,551,785	1	4,150,036	1	3,000,869	1	
2312	預收房地款(附註四)	2,703,706	1	480,325	_	19,248	_	
2321	一年内到期之應付公司債(附註四及十八)	14,685,866	4	_	_	731,438	_	
2322	一年内到期之長期借款(附註十七及三二)	2,057,465	1	2,831,007	1	5,276,206	2	
2399	其他流動負債	3,180,767	1	2,134,917	1	1,585,177	_	
21XX	流動負債合計	120,502,072	33	111,199,467	34	100,835,276	35	
	非流動負債							
2530	應付公司債(附註四及十八)	23,740,384	7	31,270,131	10	20,582,567	7	
2540	長期借款(附註十七及三二)	42,493,668	12	24,104,424	7	29,580,659	11	
2570	派延所得税負債(附註四、五及二三)	4,987,549	12	3,932,819	1	2,663,767	1	
2610	長期應付款	4,367,343		3,932,619		894,150		
2640	深期應的系 淨確定福利負債(附註三、四、五及二十)	4,072,493	1	4,382,530	1	4,545,960	2	
2670	其他非流動負債		_	657,392	_		2	
25XX	兵心升/加勤兵員 非流動負債合計	76,365,603	21	64,347,296	19	651,171 58,918,274		
23//	非川到只限口 司					30,910,274		
2XXX	負債總計	196,867,675	54	175,546,763	53	159,753,550	56	
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及二一)							
	股本							
3110	普通股股本	79,029,290	22	78,525,378	24	77,560,040	27	
3140	預收股本	156,370	_	189,801	-	620,218	_	
3100	股本總計	79,185,660	22	78,715,179	24	78,180,258	27	
3200	資本公積	23,757,099	7	16,013,058	5	7,920,220	3	
	保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	12,649,145	3	10,289,878	3	8,720,971	3	
3320	特別盈餘公積	3,353,938	1	3,353,938	1	3,663,930	2	
3350	未分配盈餘	40,180,986	11	38,737,422	12	26,521,201	9	
3300	保留盈餘總計	56,184,069	15	52,381,238	16	38,906,102	14	
3400	其他權益	5,081,689	1	5,068,539	1	(102,616)		
3500	庫藏股票	(7,292,513)	(2)	(1,959,107)	(1)	(1,959,107)	(1)	
31XX	歸屬於本公司業主之權益							
	總計	156,916,004	43	150,218,907	45	122,944,857	43	
36XX	非控制權益(附註四及二一)	11,503,878	3	8,219,097	2	4,133,282	1	
3XXX	權益合計	168,419,882	46	158,438,004	47	127,078,139	44	
3X2X	負債及權益總計	\$ 365,287,557	100	\$ 333,984,767	100	\$ 286,831,689	100	







日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國104及103年1月1日至12月31日

單位:新台幣干元,惟每股盈餘為新台幣元

4000 營業収入(的註四) \$ 283,302,536 100 \$ 2 5000 營業元本(的註十、二十及二二) 233,167,308 82 2 5900 營業利 50,135,228 18 営業費用(的註二十及二二) 4 1 1 6100 推銷費用 10,724,568 4 6300 研究發展費用 10,937,566 4 6000 營業費用合計 25,250,606 9 6900 營業淨利 24,884,622 9 營業外收入及支出 月 24,884,622 9 7010 其他收入(的註二二) 876,008 -	103年度(調整後)			
233,167,308 82 22 233,167,308 82 23 23 23 23 23 23 2	全額	%		
5900 營業毛利 50,135,228 18	56,591,447	100		
 營業費用(附註二十及二二) 6100 推銷費用 3,588,472 1 6200 管理費用 10,724,568 4 6300 研究發展費用 10,937,566 4 6000 營業費用合計 25,250,606 9 6900 營業淨利 24,884,622 9 一 7010 其他收入(附註二二) 876,008 - 	03,002,918	79		
6100 推銷費用 3,588,472 1 6200 管理費用 10,724,568 4 6300 研究發展費用 10,937,566 4 6000 營業費用合計 25,250,606 9 6900 營業淨利 24,884,622 9 營業外收入及支出 876,008 -	53,588,529	21		
6200 管理費用 10,724,568 4 6300 研究發展費用 10,937,566 4 6000 營業費用合計 25,250,606 9 6900 營業淨利 24,884,622 9 營業外收入及支出 7010 其他收入(附註二) 876,008 -				
6300 研究發展費用 10,937,566 4 6000 營業費用合計 25,250,606 9 6900 營業淨利 24,884,622 9 營業外收入及支出 876,008 -	3,438,166	2		
6000 營業費用合計 25,250,606 9 6900 營業淨利 24,884,622 9 營業外收入及支出 7010 其他收入(附註二) 876,008 -	10,214,810	4		
6900 營業淨利 24,884,622 9 營業外收入及支出 7010 其他收入(附註二) 876,008 -	10,289,684	4		
營業外收入及支出 7010 其他收入(附註二二) 876,008 —	23,942,660	10		
7010 其他收入(附註二二) 876,008 -	29,645,869	11		
,				
+ 11-7134 (14-5	588,875	_		
7020 其他利益(附註二二) 1,437,036 1	776,290	1		
7050 財務成本(附註二二) (2,312,143) (1) (2,354,097) (1)		
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額(附註四) 402,730 - (108,726)	_		
7000 營業外收入及支出合計 403,631 - (1,097,658)			
7900 税前淨利 25,288,253 9	28,548,211	11		
7950 所得税費用(附註四、五及二三) 4,839,246 2	4,266,626	2		
8200 本年度淨利	24,281,585	9		
其他綜合損益				
8310 不重分類至損益之項目:				
8311 確定福利計畫之再衡量數 (62,911) - (28,145)	-		
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (37,748) - (1,031)	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅 11,002 -	22,938	-		
8310 (89,657) — (6,238)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (63,509) —	5,405,027	2		
8362 備供出售金融資產未實現評價(損)益 10,451 - (133,714)	_		
8363 現金流量避險 — — — —	3,279	_		
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (4,832) -	235,156	_		
8360 (57,890) –	5,509,748	2		
8300 本年度其他綜合損益(稅後淨額)	5,503,510	2		
8500 本年度綜合損益總額 \$ 20,301,460 7 \$	29,785,095	11		
8600 净利歸屬於:				
8610 本公司業主 \$ 19,478,873 7 \$	23,636,522	9		
8620 非控制權益 970,134 -	645,063			
8600 \$ 20,449,007 7 \$	0.5,005	_		

			104年度				
代碼		_	金額		金額		%
8700	· 綜合損益總額歸屬於:	_					
8710	本公司業主	\$	19,405,806	7	\$	28,802,296	11
8720	非控制權益		895,654	_		982,799	_
8700		\$	20,301,460	7	\$	29,785,095	11
	每股盈餘(附註二四)						
9750	基本每股盈餘	\$	2.55		\$	3.07	
9850	稀釋每股盈餘	\$	2.44		\$	2.96	
	基本每股盈餘				\$		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國105年3月16日查核報告)

董事長:張虔生



會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國104及103年1月1日至12月31日

歸屬於本公司業主之權益

		普通	投股:	本				保	留盈餘		
代碼		股數(千股)		金額		資本公積	法	定盈餘公積	特	別盈餘公積	
A1	103年1月1日餘額	7,787,827	\$	78,180,258	\$	7,908,870	\$	8,720,971	\$	3,663,930	
АЗ	追溯適用及追溯調整之影響數	_		_		11,350		_		_	
A5	103年1月1日調整後餘額	7,787,827		78,180,258		7,920,220		8,720,971		3,663,930	
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數					26,884		_			
D1	103年度淨利(調整後)							_			
D3	103年度稅後其他綜合損益(調整後)	_		_		_		_		_	
D5	103年度綜合損益總額(調整後)										
	102年度盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	_		_		_		1,568,907		_	
B5	普通股現金股利	_		_		_		_		_	
B17	特別盈餘公積迴轉	_		_		_		_	(309,992)	
						_		1,568,907	(309,992)	
M1	發放予子公司股利調整資本公積			_		188,790		_			
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額										
	(附註二六)	_		_		6,877,099		_		_	
N1	股份基礎給付交易	73,898		534,921		1,000,065		_			
O1	子公司股東現金股利										
O1	子公司員工認股權			_							
Z1	103年12月31日餘額(調整後)	7,861,725		78,715,179		16,013,058		10,289,878		3,353,938	
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分										
	(附註十八)					214,022		_			
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數			_		150		_		_	
D1	104年度淨利	_		_		_		_		_	
D3	104年度稅後其他綜合損益					_					
D5	104年度綜合損益總額	_		-		_		_		_	
	103年度盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	_		_		-		2,359,267		_	
B5	普通股現金股利							_			
								2,359,267			
L1	庫藏股買回			_				_			
M1	發放予子公司股利調整資本公積	_		_		292,351		_		_	
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 (附註二六)	_		_		7,197,510				_	
M7	對子公司所有權權益變動		_		(564,344)	_				
N1	股份基礎給付交易	48,703	_	470,481	-	604,352					
01	子公司股東現金股利		_		_		_				
01	子公司員工認股權		_		-						
Z1	104年12月31日餘額	7,910,428	\$	79,185,660	\$	23,757,099	\$	12,649,145	\$	3,353,938	
			_	, ,							

單位:新台幣干元

歸屬於本公司業主之權益

			其他權	望益項目					
		國外營運機構	備供出售						
保留	盈餘	財務報表換算	金融資產						
未分配盈餘	 合計	之兌換差額	未實現損益	現金流量避險	合計	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額
\$ 26,608,253	\$ 38,993,154	(\$ 525,521)	\$ 426,246	(\$ 3,279)	(\$ 102,554)	(\$ 1,959,107)	\$123,020,621	\$ 4,144,338	\$127,164,959
(87,052)	(87,052)	(62)	_	_	(62)	_	(75,764)	(11,056)	(86,820)
26,521,201	38,906,102	(525,583)	426,246	(3,279)	(102,616)	(1,959,107)	122,944,857	4,133,282	127,078,139
					_		26,884	_	26,884
23,636,522	23,636,522	-	_	_	_	_	23,636,522	645,063	24,281,585
(5,381)	(5,381)	5,067,344	100,532	3,279	5,171,155		5,165,774	337,736	5,503,510
23,631,141	23,631,141	5,067,344	100,532	3,279	5,171,155		28,802,296	982,799	29,785,095
(1,568,907)	_	_	-	-	_	_	-	_	-
(10,156,005)	(10,156,005)	_	-	_	-	_	(10,156,005)	=	(10,156,005)
309,992	_	_	_	_	_	_	_	_	_
(11,414,920)	(10,156,005)						(10,156,005)		(10,156,005)
							188,790		188,790
_			_	-	_	_	6,877,099	3,068,406	9,945,505
			_		_		1,534,986	_	1,534,986
								(85,766)	(85,766)
			_	_	_		_	120,376	120,376
38,737,422	52,381,238	4,541,761	526,778		5,068,539	(1,959,107)	150,218,907	8,219,097	158,438,004
_	_	_	_	-	_	_	214,022	_	214,022
					_		150		150
19,478,873	19,478,873						19,478,873	970,134	20,449,007
(86,217)	(86,217)	(48,191)	61,341		13,150		(73,067)	(74,480)	(147,547)
19,392,656	19,392,656	(48,191)	61,341		13,150		19,405,806	895,654	20,301,460
(2,359,267)	_	_	-	-	-	_	-	-	-
(15,589,825)	(15,589,825)	_	_	_	-	_	(15,589,825)	-	(15,589,825)
(17,949,092)	(15,589,825)						(15,589,825)		(15,589,825)
						(5,333,406)	(5,333,406)		(5,333,406)
							292,351		292,351
-	-	-	-	-	_	-	7,197,510	1,712,836	8,910,346
							(564,344)	564,344	
_							1,074,833	_	1,074,833
			_		_		_	(232,148)	(232,148)
								344,095	344,095
\$40,180,986	\$ 56,184,069	\$ 4,493,570	\$ 588,119	\$ -	\$ 5,081,689	(\$7,292,513)	\$ 156,916,004	\$11,503,878	\$168,419,882

董事長:張虔生



會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表 民國104及103年1月1日至12月31日

單位:新台幣干元

代碼		104年度		103年度(調整後)	
	營業活動之現金流量				
A10000	本年度稅前淨利	\$	25,288,253	\$	28,548,211
A20000	調整項目				
A20010	不影響現金流量之收益費損項目				
A20100	折舊費用		28,938,770		25,805,042
A20200	攤銷費用		579,894		545,734
A20400	透過損益按公允價值衡量				
	金融資產及負債之淨利益	(2,472,835)	(1,838,840)
A20900	利息費用		2,268,786		2,324,426
A21200	利息收入	(242,084)	(243,474)
A21300	股利收入	(396,973)	(101,252)
A21900	股份基礎給付酬勞成本		133,496		110,157
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(402,730)		108,726
A23500	金融資產減損損失		8,232		28,421
A23700	非金融資產減損損失		610,140		899,480
A29900	匯兌損益		1,358,777		1,404,234
A29900	其他項目		1,411,599		313,138
A30000	營業資產及負債之淨變動				•
A31110	持有供交易之金融資產		4,162,522		823,313
A31150	應收帳款		7,982,736	(9,703,070)
A31180	其他應收款		55,112	(8,625)
A31200	存貨	(5,128,726)	(8,208,824)
A31240	其他流動資產	,	407,017	1	102,353
A32110	持有供交易之金融負債	(1,725,606)	(835,779)
A32110	應付帳款	(1,272,717)	1	6,422,305
A32180	其他應付款項	(
A32180 A32230	其他流動負債	(814,809)		3,045,452
		,	2,545,312	,	703,764
A32990	其他營業負債		247,024)		186,455)
A33000	營運産生之現金流入		63,047,142		50,058,437
A33100	収取之利息		253,289		233,457
A33200	収取之股利	,	499,918	,	101,252
A33300	支付之利息	(2,067,955)	(2,065,244)
A33500	支付之所得稅	(4,184,089)		2,463,153)
AAAA	營業活動之淨現金流入		57,548,305		45,864,749
	投資活動之現金流量				
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,842,813)	(108,958,658)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產價款		102,139,161		109,825,159
B00300	取得備供出售金融資產	(1,273,510)	(3,565,428)
B00400	處分備供出售金融資產價款		2,761,145		4,388,130
B00500	備供出售金融資產減資退回股款		44,511		20,411
B01800	取得採用權益法投資之關聯企業及合資	(35,673,097)	(100,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(30,280,124)	(39,598,964)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		243,031		421,207
B04500	取得無形資產	(491,135)	(396,466)
B06500	其他金融資產減少(增加)		358,266	(372,569)
B06700	其他非流動資產增加	(336,864)	(480,711)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(63,351,429)	(38,817,889)
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款減少	(8,532,792)	(3,442,162)
C00500	應付短期票券增加		4,348,054		_

代碼		104年度		103年度(調整後)	
C01200	發行公司債	\$	6,136,425	\$	8,888,562
C01300	償還公司債		_	(729,790)
C01600	舉借長期借款		39,887,570		32,030,868
C01700	償還長期借款	(22,926,660)	(40,978,403)
C04500	發放現金股利	(15,297,474)	(9,967,215)
C04800	員工執行認股權	1,285,102		1,498,343	
C04900	庫藏股票買回成本	(5,333,406)		_
C05500	處分子公司部分權益價款		8,910,346		9,991,439
C05800	支付非控制權益現金股利	(232,148)	(85,766)
C09900	其他籌資活動		391,322	(2,879)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)		8,636,339	(2,797,003)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		723,556		2,418,182
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加	3,556,771			6,668,039
E00100	年初現金及約當現金餘額	51,694,410			45,026,371
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$	55,251,181	\$	51,694,410

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國105年3月16日查核報告)







會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併財務報告附註

民國104及103年1月1日至12月31日

(除另註明外, 金額以新台幣干元為單位)

一、公司沿革

日月光半導體製造股份有限公司(以下稱本公司或日月光)於73年3月設立於高雄楠梓加工出口區:93年8月吸收合併子公司日月欣半導體公司及日月宏科技公司並設立中壢分公司,95年8月將材料事業部分割讓與日月光電子公司(日月光電子):100年1月經核准設立南投分公司:101年5月吸收合併子公司日月鴻科技公司:102年8月吸收合併子公司洋鼎科技公司。本公司及子公司(以下統稱本集團)所營業務主要為半導體、基板、電腦週邊設備及電子零配件之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司股票78年7月在台灣證券交易所掛牌上市買賣,股票代碼為2311:另於89年9月發行美國存託憑證(ADR)在紐約證券交易所掛牌上市,代號為ASX。又子公司環旭電子公司於101年2月在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼為601231。 本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於105年3月16日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可之2013 年版國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)

依據金管會發布之金管證審字第1030029342號及金管證審字第1030010325號函,本集團自104年起開始適用業經國際會計準則理事會(IASB)發布且經金管會認可之2013年版IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下稱「IFRSs」)及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定。

除下列說明外,適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及2013年版IFRSs將不致造成本集團會計政策之重大變動:

1. IFRS 12「對其他個體之權益之揭露」

IFRS 12針對子公司、聯合協議、關聯企業及未納入合併財務報告之結構型個體之權益規定應揭露内容。本集團適用 IFRS 12之揭露,請參閱附註十二。

2. IFRS 13「公允價值衡量」

IFRS 13提供公允價值衡量指引,該準則定義公允價值、建立衡量公允價值之架構,並規定公允價值衡量之揭露。此外,該準則規定之揭露內容較為廣泛,例如,適用IFRS 13前,準則僅要求以公允價值衡量之金融工具須按公允價值三層級揭露,而依照IFRS 13規定,適用該準則之所有資產及負債皆須提供前述揭露。

IFRS 13之衡量規定係自104年起推延適用。相關揭露請參閱附註三十。

3. IAS 1之修正「其他綜合損益項目之表達」

依修正之準則規定,其他綜合損益項目須按性質分類且分組為(1)不重分類至損益之項目及(2)後續可能重分類至損益之項目。相關所得稅亦按相同基礎分組。適用該修正規定前,並無上述分組之強制規定。

本集團於104年追溯適用上述修正規定,不重分類至損益之項目包含確定福利計畫再衡量數及採權益法之關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數份額。後續可能重分類至損益之項目包含國外營運機構財務報表換算之兌換差額、備供出售金融資產未實現利益(損失)、現金流量避險及採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益份額(除確定福利計畫再衡量數外)。惟適用上述修正並不影響本年度淨利、本年度稅後其他綜合損益及本年度綜合損益總額。

4. IAS 19「員工福利」

該修訂準則規定確定福利義務變動及計畫資產公允價值變動係於發生時認列,因而排除過去得按「緩衝區法」處理之選擇,並加速前期服務成本之認列。該修訂規定所有確定福利計畫再衡量數立即認列於其他綜合損益,俾使已認列之淨退休金資產或負債反映計畫短絀或剩餘之整體價值。

此外,「淨利息」取代適用修訂準則前之利息成本及計畫資產之預期報酬,並以淨確定福利負債(資產)乘以折現率決定淨利息。修訂後IAS 19除了改變確定福利成本之表達,並規定更廣泛之揭露。

首次適用修訂後IAS 19時,因追溯適用產生102年12月31日(含)以前之累積員工福利成本變動數係調整103年1月1日遞延所得稅資產、淨確定福利負債、資本公積、保留盈餘、其他權益及非控制權益,惟不調整該日存貨之帳面金額。此外,本集團選擇不予揭露103年度確定福利義務敏感度分析。

採用修訂之準則對本年度尚無重大影響,103年度影響彙總如下:

	調整前金額		首次適用之調整		調整後金額	
資產、負債及權益之影響						
103年12月31日						
遞延所得稅資產	\$	4,493,664	\$	13,307	\$	4,506,971
淨確定福利負債		4,371,136		11,394		4,382,530
資本公積		15,995,671		17,387		16,013,058
保留盈餘		52,397,278	(16,040)		52,381,238
其他權益		5,067,931		608		5,068,539
非控制權益		8,219,139	(42)		8,219,097
103年1月1日						
遞延所得稅資產		3,765,482		17,783		3,783,265
淨確定福利負債		4,441,357		104,603		4,545,960
資本公積		7,908,870		11,350		7,920,220
保留盈餘		38,993,154	(87,052)		38,906,102
其他權益	(102,554)	(62)	(102,616)
非控制權益		4,144,338	(11,056)		4,133,282
103年度綜合損益之影響						
營業成本		203,051,691	(48,773)		203,002,918
營業費用		23,968,499	(25,839)		23,942,660
所得稅費用		4,251,513		15,113		4,266,626
本年度淨利影響		24,222,086		59,499		24,281,585
不重分類至損益之項目						
確定福利計畫再衡量數	(45,884)		17,739	(28,145)
與不重分類之項目相關之所得稅		13,039		9,899		22,938
本年度稅後其他綜合損益影響		5,475,203		28,307		5,503,510
本年度綜合損益總額影響		29,697,289		87,806		29,785,095
淨利影響歸屬於						
本公司業主	\$	23,592,667	\$	43,855	\$	23,636,522
非控制權益		629,419		15,644		645,063
	\$	24,222,086	\$	59,499	\$	24,281,585
綜合損益總額影響歸屬於						
本公司業主	\$	28,730,614	\$	71,682	\$	28,802,296
非控制權益		966,675		16,124		982,799
	\$	29,697,289	\$	87,806	\$	29,785,095

5. 「2009~2011週期之年度改善」

2009~2011週期之年度改善修正IFRS 1「首次採用IFRSs」、IAS 1「財務報表之表達」、IAS 16「不動產、廠房及設備」、IAS 32「金融工具:表達」及IAS 34「期中財務報導」等準則。

IAS 1之修正係闡明,於追溯適用會計政策、追溯重編財務報表之項目,或重分類其財務報表之項目,且前述事項對前一期期初之資產負債表資訊具重大影響時,本集團應列報前一期期初之資產負債表,但無須提供前一期期初之附註資訊。

由於首次適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及2013年版IFRSs對103年1月1日合併資產負債表資訊具重大影響,本集團業已依上述IAS 1之修正列報103年1月1日合併資產負債表,並按IAS 8「會計政策、會計估計變動及錯誤」 規定揭露,惟無需額外揭露103年1月1日各單行項目之附註資訊。

(二) IASB已發布但尚未經金管會認可之IFRSs

本集團未適用下列業經IASB發布但未經金管會認可之IFRSs。金管會於105年3月10日公布自106年起開始適用之認可IFRSs 公報範圍,為IASB於105年1月1日前發布,並於106年1月1日生效之IFRSs(不含IFRS 9 「金融工具」及IFRS 15「客戶合約之收入」等尚未生效或尚未確定生效日期之IFRSs)。此外,金管會並宣布我國公開發行公司應自107年起開始適用IFRS 15。截至本合併財務報告通過發布日止,金管會尚未發布前述新發布/修正/修訂準則及解釋以外之其他準則生效日。

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)			
「2010~2012週期之年度改善」	2014年7月1日或交易於2014年7月1日及以後			
「2011~2013週期之年度改善」	2014年7月1日			
「2012~2014週期之年度改善」	2016年1月1日(註2)			
IFRS 9「金融工具」	2018年1月1日			
IFRS 9及IFRS 7之修正「強制生效日及過渡揭露」	2018年1月1日			
IFRS 10及IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定			
IFRS 10、IFRS 12及IAS 28之修正「投資個體:合併報表例外規定之適用」	2016年1月1日			
IFRS 11之修正「聯合營運權益之取得」	2016年1月1日			
IFRS 14「管制遞延帳戶」	2016年1月1日			
IFRS 15「客戶合約之收入」	2018年1月1日			
IFRS 16「租賃」	2019年1月1日			
IAS 1之修正「揭露倡議」	2016年1月1日			
IAS 7之修正「揭露倡議」	2017年1月1日			
IAS 12之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」	2017年1月1日			
IAS 16及IAS 38之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	2016年1月1日			
IAS 16及IAS 41之修正「農業:生產性植物」	2016年1月1日			
IAS 19之修正「確定福利計畫:員工提撥金」	2014年7月1日			
IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	2014年1月1日			
IAS 39之修正「衍生工具之合約更替及避險會計之繼續」	2014年1月1日			
IFRIC 21「公課」	2014年1月1日			

註1:除另註明外,上述新發布/修正/修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

除下列說明外,適用上述新發布/修正/修訂準則或解釋將不致造成本集團會計政策之重大變動:

1. IFRS 9「金融丁具」

金融資產之認列及衡量

就金融資產方面,所有原屬於IAS 39「金融工具:認列與衡量」範圍内之金融資產後續衡量係以攤銷後成本衡量或以公允價值衡量。IFRS 9對金融資產之分類規定如下:

本集團投資之債務工具,若其合約現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息,分類及衡量如下:

註2:除IFRS 5之修正推延適用於2016年1月1日以後開始之年度期間外,其餘修正係追溯適用於2016年1月1日以後開始之年度期間。

- (1) 以收取合約現金流量為目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以攤銷後成本衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益認列於損益。
- (2) 藉由收取合約現金流量與出售金融資產而達成目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以透過其他綜合 損益按公允價值衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益與兌換損 益亦認列於損益,其他公允價值變動則認列於其他綜合損益。於該金融資產除列或重分類時,原先累積於其他綜合 損益之公允價值變動應重分類至損益。

本集團投資非屬前述條件之金融資產,係以公允價值衡量,公允價值變動認列於損益。惟本集團得選擇於原始認列時, 將非持有供交易之權益投資指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產除股利收益認列於損益外,其他相 關利益及損失係認列於其他綜合損益,後續無須評估減損,累積於其他綜合損益之公允價值變動亦不重分類至損益。

金融資產之減損

IFRS 9改採用「預期信用損失模式」認列金融資產之減損。以攤銷後成本衡量之金融資產、強制透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、應收租賃款、IFRS 15「客戶合約之收入」產生之合約資產或放款承諾及財務保證合約,係認列備抵信用損失。若前述金融資產之信用風險自原始認列後並未顯著增加,則其備抵信用損失係按未來12個月之預期信用損失衡量。若前述金融資產之信用風險自原始認列後已顯著增加且非低信用風險,則其備抵信用損失係按剩餘存續期間之預期信用損失衡量。但未包括重大財務組成部分之應收帳款必須按存續期間之預期信用損失衡量備抵信用損失。

此外,原始認列時已有信用減損之金融資產,本集團考量原始認列時之預期信用損失以計算信用調整後之有效利率,後續備抵信用損失則按後續預期信用損失累積變動數衡量。

一般避險會計

IFRS 9在一般避險會計之主要改變,係調整避險會計之適用條件,以使適用避險會計之財務報表更能反映企業實際進行的風險管理活動。與IAS 39相較,其主要修正内容包括:(1)增加可適用避險會計之交易型態,例如放寬非財務風險適用避險會計之條件;(2)修改避險衍生工具之損益認列方式,以減緩損益波動程度;及(3)避險有效性方面,以避險工具與被避險項目間的經濟關係取代實際有效性測試。

2. IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」

IASB於發布IFRS 13「公允價值衡量」時,同時修正IAS 36「資產減損」之揭露規定,導致本集團須於每一報導期間增加揭露資產或現金產生單位之可回收金額。本次IAS 36之修正係釐清本集團僅須於認列或迴轉減損損失當年度揭露該等可回收金額。此外,若可回收金額係以現值法計算之公允價值減處分成本衡量,本集團須增加揭露所採用之折現率。

3. IFRS 15「客戶合約之收入」

IFRS 15係規範來自客戶合約之收入認列原則,該準則將取代IAS 18「收入」、IAS 11「建造合約」及相關解釋。 本集團於適用IFRS 15時,係以下列步驟認列收入:

- (1) 辨認客戶合約;
- (2) 辨認合約中之履約義務;
- (3) 決定交易價格;
- (4) 將交易價格分攤至合約中之履約義務;及
- (5) 於滿足履約義務時認列收入。

IFRS 15生效時,本集團得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

4. IFRS 10及IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

該修正規定,若本集團出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本集團喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大 影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司符合IFRS 3「業務」之定義時,本集團係全數認列該等交易產生之損益。

此外,若本集團出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本集團在與關聯企業(或合資)之交易中喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司不符合IFRS 3「業務」之定義時,本集團僅在與投資者對該等關聯企業(或合資)無關之權益範圍內認列該交易所產生之損益,亦即,屬本集團對該損益之份額者應予以銷除。

5. IFRS 16「租賃」

IFRS 16係規範租賃之會計處理,該準則將取代IAS 17「租賃」及相關解釋。

於適用IFRS 16時,若本集團為承租人,除小額租賃及短期租賃得選擇採用類似IAS 17之營業租賃處理外,其他租賃皆應於合併資產負債表上認列使用權資產及租賃負債。合併綜合損益表應分別表達使用權資產之折舊費用及租賃負債按有效利息法所產生之利息費用。在合併現金流量表中,償付租賃負債之本金金額表達為籌資活動,支付利息部分則列為營業活動。

對於本集團為出租人之會計處理預計無重大影響。

IFRS 16生效時,本集團得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

6. IAS 12之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」

IAS 12之修正主要係釐清,不論本集團預期透過出售或透過收取合約現金流量回收以公允價值衡量之債務工具投資,且不論該資產是否發生未實現損失,暫時性差異應按該資產公允價值及課稅基礎之差額決定。

此外,除非稅法限制可減除暫時性差異所能減除之收益類型而應就同類型可減除暫時性差異評估是否認列遞延所得稅資產,否則應就所有可減除暫時性差異一併評估。於評估是否認列遞延所得稅資產時,若有足夠證據顯示本集團很有可能以高於帳面金額回收資產,則估計未來課稅所得所考慮之資產回收金額不限於其帳面金額,且未來課稅所得之估計應排除因可減除暫時性差異迴轉所產生之影響。

除上述影響外,截至本合併財務報告通過發布日止,本集團仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響,相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之IFRSs編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外,本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第1等級至第3等級:

- 1. 第1等級輸入值:係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。
- 2. 第2等級輸入值:係指除第1等級之報價外,資產或負債直接(亦即價格)或間接(亦即由價格推導而得)之可觀察輸入值。
- 3. 第3等級輸入值:係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及約當現金、主要為交易目的而持有之資產及預期於資產負債表日後12個月內實現之資產,但不包括於 資產負債表日後逾12個月用以交換或清償負債而受有其他限制者。流動負債包括主要為交易目的而持有之負債、預期於資 產負債表日後12個月內到期清償之負債,以及不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少12個月之負債。非屬上述 流動資產或流動負債者,係分類為非流動資產或非流動負債。

另從事房地產開發之子公司,其營業週期長於1年,是以與房地產開發相關之資產及負債,係按正常營業週期作為劃分流 動或非流動之標準。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體(子公司)之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司 於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整,以使其會計政策與本集團之會計政策一致。於 編製合併財務報告時,各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司 業主及非控制權益,即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當本集團對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者,係作為權益交易處理。本集團及非控制權益之帳面金額已予調

整,以反映其於子公司相對權益之變動。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額,係直接認列為權益且歸屬於本公司業主。

子公司明細、持股比例及營業項目如下:

			本集團持有之股權百分比(%)		
子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	104年12月31日	103年12月31日	
A.S.E. Holding Limited	控股公司		100.0	100.0	
J & R Holding Limited (J&R Holding)	控股公司	百慕達	100.0	100.0	
Innosource Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0	
Omniquest Industrial Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0	
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	從事市場行銷及客戶服務業務	日本	100.0	100.0	
台灣福雷電子公司(台灣福雷)	從事半導體測試服務	楠梓加工區	100.0	100.0	
環隆電氣公司(環隆電氣)	從事各種電腦及週邊設備之製造、加 工維修及銷售	南投縣	99.0	99.2	
環電股份有限公司(環電)	投資公司,設立於104年4月	南投縣	99.2	_	
陸竹開發公司	從事房地產開發業務	台北市	86.1	86.1	
Alto Enterprises Limited	控股公司	英屬維京群島	100.0	100.0	
Super Zone Holdings Limited	控股公司	香港	100.0	100.0	
日月光半導體(昆山)有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸昆山	100.0	100.0	
日月光投資(昆山)有限公司	控股公司	中國大陸昆山	100.0	100.0	
日月光集成電路製造(中國)有限公司	將從事半導體封裝測試業務	中國大陸上海	100.0	100.0	
ASE Investment (Labuan) Inc.	控股公司	馬來西亞	100.0	100.0	
ASE Test Limited (ASE Test)	控股公司	新加坡	100.0	100.0	
ASE (Korea) Inc.	從事半導體封裝測試業務	韓國	100.0	100.0	
日月瑞公司	從事租賃及投資業務	楠梓加工區	100.0	100.0	
ASE Japan Co., Ltd.	從事半導體封裝測試業務	日本	100.0	100.0	
ASE (U.S.) Inc.	從事市場行銷支援及客戶服務業務	美國	100.0	100.0	
Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0	
日月光半導體(威海)有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸山東	100.0	100.0	
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸蘇州	60.0	60.0	
Anstock Limited	從事專業性理財活動	英屬開曼群島	100.0	100.0	
Anstock II Limited	從事專業性理財活動	英屬開曼群島	100.0	100.0	
日月光電子元器件(上海)有限公司	將從事新型電子元器件及印刷電路板 產銷	中國大陸上海	100.0	100.0	
日月光半導體(上海)有限公司	從事半導體材料製造業務	中國大陸上海	100.0	100.0	
ASE Corporation	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0	
ASE Mauritius Inc.	控股公司	模里西斯	100.0	100.0	
ASE Labuan Inc.	控股公司	馬來西亞	100.0	100.0	
上海鼎匯房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及房屋銷售物 業管理	中國大陸上海	100.0	100.0	
上海鼎祺物業管理有限公司	從事房地產物業管理服務,設立於 104年1月	中國大陸上海	100.0	_	
日月光半導體(香港)有限公司	貿易公司	香港	100.0	100.0	
上海鼎威房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業 務	中國大陸上海	100.0	100.0	
上海鼎裕房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業 務	中國大陸上海	100.0	100.0	
昆山鼎悦房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業 務	中國大陸昆山	100.0	100.0	
昆山鼎泓房地產開發有限公司	從事房地產開發、建設及商場出租業	中國大陸昆山	100.0	100.0	

務

本集團持有之股權百分比(%)

子公司名稱	主要業務	設立及營運地點	104年12月31日	103年12月31日
日月光電子	從事半導體材料製造業務	一 楠梓加工區	100.0	100.0
ASE Test Holdings, Ltd.	控股公司	英屬開曼群島	100.0	100.0
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	控股公司	新加坡	100.0	100.0
ASE Test Finance Limited	已於104年7月清算完結	模里西斯	_	100.0
ASE Singapore Pte. Ltd.	從事半導體封裝測試業務	新加坡	100.0	100.0
ISE Labs, Inc.	從事半導體測試服務	美國	100.0	100.0
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	從事半導體封裝測試業務	馬來西亞	100.0	100.0
日月光封裝測試(上海)有限公司(日月 光上海封測)	從事半導體封裝測試業務	中國大陸上海	100.0	100.0
日月光貿易(上海)有限公司	貿易公司,由日月光上海封測於104 年1月投資	中國大陸上海	100.0	-
無錫通芝微電子有限公司	從事半導體封裝測試業務	中國大陸無錫	100.0	100.0
Huntington Holdings International Co. Ltd.	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
展毅投資公司	已於104年12月清算完結	南投縣	_	99.2
Unitech Holdings International Co. Ltd.	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
Real Tech Holdings Limited	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
Universal ABIT Holding Co., Ltd.	清算中	英屬開曼群島	99.2	99.2
Rising Capital Investment Limited	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
Rise Accord Limited	控股公司	英屬維京群島	99.2	99.2
雲湧電子(上海)有限公司	已於104年7月清算完結	中國大陸上海	-	99.2
環銓電子(昆山)有限公司	生產電腦輔助系統、週邊設備及銷售 自產產品	中國大陸昆山	99.2	99.2
USI Enterprise Limited(環誠)	投資諮詢服務及倉儲管理服務	香港	96.7	98.7
環旭電子公司(環旭上海)	提供各種電子產品設計、製造及銷售	中國大陸上海	75.7	82.1
Universal Global Technology Co., Limited	控股公司	香港	75.7	82.1
環鴻電子(昆山)有限公司	提供電子產品設計及製造服務	中國大陸昆山	75.7	82.1
環維電子(上海)有限公司	電子產品、通訊產品及零配件之加工 及銷售,及貨物及技術之進出口業 務	中國大陸上海	75.7	82.1
環豪電子(上海)有限公司	電子元器件、計算機軟硬體、通訊設 備及配件之銷售	中國大陸上海	75.7	82.1
環旭科技有限公司	製造、貿易及投資公司	香港	75.7	82.1
環鴻科技公司(環鴻科技)	電子通信器材、汽車及其零件製造、 產品設計及研究發展服務	南投縣	75.7	82.1
USI America Inc.	新型主機板組裝與製作、無線通訊 產品製作及維修服務。原名為USI Manufacturing Service, Inc.,於 104年5月更名為USI America Inc.	美國	75.7	82.1
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	主機板及電腦系統組裝	墨西哥	75.7	82.1
USI Japan Co., Ltd.	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電 子零件等之製造買賣	日本	75.7	82.1
USI@Work, Inc.	已於104年8月由USI America Inc.吸 收合併	美國	_	82.1
環勝電子(深圳)有限公司	主機板和相關電腦週邊設備及通訊和 工業控制等產品之設計、製造及銷 售	中國大陸深圳	75.7	82.1

- 1. 為進行組織調整以提高營運彈性,本公司之子公司環隆電氣經董事會決議以104年4月1日為基準日,分割投資部門業務並辦理減資16,012,966千元,計銷除已發行股份1,601,297千股,減資比率為97.56%;並按環隆電氣被分割標的之營業價值,由新設立之環電發行普通股新股1,000,000千股予環隆電氣之股東。環隆電氣股東依分割基準日之持股比例,按每1千股換取環電普通股609.27股,環隆電氣已於104年4月17日完成減資變更登記,另環電亦於104年4月17日經核准登記設立。分割完成後,本集團對環隆電氣與環電皆具有控制能力,且該分割對本集團之財務狀況無重大影響。
- 2. 為整合本集團電子組裝部門業務上下游產業鏈資源,本公司於104年9月經董事會決議預計以每股20元處分子公司環隆電氣股權39,603干股予本集團之子公司環鴻科技,交易總金額為792,064干元,該價款係參酌環隆電氣截至104年6月30日經會計師查核財務報表之每股淨值議定之。105年2月業經經濟部投資審議委員會審議通過。

(五)企業合併

企業合併係採收購法處理。收購相關成本於成本發生及勞務取得當年度列為費用。

商譽係按移轉對價之公允價值、被收購者之非控制權益金額以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日之公允價值之總額,超過收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額衡量。倘於重評估後,收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額仍超過移轉對價、被收購者之非控制權益以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日公允價值之總數,則該差額為廉價購買利益,並立即認列為損益。

分階段達成之企業合併係以收購日之公允價值再衡量本集團先前已持有被收購者之權益,若因而產生任何利益或損失,則認列為損益或其他綜合損益。因先前已持有被收購者之權益而於收購日前已認列於其他綜合損益之金額,係按與本集團若 直接處分其先前已持有權益之相同基礎認列。

因本集團企業合併所取得可辨認資產及承擔負債之衡量若尚未完成,於資產負債表日係以暫定金額認列,並於衡量期間進行追溯調整或認列額外之資產或負債,以反映所取得有關收購日已存在事實與情況之新資訊。

本集團未採用收購法處理組織重組下之企業合併,而係採用帳面價值法,並視為自始合併而重編前期比較資訊。

(六) 外幣

各個體編製財務報告時,以個體功能性貨幣以外之貨幣(外幣)交易者,依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額,於發生當期 認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算,所產生之兌換差額列為當期損益,惟屬公允價值 變動認列於其他綜合損益者,其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算,不再重新換算。

於編製合併財務報告時,本集團國外營運機構之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣:收益及費損項目係以當年度各月份之平均匯率換算並累計,所產生之兌換差額認列於其他綜合損益,並分別歸屬予本公司業主及非控制權益。

若本集團處分國外營運機構之所有權益,或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制,所有可歸屬於本公司業主且與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制,係按比例將累計兌換差額重新歸屬予該子公司之非控制權益,而不認列為損益。在其他任何部分處分國外營運機構之情況下,累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(七) 存貨及存貨-營建房地

存貨包括原料(不包括受託加工之晶圓)、物料、在製品、製成品及在途原物料。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量,比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入及完成出售所需之估計成本後之餘額。原料及物料成本按移動平均法計價,在製品及製成品成本按標準成本計價。

存貨-營建房地包括待售房地、在建房地及營建用地。預計開發之土地於取得所有權後列為營建用地:在建房地於積極進行土地開發及建造房屋期間,就已支付在建房地成本所必須負擔之利息,予以資本化列為在建房地成本,俟工程完工則轉列為待售房地。待售房地、在建房地及營建用地以成本與淨變現價值孰低衡量,比較成本與淨變現價值係以個別項目為基礎。待售房地及在建房地預售所收取之款項先列入預收房地款。俟工程完工後,就已銷售房地交付予客戶且不再承擔顯著風險部分,轉列當年度營建收入,待售房地依出售面積比例轉為當年度營業成本。

(八) 投資關聯企業及合資

本集團對投資關聯企業及合資係採用權益法。關聯企業係指本集團具有重大影響,但非屬子公司或合資之企業。合資係本 集團與他公司具有聯合控制且對淨資產具有權利之聯合協議。

權益法下,投資關聯企業及合資原始依成本認列,取得日後帳面金額係隨本集團所享有之關聯企業及合資損益及其他綜合 損益份額與利潤分配而增減。此外,針對關聯企業權益及合資之變動係按持股比例認列。

取得成本超過本集團於取得日所享有關聯企業及合資可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽,該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷。

本集團與關聯企業及合資間之逆流、順流及側流交易所產生之損益,僅在與本集團對關聯企業權益及對合資權益無關之範 圍內,認列於合併財務報告。

(九) 不動產、廠房及設備

除土地以成本計價外,土地以外之不動產、廠房及設備係以成本認列,後續以成本減除累計折舊及累計減損後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時,分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

自有十地不提列折舊。

本集團之不動產、廠房及設備(包含融資租賃所持有之資產)於耐用年限内按直線基礎,對於每一重大部分單獨提列折舊。若租賃期間較耐用年限短者,則於租賃期間内提列折舊。本集團至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視,並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(十) 商譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本,後續以成本減除累計減損後之金額衡量。

為減損測試之目的,商譽分攤至本集團預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組(簡稱「現金產生單位」)。

受攤商譽之現金產生單位每年(及有跡象顯示該單位可能已減損時)藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較,進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得,則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額,減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額,次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當年度損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

(十一) 其他無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量,後續係以成本減累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按未來經濟效益之預期消耗型態或以直線基礎進行攤銷,並且至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視。並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

企業合併所取得之無形資產係以收購日之公允價值認列,並與商譽分別認列。後續衡量方式與單獨取得之無形資產相同。 無形資產除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當年度損益。

(十二) 有形及無形資產(商譽除外)之減損

本集團於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產(商譽除外)可能已減損。若有任一減損跡象存在,則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額,本集團估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者,個別資產或現金產生單位之可回收金額若其低於帳面金額時,則將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額,減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時,該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額,惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十三) 金融工具

金融資產與金融負債於本集團成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。原始認列時,若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者,係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本,則立即認列為損益。

金融資產

金融資產之慣例交易係採交割日會計認列及除列。

1. 衡量種類

本集團所持有之金融資產分類係於原始認列時視其性質及目的而決定。

(1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公分價值衡量之金融資產包括持有供交易及指定為透過損益按公分價值衡量之金融資產。

本集團於下列情況下,係將金融資產於原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量:

- A. 該指定可消除或重大減少衡量或認列不一致;或
- B. 一組金融資產、金融負債或兩者,依書面之風險管理或投資策略,以公允價值基礎管理並評估其績效,且本集團內部提供予管理階層之該投資組合資訊,亦以公允價值為基礎;或
- C. 將包含一個或多個嵌入式衍生工具之混合(結合)合約整體進行指定。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失(包含該金融資產所產生之任何股利或利息)係認列於損益。

公允價值之決定方式請參閱附註三十。

(2) 備供出售金融資產

備供出售金融資產係非衍生金融資產被指定為備供出售,或未被分類為放款及應收款、持有至到期日投資或透過損益按公允價值衡量之金融資產。

備供出售金融資產係按公允價值衡量,備供出售貨幣性金融資產帳面金額之變動中屬外幣兌換損益與以有效利息法 計算之利息收入,以及備供出售權益投資之股利,係認列於損益。其餘備供出售金融資產帳面金額之變動係認列於 其他綜合損益,於投資處分或確定減損時重分類為損益。

備供出售權益投資之股利於本集團收款之權利確立時認列。

(3) 放款及應收款

放款及應收款主要包括現金及約當現金、應收帳款、其他應收款及其他金融資產,係採用有效利息法按攤銷後成本 減除減損損失後之金額衡量,惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

約當現金包括自取得日起3個月内,高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款,係用於 滿足短期現金承諾。

2. 金融資產之減損

除透過損益按公允價值衡量之金融資產外,本集團係於每一資產負債表日評估其他金融資產是否有減損客觀證據,當有客觀證據顯示,因金融資產原始認列後發生之單一或多項事項,致使金融資產之估計未來現金流量受損失者,該金融資產即已發生減損。

按攤銷後成本列報之金融資產,如應收帳款及其他應收款,該資產經個別評估未有客觀減損證據後,再以組合就過去收 款經驗以及與應收款項違約有關之可觀察因素評估減損。

按攤銷後成本列報之金融資產之減損損失金額係該資產帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產原始有效利率折現之現值間之差額。於後續期間減損損失金額減少,且經客觀判斷該減少與認列減損後發生之事項相連結,則先前認列之減損損失直接或藉由調整備抵帳戶予以迴轉認列於損益,惟該迴轉不得使金融資產帳面金額超過若未認列減損情況下於迴

轉日應有之攤銷後成本。

當備供出售權益投資之公允價值低於成本且發生大幅或持久性下跌時,係為客觀減損證據。當備供出售金融資產發生減損時,原先已認列於其他綜合損益之累計損失金額將重分類至損益。備供出售權益工具投資已認列於損益之減損損失不得透過損益迴轉。任何認列減損損失後之公允價值回升金額係認列於其他綜合損益。備供出售債務工具之公允價值若於後續期間增加,而該增加能客觀地連結至減損損失認列於損益後發生之事項,則減損損失予以迴轉並認列於損益。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除,惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當判斷應收帳款無法收回時,係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。除因應收帳款無法收回而沖銷備抵帳戶外,備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

3. 金融資產之除列

本集團僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效,或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉 予其他企業時,始將金融資產除列。除列時,其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損 失之總和間之差額係認列於損益。

權益工具

本集團發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

金融負債

金融負債係以有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係持有供交 易之金融負債。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失係認列於損益,包含所支付之股利或利息。公允價值之決定方式請參閱附註三十。

本集團僅於義務解除、取消或到期時,始將金融負債除列。除列時,其帳面金額與所支付對價間之差額認列為損益。

衍生工具

衍生工具於簽訂合約時,原始以公允價值認列,後續於資產負債表日按公允價值再衡量,後續衡量產生之利益或損失直接 列入損益,然指定且為有效避險工具之衍生工具,其認列損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值 為正值時,列為金融資產:公允價值為負值時,列為金融負債。

嵌入式衍生工具之風險及特性與主契約之風險及特性並非緊密關聯,且主契約非屬透過損益按公允價值衡量之金融資產或 金融負債時,該衍生工具係視為單獨衍生工具。

可轉換公司債

1. 可轉換公司債包含之轉換權屬權益性質

本集團發行之複合金融工具(可轉換公司債)係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義,於原始認列時將其組成部分分別分類為金融負債及權益。

原始認列時,負債組成部分之公允價值係以類似之不可轉換工具當時市場利率估算,並於執行轉換或到期日前,以有效利息法計算之攤銷後成本衡量。屬嵌入非權益衍生工具之負債組成部分則以公允價值衡量。

分類為權益之轉換權係等於該複合工具整體公允價值減除經單獨決定之負債組成部分公允價值之剩餘金額,經扣除所得 稅影響數後認列為權益,後續不再衡量。於該轉換權被執行時,其相關之負債組成部分及於權益之金額將轉列股本及資 本公積—發行溢價。可轉換公司債之轉換權若於到期日仍未被執行,該認列於權益之金額將轉列資本公積—發行溢價。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按分攤總價款之比例分攤至該工具之負債(列入負債帳面金額)及權益組成部分(列入權益)。

2. 可轉換公司債包含之轉換權屬負債性質

本集團發行之可轉換公司債所含轉換權組成部分,如非透過以固定金額現金或其他金融資產交換固定數量之本集團之權 益工具交割之轉換權,則分類為衍生性金融負債。 原始認列時,可轉換公司債之衍生性金融負債部分係以公允價值衡量,非衍生性金融負債部分之原始帳面金額則為分離 嵌入式衍生工具後之餘額。於後續期間,非衍生性金融負債係採有效利息法按攤銷後成本衡量,衍生性金融負債係按公 允價值衡量,且公允價值變動認列於損益。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按相對公允價值之比例分攤至該工具之非衍生性金融負債部分(列入負債帳面金額)及衍生性金融負債部分(列入損益)。

(十四) 避險會計

本集團指定部分避險工具進行現金流量避險。

指定且符合現金流量避險之避險工具,其公允價值變動屬有效避險部分係認列於其他綜合損益:屬無效避險部分則立即認 列於損益。

當被避險項目認列於損益時,原先認列於其他綜合損益之金額將於同一期間重分類至損益,並於合併綜合損益表認列於與被避險項目相關之項目下。然而,當預期交易之避險將認列非金融資產或非金融負債時,原先認列於其他綜合損益之金額,將自權益轉列為該非金融資產或非金融負債之原始成本。

當本集團取消指定避險關係、避險工具到期、出售、解約、執行或不再符合避險會計時,即推延停止避險會計。先前於避險有效期間已認列於其他綜合損益之金額,於預期交易發生前仍列於權益。當預期交易不再預期會發生時,先前認列於其他綜合損益之金額將立即認列於損益。

(十五) 收入認列

收入係按已收或應收對價之公允價值衡量,並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

1. 商品及房地之銷售

銷售商品及房地係於下列條件完全滿足時認列收入:

- (1) 本集團已將商品及房地所有權之重大風險及報酬移轉予買方;
- (2) 本集團對於已經出售之商品及房地既不持續參與管理,亦未維持有效控制;
- (3) 收入金額能可靠衡量;
- (4) 與交易有關之經濟效益很有可能流入本集團;及
- (5) 與交易有關之已發生或將發生之成本能可靠衡量。
- 2. 勞務之提供

勞務收入係於勞務提供時予以認列。

3. 股利收入及利息收入

投資所產生之股利收入及金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本集團,且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(十六) 租賃

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人,則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

1. 本集團為出租人

營業租賃之租賃收益係按直線基礎於租賃期間内認列為收益。

2. 本集團為承租人

融資租賃係以各期最低租賃給付現值總額或租賃開始日租賃資產公允價值較低者作為成本入帳,並同時認列應付租賃款 負債。

營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間内認列為費用。

(十七) 借款成本

直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本,係作為該資產成本之一部分,直到該資產達到預定使用或出售狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入,係自符合資本化條件之借款成本中減除。除上述外,其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

(十八) 政府補助

政府補助僅於可合理確信本集團將遵循政府補助所附加之條件,且將可收到該項補助時,始予以認列。

政府補助係於其意圖補償之相關成本於本集團認列為費用之期間內,按有系統之基礎認列於損益。以本集團應購買、建造或其他方式取得非流動資產為條件之政府補助係認列為遞延收入,並以合理且有系統之基礎於相關資產耐用年限期間轉列損益。

若政府補助係用於補償已發生之費用或損失,或係以給與本集團立即財務支援為目的且無未來相關成本,則於其可收取之期間認列於損益。

(十九) 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本(含服務成本、淨利息及再衡量數)係採預計單位福利法精算。服務成本(含當期服務成本及前期服務成本)及淨確定福利負債(資產)淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數(含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬)於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘,後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債(資產)係確定福利退休計畫之提撥短絀(剩餘)。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來 提撥金之現值。

(二十) 股份基礎給付協議

對員工之員工認股權,係以給與日權益工具之公允價值與預期既得之最佳估計數量,於既得期間内以直線基礎認列費用, 並同時調整資本公積一員工認股權及非控制權益。若其於給與日立即既得,係於給與日全數認列費用。

本集團於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量,其影響數係認列為損益,使累計費用反映修正之估計數,並相對調整資本公積—員工認股權及非控制權益。

(二一) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵10%所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。

以前年度應付所得稅之調整,列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依本集團内各個體之帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。 遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列,而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時 性差異、虧損扣抵或購置機器設備等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司相關之應課稅暫時性差異皆認列為遞延所得稅負債,惟本集團若可控制暫時性差異迴轉之時點,且該暫時 性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視,並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所 有或部分資產者,調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者,亦於每一資產負債表日予以重新檢視,並在未來很有 可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者,調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量,該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法 之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本集團於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金 額之方式所產生之租稅後果。

3. 本年度當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益,惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列

於其他綜合損益或直接計入權益。若當期所得稅或遞延所得稅係自企業合併所產生,其所得稅影響數納入企業合併之會 計處理。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團於採用附註四所述之會計政策時,對於不易自其他來源取得相關資訊者,管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將持續檢視估計與基本假設。若會計估計之修正僅影響當年度,則於修正當年度認列。若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度,則於修正當年度及未來年度認列。

(一) 商譽減損評估

決定商譽是否減損時,須估計分攤到商譽之現金產生單位之使用價值。為計算使用價值,管理階層應估計預期自現金產生單位所產生之未來現金流量,並決定計算現值所使用之適當折現率。若實際現金流量少於預期,可能會產生重大減損損失。

(二) 有形資產及無形資產(商譽除外)減損評估

資產減損評估過程中,本集團需依賴主觀判斷並依據資產使用模式及半導體產業特性,決定特定資產群組之獨立現金流量、資產耐用年數及未來可能產生之收益與費損,任何由於經濟狀況之變遷或本集團策略所帶來的估計改變均可能在未來 造成重大減損。

(三) 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價,故本集團必須運用判斷及估計以決定資產負債表日存貨之淨變現價值。 由於科技或環境快速變遷,本集團評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額,並將存貨成本 沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎,故可能產生重大變動。

(四) 所得稅

遞延所得稅資產之可實現性主要視未來是否有足夠之獲利或應課稅暫時性差異而定。若未來實際產生之獲利少於預期,可能會產生重大遞延所得稅資產之迴轉,該等迴轉係於發生年度認列為損益。

(五)確定福利計畫之認列

確定福利退休計畫應認列之確定福利成本及淨確定福利負債係使用預計單位福利法進行精算評價,其採用之精算假設包括 折現率、離職率及薪資預期增加率等估計,若該等估計因市場與經濟情況之改變而有所變動,可能會重大影響應認列之費 用與負債金額。

(六) 公允價值衡量及評價流程

如附註三十所述,本集團管理階層運用判斷以選定用以估計於活絡市場無市場報價金融工具之適當評價技術。本集團係採用市場參與者所通用之評價技術。對衍生金融工具之假設係基於市場價格或利率並依該工具之特性予以調整。債務工具係採用現金流量折現方式估計,而所使用假設係基於可觀察之市場價格或利率(若可行)。興櫃及未上市(櫃)權益工具之公允價值估計係基於對被投資者財務狀況與營運結果之分析、最近交易價格、相同權益工具於非活絡市場之報價、類似工具於活絡市場之報價及可比公司評價乘數等,包括非由可觀察市場價格或利率支持之假設。評價技術所使用之詳細假設係揭露於附註三十。本集團管理階層認為所選定之評價技術及假設可適當用以決定金融工具之公允價值。

六、現金及約當現金

	104年12月3	31日	103年12月	31日
庫存現金	\$	8,806	\$	9,953
銀行支票存款及活期存款		50,291,823		43,059,911
約當現金		4,950,552	_	8,624,546
	\$	55,251,181	\$	51,694,410

約當現金包括自取得日起3個月内、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款,係用於滿足短期現金承諾。

七、透過損益按公允價值衡量之金融工具

	104年12月31日		103年12月31日		
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產					
結構式定期存款	\$	1,646,357		\$	2,376,050
上櫃公司私募可轉換公司債		100,500			100,500
小計		1,746,857			2,476,550
持有供交易之金融資產					
換匯合約		1,452,611			1,907,705
基金受益憑證		573,242			533,425
上市(櫃)公司股票		37,058			43,352
遠期外匯合約		18,913			27,811
外幣選擇權合約		5,020			
小計		2,086,844			2,512,293
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	\$	3,833,701		\$	4,988,843
持有供交易之金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權(附註十八)	\$	2,632,565		\$	2,520,606
換匯合約		290,176			99,165
遠期外匯合約		69,207			31,581
外幣選擇權合約		13,659			_
利率交換合約		119			
透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動	\$	3,005,726		\$	2,651,352

(一)本集團與銀行簽訂之結構式定期存款以及本公司投資之私募可轉換公司債,皆包括非與主契約緊密關聯之 嵌入式衍生工具,於原始認列時將前述合約整體指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

(二) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之換匯合約如下:

幣別	到期期間	合約金額(千元)
104年12月31日		
新台幣兌美金	105.01~105.12	NTD57,554,138 / USD1,802,834
美金兌人民幣	105.01~105.03	USD353,881 / CNY2,255,872
美金兌日幣	105.03	USD67,125 / JPY8,240,000
美金兌新台幣	105.01	USD91,750 / NTD3,005,494
103年12月31日		
新台幣兌美金	104.01~104.12	NTD36,199,735 / USD1,209,000
美金兌新台幣	104.01~104.02	USD132,100 / NTD4,149,958
美金兌日幣	104.01	USD72,248 / JPY8,450,000
美金兌人民幣	104.01~104.06	USD80,000 / CNY503,452
人民幣兌美金	104.03	CNY217,288 / USD35,000

(三) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下:

幣別	到期期間	合約金額(千元)	
104年12月31日			
新台幣兌美金	105.02	NTD325,400 / USD10,000	
美金兌人民幣	105.01~105.03	USD121,000 / CNY780,252	
美金兌日幣	105.01	USD14,000 / JPY1,713,388	
美金兌韓圜	105.01	USD8,000 / KRW9,420,350	
美金兌馬幣	105.01~105.02	USD6,000 / MYR25,525	
美金兌新台幣	105.01~105.03	USD155,000 / NTD5,088,230	
美金兌新加坡幣	105.01~105.02	USD11,400 / SGD16,079	
103年12月31日			
美金兌新台幣	104.01	USD14,000 / NTD438,434	
美金兌人民幣	104.01~104.03	USD127,000 / CNY785,683	
美金兌馬幣	104.01~104.02	USD6,000 / MYR20,860	
美金兌新加坡幣	104.01~104.02	USD11,700 / SGD15,211	
美金兌日幣	104.01~104.04	USD18,385 / JPY2,177,800	

(四) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之外幣選擇權合約如下:

合約内容	到期期間	每期合約金額(千元)				
104年12月31日						
Buy USD Call / CNY Put	105.01~106.08(註)	USD2,000 / CNY13,800				
Buy USD Put / CNY Call	105.03	USD20,000 / CNY131,600				
Sell USD Put / CNY Call	105.01~106.08(註)	USD1,000 / CNY6,900				
註:上述合約約定每月進行交割,惟交易對手有權利提前終止合約,或當符合約定條件時合約將提前終止或交易雙方均無交割義務。						

(五) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之利率交換合約如下:

到期期間	合約金額(千元)	支付利率區間	收取利率區間
104年12月31日			
105.10	NTD1,000,000	4.6%	0.0%~5.0%

八、備供出售金融資產

	104年12月31日		103年12月31日		
有限合夥	\$	476,612	\$	555,361	
非上市(櫃)公司普通股		249,217		211,726	
上市(櫃)公司普通股		197,580		195,070	
基金受益憑證		16,037		1,500,434	
非上市(櫃)公司特別股		15,260		11,779	
備供出售金融資產		954,706		2,474,370	
減:列為流動資產		30,344		1,533,265	
列為非流動資產	\$	924,362	\$	941,105	

九、應收帳款淨額

	104年12月31	B	103年1	2月31日	3
應收帳款	\$	45,014,393		\$	53,004,955
減:備抵呆帳		82,906			84,145
	\$	44,931,487		\$	52,920,810

(一) 應收帳款

本集團之主要授信期間為30~90天。於評估應收帳款備抵呆帳時,本集團考量應收帳款之帳齡分析、歷史經驗及客戶財務 狀況等。

截至104及103年12月31日止,前五大客戶之應收帳款餘額占本集團應收帳款餘額之百分比分別為26%及30%,其餘應收帳款之信用集中風險相對並不重大。

應收帳款之帳齡分析如下:

	104年12月31日	103年12月31日
未逾期	\$ 40,40	9,227 \$ 47,387,888
1至30天	3,90	1,300 5,222,943
31至90天	49	95,664 306,052
91天以上	20	88,072
合計	\$ 45,0	4,393 \$ 53,004,955

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

已逾期但未減損應收帳款之逾期帳齡分析如下:

	104年12月31日	<u> </u>	103年12月31日	<u> </u>
30天以下	\$	3,086,796	\$	5,191,521
31至90天		344,265		131,247
91天以上				1,407
合計	\$	3,431,061	\$	5,324,175

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

於資產負債表日上述已逾期但本集團尚未認列備抵呆帳之應收帳款,因其信用品質並未重大改變,本集團管理階層認為仍可回收其金額。本集團對該等應收帳款並未持有任何擔保品或其他信用增強保障。

應收帳款之備抵呆帳變動資訊如下:

	個別評估減損損失		群組	評估減損損失	合計	
104年1月1日餘額	\$	28,305	\$	55,840	\$	84,145
本年度提列(迴轉)呆帳費用		18,816	(10,584)		8,232
本年度實際沖銷	(7,617)	(209)	(7,826)
外幣換算差額	(458)	(1,187)	(1,645)
104年12月31日餘額	\$	39,046	\$	43,860	\$	82,906
103年1月1日餘額	\$	26,885	\$	41,235	\$	68,120
本年度提列呆帳費用		2,875		15,156		18,031
本年度實際沖銷	(891)	(917)	(1,808)
外幣換算差額	(564)		366	(198)
103年12月31日餘額	\$	28,305	\$	55,840	\$	84,145

(二) 金融資產之移轉

本集團讓售應收帳款之相關資訊如下:

交易對象	本年度調	賽售金額(千元)	本年度日	年度已收現金額(千元) 截至年底已預支金額(千元) 已預支金額年利率(%)		額度(千元)		
104年度								
花旗銀行	USD	78,804	USD	36,955	USD	41,849	1.30%	USD 92,000
103年度								
花旗銀行	USD	103,744	USD	103,744	USD	_	-	USD 92,000

上述額度可循環使用,另依讓售合約之規定,因商業糾紛(如銷貨退回或折讓等)而產生之損失由本公司承擔,因信用風險 而產生之損失則由該銀行承擔。本公司於104年及103年12月31日均已提供美金5,000千元之商業本票予銀行用以補償商業 糾紛損失。截至104年12月31日止,本公司並未發生重大商業糾紛,於可預見之未來亦預期不會發生重大商業糾紛。

十、存貨

	104年12月31日		103年12月31日		
製成品	\$	10,012,182	\$	6,568,459	
在製品		1,692,346		2,064,377	
原料		9,672,894		10,155,006	
物料		852,251		797,353	
在途原物料		1,028,606		577,898	
	\$	23,258,279	\$	20,163,093	

104及103年度與存貨相關之營業成本分別為233,165,722千元及202,960,428千元,其中分別包括存貨損失352,011千元及601,726千元。

十一、存貨-營建房地

	104年12月31日	3	103年12月31日		
待售房地	\$	5,431	\$	5,558	
在建房地(附註十六)		23,956,678		22,242,065	
營建用地		1,751,429		1,738,855	
	\$	25,713,538	\$	23,986,478	

待售房地主係位於上海張江,已完工陸續出售:在建房地主係位於上海漕寶路段與滬太路段及昆山利都路段與新虹路段: 利息資本化資訊請參閱附註二二。

截至104年及103年12月31日,預期超過12個月以後回收之存貨分別為24,837,046千元及23,697,339千元。 本集團設定抵押作為借款擔保之存貨-營建房地金額,請參閱附註三二。

十二、採用權益法之投資

	104年12月31日	<u> </u>	103年12月31日		
投資關聯企業	\$	36,809,068	\$	1,492,441	
投資合資		613,841			
	\$	37,422,909	\$	1,492,441	

(一) 投資關聯企業

1. 本集團採用權益法之關聯企業投資列示如下:

被投資公司名稱	主要業務	營運地點	104年12月31日		103年12月31日	
具重大性之關聯企業						
矽品精密工業公司(矽品)	各項積體電路構裝之製造、加工、買 賣及測試等業務	台灣	\$	35,423,058	\$	_
個別不重大之關聯企業						
宏璟建設公司(宏璟)	委託營造廠商興建大樓及出租業務等	台灣		1,313,499		1,351,400
宏錦光公司(宏錦光)	經營辦公大樓及攤位出租業務	台灣		332,444		342,138
元隆電子公司(元隆)	晶圓積體電路代工	台灣		40,216		99,052
				37,109,217		1,792,590
	減: 以土地作價投資宏錦光之未實現			300,149		300,149
	利益		\$	36,809,068	\$	1,492,441

2. 資產負債表日對關聯企業持有之股權百分比如下:

被投資公司名稱 104年12月31日		103年12月31日
矽品	24.99%	_
宏璟	26.22%	26.22%
元隆	18.24%	18.24%
宏錦光	27.31%	27.31%

- 3. 本公司於104年9月以每股價格45元收購矽品普通股725,749干股及海外存託憑證10,650干單位(每單位表彰普通股5股), 合計持股24.99%,對矽品具重大影響。另截至104年12月31日止,本公司尚未完成投資成本與所享有關聯企業可辨認資 產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識。
 - 另,本公司於104年12月經董事會決議自104年12月29日至105年2月16日止,以每股價格55元及等值275元之美元現金作為對價,公開收購矽品已發行之普通股及海外存託憑證(每單位表彰普通股5股)。預定之最高收購數量為矽品普通股770,000千股,約當於矽品已發行普通股股份總數之24.71%。因台灣公平交易委員會目前仍在審查本公司與矽品結合之申報案,本公司已延長公開收購日期至105年3月17日止。
- 4. 本公司於103年1月認購元隆私募之普通股並對元隆具重大影響。該普通股依相關法令規定於3年內不得轉讓。
- 5. 關聯企業具公開市場報價之第1級公允價值資訊如下:

	104年12月31日			103年12月31日		
矽品	_	\$	40,741,700		\$	_
宏璟		\$	1,149,549		\$	1,427,499
元隆		\$	104,255		\$	184,862

6. 本集團重大關聯企業之彙整性財務資訊

以下彙總性財務資訊係以矽品依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之IFRSs編製之合併財務報告為基礎編製,並已反映採權益法時所做之調整。

	104年12月31日	
流動資產	\$	48,785,212
非流動資產		74,460,018
流動負債	(30,677,239)
非流動負債	(21,967,349)
權益	\$	70,600,642
本集團持股比例(%)		24.99
本集團享有之權益	\$	17,643,100
取得成本與股權淨值差額		17,779,958
投資帳面金額	\$	35,423,058
	104年度	
營業收入	\$	82,839,922
本年度淨利	\$	8,762,257
本年度其他綜合損益	(906,053)
本年度綜合損益總額	\$	7,856,204

7. 本集團個別不重大之關聯企業彙總資訊

	104年度		103年度	
本集團享有之份額				_
本年度淨利	\$	115,857	\$	147,085
其他綜合損益	(2,916)		234,125
綜合損益總額	\$	112,941	\$	381,210

採用權益法之關聯企業之損益及其他綜合損益份額,係依據各關聯企業同期間經會計師查核之財務報告認列。

(二)投資合資

1. 本集團採用權益法之個別不重大之合資投資列示如下:

				104年12月31日		
被投資公司名稱	主要業務	營運地點	金額		持股比例(%)	
日月陽電子公司(日月陽)	電子零組件製造	台灣	\$	613,841	51.00	

本集團於104年5月與日商TDK Corporation簽署合資協議共同出資成立日月陽,並於104年8月以現金投資618,097千元,取得51.00%股權,然而,依據聯合協議,由出資雙方共同主導該公司相關營運活動,因此本集團對日月暘不具控制,對日月陽之投資採用權益法。

2. 本集團個別不重大之合資彙總資訊

	104年度	
本集團享有之份額		
本年度淨利	(\$	4,274)
其他綜合損益		
綜合損益總額	(\$	4,274)

採用權益法之合資之損益及其他綜合損益份額,係依據合資公司同期間經會計師查核之財務報告認列。

十三、不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備每一類別之帳面金額如下:

	104年12月31日		103年12月31日		
土地	\$	3,381,300		\$	3,348,018
建築物及附屬設備		59,801,054			56,395,710
機器設備		78,715,309			84,171,647
其他設備		1,814,994			1,816,687
未完工程及待驗設備		6,284,418			5,855,053
	\$	149,997,075		\$	151,587,115

104年1月1日至12月31日

	建築物及			未完工程及		
	土地	附屬設備	機器設備	其他設備	待驗設備	合計
成本						
104年1月1日餘額	\$ 3,348,018	\$ 86,725,254	\$ 233,669,627	\$ 7,182,574	\$ 5,862,217	\$ 336,787,690
增添	_	132,584	553,496	401,417	27,193,324	28,280,821
處分	_	(405,040)	(8,041,933)	(232,555)	(20,711)	(8,700,239)
重分類	_	8,579,472	18,054,712	389,783	(26,893,158)	130,809
淨兌換差額	33,282	(584,338)	(952,295)	(18,811)	256,088	(1,266,074)
104年12月31日餘額	\$ 3,381,300	\$ 94,447,932	\$ 243,283,607	\$ 7,722,408	\$ 6,397,760	\$ 355,233,007

	建築物及							未完工程及						
	土地		-	附屬設備		機器設備		其他設備	待驗設備			合計		
累計折舊及減損														
104年1月1日餘額	\$	_	\$	30,329,544	\$	149,497,980	\$	5,365,887	\$	7,164	\$	185,200,575		
折舊費用		_		4,790,646		23,372,408		775,716		_		28,938,770		
減損損失		_		120,424		31,116		_		106,589		258,129		
處分		_	(308,895)	(7,838,937)	(224,509)		_	(8,372,341)		
重分類		_		5,704	(11,920)		3,008		_	(3,208)		
淨兌換差額		_	(290,545)	(482,349)	(12,688)	(411)	(785,993)		
104年12月31日餘額	\$	_	\$	34,646,878	\$	164,568,298	\$	5,907,414	\$	113,342	\$	205,235,932		

103年1月1日至12月31日

	土地	建築物及 附屬設備	機器設備	其他設備	未完工程及 待驗設備	合計
成本						
103年1月1日餘額	\$ 3,295,758	\$ 70,593,537	\$ 208,351,905	\$ 6,384,589	\$ 7,009,702	\$ 295,635,491
增添	=	1,246,123	1,140,822	572,766	40,488,876	43,448,587
處分	_	(299,515)	(8,188,532)	(447,047)	(56,209)	(8,991,303)
重分類	_	12,683,476	27,935,525	395,115	(41,044,364)	(30,248)
淨兌換差額	52,260	2,501,633	4,429,907	277,151	(535,788)	6,725,163
103年12月31日餘額	\$ 3,348,018	\$ 86,725,254	\$ 233,669,627	\$ 7,182,574	\$ 5,862,217	\$ 336,787,690
累計折舊及減損						
103年1月1日餘額	\$ -	\$ 25,826,936	\$ 133,266,723	\$ 5,044,501	\$ -	\$ 164,138,160
折舊費用	_	3,980,337	21,180,214	644,491	_	25,805,042
減損損失	_	79,124	211,466	_	7,164	297,754
處分	_	(248,477)	(7,786,216)	(433,863)	_	(8,468,556)
重分類	_	7,459	(7,122)	(7,907)	_	(7,570)
淨兌換差額		684,165	2,632,915	118,665		3,435,745
103年12月31日餘額	\$ -	\$ 30,329,544	\$ 149,497,980	\$ 5,365,887	\$ 7,164	\$ 185,200,575

由於部分廠房及設備不符本集團生產需求致其可回收金額小於帳面價值,本集團於104及103年度分別認列減損損失 258,129千元及297,754千元,並列入合併綜合損益表之其他利益(損失)項下。本集團評估已減損之廠房及設備之可回收金額,部分係依據當時二手市場中相似機齡及使用狀況之資產報價減處分成本衡量,因二手市場之交易並不活絡,故該等資產二手市場報價係屬於第三級之公允價值。其餘廠房及設備則係以使用價值評估。

本集團之不動產、廠房及設備係以直線基礎按下列耐用年數計提折舊:

建築物及附屬設備	
廠房主建物	10至40年
無塵室工程	10至20年
其他	3至20年
機器設備	2至10年
其他設備	2至20年

利息資本化資訊請參閱附註二二。

十四、<u>商譽</u>

 成本		累計減損		帳面價值
\$ 12,434,411	\$	1,988,996	\$	10,445,415
61,104		_		61,104
\$ 12,495,515	\$	1,988,996	\$	10,506,519
\$ 12,336,816	\$	1,988,996	\$	10,347,820
97,595		_		97,595
\$ 12,434,411	\$	1,988,996	\$	10,445,415
\$	\$ 12,434,411 61,104 \$ 12,495,515 \$ 12,336,816 97,595	\$ 12,434,411 \$ 61,104 \$ 12,495,515 \$ \$ 12,336,816 \$ 97,595	\$ 12,434,411 \$ 1,988,996 61,104	\$ 12,434,411 \$ 1,988,996 \$ 61,104

(一)分攤商譽至現金產生單位

進行減損測試時,商譽係分攤至封裝部門、測試部門、電子組裝部門及其他部門等四個現金產生單位。分攤至現金產生單位之商譽帳面金額如下:

現金產生單位	104年12月31日	103年12月31日	
測試部門	\$ 7,890),525 \$ 7,846,46	0
其他	2,615	5,994 2,598,95	5
	\$ 10,506	\$ 10,445,41	5

(二) 減損評估

本集團於各年度結束日對商譽之可回收金額進行減損評估,並以使用價值作為可回收金額之計算基礎,預估未來5年現金流量及以持平之成長率2%外推超過5年後之現金流量,並使用年折現率折算而得。基於此分析結果,本集團104及103年度皆未認列任何商譽之減損損失。

本集團用以計算現金產生單位之使用價值之關鍵假設包括營收成長率及折現率。營收成長率係參考本集團及相關行業增長預測及歷史經驗予以評估,而104年及103年12月31日所使用之折現率分別為8.67%~10.71%及9.70%~11.50%。

有關現金產生單位之使用價值評估,本集團管理階層相信前述關鍵假設之變動並無相當可能使各該現金產生單位之帳面金 額重大超過其可回收金額。

十五、其他無形資產

其他無形資產每一類別之帳面金額如下:

	104年12月31	日	103年12月31日			
客戶關係	\$	274,402	\$	501,501		
電腦軟體		953,322		798,127		
其他		154,369	_	168,243		
	\$	1,382,093	_\$	1,467,871		

104年度

	客戶關係		電腦軟體		腦軟體 其他			合計
成本								
104年1月1日餘額	\$	1,579,015	\$	2,882,932	\$	2,323,547	\$	6,785,494
增添		_		481,412		9,723		491,135
處分或除列	(663,379)	(8,426)	(1,984,118)	(2,655,923)
重分類		_		12,360		_		12,360
淨兌換差額			(29,918)	(1,732)	(31,650)
104年12月31日餘額	\$	915,636	\$	3,338,360	\$	347,420	\$	4,601,416
累計攤銷								
104年1月1日餘額	\$	1,077,514	\$	2,084,804	\$	2,155,305	\$	5,317,623
攤銷費用		227,099		325,856		26,939		579,894
處分或除列	(663,379)	(7,402)	(1,983,914)	(2,654,695)
重分類		_		3,190		_		3,190
淨兌換差額			(21,410)	(5,279)	(26,689)
104年12月31日餘額	\$	641,234	\$	2,385,038	\$	193,051	\$	3,219,323
	_							

103年度

	客戶關係		電腦軟體		其他		合計	
成本								
103年1月1日餘額	\$	1,579,015	\$	3,679,835	\$	2,304,655	\$	7,563,505
增添		_		375,623		20,843		396,466
處分或除列		_	(1,232,757)	(6,406)	(1,239,163)
重分類		_		6,228		_		6,228
淨兌換差額				54,002		4,456		58,458
103年12月31日餘額	\$	1,579,015	\$	2,882,931	\$	2,323,548	\$	6,785,494
累計攤銷								
103年1月1日餘額	\$	924,194	\$	3,002,828	\$	2,030,659	\$	5,957,681
攤銷費用		153,320		269,375		123,039		545,734
處分或除列		_	(1,227,346)		_	(1,227,346)
重分類		_		2,516		_		2,516
淨兌換差額				37,431		1,607		39,038
103年12月31日餘額	\$	1,077,514	\$	2,084,804	\$	2,155,305	\$	5,317,623

上述無形資產除部分客戶關係係依據未來經濟效益之預期消耗型態計提攤銷費用外,其餘係以直線基礎按下列耐用年數計提攤銷費用:

 客戶關係
 11年

 電腦軟體
 2至5年

 其他
 5至32年

十六、長期預付租金

長期預付租金主要係中國大陸之土地使用權,使用期限為50至70年。截至104年及103年12月31日止,本集團尚在進行取得使用權證明程序中之土地使用權分別為0元及17,594千元。本集團於103年度取得經中國大陸地區政府核准之土地使用權證,並將部分長期預付租金重分類至存貨-營建房地之在建房地項下。

十七、借款

(一) 短期借款

主係無擔保之銀行週轉性借款,104年及103年12月31日年利率分別為0.57%~5.78%及0.81%~6.00%。

(二) 應付短期票券

104年12月31日尚未到期之應付短期票券係應付商業本票面額4,350,000千元減除未攤銷折價1,946千元後之餘額,年利率0.78%。保證機構係中華及兆豐票券金融公司。

(三) 長期借款

1. 銀行借款

本集團104年及103年12月31日之長期銀行借款中屬固定利率之週轉性借款分別計1,500,000千元及1,192,975千元,將於107年12月到期,年利率分別為1.17%及1.10%~6.15%,一年内到期之部分分別為0元及116,876千元。餘皆係浮動利率之長期銀行借款,包括:

	104年12月31日		103年12月31日
(1) 週轉性借款			
銀行團聯貸-將陸續於105年4月至107年7月償還,年			
利率104年及103年12月31日分別為1.56%~1.92%及			
0.90%~1.83%	\$	12,159,037	\$ 10,760,548

	104年12月31日	103年12月31日
 其他-將陸續於105年6月至108年8月償還,年利率104 年及103年12月31日分別為0.90%~3.98%及1.03%~ 3.74%	\$ 25,660,638	\$ 12,479,650
(2) 質抵押借款		
將陸續於105年7月至112年6月償還,年利率104年及103		
年12月31日分別為4.95%~5.39%及6.77%	3,251,139	2,534,483
	41,070,814	25,774,681
減:未攤銷遞延主辦費	18,670	32,225
	41,052,144	25,742,456
減:一年内到期之銀行借款	2,057,465	2,714,131
銀行借款	\$ 38,994,679	\$ 23,028,325

上述銀行團聯合融資合約,除其他有關規定外,尚規定本集團以經會計師查核或核閱之年度或半年度合併財務報告或子公司經會計師查核之年度個體財務報告為計算基礎,於貸款存續期間內,應維持約定流動比率、負債比率、有形淨值金額及利息償付能力。本集團及子公司於104年及103年12月31日均符合上述規定。

本集團預計可將部分一年內到期之長期借款再融資至104年12月31日後至少12個月,是以截至104年12月31日止尚有 2,105,883千元未列入一年內到期部分。

2. 應付票券

係本公司與大慶票券公司簽訂發行3年期循環冤保證票券2,000,000千元。104年12月31日年利率1.03%,未攤銷折價 1,011千元。

十八、應付公司債

	104年12月31日	103年12月31日
國内有擔保公司債-由銀行提供擔保		
期間5年,將於105年8月到期一次償還,每年付息,年利率 1.45%	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000
海外無擔保轉換公司債		
美金400,000千元	13,130,000	12,660,000
美金200,000千元(新台幣計價)	6,185,600	-
海外有擔保公司債-由本公司提供擔保		
美金300,000千元,期間3年,將於106年7月到期一次償還,每半年付息,年利率2.125%	9,847,500	9,495,000
人民幣500,000千元,期間5年,將於105年9月到期一次償 還,每半年付息,年利率4.25%	2,527,489	2,586,207
	39,690,589	32,741,207
減:應付公司債折價	1,264,339	1,471,076
	38,426,250	31,270,131
減:一年內到期之應付公司債	14,685,866	
應付公司債	\$ 23,740,384	\$ 31,270,131

本集團預計可將部分一年內到期之應付公司債8,000,000千元再融資至104年12月31日後至少12個月,是以相關應付公司債仍列為非流動。

(一)本公司於102年9月發行海外第三次無擔保轉換公司債,發行總額計美金400,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限5年。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣29.956元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股。發行時轉換價格為33.085元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,104年及103年12月31日轉換價格分別為30.28元及31.93元。

發行滿3年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於此公司債發行屆滿3年當日;或本公司控制權發生變動;或本公司普通股下市時,要求本公司贖回部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權、贖回權及賣回權(列入透過損益按公允價值衡量之金融負債項下),主債務契約原始認列之有效利率為3.16%,轉換權、贖回權與賣回權原始認列之公允價值為1,667,950千元。

(二)本公司於104年7月發行海外第四次無擔保轉換公司債,發行總額計美金200,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限2.75年。償還、賣回及贖回金額將按固定匯率美金1元對新台幣30.928元換算為新台幣,並以該新台幣金額按償還、賣回及贖回當時之匯率換算為美金計算。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣30.928元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股,本公司庫藏股可供轉換股權之用。發行時轉換價格為54.55元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,104年12月31日轉換價格為51.73元。

發行滿2.72年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續30個營業日中有20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算 為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法 令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於本公司控制權發生變動;或本公司普通股下市時,要求本公司贖回部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權(列入資本公積項下)。主債務契約原始認列之有效利率為1.58%,轉換權原始認列之金額為214,022千元。

(三) 另本公司秉持永續發展的精神,為進一步落實對於環境保護及節約能源的承諾,本公司間接持股100%之子公司 Anstock II Limited於103年7月發行總額美金300,000千元,票面利率2.125%之3年期海外公司債,由本公司提供擔保,將用於本集團所推行各項環境保護及節約能源之計畫支出。

十九、其他應付款

	104年12月31日		103年12月31日	
應付設備款	\$	4,782,357	\$	7,097,129
應付薪資及獎金		5,826,982		5,550,040
應付員工紅利或酬勞及董監酬勞		2,270,608		2,602,796
應付員工保險費		599,218		572,259
應付水電費		466,956		495,404
應付和解金		_		814,185
其他		5,248,697		5,232,703
	\$	19,194,818	\$	22,364,516

本公司及子公司ASE (U.S.) Inc.與美商Tessera Inc.之專利侵權訴訟於103年10月簽署最終和解協議書,並已撤銷美國加州地方法院之訴訟。103年12月31日之最終和解金為814,185千元(美金27,000千元),已於104年1月支付。

二十、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

- 1. 本集團中之本公司及國内子公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度,係屬政府管理之確定提撥退休計畫,依員工 每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。
- 2. 大陸、美國、馬來西亞、新加坡及墨西哥等地之子公司,亦依當地法令規定,提撥並繳付相關單位。

(二)確定福利計畫

- 1. 本集團中之本公司及國内子公司所適用我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付,係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算。本公司及國内子公司按員工每月薪資總額之一定比率按月提撥員工退休基金,交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶,年度終了前,若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工,次年度3月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理,本公司及國内子公司並無影響投資管理策略之權利。
- 2. ASE Japan Co., Ltd.規定服務滿10年以上之員工,得按服務年資及其退休時薪資之一定比率領取退休金: ASE (Korea) Inc.亦規定服務滿1年以上之員工及董事得按服務年資及其離職或退休時薪資之一定比率領取資遣費或退休金,且按員工薪資一定比率提撥至以員工名義並受公司管理之外部財務機構。
- 3. 本公司、台灣福雷及日月光電子另提列委任經理人退休金準備,104及103年度分別認列退休金成本2,302千元及16,645 千元(列入淨確定福利負債項下),並分別支付經理人退休金2,549千元及25,315千元。截至104年及103年12月31日止, 屬委任經理人之應計退休金負債分別為199,595千元及199,842千元。
- 4. 確定福利退休計畫應認列之確定福利成本及淨確定福利負債係使用預計單位福利法進行精算評價。除經理人退休金外, 本集團之確定福利義務現值,係由合格精算師進行精算。衡量日之重大假設如下:

	104年12月31日	103年12月31日		
折現率	0.15%~3.48%	0.12%~4.03%		
薪資預期增加率	2.00%~4.57%	2.00%~4.70%		

5. 除經理人退休金外,有關確定福利計畫所認列之損益金額依功能別彙總如下:

	104年	度		103年度	要(調整後)	
營業成本	9	6	319,151		\$	345,309
推銷費用			10,160			11,448
管理費用			43,753			35,867
研究發展費用	_		38,124			36,526
合計	9	5	411,188		\$	429,150

- 6. 於104及103年度,本集團分別認列精算損失51,909千元及5,207千元(調整後)於其他綜合損益。截至104年及103年12月 31日止,認列於其他綜合損益及非控制權益之精算損失累積金額分別為420,111千元及333,894千元(調整後)暨7,931千元及4,491千元(調整後)。
- 7. 除經理人退休金外,本集團列入合併資產負債表之確定福利計畫金額列示如下:

	104年12月31	103年12月31日(調整後)			
確定福利義務之現值	\$	7,973,676	9	B	7,674,293
計畫資產之公允價值	(3,973,729)	(3,502,487)
提撥短絀		3,999,947			4,171,806
列入其他應付款	(138,959)	(1,028)
列入預付退休金		11,910	_		11,910
淨確定福利負債	\$	3,872,898	9	\$	4,182,688

淨確定福利義務負債(資產)變動如下:

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債(資產)		
104年1月1日	\$ 7,674,293	(\$ 3,502,487)	\$ 4,171,806		
服務成本					
當期服務成本	335,655	_	335,655		
利息費用(收入)	183,889	(108,356)	75,533		
認列於損益	519,544	(108,356)	411,188		

	確定	定福利義務現值	計畫資產公允價值		淨	確定福利負債(資產)
再衡量數						
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)	\$	_	\$	12,426	\$	12,426
精算(利益)損失						
財務假設變動		309,695		_		309,695
經驗調整	(243,363)		_	(243,363)
人口統計假設變動	(15,847)		_	(15,847)
認列於其他綜合損益		50,485		12,426		62,911
雇主提撥		_	(611,581)	(611,581)
福利支付數						
計劃資產	(192,928)		192,928		_
雇主	(43,088)		_	(43,088)
國外退休計劃之兌換差額	(34,630)		43,341		8,711
104年12月31日	\$	7,973,676	(\$	3,973,729)	\$	3,999,947
103年1月1日	\$	7,472,145	(\$	3,118,804)	\$	4,353,341
服務成本						
當期服務成本		327,707		-		327,707
前期服務成本		22,036		-		22,036
利息費用(收入)		189,043	(109,636)		79,407
認列於損益		538,786	(109,636)		429,150
再衡量數						
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)精算(利益)損失		-		29,338		29,338
財務假設變動	(46,913)		-	(46,913)
經驗調整		38,516		_		38,516
人口統計假設變動		7,204				7,204
認列於其他綜合損益	(1,193)		29,338		28,145
雇主提撥		_	(556,555)	(556,555)
福利支付數						
計劃資產	(292,996)		292,996		_
雇主	(16,237)		_	(16,237)
國外退休計劃之兌換差額	(26,212)	(39,826)	(66,038)
103年12月31日	\$	7,674,293	(\$	3,502,487)	\$	4,171,806

8. 計畫資產之主要類別於資產負債表日之公允價值如下:

_	104年12月31日	103年12	1		
現金	\$	2,090,399		\$	1,854,926
權益工具		1,020,532			691,720
債務工具		823,496			869,752
其他		39,302	_		86,089
	\$	3,973,729	_	\$	3,502,487

9. 本公司及國内子公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險:

(1) 投資風險

勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式,將勞工退休基金分別投資於國内(外)權益證券與債務證券及 銀行存款等標的,惟合併公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。

(2) 利率風險

政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加,惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加,兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

(3) 薪資風險

確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

- 10. ASE (Korea) Inc.依法規定應管理基金資產及決定投資策略,並負有基金資產不足支付確定福利義務時之責任;其計畫資產均投資於銀行存單。
- 11. 若重大精算假設分別發生合理可能之變動,在所有其他假設維持不變之情況下,將使確定福利義務現值增加(減少)之金額如下:

	1049	≢12月31日
折現率		
增加0.5%	(\$	444,132)
减少0.5%	\$	497,046
薪資預期增加率		
增加0.5%	\$	476,378
减少0.5%	(\$	426,130)

由於精算假設可能彼此相關,僅單一假設變動之可能性不大,故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際 變動情形。

12. 未折現之退休金福利支付到期分析

	104年12月3	1日	103年12月	月31日
1年内	\$	247,030		249,000
超過1年但未超過5年		1,616,804		1,462,070
超過5年		17,674,518		14,468,022
	\$	19,538,352	3	16,179,092

本集團於104年12月31日預期1年内對確定福利計畫提撥之金額為705,384千元。

截至104年及103年12月31日,本集團確定福利義務平均到期期間分別為8年~16年及9年~18年。

二一、權益

(一) 股本

普通股股本

	104年12月31日	103年12月31日
額定股數(干股)	10,000,000	10,000,000
保留股數(干股)		
員工認股權	800,000	800,000
額定股本	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000

_	104年12月31日	103年12月31日
保留股本		
員工認股權	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000
已登記股數(干股)	7,902,929	7,852,538
預收股數(干股)	7,499	9,187
已發行且已收足股款之股數(干股)	7,910,428	7,861,725

本公司已發行之普通股每股面額為10元,每股享有一表決權(子公司持有之本公司股票除外)及收取股利之權利。104年及103年12月31日額定股數中均尚有500,000干股暫無須辦理變更登記。

發行海外存託憑證

本公司發行ADR,每單位表彰本公司普通股5股,截至104年及103年12月31日止,流通在外之ADR分別為115,240千單位及125,731千單位,折合普通股分別約576,198千股及628,657千股。

(二) 資本公積

	104年12月31日	103年12月31日(調整後)
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(註1)		
股票發行價格超過面額	\$ 5,479,616	\$ 4,946,308
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	7,197,510	_
僅得用以彌補虧損		
認列對子公司所有權權益變動數(註2)	8,489,984	9,054,328
庫藏股票交易	717,355	425,004
員工認股權執行	544,112	375,448
員工認股權失效	3,626	3,626
不得作為任何用途		
員工認股權	1,080,590	1,178,210
發行可轉換公司債認列權益組成部分	214,022	_
採權益法認列關聯企業資本公積之變動數	30,284	30,134
	\$ 23,757,099	\$ 16,013,058

註1:此類資本公積得用以彌補虧損,亦得於公司無虧損時,用以發放現金或撥充股本,惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司於104年6月股東常會決議通過新修訂之章程規定,每年度有純益時,依下列順序分派之:

- 1. 彌補虧損。
- 2. 提存百分之十為法定盈餘公積。
- 3. 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 4. 長期投資採權益法計算之投資收益内屬於現金股利以外未實現部分,得就當年度盈餘項下轉列特別盈餘公積,俟實現後 再列入盈餘分配。
- 5. 加計或減除保留盈餘中屬已實現之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益。
- 6. 董事酬勞金依1.至5.款規定數額後剩餘之數提撥百分之一(含)以下。
- 7. 員工紅利依1.至5.款規定數額後剩餘之數提撥百分之七(含)以上,百分之十一(含)以下,其中百分之七部分係按員工紅利 發放辦法分配予全體員工,另其超過百分之七部分則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。
- 8. 其餘由董事會擬定盈餘分派案,按股份總數比例分派之。

註2:此類資本公積係本公司未實際取得或處分子公司股權時,因子公司權益變動認列之權益交易影響數,或本公司採權益法認列子公司資本公積之調整數。

前述第7款所稱之員工,其對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件由董事會訂定之。

本公司正處於企業穩定成長階段,為因應目前及未來業務擴展之資金需求,並滿足股東對現金流入之需求,本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利,其中現金股利發放之比例不低於股利總額30%,餘額則配發股票股利,並由董事會擬具盈餘分配案,經股東會決議後辦理。

依104年5月公司法之修正,股息及紅利之分派限於股東,員工非屬盈餘分派之對象。本公司預計於105年度之股東常會配合上述法規修正公司章程。員工及董監事酬勞於104及103年度之估列基礎及103及102年度之實際配發情形,請參閱稅前淨利之員工福利費用(附註二二(五))。

本公司依金管證發字第1010012865號函、金管證發字第1010047490號函及「採用國際財務報導準則(IFRSs)後,提列特別盈餘公積之適用疑義問答」規定提列及迴轉特別盈餘公積。嗣後其他股東權益減項餘額有迴轉時,得就迴轉部分分派盈餘。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時,法定盈餘公積超過實收股本總額25%之部分除得撥充股本外,尚得以現金分配。

本公司於104年及103年6月舉行股東常會,分別決議通過103及102年度盈餘分配案如下:

	盈餘分配案				每股股利(元)					
	103年度		102年度			103年度			102年度	
法定盈餘公積	\$	2,359,267	\$	1,568,907						
特別盈餘公積迴轉		_	(309,992)						
現金股利		15,589,825		10,156,005	\$		2.00	\$		1.30
	\$	17,949,092	\$	11,414,920						

(四) 首次採用IFRSs應提列之特別盈餘公積

本公司因首次採用IFRSs帳列累積換算調整數轉入保留盈餘之金額為3,353,938千元,已於102年1月1日依金管會之規定提列相同數額之特別盈餘公積。

(五) 其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	104年度 103年度(調整			(調整後)	<u> </u>	
年初餘額	\$		4,541,761		(\$	525,583)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額			11,459			5,065,577
採用權益法之關聯企業或合資之換算差額之份額	(59,650)			1,767
年底餘額	\$		4,493,570		\$	4,541,761

2. 備供出售金融資產未實現損益

_	104年度		103年度	
年初餘額	\$	526,778	\$	426,246
備供出售金融資產未實現損失	(4,304)	(142,418)
處分備供出售金融資產累計損益重分類至損益		10,827		9,561
採用權益法之關聯企業或合資之備供出售金融資產未實現利益 之份額		54,818		233,389
年底餘額	\$	588,119	\$	526,778

3. 現金流量避險一僅103年度

	103年度	
年初餘額	(\$	3,279)
避險工具公允價值變動產生之損益-利率交換合約		795
重分類至損益之避險工具公允價值變動產生之損益-利率交換合約		2,484
年底餘額	\$	

(六) 庫藏股票

	年初股數 (千股)	本年度增加 (千股)	本年度減少 (千股)	年底股數 (千股)
104年度				
子公司持有本公司股票	145,883	_	_	145,883
買回供轉換公司債股權轉換之用		120,000		120,000
合計	145,883	120,000		265,883
103年度				
子公司持有本公司股票	145,883			145,883

本公司董事會於104年2月通過買回庫藏股120,000千股,俾供本公司海外無擔保轉換公司債股權轉換之用,並已於104年3月間執行完畢,實際買回股份占本公司已發行股份總數1.53%,實際買回平均價格為每股44.45元。

子公司於資產負債表日持有本公司股票之相關資訊如下:

	持有股數(千股)	帳面金額		公允價值	
104年12月31日					
ASE Test	88,200	\$	1,380,721	\$	3,351,618
J&R Holding	46,704		381,709		1,774,743
台灣福雷	10,979		196,677		417,193
	145,883	\$	1,959,107	\$	5,543,554
103年12月31日					
ASE Test	88,200	\$	1,380,721	\$	3,360,438
J&R Holding	46,704		381,709		1,779,413
台灣福雷	10,979		196,677		418,291
	145,883	\$	1,959,107	\$	5,558,142

上述公允價值係屬具公開市場報價之第1級公允價值。

子公司持有本公司股票係本公司因吸收合併及收購子公司,而將子公司持有本公司股票之帳面價值依本公司對子公司持股 比例計算之金額轉列庫藏股票。

本公司持有之庫藏股票,依證券交易法規定不得質押,亦不得享有股利之分派及表決權等權利。子公司持有本公司股票視 同庫藏股票處理,除不得參與本公司之現金增資及無表決權外,其餘與一般股東權利相同。

(七) 非控制權益

	104年度	104年度 103年度(•)
年初餘額	\$	8,219,097	\$		4,133,282
歸屬於非控制權益之份額					
本年度淨利		970,134			645,063
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(74,968)			339,450
備供出售金融資產未實現損益		3,928	(857)
確定福利計劃精算損失	(3,440)	(857)
子公司現金增資(附註二六)		_			3,068,406
處分子公司部分權益(附註二六)		1,712,836			_
子公司分割		3,535			_
子公司員工持有之流通在外既得認股權相關非控制權益		904,904			120,376
發放予非控制權益之現金股利	(232,148)	(85,766)
年底餘額	\$	11,503,878	\$		8,219,097

二二、稅前淨利

(一) 其他收入

	104年度		103年度	
股利收入	\$	396,973	\$	101,252
利息收入		242,084		243,474
補助款收入		176,721		184,525
租金收入		60,230		59,624
	\$	876,008	\$	588,875

(二) 其他利益(損失)

	104年度		103年度	
持有供交易之金融工具利益	\$	1,657,093	\$	1,266,653
指定透過損益按公允價值衡量之金融工具利益		815,742		572,187
外幣兌換損失	(713,213)	(1,221,979)
減損損失	(258,129)	(308,144)
其他	(64,457)		467,573
	\$	1,437,036	\$	776,290

(三) 財務成本

	104年度		103年度	
以攤銷後成本衡量之金融負債之利息費用總額	\$	2,514,208	\$	2,548,850
減:列入符合要件資產成本之金額				
列入存貨-營建房地項下	(197,287)	(100,705)
列入不動產、廠房及設備頂下	(48,135)	(126,203)
		2,268,786		2,321,942
指定為現金流量避險關係之衍生工具自權益重分類至損益之公				
允價值損失		_		2,484
其他財務成本		43,357		29,671
	\$	2,312,143	\$	2,354,097

利息資本化年利率如下:

	104年度	103年度
存貨-營建房地	4.35%~6.77%	6.00%~7.21%
不動產、廠房及設備	0.75%~6.15%	0.88%~6.15%

(四) 折舊及攤銷

	104年度		103年度	
不動產、廠房及設備	\$	28,938,770	\$	25,805,042
無形資產		579,894		545,734
合計	\$	29,518,664	\$	26,350,776
折舊費用依功能別彙總				
營業成本	\$	27,023,957	\$	24,050,546
營業費用		1,914,813		1,754,496
	\$	28,938,770	\$	25,805,042
攤銷費用依功能別彙總				
營業成本	\$	124,235	\$	180,719
營業費用		455,659		365,015
	\$	579,894	\$	545,734

(五) 員工福利費用

	104年度		103年度(調整後)		
退職後福利(附註二十)					
確定提撥計畫	\$	1,693,060		\$	1,589,505
確定福利計畫		413,490			445,795
		2,106,550			2,035,300
權益交割之股份基礎給付		133,496			110,157
薪資、獎金及紅利		41,985,329			40,475,594
其他員工福利		6,529,812			5,984,074
員工福利費用合計	\$	50,755,187		\$	48,605,125
依功能別彙總					
營業成本	\$	34,720,359		\$	33,243,224
營業費用		16,034,828			15,361,901
	\$	50,755,187		\$	48,605,125

依現行章程規定,本公司係以當年度稅後可分配盈餘分別以7%~11%及不高於1%分派員工紅利及董監事酬勞(附註二一(三)保留盈餘及股利政策),103年度係分別按11%及1%估列員工紅利2,335,786千元及董監事酬勞212,344千元。

依104年5月修正後公司法及105年1月經董事會擬議之修正章程,本公司係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以5.25%~8.25%及0.75%以下提撥員工及董事酬勞。104年度佔列員工酬勞2,033,500千元及董事酬勞184,500千元,係分別按前述稅前利益之8.25%及0.75%佔列,該等金額尚待董事會決議且經股東常會決議修正章程後,報告股東會。

年度合併財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原提列年度費用,年度合併財務報告 通過發布日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

本公司於104年及103年6月舉行股東常會,分別決議通過103及102年度員工紅利(以現金配發)及董監事酬勞如下:

	103年度		102年度	
員工紅利	\$	2,335,600	\$	1,587,300
董監事酬勞		211,200		144,000

上述103及102年度員工紅利及董監事酬勞與前一年度財務報表估列之員工紅利及董監事酬勞之差異分別為1,330千元及385千元,主要係因估計改變,分別調整為104及103年度之損益。

有關本公司董事會及股東會決議之員工酬勞(紅利)及董監事酬勞資訊,請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二三、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅主要組成項目

104年度		103年度(調整征	姜)
		,	
\$	4,029,076	\$	3,524,456
	474,076		25,737
(20,719)		72,380
	4,482,433		3,622,573
	436,374		571,662
(58,671)		75,305
(20,890)	(2,914)
	356,813		644,053
\$	4,839,246	\$	4,266,626
	((\$ 4,029,076 474,076 (20,719) 4,482,433 436,374 (58,671) (20,890) 356,813	\$ 4,029,076 \$ 474,076 (20,719) 4,482,433 436,374 (58,671) (20,890) (356,813

會計所得與所得稅費用之調節如下:

	104年度		103年度(調	整後)
稅前淨利	\$	25,288,253	\$	28,548,211
			_	
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$	6,306,316	\$	5,104,220
稅上不可減除之費損		161,362		126,407
竞税所 得	(537,987)	(623,652)
未分配盈餘加徵		624,564		488,517
所得稅抵減	(1,044,954)	(1,186,565)
暫時性差異之產生及迴轉有關之遞延所得稅	(649,336)		291,956
以前年度所得稅調整	(20,719)		72,380
土地增值稅		_	(6,637)
認列於損益之所得稅費用	\$	4,839,246	\$	4,266,626

於104及103年度,本集團中適用中華民國所得稅法之個體所適用之稅率為17%;中國地區子公司所適用之稅率為25%; 其他轄區所產生之稅額係依各相關轄區適用之稅率計算。

由於105年度股東會盈餘分配情形尚具不確定性,故104年度未分配盈餘加徵10%所得稅之潛在所得稅後果尚無法可靠決定。

(二) 直接認列於權益之所得稅

(二) 巨级的列尔催亚尼尔特尔					
	104年度		103年度		
遞延所得稅					
員工認股權	(\$	33)	\$	4,481	
(三) 認列於其他綜合損益之所得稅					
	104年度		103年度(調整後)		
遞延所得稅					
與確定福利計劃精算損益有關	\$	11,002	\$	22,938	
(四) 本期所得稅資產與負債					
	104年12月31日	1	103年12月31日		
本期所得稅資產					
應收退稅款	\$	10,984	\$	23,616	
預付所得稅		157,733		41,696	
	\$	168,717	\$	65,312	

(五) 遞延所得稅資產與負債

本集團將若干符合互抵條件之遞延所得稅資產及負債予以互抵。

遞延所得稅資產及負債之變動如下:

104年度

本期所得稅負債 應付所得稅

	年初餘額 (調整後)	認列於損益	 於其他 含損益	直接認於權		兌	換差額	年底餘額
遞延所得稅資產(負債)								
暫時性差異								
不動產、廠房及設備	(\$ 2,431,855)	(\$ 1,083,273)	\$ _	\$	_	\$	10,670	(\$ 3,504,458)
確定福利計劃	796,642	20,398	11,002		_		17,897	845,939

4,551,785

4,150,036

		丰初餘額 (調整後)	認	列於損益	列於其他 合損益		妾認列 注權益	兒	換差額	í	丰底餘額
透過損益按公允價值衡量之金融商品	(\$	170,059)	(\$	62,152)	\$ _	\$		\$	13	(\$	232,198)
其他		1,166,297		229,799	_	(33)	(11,076)		1,384,987
	(638,975)	(895,228)	11,002	(33)		17,504	(1,505,730)
虧損扣抵		519,898		812,217	_		_	(8,538)		1,323,577
投資抵減		694,082	(274,655)	_		_	(68,308)		351,119
其他	(853)		853	_				_		_
	\$	574,152	(\$	356,813)	\$ 11,002	(\$	33)	(\$	59,342)	\$	168,966

103年度(調整後)

		丰初餘額 (調整後)		列於損益 調整後)	別於其他綜 合損益 調整後)	直接認列 於權益		兌換差額 調整後)		年底餘額 (調整後)
遞延所得稅資產(負債)										
暫時性差異										
不動產、廠房及設備	(\$	1,684,616)	(\$	804,082)	\$ _	\$ _	\$	56,843	(\$	2,431,855)
確定福利計劃		854,540	(59,807)	22,938	_	(21,029)		796,642
透過損益按公允價值衡量之金融商品	(12,329)	(170,722)	_	_		12,992	(170,059)
其他		767,744		372,563	_	4,481		21,509		1,166,297
	(74,661)	(662,048)	22,938	4,481		70,315	(638,975)
虧損扣抵		270,031		246,334	_	_		3,533		519,898
投資抵減		924,128	(227,486)	_	_	(2,560)		694,082
其他			(853)				_	(853)
	\$	1,119,498	(\$	644,053)	\$ 22,938	\$ 4,481	\$	71,288	\$	574,152

(六) 未於合併資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異、未使用虧損扣抵及未使用投資抵減金額

	104年12月	月31日		103年1	2月31日	1
虧損扣抵	5	\$	666,373		\$	694,960
投資抵減			387,480			629,231
可減除暫時性差異			1,007,105			957,183
	-	\$	2,060,958		\$	2,281,374

未認列之虧損扣抵將陸續至119年度到期,未認列之投資抵減將陸續至107年度到期。

(七) 未使用虧損扣抵與投資抵減、免稅及其他租稅減免之相關資訊

截至104年12月31日止,虧損扣抵相關資訊如下:

尚未扎	□抵餘額	最後扣抵年度
	\$ 124,478	105年
	318,985	106年
	268,332	107年
	333,284	108年
	944,871	109年及以後
	\$ 1,989,950	

截至104年12月31日止,投資抵減相關資訊如下:

法令依據	抵減項目	尚未抵洞	或餘額	最後抵減年度
促進產業升級條例	機器設備	\$	710,863	107年
	其他		27,736	106年
		\$	738,599	

截至104年12月31日止,本公司及部分子公司之下列增資擴展產生之所得可享受3年或5年冤稅:

公司名稱	增資擴展案	趸稅期間
日月光	93年增資擴展案	101.01~105.12
	94年增資擴展案	101.01~105.12
	合併繼受日月鴻96年增資擴展案	102.01~104.12
	96年增資擴展案	105.01~109.12
	97年增資擴展案	103.01~107.12
台灣福雷	94年增資擴展案	100.01~104.12
	97年增資擴展案	103.01~107.12
	98年增資擴展案	107.01~111.12
日月光電子	94年分割案	101.01~105.12
	97年增資擴展案	105.01~109.12

另部份中國子公司依據當地稅法規定享有高新技術企業15%優惠稅率及課稅所得扣除研發費用若干倍數等之所得稅優惠。

(八) 與投資相關且未認列遞延所得稅負債之暫時性差異彙總金額

截至104年及103年12月31日止,與投資子公司有關且未認列為遞延所得稅負債之應課稅暫時性差異分別為12,676,347千元及11,400,826千元。

(九) 兩稅合一資訊

104年及103年12月31日本公司之未分配盈餘均屬87年度(含)以後產生,股東可扣抵稅額帳戶餘額104年及103年12月31日分別為1,913,243千元及934,038千元。

104及103年度盈餘分配適用之稅額扣抵比率分別為8.66%(預計)及6.88%(實際)。

(十) 所得稅核定情形

本公司截至101年度及台灣子公司分別截至99至102年度之營利事業所得稅結算申報案件,業經台灣稅捐稽徵機關核定。惟本公司及部份台灣子公司對93至97及99至101年度核定内容不服,已依法提起行政救濟並於104年第2季達成和解。上述相關所得稅影響數已分別估列於核定年度所得稅費用項下。

二四、每股盈餘

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下:

本年度淨利

_	104年度		103年度(調整後)	
歸屬於本公司業主之淨利	\$	19,478,873	\$	23,636,522
具稀釋作用潛在普通股之影響				
子公司發行員工認股權憑證	(210,126)	(260,925)
可轉換公司債		901,187		931,344
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	\$	20,169,934	\$	24,306,941

股數

		單位:干股
	104年度	103年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	7,652,773	7,687,930
具稀釋作用潛在普通股之影響		
可轉換公司債	455,671	375,271
員工認股權	86,994	101,850
員工紅利或酬勞	54,626	55,643
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	8,250,064	8,220,694

本集團得選擇以股票或現金發放員工紅利或酬勞,於計算稀釋每股盈餘時,須假設員工紅利或酬勞將採發放股票方式,並 於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數,以計算稀釋每股盈餘。於次年度股東會決議員工紅利或酬勞 發放股數前計算稀釋每股盈餘時,亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二五、股份基礎給付協議

(一) 本公司及子公司員工認股權計畫

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才,激勵員工並提昇員工向心力,業經主管機關核准發行5次員工認股權憑證(其中104年4月核准發行100,000千單位),每單位得認購本公司普通股1股,並以等於或不低於給與日當日之普通股股票收盤價為行使價格。該認股權憑證給與對象包含本集團之全職正式員工,且存續期間為10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年才可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時,認股權行使價格依規定公式予以調整。

本公司

本公司發行之員工認股權憑證相關資訊如下:

		104年度				103年度					
認股權憑證		單位(千)	į.	加權平均行使價格(元)				望平均行使價格(元)			
年初流通在外		209,745	\$	20.7		285,480	\$	20.5			
本年度給與		94,270		36.5		-		-			
本年度沒收	(1,975)		30.3	(1,515)		20.5			
本年度逾期失效	(730)		11.1	(322)		13.5			
本年度行使	(48,703)		20.6	(73,898)		19.7			
年底流通在外		252,607		26.6		209,745		20.7			
年底可行使		158,103		20.8		189,240		20.7			
本年度給與之認股權加權平均公允價值(元)	\$	7.18~7.39			\$	_					

104及103年度執行之本公司員工認股權,其於執行日之加權平均股價分別為38.8元及35.1元。

截至資產負債表日止,本公司發行之流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下:

	執行價格之範圍	[(元)	加權平均剩餘合約期限(年)			
104年12月31日	\$	20.4~22.6	3.5	;		
		36.5	9.7	,		
103年12月31日		11.1~13.5	0.4	ļ		
		20.4~22.6	4.4	ļ		

ASE Mauritius Inc.

ASE Mauritius Inc.於96年12月發行認股權憑證30,000千單位,每單位認股權憑證得認購ASE Mauritius Inc.普通股1股。給與對象包含本集團員工,存續期間10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年才可行使被給與之一定比例之認股權。

上述員工認股權憑證相關資訊揭露如下:

	1	度	103年度				
認股權憑證	單位(千)		行使價格(美金元)	單位(千)		行使價格(美金元)	
年初流通在外	28,545	\$	1.7	28,545	\$	1.7	
本年度沒収	(75)		1.7			_	
年底流通在外	28,470		1.7	28,545		1.7	
年底可行使	28,470		1.7	28,545		1.7	

截至104年及103年12月31日止,上述認股權憑證預期剩餘存續期限分別為2年及3年。

環誠

環誠發行員工認股權憑證之發行條件與本公司相同,相關資訊如下:

	104年度			103年度				
認股權憑證		單位(千)	加權平均	行使價格(美金元)		單位(千)	加權平均行使價格(美金元)	
年初流通在外		34,159	\$	2.1		34,939	\$	2.1
本年度沒収	(84)		2.8		_		_
本年度行使	(4,380)		1.9	(780)		1.5
年底流通在外		29,695		2.1		34,159		2.1
年底可行使		28,106		2.1		30,874		2.0

截至資產負債表日止,環誠發行之流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下:

	執行價格之範圍(美金元)		加權平均剩餘合約期限(年)			
104年12月31日	\$	1.5		5.0		
		2.4~2.9		4.9		
103年12月31日		1.5		5.0		
		2.4~2.9		5.8		

環旭上海

環旭上海於104年11月經股東會決議發行員工認股權憑證,每單位得認購環旭上海普通股1股。該認股權憑證給與對象為該公司員工,存續期間10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年及達到特定之績效目標後方可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後,遇有環旭上海流通在外普通股股份發生變動時,認股權行使價格依規定公式予以調整。相關資訊如下:

	104年度								
認股權憑證	單位(千)	行使價格(人民幣元)							
年初流通在外	_	\$ -							
本年度給與	26,640	15.5							
本年度沒收	(13)	15.5							
年底流通在外	26,627	15.5							
年底可行使		_							
本年度給與之認股權加權平均公允價值(人民幣元)	\$ 5.95~7.14								

截至104年12月31日止,上述認股權憑證預期剩餘存續期限為9.9年。

(二) 認股權公允價值資訊

本公司及環旭上海於104年度發行之員工認股權憑證分別係採用Hull & White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型及Black-Scholes選擇權評價模型以估計給與日認股權憑證之公允價值,評價模型所採用之參數分別如下:

	本公司	環旭上海
給與日股價	36.5元	人民幣15.2元
行使價格	36.5元	人民幣15.5元
預期股價波動率	27.02%	40.33%~45.00%
合約期間	10年	10年
預期股利率	4.00%	0.87%
無風險利率	1.34%	3.06%~3.13%

預期股價波動率係分別基於本公司及環旭上海之同業過去10年歷史股票價格波動情形,且在Hull & White(2004)結合 Ritchken(1995)三項樹模型下,為將提早執行之效果納入考量,係假設於既得期間屆滿後之股票價格為行使價格1.88倍時,員工將執行認股權。

另,環誠分別於104年及103年12月修改96年度發行之員工認股權憑證辦法,將存續期間分別自11年延長為12年及自12年 再延長為13年。因係於既得日後修改員工認股權憑證辦法,分別增額之公允價值13,721千元及10,378千元立即認列為104 及103年度酬勞成本。

104及103年度認列之員工認股權之酬勞成本分別為133,496千元及110,157千元。

二六、與非控制股權之權益交易

103年11月子公司環旭上海辦理現金增資計人民幣2,017,690千元,因本集團未依持股比例認購,致本集團持股比例由88.6%降至82.1%。此交易並未改變本集團對子公司環旭上海之控制,本集團係採權益交易處理之,並於103年第4季認列資本公積增加6,877,099千元(調整後)。

104年4月子公司環誠以人民幣1,992,060千元出售其持有之環旭上海股權54,000千股,致本集團對環旭上海之持股比例由82.1%降至77.2%。此交易並未改變本集團對子公司環旭上海之控制,本集團係採權益交易處理之,並於104年第2季認列資本公積增加7,197,510千元。

104年12月本集團之子公司環誠經股東會決議,以每股美金18.82元買回已發行流通在外之普通股計4,500,820股,並於105年2月經董事會決議以105年2月17日為減資基準日,將其買回之股份予以註銷。

二七、非現金交易

本集團於104年及103年度進行下列非現金交易之投資活動:

104年度		103年度	
			_
\$	28,280,821	\$	43,448,587
(267,334)	(34,894)
	2,314,772	(3,688,526)
(48,135)	(126,203)
\$	30,280,124	\$	39,598,964
\$	201,766	\$	462,438
	41,265	(41,231)
\$	243,031	\$	421,207
	\$ ((\$	\$ 28,280,821 (267,334) 2,314,772 (48,135) \$ 30,280,124 \$ 201,766 41,265	\$ 28,280,821 \$ (267,334) (2,314,772 (48,135) \$ (\$ 30,280,124 \$ \$ \$ 201,766 \$ \$ 41,265 ((

二八、營業租賃協議

除附註十六所述外,本公司及台灣福雷之廠房用地係向政府租用,其租期將陸續於124年6月底前屆滿。租期屆滿時得予續約,但政府得於該土地公告地價增高時調整租金,並得於若干條件下終止租約。此外本集團亦簽有建築物及機器設備之營業租賃合約。

其他子公司於美國、日本等之辦公室係向他人承租,租期將陸續於105年至112年間到期,到期時可再續約。 104及103年度認列之租金費用分別為1,390.821千元及1,459.835千元。

二九、資本風險管理

本集團資本結構係由淨債務及權益組成,而資本管理的目標是保障本集團能夠持續經營,並進而藉由將債務及權益餘額最適化,以使股東報酬極大化,是以定期檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險,並藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

除附註十七所述外,本集團尚無須遵循之其他外部資本規定。

三十、金融工具

(一) 公允價值資訊-非按公允價值衡量之金融工具

1. 帳面金額與公允價值有重大差異之金融負債

除以攤銷後成本衡量之應付公司債外,本集團管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。104年及103年12月31日應付公司債之帳面金額及公允價值如下:

資產負債表日	 帳面金額	公允價值			
104年12月31日	\$ 38,426,250	\$	38,465,355		
103年12月31日	31.270.131		31.702.988		

2. 公允價值衡量層級

上述應付公司債之公允價值屬第3等級公允價值衡量,係按現金流量折現分析或最近一次交易價格決定之。

(二) 公允價值資訊-按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

104年12月31日

	第1等級		第2等級		第3等級	合計	
透過損益按公允價值衡量之金融資產							
指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產							
結構式定期存款	\$	_	\$ 1,646,357	\$	_	\$	1,646,357
私募可轉換公司債		_	100,500		_		100,500
衍生金融資產							
換匯合約		_	1,452,611		_		1,452,611
遠期外匯合約		_	18,913		_		18,913
外幣選擇權合約		_	5,020		_		5,020
持有供交易之非衍生金融資產							
基金受益憑證		573,242	_		_		573,242
上市(櫃)公司股票		37,058	_		_		37,058
合計	\$	610,300	\$ 3,223,401	\$		\$	3,833,701
備供出售金融資產							
有限合夥	\$	_	\$ _	\$	476,612	\$	476,612
非上市(櫃)公司股票		_	_		264,477		264,477
上市(櫃)公司股票		197,580	_		_		197,580
基金受益憑證		16,037	_		_		16,037
合計	\$	213,617	\$ 	\$	741,089	\$	954,706
透過損益按公允價值衡量之金融負債							
衍生金融負債							
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$	_	\$ 2,632,565	\$	_	\$	2,632,565
換匯合約		_	290,176		_		290,176
遠期外匯合約		=	69,207		_		69,207
外幣選擇權合約		_	13,659		_		13,659
利率交換合約			119				119
合計	\$		\$ 3,005,726	\$		\$	3,005,726

103年12月31日

	第1等級		 第2等級		第3等級		合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產		_					
指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產							
結構式定期存款	\$	_	\$ 2,376,050	\$	_	\$	2,376,050
私募可轉換公司債		_	100,500		_		100,500
衍生金融資產							
換匯合約		_	1,907,705		_		1,907,705
遠期外匯合約		_	27,811		_		27,811
基金受益憑證		533,425	_		_		533,425
上市(櫃)公司股票		43,352	_				43,352
合計	\$	576,777	\$ 4,412,066	\$		\$	4,988,843

	第1等級		第2等級	第3等級	合計
備供出售金融資產		-		 _	
基金受益憑證	\$ 1,500,434	\$	_	\$ _	\$ 1,500,434
有限合夥	_		_	555,361	555,361
非上市(櫃)公司股票	_		_	223,505	223,505
上市(櫃)公司股票	195,070		_	_	195,070
合計	\$ 1,695,504	\$	_	\$ 778,866	\$ 2,474,370
		-		 	
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$ _	\$	2,520,606	\$ _	\$ 2,520,606
換匯合約	_		99,165	_	99,165
遠期外匯合約	_		31,581	_	31,581
合計	\$ _	\$	2,651,352	\$ 	\$ 2,651,352

104及103年度無第1等級與第2等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 金融資產以第3等級公允價值衡量之調節

本集團以第3等級公允價值衡量之金融資產,係列入備供出售金融資產-非流動項下之無公開報價之權益工具投資,104 及103年度之調節如下:

	104年度		103	年度	
年初餘額	\$	778,866		\$	797,162
購買		2,010			38,793
認列於損益	(15,891)		(10,390)
認列於其他綜合損益		21,195		(25,687)
處分	(45,091)		(21,012)
年底餘額	\$	741,089		\$	778,866

截至104年及103年12月31日止,與年底持有之採第3等級公允價值衡量之資產有關之末實現損益,分別有末實現損失 8,611千元及21,519千元列入其他權益項下之備供出售金融資產未實現損益。

3. 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

(1) 第2等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具一換匯合約、遠期外匯合約、外幣選擇 權合約及利率交換合約	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察遠期匯率或利率及合約所訂匯率或利率估計未來現金流量,並以可反 映各交易對方信用風險之折現率分別折現。
衍生工具-可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	選擇權定價模式:納入現值技術並反映選擇權之時間價值及內含價值。
結構式定期存款及私募可轉換公司債	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察遠期匯率或股價,及合約所訂之利率區間或轉換價格估計未來現金流量,並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

(2) 第3等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

無活絡市場之非上市(櫃)公司股票係以市場法估計公允價值,其判定係參考公司近期籌資活動、技術發展情形、同種類公司評價、市場狀況及其他經濟指標等。

有限合夥投資係以現金流量折現法及類比成數技術估計公允價值。現金流量折現法下之重大不可觀察輸入值分別為 折現率12.34%及長期成長率2.50%。當折現率增加或長期成長率降低,將導致該等投資公允價值減少。而類比成數 技術下之重大不可觀察輸入值為EBITDA成數9.73。當EBITDA成數減少,將導致該等投資公允價值減少。

(三) 金融工具之種類

	104年12月31日		103年12月31日	
金融資產				
透過損益按公允價值衡量				
指定為透過損益按公允價值衡量	\$	1,746,857	\$	2,476,550
持有供交易		2,086,844		2,512,293

	104年12月31日		103年12月31日		
備供出售金融資產	\$	954,706	\$	2,474,370	
放款及應收款(註1)		101,259,880		106,158,279	
金融負債					
透過損益按公允價值衡量					
持有供交易		3,005,726		2,651,352	
以攤銷後成本衡量(註2)		173,294,140		157,157,392	

註1:餘額係包含現金及約當現金、應收帳款、其他應收款及其他金融資產等以攤銷後成本衡量之放款及應收款。

(四) 財務風險管理目的與政策

本集團從事衍生商品交易之經營避險策略,主要係以確保公司穩健、安全經營為原則。從事衍生金融商品交易時,應依其交易目的區分為「避險性」及「非避險性」兩種交易,除依規定分別適用不同部位限制外,以避險為目的之交易其商品的選擇應以規避本集團業務經營所產生之收入、支出、資產或負債等風險為主,持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。

風險管理部門係為專責監督風險以減輕暴險之單位,每月就持有部位、交易餘額及損益狀況對財務長提出報告。

1. 市場風險

本集團之營運活動使本集團承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險以及利率變動風險。從事各式衍生金融工具以管理所承擔之外幣匯率及利率風險,因此匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷,而利率風險亦因預期之資金成本已固定,故市場價格風險並不重大。

本集團有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本集團從事外幣計價之進銷貨交易及融資活動,因而產生匯率變動暴險。為避免因匯率變動造成外幣資產或負債價值波動,本集團使用衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用,可協助本集團減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

本集團於資產負債表日具重大影響之非功能性貨幣計價之金融資產及負債(包含合併財務報告中已沖銷之非功能性貨幣項目)以及具匯率風險暴險之衍生工具外幣合約金額,參閱附註三五。

本集團主要受到美金及日幣兌新台幣或人民幣匯率波動之影響。本集團內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率為1%,敏感度分析之範圍包括主要之金融資產、金融負債,及集團內部交易所產生之應收應付款項。當資產負債表日美金及日幣兌新台幣或人民幣變動1%時,104及103年度稅前淨利影響數將分別約為18,000千元及41,000千元。上述稅前淨利影響數業已考量避險合約及被避險項目之影響,惟資產負債表日之外幣暴險無法反映期中暴險情形。

(2) 利率風險

本集團除發行固定利率之公司債及舉借固定利率之借款外,主係以浮動利率借入資金,因而產生利率暴險,市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動,而產生未來現金流量之波動。

本集團於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下:

	104年12月31	目	103年12月31日		
具公允價值利率風險 金融負債	\$	18,030,482	\$	34,003,038	
亚树中间	D. C.	16,030,462	Ф	34,003,036	
具現金流量利率風險					
金融資產		53,475,994		51,603,455	
金融負債		65,213,083		65,149,698	

註2:餘額係包含短期借款、應付短期票券、應付帳款、其他應付款、應付公司債及長期借款等以攤銷後成本衡量之金融負債。

對於浮動利率之資產及負債,本集團內部向主要管理階層報告利率風險時所使用之變動率為100個基點,若資產負債表日利率變動100個基點(1%),在所有其他變數維持不變之情況下,本集團104及103年度之稅前淨利將分別增減約117.000千元及135.000千元。

(3) 其他價格風險

本集團持有透過損益按公允價值衡量之金融資產(上櫃公司私募可轉換公司債、上市(櫃)公司股票及基金受益憑證)及 備供出售金融資產受權益及債券價格暴險之影響。若資產負債表日權益及債券價格變動1%,104及103年度稅前淨利將分別增減約7,100千元及6,800千元,稅前其他綜合損益將分別增減約10,000千元及25,000千元。

此外,本公司於102年發行之海外無擔保轉換公司債亦受本公司股票價格暴險之影響。本集團内部向主要管理階層報告價格風險時所使用之敏感度比率為7%,若資產負債表日本公司股票價格增加或減少7%,104及103年度稅前淨利將分別減少約605,000千元及651,000千元或分別增加約638,000千元及608,000千元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本集團財務損失之風險。本集團之信用風險,主要係來自於現金及約當現金、應收款項、其他應收款及其他金融資產等。最大之信用風險暴險與合併資產負債表上之金融資產帳面價值相同。

本集團主係與信譽卓著之對象進行交易,並訂有授信政策及應收帳款管理程序以確保應收款項之回收及評價。另交易對 象涵蓋衆多客戶及銀行,並無重大集中的信用暴險。

3. 流動性風險

本集團透過管理適當之營運資金及融資額度以支應集團營運及資本支出之現金流量需求,另亦監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合約條款之遵循,故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

本集團可被要求立即清償之金融負債,係列於下表中最早之期間内,不考慮交易對手立即執行該權利之機率:其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

以浮動利率支付之利息現金流量,其未折現之利息金額係依據資產負債表日之利率做為估計未來利息現金流量之基礎。

104年12月31日

	要求問	II付或短於1個月	1至3個月	3個月至1年	1至5年	超過5年
非衍生性金融負債		_				
無附息負債	\$	19,393,406	\$ 19,626,026	\$ 6,493,504	\$ 1,926	\$ 194,346
浮動利率工具		6,617,050	5,677,129	10,582,324	39,202,454	775,273
固定利率工具		16,168,484	2,463,617	24,787,238	18,078,920	
	\$	42,178,940	\$ 27,766,772	\$ 41,863,066	\$ 57,283,300	\$ 969,619

103年12月31日

	要求民	即付或短於1個月	1至3個月	3個月至1年	2至5年	超過5年
非衍生性金融負債					_	
無附息負債	\$	23,660,711	\$ 21,370,876	\$ 4,606,064	\$ 155,599	\$ 29,139
浮動利率工具		21,534,220	9,003,403	12,364,453	23,870,629	175,302
固定利率工具		684,039	838,234	846,899	34,458,859	_
	\$	45,878,970	\$ 31,212,513	\$ 17,817,416	\$ 58,485,087	\$ 204,441

上述非衍生金融負債之浮動利率工具金額,將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

下表詳細說明本集團針對衍生金融工具所作之流動性分析,就採淨額交割之衍生金融工具,係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製:就採總額交割之衍生金融工具,係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。當應付或應收金額不固定時,揭露之金額係依資產負債表日殖利率曲線所推估之預計利率決定。

104年12月31日

	要求即付頭	成短於1個月		1至3個月		1至3個月 3個月至		3個月至1年
淨額交割								
遠期外匯合約	(\$	230)	\$	3,435	\$	_		
外幣選擇權合約	\$	2,054	\$	8,735	\$			

	要求即付或	ズ短於1個月	1至3個月		3個月至1年
總額交割					
遠期外匯合約					
流入	\$	2,822,265 \$	2,421,602	\$	_
流出	(2,836,080) (2,429,050)		_
	(13,815) (7,448)		_
換匯合約					
流入		16,561,521	22,476,799		36,796,825
流出	(16,564,549) (22,007,274)	(35,813,527)
	(3,028)	469,525		983,298
利率交換合約					
流入		12,603	12,466		25,069
流出	(11,595) (11,469)	(23,063)
		1,008	997		2,006
	(\$	15,835) \$	463,074	\$	985,304
103年12月31日					
	要求即付或	ズ短於1個月	1至3個月		3個月至1年
總額交割					
遠期外匯合約 流入	\$	3,662,813 \$	1,959,573	\$	9,241
流出	5	3,655,279) (1,939,373	Þ	9,241
//iLLJ		7,534	19,428		90)
		7,334	19,420		30)
換匯合約					
流入		10,342,259	4,621,200		33,399,031
流出	(10,215,834) (4,461,118)	(31,646,310)
		126,425	160,082		1,752,721
	\$	133.959 \$	179.510	\$	1.752.631

三一、關係人交易

本集團間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時已銷除,故未揭露於本附註。本集團與其他關係人間之重大交易如下:

- (一)公司於104及103年度皆提撥100,000千元由財團法人日月光文教基金會(以下稱「日月光基金會」)執行環保公益之捐贈作業,以協助國内環保相關工作之推動及公益活動(附註三三)。
- (二) 本公司於104及103年度向關聯企業購入不動產,價款分別為2,466,000千元及4,540,086千元,均係參酌專業機構出具之鑑價報告議定之,且均已付訖。
- (三)本公司委託關聯企業於現有租地興建外勞宿舍,104年度累計投入金額為504,600千元。另本公司於103年度委託其於現有租地興建環保大樓及其他工程共計349,646千元,係參酌鑑價機構出具之鑑價報告及詢、 比價後議定之,且依驗收進度付款。
- (四) 本公司於103年度透過日月光基金會捐贈高雄市政府社會局15,000千元,以協助高雄市政府進行前鎮區重大氣爆意外事件之災後重建工程及受災居民之安置作業。

(五) 對主要管理階層之獎酬

	104年度		103年度	₹
短期員工福利	\$	812,002	\$	989,720
退職後福利		3,944		4,049
股份基礎給付		17,937		50,327
	\$	833,883	\$	1,044,096

三二、質抵押之資產

除附註九所述外,本集團已提供下列資產,作為銀行借款之擔保品、進口原物料之關稅擔保品、履約擔保品或保證金:

	104年12月31	103年12月	103年12月31日			
存貨-營建房地	\$	16,312,519	\$	15,164,	,858	
其他金融資產(流動與非流動)		229,613		268,	3,562	
	\$	16,542,132	\$	15,433,	,420	

三三、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註所述者外,本集團於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項:

(一) 重大承諾

- 1. 截至104年及103年12月31日止,本集團已開立未使用之信用狀金額分別約93,000千元及137,000千元。
- 2. 截至104年及103年12月31日止,本集團已承諾購置之不動產、廠房及設備金額分別約8,089,200千元及17,498,000千元,其中已支付金額分別為1,756,990千元及1,516,396千元。
- 3. 截至104年及103年12月31日止,本集團因房地產開發建設業務已簽約尚未支付之工程款金額分別約2,745,400千元及 3,156,100千元。
- 4. 本公司為善盡環境保護之社會責任,於102年12月經董事會決議通過預計未來將捐獻每年至少1億元、至少30年、總金額至少30億元以推動台灣環保相關工作。

本公司於105年1月經董事會決議提撥100,000千元交由日月光基金會繼續執行環保相關捐贈作業,以持續協助國内環境相關工作之推動及公益活動。

(二) 不可取消之營業租賃承諾

	104	年12月31日
1年内	\$	211,225
超過1年但未超過5年		353,470
超過5年		462,733
	\$	1,027,428

三四、重大之期後事項

本公司於105年1月分別發行國内無擔保公司債5年期7,000,000千元及7年期2,000,000千元,票面利率分別為1.30%及1.50%,每年付息一次。

三五、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本集團各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達,所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重 大影響之外幣資產及負債如下:

	外幣(千元) 匯率		新台幣(千元)
104年12月31日	 		
貨幣性金融資產			
美金	\$ 2,926,597	USD1=NTD32.825	\$ 96,065,552
美金	1,008,097	USD1=CNY6.4936	33,090,795
日幣	3,380,683	JPY1=NTD0.2727	921,912
日幣	8,467,689	JPY1=USD0.0083	2,309,139
貨幣性金融負債			
美金	2,988,953	USD1=NTD32.825	98,112,393
美金	995,195	USD1=CNY6.4936	32,667,265

		外幣(千元)	進率	新台幣(千元)
	104年12月31日			
日幣		\$ 3,747,333	JPY1=NTD0.2727	\$ 1,021,898
日幣		8,775,382	JPY1=USD0.0083	2,393,047
	103年12月31日			
貨幣性金融資產				
美金		3,086,749	USD1=NTD31.65	97,695,606
美金		649,271	USD1=CNY6.119	20,549,427
日幣		3,354,008	JPY1=NTD0.2646	887,471
日幣		8,787,236	JPY1=USD0.0084	2,325,103
	103年12月31日			
貨幣性金融負債				
美金		2,896,001	USD1=NTD31.65	91,658,432
美金		976,913	USD1=CNY6.119	30,919,296
日幣		3,159,712	JPY1=NTD0.2646	836,060
日幣		8,903,753	JPY1=USD0.0084	2,355,933

具重大影響之外幣兌換損益如下:

	104		103	年度		
功能性貨幣	功能性貨幣兌表達貨幣		淨兌換(損)益	功能性貨幣兌表達貨幣		淨兌換(損)益
美元	USD1=NTD32.825	\$	136,795	USD1=NTD31.65	\$	298,225
新台幣		(695,510)		(1,591,124)
人民幣	CNY1=NTD5.0550	(271,358)	CNY1=NTD5.1724		42,049
		(\$	830,073)		(\$	1,250,850)

三六、其他

- (一)本公司於104年11月收到臺灣高雄地方法院所送達之起訴書狀,係矽品訴請法院確認本公司請求於矽品股東 名簿記載為股東之請求權不存在。本公司已委請律師研究矽品所提訴訟内容,並已依法向法院提出答辯,以 維護本公司權益。法院尚未開庭審理本件訴訟,本公司預計對合併財務狀況及財務績效並無重大影響。
- (二) 高雄市政府環境保護局(以下稱「環保局」)於102年12月20日以本公司違反水污染防治法作成「高市環局土字第10243758100號函」暨「高市環局水處字第30-102-120022號裁處書」,科處本公司110,065千元(已列入102年度其他利益(損失)項下)(以下稱「罰鍰處分」),嗣於103年4月7日將罰鍰更正為109,359千元,復於104年9月4日將罰鍰更正為102,014千元。本公司於103年1月17日委請律師依法對該罰鍰處分提起訴願,於訴願遭駁回後,委請律師依法提起行政訴訟,請求撤銷該罰鍰處分,案件現由高雄高等行政法院審理中。因前述事件,高雄地方法院檢察署於103年1月3日依違反廢棄物清理法等法對本公司提起公訴,高雄地方法院審理後於103年10月20日宣判,以本公司違反廢棄物清理法第47條規定判處新臺幣3,000千元罰金(已列入103年度其他利益(損失)項下)。嗣本公司依法向高雄高等法院提出上訴,高雄高等法院業於104年9月29日判決本公司無罪確定。

三七、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊

- 1. 資金貸與他人:詳附表一。
- 2. 為他人背書保證:詳附表二。
- 3. 年底持有有價證券情形:詳附表三。
- 4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上者:詳附表四。
- 5. 取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上者:附表五。
- 6. 處分不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上者:無。
- 7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元或實收資本額20%以上者:詳附表六。
- 8. 應收關係人款項達新台幣1億元或實收資本額20%以上者:詳附表七。
- 9. 從事衍生工具交易:詳附註七。
- 10.其他:母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額:詳附表十。
- 11. 被投資公司資訊(對非屬大陸地區之被投資公司直接或間接具重大影響、控制或聯合控制者): 詳附表八。

(三) 大陸投資資訊

- 1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本年度損益及認列之投資 損益、年底投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額:詳附表九。
- 2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項,及其價格、付款條件、未實現損益:
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比:詳附表六。
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比:無。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額:無重大交易。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的:詳附表二。
 - (5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當年度利息總額:無。
 - (6) 其他對當年度損益或財務狀況有重大影響之交易事項,如勞務之提供或收受等:無。

三八、部門資訊

本集團應報導部門分為封裝部門、測試部門及電子組裝部門,分別從事半導體封裝、測試及電腦與周邊設備之製造等服務。另有未達量化門檻之其他部門,主要從事半導體材料製造及房地產開發建設等業務。

本集團營運部門之會計政策與附註四所述之重要會計政策彙總說明並無重大不一致。營運部門損益係以部門稅前淨利衡量,並作為評估績效之基礎。

(一) 部門收入與營運結果

			 装部門		電子組裝部門	其他			合併	
104年度	_									
來自外部客戶收入	\$	116,607,314	\$	25,191,916	\$	138,242,100	\$	3,261,206	\$	283,302,536
部門間收入(註)		9,454,671		191,608		58,451,996		7,659,282		75,757,557
部門收入		126,061,985		25,383,524		196,694,096		10,920,488		359,060,093
利息收入		53,235		12,536		149,385		26,928		242,084
利息費用	(1,520,118)	(5,821)	(147,792)	(595,055)	(2,268,786)
折舊與攤銷	(18,946,460)	(6,516,912)	(2,738,722)	(1,316,570)	(29,518,664)
採用權益法認列之關聯企業及合資之損益之份額		402,730		_		_		_		402,730
減損損失	(139,397)		_	(102,389)	(16,343)	(258,129)
部門稅前淨利		15,756,333		6,354,140		2,874,944		302,836		25,288,253
部門之資本支出		19,691,068		4,754,481		2,917,939		917,333		28,280,821

	封裝部門 測試部門		測試部門	電子組裝部門		其他		合併		
104年12月31日										
採用權益法認列之關聯企業及合資之投資餘額	\$	37,422,909	\$	=	\$	_	\$	-	\$	37,422,909
部門資產		193,623,969		42,652,569		79,997,341		49,013,678		365,287,557
103年度										
來自外部客戶收入		121,336,453		25,874,694		105,784,427		3,595,873		256,591,447
部門間收入(註)		9,418,359		177,793		48,596,814		8,437,439		66,630,405
部門收入		130,754,812		26,052,487		154,381,241		12,033,312		323,221,852
利息收入		96,737		10,245		116,451		20,041		243,474
利息費用	(1,566,595)	(15,663)	(155,702)	(586,466)	(2,324,426)
折舊與攤銷	(17,533,267)	(6,160,378)	(1,435,509)	(1,221,622)	(26,350,776)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(108,726)		_		-		_	(108,726)
減損損失	(231,936)	(4,701)	(10,390)	(61,117)	(308,144)
部門稅前淨利		17,292,396		6,800,893		3,818,393		636,529		28,548,211
部門之資本支出		29,863,337		6,157,154		6,562,513		865,583		43,448,587
103年12月31日										
採用權益法認列之關聯企業投資餘額		1,492,441		-		_		-		1,492,441
部門資產		166,625,901		44,147,813		78,865,897		44,345,157		333,984,768

註:來自母公司及合併子公司之收入業已於編製合併報告時銷除。

(二) 主要產品及勞務之收入

104年度		103年度	
\$	103,735,586	\$	108,384,405
	24,136,399		25,116,026
	137,347,359		104,904,455
	18,083,192		18,186,561
\$	283,302,536	\$	256,591,447
	\$	\$ 103,735,586 24,136,399 137,347,359 18,083,192	24,136,399 137,347,359 18,083,192

(三) 地區別資訊

本集團來自外部客戶之收入依客戶所在地區及非流動資產按資產所在地區之資訊列示如下:

1.來自外部客戶之收入

	104年度		103年原	き
地區				
美國	\$	205,730,670	\$	173,912,974
台灣		32,631,149		36,747,699
亞洲		22,885,128		24,042,586
歐洲		20,577,069		20,826,125
其他		1,478,520		1,062,063
	\$	283,302,536	\$	256,591,447

2.非流動資產

	104年12月31	日	103年12月31	∃
地區				
台灣	\$	98,849,362	\$	97,159,564
中國大陸		40,385,484		43,384,186
其他		25,458,503		26,177,965
	\$	164,693,349	\$	166,721,715

非流動資產不包括金融工具、退職後福利資產及遞延所得稅資產。

(四) 主要客戶資訊

除104及103年度營業收入總額中分別有88,311,697千元及54,431,222千元係來自封裝及電子組裝部門之某一客戶外,104及103年度無其他來自單一客戶之收入達本集團收入總額之10%以上。

資金貸與他人

民國104年1月1日至12月31日

附表一

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本年度 最高額度餘額	年底額度餘額	年底實際 動支餘額
1	A.S.E. Holding Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	\$ 2,859,690	\$ 2,757,300	\$ 2,757,300
		J & R Holding Limited	長期應收款-關係人	是	189,000	_	-
		日月光貿易(上海)有限公司	長期應收款-關係人	是	821,750	820,625	-
2	J & R Holding Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	9,367,950	9,256,650	9,256,650
		Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	其他應收款-關係人	是	2,465,250	2,461,875	2,461,875
		日月光半導體(威海)有限公 司	其他應收款-關係人	是	3,782,175	1,378,650	1,378,650
		Omniquest Industrial Limited	長期應收款-關係人	是	1,482,437	1,480,408	3,283
		日月光封裝測試 (上海)有限公司	長期應收款-關係人	是	1,579,000	558,025	558,025
		日月光半導體 (昆山)有限公司	其他應收款-關係人	是	1,334,528	_	-
		Anstock Limited	長期應收款-關係人	是	775,080	758,250	758,250
		日月光貿易(上海)有限公司	長期應收款-關係人	是	6,947,600	4,923,750	_
		Innosource Limited	長期應收款-關係人	是	723,140	722,150	722,150
		ASE Labuan Inc.	長期應收款-關係人	是	723,140	_	-
		ASE Investment (Labuan)	其他應收款-關係人	是	2,662,470	_	_
		Real Tech Holdings Limited	其他應收款-關係人	是	2,136,550	2,133,625	2,133,625
3	ASE Test Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	5,842,850	5,842,850	4,037,475
		J & R Holding Limited	長期應收款-關係人	是	1,386,000	_	-
		ASE Singapore Pte. Ltd.	長期應收款-關係人	是	443,100	_	-
		A.S.E. Holding Limited	其他應收款-關係人	是	1,643,500	1,641,250	1,641,250
		Omniquest Industrial Limited	長期應收款-關係人	是	1,643,500	1,641,250	1,641,250
4	台灣福雷電子公司	本公司	其他應收款-關係人	是	5,600,000	5,600,000	5,600,000
		日月光貿易(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	2,629,600	656,500	-
		ASE Corporation	其他應收款-關係人	是	2,793,950	1,879,444	900,000
		ASE Investment (Labuan) Inc.	其他應收款-關係人	是	2,626,000	2,626,000	_
5	日月光電子元器件 (上 海)有限公司	日月光半導體 (上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	516,720	_	-
6	 日月瑞公司	本公司	其他應收款-關係人	是	190,000	190,000	190,000
5		日月光電子公司	其他應收款-關係人	是	190,000	190,000	190,000
7	ISE Labs, Inc.	J & R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	1,512,020	1,509,950	1,509,950

								單位:新台幣干元
利率區間(%)	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通	提列備抵	擔係	采品	對個別對象	資金貸與最高
19年四周(70)	其业员六门员	米奶 比不亚识	資金必要之原因	呆帳金額	名稱	價值	資金貸與限額(註1)	限額(註2)
0.57~0.64	短期融通	\$ -	營業週轉	\$ -	_	\$ -	\$ 3,103,833	\$ 6,207,666
0.57	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
-	短期融通	_	營業週轉/購置設備	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	9,992,655	19,985,309
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.63~0.76	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.63~0.84	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
3.81~5.77	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
3.64~5.13	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
_	短期融通	_	營業週轉/購置設備	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.59~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.59~0.61	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.59~0.61	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.59~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	9,992,655	19,985,309
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	6,059,525	12,119,051
0.57~0.60	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.57~0.58	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.59~0.64	短期融通	_	營業週轉	_		_	15,691,600	23,537,401
0.87~1.03	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	5,981,659	11,963,319
_	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	5,981,659	11,963,319
0.87~0.93	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	5,981,659	11,963,319
_	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	5,981,659	11,963,319
4.59~5.40	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.87~1.03	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	199,539	399,079
0.87~1.03	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	199,539	399,079
0.65~0.99	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本年度 最高額度餘額	年底額度餘額	年底實際 動支餘額
8	ASE (Korea) Inc.	本公司	其他應收款-關係人	是	\$ 2,958,300	\$ 2,954,250	\$ 2,626,000
		日月光半導體 (威海)有限公司	其他應收款-關係人	是	1,641,250	1,641,250	1,641,250
9	ASE Japan Co., Ltd.	J & R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	2,431,520	2,263,410	2,263,410
10	USI Enterprise	本公司	其他應收款-關係人	是	5,916,600	2,626,000	2,626,000
	Limited	環隆電氣公司	其他應收款-關係人	是	283,500	-	_
		環電公司	其他應收款-關係人	是	2,235,160	2,232,100	2,232,100
		J&R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	6,443,317	6,390,340	6,390,340
11	Huntington Holdings International Co.Ltd.	本公司	其他應收款-關係人	是	1,807,850	1,805,375	1,805,375
12	Anstock Limited	日月光封裝測試 (上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	3,322,510	3,250,365	3,250,365
13	日月光半導體 (昆山) 有限公司	日月光投資(昆山)有限公司	其他應收款-關係人	是	4,130	2,022	2,022
14	Real Tech Holdings	本公司	其他應收款-關係人	是	3,944,400	3,939,000	3,939,000
	Limited	J & R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	1,260,000	_	-
15	上海鼎匯房地產開發 有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	其他應收款-關係人	是	205,312	_	_
		昆山鼎泓房地產開發有限公司	其他應收款-關係人	是	682,425	682,425	556,050
16	環旭電子公司	環鴻電子(昆山)有限公司	其他應收款-關係人	是	1,550,160	1,516,500	_
		環維電子(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	3,875,400	3,791,250	1,982,623
		Universal Global Technology Co., Limited	其他應收款-關係人	是	6,200,640	6,066,000	-
		環豪電子(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	516,720	505,500	_
		環鴻科技公司	其他應收款-關係人	是	1,283,200	_	_
17	Omniquest Industrial	本公司	其他應收款-關係人	是	3,122,650	3,118,375	1,641,250
18	Anstock II Limited	J & R Holding Limited	長期應收款-關係人	是	9,762,390	9,749,025	9,749,025
19	環勝電子(深圳)有限公	環旭電子公司	其他應收款-關係人	是	1,283,200	_	-
	司	環維電子(上海)有限公司	其他應收款-關係人	是	1,756,848	1,313,006	1,313,006
		Universal Global Technology Co., Limited	其他應收款-關係人	是	1,756,848	1,465,950	_

		李全体的性質,类双位在全部。 有短期融通 提列備抵 擔保品		 呆品	對個別對象	資金貸與最高		
利率區間(%)	資金貸與性質	業務往來金額	資金必要之原因	呆帳金額	名稱	價值	資金貸與限額(註1)	限額(註2)
3.17~3.42	短期融通	\$ -	營業週轉	\$ -	_	\$ -	\$ 3,187,595	\$ 6,375,190
3.21~3.24	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.53	短期融通	_	營業週轉	_	=	_	15,691,600	23,537,401
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	8,435,979	16,871,957
0.57~0.58	短期融通		營業週轉	-	_	_	8,435,979	16,871,957
0.59~0.64	短期融通	_	營業週轉	-	_	_	8,435,979	16,871,957
0.59~3.29	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	8,435,979	16,871,957
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	9,161,282	18,322,564
4.45	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
4.85~6.00	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	-	_	_	8,704,050	17,408,100
0.57~0.58	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	8,704,050	17,408,100
6.00	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
4.35~6.00	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
	k=+0=4\7		WW 2446 NEW + 100					
- 2.25	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	6,906,269	13,812,538
0.80~2.25 2.25	短期融通短期融通		營業週轉 營業週轉	_	_		6,906,269 6,906,269	13,812,538 13,812,538
	r=+n=+:×		WW 光花 7 四 丰庫					42.040.520
_	短期融通短期融通		營業週轉 營業週轉	_	_		6,906,269 6,906,269	13,812,538 13,812,538
							, ,	, ,
0.57~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	3,236,524	6,473,048
2.45	短期融通	_	營業週轉	_		_	15,691,600	23,537,401
_	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	1,667,679	3,335,357
0.8~5.04	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	1,667,679	3,335,357
_	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	1,667,679	3,335,357
	I	I	I	1		I	I	I

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本年度 最高額度餘額	年底額度餘額	年底實際 動支餘額
20	日月光封裝測試 (上 海)有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	其他應收款-關係人	是	\$ 774,375	\$ -	\$ -
		日月光貿易(上海)有限公司	長期應收款-關係人	是	986,100	984,750	_
21	日月光貿易(上海)有限	J & R Holding Limited	長期應收款-關係人	是	6,574,000	6,565,000	_
	公司	A.S.E. Holding Limited	長期應收款-關係人	是	3,287,000	3,282,500	-
22	日月光半導體(上海)有 限公司	日月光半導體(威海)有限公司	其他應收款-關係人	是	427,310	164,125	164,125
23	Innosource Limited	本公司	其他應收款-關係人	是	723,140	722,150	722,150
24	ASE Investment (Labuan) Inc.	本公司	其他應收款-關係人	是	3,118,375	3,118,375	_
25	ASE Labuan Inc.	本公司	其他應收款-關係人	是	723,140	_	_
26	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	本公司	其他應收款-關係人	是	1,939,330	1,936,675	1,936,675
27	ASE Corporation	本公司	其他應收款-關係人	是	2,793,950	1,879,444	900,000
28	日月光電子公司	本公司	其他應收款-關係人	是	350,000	200,000	200,000
29	ASE Electronics (M) SDN. BHD.	A.S.E. Holding Limited	其他應收款-關係人	是	131,480	_	-
30	ASE Singapore Pte. Ltd.	A.S.E. Holding Limited	其他應收款-關係人	是	394,440	393,900	393,900
31	日月光半導體(香港)有 限公司	J&R Holding Limited	其他應收款-關係人	是	230,090	_	_

註1:對個別對象資金貸與限額為不超過該公司淨值之百分之二十。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者,以不超過本公司最近期財務報表淨值 之百分之十為限。

註2:因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額度,以不超過該公司淨值百分之四十為限。惟本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事 資金貸與者,以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十五為限。

註3:已於編製合併報告時沖銷。

	-	## 75 /2 - 1 A A	有短期融通	提列備抵	擔任	 呆品	對個別對象	資金貸與最高
利率區間(%)	資金貸與性質	業務往來金額	資金必要之原因	呆帳金額	名稱	價值	資金貸與限額(註1)	限額(註2)
5.35	短期融通	\$ -	營業週轉	\$ -	-	\$ -	\$ 15,691,600	\$ 23,537,401
0.94	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
0.94	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	15,691,600	23,537,401
_	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.73~1.12	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.59~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	798,494	1,596,988
0.59~0.61	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	3,221,829	6,443,658
0.59~0.61	短期融通	-	營業週轉	_	_	-	769,385	1,538,770
0.59~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	2,073,390	4,146,780
0.87~0.93	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	3,237,259	6,474,518
0.87~0.93	短期融通	_	營業週轉	_	-	_	765,609	1,531,218
0.60	短期融通	_	營業週轉	-	-	-	15,691,600	23,537,401
0.59~0.64	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401
0.61	短期融通	_	營業週轉	_	_	_	15,691,600	23,537,401

為他人背書保證

民國104年1月1日至12月31日

附表二

編號	背書保證者	被背	f書保證對象	對單一企業背書	本年度最高	年底	年底實際
利用 51元	公司名稱	公司名稱	關係	保證限額(註1)	額度餘額	額度餘額	動支餘額
0	本公司	Anstock Limited	間接持有表決權股份100%之子公司	\$ 47,074,801	\$ 2,783,448 (註3)	\$ 2,634,135 (註3)	\$ 2,557,224 (註3)
		Anstock II Limited	間接持有表決權股份100%之子公司	47,074,801	10,280,093 (註3)	10,266,019 (註3)	9,941,667 (註3)
1	上海鼎匯房 地產開發 有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	直接持有表決權股份100%之子公司	13,765,242	5,693,228 (註3)	_	_

註1:依本公司及上海鼎匯房地產開發有限公司「背書保證作業程序」,對單一企業之背書保證額度分別以不超過股東權益總額之百分之三十及百分之七十為限。

註2:依本公司及上海鼎匯房地產開發有限公司「背書保證作業程序」,背書保證責任總額分別以不超過股東權益總額之百分之四十及百分之百為限。

註3:係包含本金及利息。

單位:新台幣干元

 以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證金額佔 最近期財務報表淨值之比率(%)	背書保證最高 限額(註2)	屬母公司對子公司 背書保證	屬子公司對母公司 背書保證	屬對大陸地區 背書保證
\$ -	1.7	\$ 62,766,402	是	否	否
-	6.5	62,766,402	是	否	否
-	_	19,664,631	是	否	是

年底持有有價證券情形明細表

民國104年1月1日至12月31日 附表三

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
本公司	股票		
	漢驊創業投資公司	_	備供出售金融資產-非流動
	漢大創業投資公司	_	備供出售金融資產-非流動
	神通資訊科技公司	_	備供出售金融資產-非流動
	亞太新興產業創業投資公司	_	備供出售金融資產-非流動
	晶錡科技公司	_	備供出售金融資產-非流動
	債券		
	元隆電子公司國内第二次私募無擔保轉換公司債	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	有限合夥		
	Ripley Cable Holdings I, L.P.	_	備供出售金融資產-非流動
台灣福雷電子公司	股票		
	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產-非流動
	神通資訊科技公司	_	備供出售金融資產-非流動
	基金		
	中國信託亞太多元入息平衡基金	_	備供出售金融資產-流動
日月瑞公司	基金		
	台新大衆貨幣市場	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	日盛貨幣市場	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	華南永昌麒麟貨幣市場基金	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	華南永昌鳳翔貨幣市場基金	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
陸竹開發公司	股票		
	力晶科技公司	_	備供出售金融資產-非流動
A.S.E. Holding Limited	股票		
	Global Strategic Investment Inc.	_	備供出售金融資產-非流動
	SiPhoton, Inc.	_	備供出售金融資產-非流動
	Global Strategic Investment, Inc. (Samoa)	_	備供出售金融資產-非流動
J & R Holding Limited	股票		
	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產-非流動
	有限合夥		
	Crimson Velocity Fund, L.P.	_	備供出售金融資產-非流動
	H&QAP Greater China Growth Fund, L.P.	_	備供出售金融資產-非流動
ASE Test Limited	股票		
	日月光半導體製造公司	母公司	備供出售金融資產-非流動

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

單位:新台幣干元(除另予註明者	年底							
備註	公允價值	持股比率(%)	帳面金額					
	公が原他	141111111111111111111111111111111111111	AN TOTAL BY					
	\$ 10,771	15	\$ 10,771	2,528,090				
	33,798	13	33,798	2,482,758				
	27	_	27	4,203				
	37,524	7	37,524	6,000,000				
	-	6	-	333,334				
	100,500	_	100,500	1,000				
	390,987	4	390,987	_				
	417,193	_	417,193	10,978,776				
	7,314	1	7,314	1,133,363				
	16,037	-	16,037	1,600,192				
	472,164	-	472,164	33,664,705				
	23,029	-	23,029	1,575,019				
	30,962		30,962	2,616,592				
	45,555	_	45,555	2,833,825				
	27,530	_	27,530	1,677,166				
	美金 414干元	3	美金 414干元	490,000				
	美金 一千元	4	美金 - 千元	544,800				
	美金 1,253千元	2	美金 1,253千元	869,891				
	美金 54,067干元	1	美金 54,067干元	46,703,763				
	美金 1,597千元	_	美金 1,597千元	_				
	美金 1,011干元	8	美金 1,011干元	-				
	¥		¥A 400.400T-	00 200 472 (=+)				
	美金 102,106千元	1	美金 102,106千元	88,200,472 (註)				

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
上海鼎匯房地產開發	基金		
有限公司	180ETF	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	300ETF	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	5002.1		
	股票		
	珠海格力電器股份有限公司	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	上海汽車集團股份有限公司	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	瀋陽桃李麵包股份有限公司	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
環電公司	股票		
	博智電子公司	_	備供出售金融資產—流動
	全球創業投資公司	_	備供出售金融資產—非流動
	精磁科技公司	_	備供出售金融資產—非流動
Huntington Holdings	股票		
International Co., Ltd.	United Pacific Industrial Ltd.	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	Cadence Design SYS Inc.	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	Solid Gain Invenstments Ltd.	_	備供出售金融資產─非流動
	特別股		
	Techgains I Corporation	_	備供出售金融資產—非流動
	Techgains II Corporation	_	備供出售金融資產─非流動
	00.395		
Unitech Holdings	股票		
International Co., Ltd.	United Pacific Industrial Ltd.	_	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
	WacomCo., Ltd.	_	備供出售金融資產—非流動
	Sequans Communications SA	_	備供出售金融資產—非流動
	Asia Global Venture Co., Ltd.	_	備供出售金融資產—非流動

註: ASE Test Limited持有本公司股票88,200,472股,則全數以非保留運用決定權信託專戶保管。

	年底							
股數/單位數		帳面金額	持股比率(%)		公允價值	備註		
47,825	人民幣	153千元	_	人民幣	153千元			
39,700	人民幣	150千元	_	人民幣	150千元			
28,000	人民幣	626干元	_	人民幣	626干元			
19,250	人民幣	408干元	_	人民幣	408千元			
1,000	人民幣	39千元	-	人民幣	39千元			
007.000		44.207	-		44.207			
827,009	\$	14,307	2	\$	14,307			
6,200,000		35,789	5		35,789			
733,000		_	2		_			
5,548,800	美金	379干元	_	美金	379干元			
9,633	美金	200千元	_	美金	200千元			
1,439,500	美金	818千元	20		818干元			
1,433,300		0.0178	20	<u> </u>	010178			
526,732	美金	268干元	10	美金	268干元			
669,705	美金	197干元	4	美金	197干元			
5,613,600	美金	384干元	_	美金	384干元			
1,200,000	美金	4,805干元	1	美金	4,805千元			
370,554	美金	778千元	1	美金	778干元			
1,000,000	美金	454干元	10	美金	454千元			

重大累積買進或賣出同一有價證券明細表

民國104年1月1日至12月31日

附表四

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	年初		
貝、頁之公司	有 順起 芬 性類及 石 構	版 <u>別</u> 科日	父易到家	附1术	股數/單位數	金額(註1)	
本公司	基金						
	兆豐國際寶鑽貨幣市場	備供出售金融資產-流動	_	_	32,504,205	\$ 400,000	
	股票						
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	註2	子公司	1,625,015,916	36,706,080	
	環電公司	採權益法之長期股權投資	註2	子公司	_	-	
	日月暘公司	採權益法之長期股權投資	註3	合資	_	-	
	矽品公司	採權益法之長期股權投資	註4	關聯企業	_	-	
台灣福雷電子公司	基金						
	統一強棒貨幣市場基金	備供出售金融資產-流動	_	_	18,289,114	300,338	
	中國信託華盈貨幣市場基金	備供出售金融資產-流動	_	_	27,717,723	300,033	
	富邦吉祥貨幣市場基金	備供出售金融資產-流動	_	_	_	-	
	股票						
	Alto Enterprises Limited	採權益法之長期股權投資	註5	子公司	140,000,000	3,351,112	
日月瑞公司	基金						
	台新1699貨幣市場	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	_	_	34,302,310	455,720	
	台新大衆貨幣市場	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	_	_	_	-	
Alto Enterprises Limited	股權憑證						
	日月光投資(昆山)有限公司	採權益法之長期股權投資	註5	子公司	_	美金 55,957干元	
日月光投資(昆山)有限公司	股權憑證						
	日月光半導體(昆山)有限公 司	採權益法之長期股權投資	註5	子公司	_	美金 55,981干元	
環旭電子公司	股權憑證						
	環維電子(上海)有限公司	採權益法之長期股權投資	註5	子公司	_	人民幣 341,706千元	
環誠科技公司	股票						
	環旭電子公司	採權益法之長期股權投資	_	子公司	895,874,563	美金 854,449千元	

註1:採權益法之長期股權投資金額係包括權益法認列之投資損益及股東權益相關調整項目等。其他金融資產金額則包括以公平價值衡量之評價調整數。

註2:係環隆電氣辦理分割換股新設立環電公司。

註3:係與日商TDK Corporation合資設立。

註4:係辦理公開收購。

註5:係辦理現金增資。

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

	 [入			:出			事件人(陈为了赶明有外) 一 手底
股數/單位數	金額	股數/單位數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數/單位數	金額(註1)
-	\$ -	32,504,205	\$ 400,085	\$ 400,000	\$ 85	-	\$ -
-	_	1,585,412,694	36,214,968	36,218,502	(3,534)	39,603,222	1,187,548
990,080,566	36,214,968	_	_	_	_	990,080,566	44,733,359
61,809,660	618,097	_	_	_	_	61,809,660	613,841
779,000,000	35,055,000	_	_	_	_	779,000,000	35,423,058
18,187,991	300,000	36,477,105	601,787	600,000	1,787	-	_
_	_	27,717,723	301,242	300,000	1,242	_	_
25,850,193	400,000	25,850,193	400,257	400,000	257	=	_
48,000,000	1,507,200	_	-	_	_	188,000,000	4,490,553
14,256,665	190,000	48,558,975	646,223	644,000	2,223	_	_
33,664,705	470,066	_	_	_	_	33,664,705	472,164
-	美金 48,000千元	_	-	_	_	-	美金 88,752干元
_	美金 48,000干元	_	_	_	_	_	美金 88,805干元
-	人民幣 800,000千元	_	_	_	_	-	人民幣 727,596干元
	_	_	美金 319,785千元	美金 52,456千元	美金 232,972干元	1,683,749,126	美金 814,021干元

取得不動產之金額達新台幣3億或實收資本額20%以上

民國104年1月1日至12月31日 附表五

取得不動產之公司	財產名稱	事實發生日	交易金額(未稅)	價款支付情形	交易對象	關係
本公司	楠梓加工區第2園區創意北 路1號	104.06.04	\$ 1,718,000	已付訖	宏璟建設公司	關聯企業
	楠梓加工區第2園區研發路 66號	104.06.04	748,000	已付訖	宏璟建設公司	關聯企業
	高雄廠外勞宿舍興建之土建及機電工程	104.01.01~104.12.31	504,600	尚餘37,800干元將於 驗收後付款	福華工程股份有限公司	關聯企業
	高雄廠區供營業用之廠務設備及工程等	104.01.01~104.12.31	355,282	尚餘121,521干元將於 驗收後付款	坤琳工程股份有限 公司	-
	高雄廠區供營業用之廠務設 備及工程等	104.01.01~104.12.31	337,374	尚餘55,130干元將於 驗收後付款	炫昶企業有限公司	_
	高雄廠區供營業用之廠務設備及工程等	104.01.01~104.12.31	310,414	尚餘62,600千元將於 驗收後付款	長頂工程有限公司	-
	高雄廠區供營業用之廠務設 備及工程等	104.01.01~104.12.31	307,000	尚餘184,200干元將於 驗收後付款	水礦科技股份有限公司	_
日月光封裝測試(上海) 有限公司	日月光集團張江二期廠房新建專案	104.05.08~104.12.24	548,465	尚餘90,747干元將於 驗收後付款	中國二十冶集團有限公司	_

單位:新台幣干元

	交易對象為關係人者	省,其前次移轉資料		唐权 为宁之 <u></u>	取得日的及唐田桂形	甘州如宁東西
所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額	價格決定之參考依據	取得目的及使用情形	其他約定事項
-	-	_	\$ -	參酌專業機構出具之 鑑價報告議定之	因應未來產能擴充	無
-	_	_	_	参酌專業機構出具之 鑑價報告議定之	因應未來產能擴充	無
-	_	-	_	參酌專業機構出具之 鑑價報告議定之	因應未來營運成長將 引進外勞所產生之 住宿需求,並提升 外勞員工之居住安 全及品質	無
-	_	-	-	依詢、比、議價	依營業用之廠務設備 及工程擴充	無
-	_	-	-	依詢、比、議價	依營業用之廠務設備 及工程擴充	無
-	_	_	-	依詢、比、議價	依營業用之廠務設備 及工程擴充	無
_	_	_	_	依詢、比、議價	依營業用之廠務設備 及工程擴充	無
	_	_	_	招標,比價及議價	因應未來產能擴充	無

重大與關係人進、銷貨明細表

民國104年1月1日至12月31日 附表六

淮/錦/呉ウ八ヨ	六日料色夕 極	見見/で			交	易情形		
進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	進(銷)貨		金額	佔總進(銷)貨之比率%	授信期間	
本公司	日月光半導體(上海)有限公司	子公司	進貨	\$	1,713,266	6	月結60天	
	日月光電子公司	子公司	進貨		1,990,597	6	月結60天	
	ISE Labs, Inc.	子公司	銷貨	(121,374)	-	發票日後45天	
	環隆電氣公司	子公司	銷貨	(9,083,160)	(10)	月結60天	
	ASE Japan Co., Ltd	子公司	銷貨	(116,993)	_	月結60天	
日月光封裝測試(上	日月光半導體(上海)有限公司	聯屬公司	進貨		399,553	13	月結60天	
海)有限公司	日月光電子公司	聯屬公司	進貨		212,770	7	月結60天	
日月光半導體(香港) 有限公司	日月光半導體(上海)有限公司	母公司	進貨		1,059,036	100	月結90天	
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	日月光電子公司	聯屬公司	進貨		380,496	26	發票日後60天	
ISE Labs, Inc.	本公司	最終母公司	進貨		121,374	47	發票日後45天	
環隆電氣公司	本公司	最終母公司	進貨		9,083,160	30	月結60天	
ASE Japan Co.,Ltd	本公司	最終母公司	進貨		116,993	50	月結60天	
日月光半導體(上海)	本公司	最終母公司	銷貨	(1,713,266)	(39)	月結60天	
有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	銷貨	(399,553)	(9)	發票日後60天	
	日月光半導體(香港)有限公司	子公司	銷貨	(1,059,036)	(24)	月結90天	
日月光電子公司	本公司	最終母公司	銷貨	(1,990,597)	(50)	月結60天	
	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	聯屬公司	銷貨	(380,496)	(10)	發票日後60天	
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	銷貨	(212,770)	(5)	月結60天	
	Universal Global Technology Co., Limited	聯屬公司	銷貨	(305,682)	(8)	月結60天	
蘇州日月新半導體有限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體 有限公司有重大影響力公司之子公司-荷蘭NXP B.V之子公司	銷貨	(1,924,007)	(39)	月結90天	
環勝電子(深圳)有限 公司	環旭科技有限公司	聯屬公司	進貨銷貨	人民幣 (人民幣	738,134干元 2,596,129干元)	20 (54)	75天 75天	
環旭電子公司	Universal Global Technology Co., Limited	子公司	進貨	人民幣	1,809,909干元	22	75天	

	Ե原因		同之情形及原因	交易條件與一般交易	
備註		佔總應收(付)票據	餘額	授信期間	單價
註	6)		433,581)	- IXIII//III	5 -
註	6)		475,673)	_	_
註	-			_	_
註			30,216		
	14		2,220,182	_	-
註	-		18,075	_	-
註	11)		68,869)	_	-
註	8)	(47,235)	_	-
註	100)	(306,358)	-	-
註	24)	(61,229)	-	-
=+	20)	,	20.205)		
註	38)	(30,295)	_	-
=					
註	62)	(2,214,594)	_	-
註	22)	(18,101)	_	-
註	48		435,484	-	-
註	8		68,869	-	-
註	34		306,358	_	-
註	51		494,337	_	-
註	6		61,337	_	-
=+	_		47.076		
註	5		47,876	_	-
註	12		115,072	_	_
P.L.			113,672		
註	51		668,998	_	_
=+					
註	13)	(149,480千元)		-
註	54		649,947千元	_	-
註	48)	(903,017千元)	_	-

**/金/たうりョ	六日料色石矿	88 17	交易情形				
進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	進(銷)貨		金額	佔總進(銷)貨之比率%	授信期間
	環旭科技有限公司	子公司	銷貨	(人民幣	35,722千元)	-	75天
	環勝電子(深圳)有限公司	子公司	銷貨	(人民幣	34,959千元)	_	75天
Universal Global	環旭電子公司	母公司	銷貨	(美金	288,558千元)	(68)	75天
Technology Co.,	環鴻電子(昆山)有限公司	聯屬公司	銷貨	(美金	137,121千元	(32)	75天
Limited	日月光電子公司	聯屬公司	進貸	\$	305,682	2	月結60天
環旭科技有限公司	環勝電子(深圳)有限公司	聯屬公司	進貨	美金	417,234干元	54	75天
			銷貨	(美金	107,966千元)	(14)	75天
	環旭電子公司	母公司	進貨	美金	5,707千元	1	75天
	環鴻科技公司	聯屬公司	進貨	美金	9,520千元	1	75天
			銷貨	(美金	544,423千元)	(70)	75天
	環鴻電子(昆山)有限公司	聯屬公司	進貨	美金	241,229千元	31	75天
			銷貨	(美金	11,791千元)	(2)	75天
環鴻科技公司	環旭科技有限公司	聯屬公司	進貨	\$	17,349,315	89	75天
			銷貨	(273,913)	(1)	75天
	環旭電子公司	母公司	銷貨	(220,300)	(1)	75天
	環勝電子(深圳)有限公司	聯屬公司	銷貨	(149,600)	(1)	75天
	環隆電氣公司	聯屬公司	銷貨	(1,496,637)	(7)	75天
環鴻電子(昆山)有限 公司	Universal Global Technology Co., Limited	聯屬公司	進貨	人民幣	853,882千元	46	75天
	環旭科技有限公司	聯屬公司	進貨	人民幣	73,828千元	4	75天
			銷貨	(人民幣	1,497,895干元)	(66)	75天

註:已於編製合併報告時沖銷。

交易條件與一般交	易不同之情形及原因		應收(付)	票據、帳款	/±=+
單價	授信期間		餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	備註
\$ -	-	人民幣	12,184干元	1	註
-	_	人民幣	329干元	_	註
_	_	美金	139,083千元	93	註
_	_	美金	10,721千元	7	註
_	_	(\$	115,072)	(1)	註
_	_	(美金	100,090千元)	(58)	註
-	_	美金	21,927千元	12	註
_	_	(美金	1,876千元)	(1)	註
-	_	(美金	1,143千元)	(1)	註
-	_	美金	121,600千元	68	註
-	_	(美金	31,576千元)	(18)	註
_	_	美金	2,144千元	1	註
-	_	(\$	3,989,045)	(88)	註
_	_		76,102	1	註
_	_		_	-	註
_	_		_	-	註
_	_		329,214	6	註
_	_	(人民幣	69,615干元)	(22)	詿
_	-	(人民幣	13,922干元)	(4)	註
_	-	人民幣	206,744干元	45	註

重大應收關係人款項明細表

民國104年12月31日 附表七

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係
本公司	環隆電氣公司	子公司
日月光電子公司	本公司	最終母公司
	Universal Global Technology Co., Limited	聯屬公司
Omniquest Industrial Limited	本公司	母公司
ISE Labs, Inc.	J & R Holding Limited	母公司
Anstock II Limited.	J & R Holding Limited	母公司
Anstock Limited	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司
A.S.E. Holding Limited	本公司	母公司
台灣福雷電子公司	本公司	母公司
	ASE Corporation	聯屬公司
ASETest Limited	本公司	最終母公司
	A.S.E. Holding Limited Omniquest Industrial Limited	聯屬公司 聯屬公司
	Offiniquest industrial Elithited	white 전 대
ASE Singapore Pte. Ltd.	A.S.E. Holding Limited	聯屬公司
ASE (Korea) Inc.	本公司	最終母公司
	日月光半導體(威海)有限公司	子公司
J & R Holding Limited	本公司	母公司
	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands.	子公司
	Anstock Limited	子公司
	日月光半導體(威海)有限公司 日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司 聯屬公司
	Innosource Limited	聯屬公司
	Real Tech Holdings Limited	聯屬公司
Innosource Limited	本公司	母公司
日月瑞公司	本公司	最終母公司
	日月光電子公司	聯屬公司
Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands.	本公司	最終母公司

金額 盛理方式 期後收回金額 呆帳金額 1,766,202 \$	 提列備抵	應收關係人款項	人款項(註1)	逾期應收關係人	週轉率(次)		應收關係人
\$ 6,173 持機能収 \$ 1,766,202 \$					(註2)		款項餘額(註
5	\$	\$ 1,766,202	持續催収	\$ 6,173	3	(註5)	2,220,182
5 - 94,861							
		406,076	-	-	4	(註5)	700,436
61,040		94,861	_	-	5	(註5)	115,072
61,040		_	-	_	-	(註3及5)	1,641,250
		_	-	-	-	(註3及5)	1,510,312
590,421 — 590,421 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		61,040	-	-	-	(註3及5)	9,810,065
590,421		_	-	-	-	(註3及5)	3,293,743
		_	-	-	-	(註3及5)	2,757,300
		590,421	-	_	-	(註3、4及5)	7,320,710
		_	_	-	-	(註3及5)	900,000
		_	-	-	-	(註3及5)	4,037,475
		-	-	-	-	(註3及5)	1,663,540
		_	_	=	_	(註3及5)	1,644,277
		_	_	-	-	(註3及5)	394,118
		241	_	_	-	(註3及5)	2,627,294
		_	_	-	-	(註3及5)	1,643,994
		_	_	_	_	(註3及5)	9,256,650
		_	-	_	-	(註3及5)	2,471,186
		_	-	_	-	(註3及5)	801,897
		_	-	_	_	(註3及5)	1,380,065
		_	_	_	_	(註3及5)	560,401
		_	-	_	_	(註3及5)	723,447
		_	-	-	-	(註3及5)	2,134,808
		-	-	-	-	(註3及5)	722,150
		_	-	_	-	(註3及5)	190,000
		_	-	_	-	(註3及5)	190,000
		_	-	_	-	(註3及5)	1,936,675

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係
ASE Japan Co., Ltd.	J & R Holding Limited	母公司
ASE Corporation	本公司	最終母公司
日月光半導體(上海)公司	本公司	最終母公司子公司
	日月光半導體(香港)有限公司 日月光半導體(威海)有限公司	聯屬公司
上海鼎匯房地產開發有限公司	昆山鼎泓房地產開發有限公司	子公司
USI Enterprise Limited	本公司	最終母公司
	J & R Holding Limited 環電公司	聯屬公司 母公司
Huntington Holdings International Co. Ltd.	本公司	最終母公司
Real Tech Holdings Limited	本公司	最終母公司
蘇州日月新半導體有限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體有限公司有重大影響力公司之子公司
環勝電子(深圳)有限公司	環旭科技有限公司	聯屬公司
	環維電子(上海)有限公司	聯屬公司
環旭電子公司	環維電子(上海)有限公司 環勝電子(深圳)有限公司	子公司 子公司
Universal Global Technology Co.,	環旭電子公司	母公司
Limited	環鴻電子(昆山)有限公司 環勝電子(深圳)有限公司	聯屬公司 子公司
環旭科技有限公司	環勝電子(深圳)有限公司	聯屬公司
	環鴻科技公司	聯屬公司
環鴻科技公司	環隆電氣公司	聯屬公司
環鴻電子(昆山)有限公司	環旭科技有限公司	聯屬公司

註1:係包含應收帳款及其他應收款。

註2:不含其他應收款。

註3:主係應收融資款:詳附表一說明。

註4:主係Turnkey代收代付。 註5:已於編製合併報表時沖銷。

	應收關係力	Λ	週轉率(次)	逾期應收關係	系人款項(註1)	應收關係人款項	提列備抵
	款項餘額(討	Ē1)	(註2)	金額	處理方式	期後收回金額	呆帳金額
\$	2,264,163	(註3及5)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
	900,000	(註3及5)	-	_	-	-	_
	435,484	(註5)	3	40,311	持續催収	105,042	_
	306,358	(註5)	3	1,772	持續催収	100,053	_
	164,556	(註3及5)	_	_	_	_	_
	570,852	(註3及5)	-	_	_	750	-
	2,626,000	(註3及5)	_	_	_	_	_
	6,402,296	(註3及5)	-	_	-	6,663	-
	2,233,090	(註3及5)	_	_	_	_	_
	1,805,375	(註3及5)	-	_	_	_	-
	3,939,000	(註3及5)	_	_	_	_	-
	683,680		3	_	_	154,965	-
人民幣 65	0,086干元	(註5)	4	_	_	人民幣 249,196干元	-
人民幣 26	1,002千元	(註5)	-	_	_	=	=
人民幣 39	3,196干元	(註5)	-	_	-	_	-
人民幣 28	9,096干元	(註5)	_	_	_	_	_
美金 13	9,153干元	(註5)	4	_	-	美金 49,939千元	-
	0,721千元	(註5)	5	_	_	_	-
美金 4.	3,119干元	(註5)	_	_	_	美金 43,119千元	-
	3,084干元	(註5)	4	_	_	美金 6,589干元	-
美金 12	1,863干元	(註5)	5	_	_	美金 46,803千元	-
	348,070	(註5)	4	2,563	持續催収	273,537	=
人民幣 20	6,744干元	(註5)	6	_	_	人民幣 63,666千元	-

被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊

民國104年1月1日至12月31日 附表八

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
本公司	A.S.E. Holding Limited	百慕達群島	從事專業性投資活動
	J & R Holding Limited	百慕達群島	從事專業性投資活動
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	日本	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	Innosource Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	宏錦光公司	台灣	自有剩餘攤位及辦公大樓出租
	宏璟建設公司	台灣	委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租業務、買賣各種建材及其進出口 業務、房屋租售之介紹業務、室内設計裝潢工程
	環隆電氣公司	台灣	各種電腦資訊之週邊設備,厚膜混合積體電路,電子零件配件及個人電腦及 其零件之製造、加工與買賣
	台灣福雷電子公司	台灣	半導體產品測試服務
	環電公司	台灣	從事專業性投資活動
	陸竹開發公司	台灣	從事土地及建築開發業務
	日月陽公司	台灣	從事積體電路内埋式基板之產銷業務
	矽品公司	台灣	各項積體電路構裝之製造、加工、買賣及測試等有關業務
	元隆電子公司	台灣	晶圓積體電路代工
台灣福雷電子公司	Alto Enterprises Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	Super Zone Holdings Limited	香港	從事專業性投資活動
	陸竹開發公司	台灣	從事土地及建築開發業務
A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited	新加坡	從事專業性投資活動
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
J & R Holding Limited	ASE Test Limited	新加坡	從事專業性投資活動
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
	日月瑞公司	台灣	各型積體電路封裝測試用機器設備及引線架機器設備之租賃等
	ASE Japan Co., Ltd.	日本	積體電路之封裝及製造
	ASE (U.S.) Inc.	美國	從事市場行銷支援及客戶服務等業務
	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	開曼群島	從事專業性投資活動
	Anstock Limited	開曼群島	從事專業性投資活動
	Anstock II Limited	開曼群島	從事專業性投資活動
ASE Investment (Labuan) Inc.	ASE (Korea) Inc.	南韓	電子零組件,通信機械器材製造
ASE Test Limited	ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	新加坡	從事專業性投資活動
	ASE Test Holdings, Ltd.	開曼群島	從事專業性投資活動
	ASE Test Finance Limited	模里西斯	從事專業性理財活動
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
	ASE Singapore Pte. Ltd.	新加坡	半導體產品測試服務
ASE Test Holdings, Ltd.	ISE Labs, Inc.	美國	半導體產品測試服務

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

										干元(除另予註明者外)	
	原始投	資金額	[年底持有	1		4	投資公司	本年度認列之	備註
	本年年底	:	去年年底	股數	比率 ————————————————————————————————————		帳面金額	本2	丰度(損)益 ————————————————————————————————————	投資(損)益(註1)	
美金	283,966千元	美金	283,966千元	243,966	100	\$	15,251,124	\$	498,485	\$ 480,474	子公司
美金	479,693千元	美金	479,693千元	435,128	100		47,271,666		2,304,578	2,049,623	子公司
日幣	60,000千元	日幣	60,000千元	1,200	100		27,986		2,082	2,082	子公司
美金	250,504千元	美金	250,504千元	250,504,067	71		11,140,252		233,728	198,948	子公司
美金	86,000千元	美金	86,000千元	86,000,000	100		3,998,959		67,639	77,641	子公司
\$	390,470	\$	390,470	35,497,273	27		332,444	(35,497)	(9,694)	被投資公司
	2,845,913		2,845,913	68,629,782	26		1,313,499		701,531	64,151	被投資公司
	520,490		21,356,967	39,603,222	99		1,187,548		776,524	1,200,793	子公司
	20,698,867		20,698,867	851,997,366	100		29,586,903		2,905,510	2,883,511	子公司
	20,836,477		-	990,080,566	99		44,733,359		1,427,299	1,239,134	子公司
	1,366,238		1,366,238	131,961,457	67		1,332,571	(2,276)	(1,527)	子公司
	618,097		_	61,809,660	51		613,841	(8,375)	(4,274)	被投資公司
	35,055,000		-	779,000,000	24		35,423,058		8,762,257	410,937	被投資公司
	178,861		178,861	33,308,452	18		40,216	(320,121)	(58,390)	被投資公司
美金	188,000千元	美金	140,000千元	188,000,000	100		4,490,553	(163,043)	註2	子公司
美金	100,000千元	美金	100,000千元	100,000,000	100		3,332,370		83,754	註2	子公司
	372,504		372,504	37,250,448	19		376,082	(2,276)	註2	子公司
美金	84,889干元	美金	84,889干元	11,148,000	10	美金	102,620千元	美金	57,830千元	註2	子公司
美金	168,643干元	美金	168,643干元	168,642,842	70	美金	343,531千元	美金	14,196千元	註2	子公司
美金	964,524千元	美金	964,524干元	98,276,087	90	美金	1,028,767千元	美金	57,830千元	註2	子公司
美金	30,200千元	美金	30,200千元	30,200,000	8	美金	41,954千元	美金	7,478千元	註2	子公司
美金	51,344千元	美金	51,344千元	170,000,006	100	美金	30,394千元	美金	146千元	註2	子公司
美金	25,606千元	美金	25,606千元	7,200	100	美金	70,861千元	美金	788千元	註2	子公司
美金	4,600千元	美金	4,600千元	1,000	100	美金	12,014千元	美金	1,086千元	註2	子公司
美金	190,000千元	美金	190,000千元	190,000,000	100	美金	328,528千元	美金	13,060千元	註2	子公司
										-+.	
美金	10千元		10千元	10,000	100		602千元	(美金	18千元)	註2	子公司
美金	10千元	美金	10千元	10,000	100	美金	34千元	美金	90千元	註2	子公司
美金	160,000干元	美金	160,000干元	20,741,363	100	美金	490,753干元	美金	13,955干元	註2	子公司
美金	65,520千元	美金	65,520干元	71,428,902	100	美金	129,372千元	美金	22,127千元	註2	子公司
美金	222,399干元	美金	222,399干元	5	100	美金	99,491干元	美金	558干元	註2	子公司
	-千元	美金	0.002干元	_	-	美金	-千元	(美金	1干元)	註2	子公司
美金	72,304干元	美金	72,304干元	72,304,040	30	美金	147,228干元	美金	14,196干元	註2	子公司
美金	55,815干元	美金	55,815干元	30,100,000	100	美金	171,580干元		25,319干元	註2	子公司
美金	221,145千元	美金	221,145千元	26,250,000	100	美金	99,490干元	美金	558千元	註2	子公司

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	馬來西亞	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
Omniquest Industrial Limited	ASE Corporation	開曼群島	從事專業性投資活動
ASE Corporation	ASE Mauritius Inc.	模里西斯	從事專業性投資活動
	ASE Labuan Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
ASE Labuan Inc.	日月光電子公司	台灣	電子材料批發業、電子材料零售業及國際貿易業
Innosource Limited	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
日月光半導體(上海)有限 公司	日月光半導體(香港)有限公司	香港	從事貿易相關業務活動
環隆電氣公司	Huntington Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司
	展毅投資公司	台灣	對各種生產事業、創投公司、證券公司等之投資
環電公司	Huntington Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司
	展毅投資公司	台灣	對各種生產事業、創投公司、證券公司等之投資
Huntington Holdings	Unitech Holdings International Co. Ltd.	英屬維京群島	控股公司
International Co. Ltd.	Real Tech Holdings Limited	英屬維京群島	控股公司
	Universal ABIT Holding Co., Ltd.	開曼群島	控股公司
	Rising Capital Investment Limited	英屬維京群島	控股公司
	Rise Accord Limited	英屬維京群島	控股公司
Real Tech Holdings Limited	USI Enterprise Limited	香港	投資諮詢服務及倉儲管理服務
環旭電子公司	Universal Global Technology Co., Limited	香港	控股公司
Universal Global	環旭科技有限公司	香港	
Technology Co., Limited	環鴻科技公司	台灣	有線通信機械器材、無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、 汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業
	USI Japan Co., Ltd	日本	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
	USI @ Work, Inc.	美國	海外售後服務
	Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝
	USI America Inc.	美國	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作、維修服務
環旭科技有限公司	Universal Scientific Industrial De MexicoS.A. De C.V.	墨西哥	主機板及電腦系統組裝

註1:期認列之投資(損)益業已考量公司間交易之未實現損益之影響數。 註2:該被投資公司之損益業已包含於其投資公司,為避免混淆,於此不再另行表達。

	—————————————————————————————————————	資金額	1	年底持有			被		本年度認列之		
			去年年底		比率		 帳面金額		丰度(損)益	投資(損)益(註1)	備註
美金	60,000千元	美金	60,000千元	159,715,000	100	美金	129,372干元	美金	22,127千元	註2	子公司
美金	352,784干元	美金	352,784干元	352,784,067	100	美金	493,109干元	美金	7,542干元	註2	子公司
美金	217,800千元	美金	217,800千元	217,800,000	100	美金	375,804干元	美金	4,246千元	註2	子公司
美金	126,184干元	美金	126,184千元	126,184,067	100	美金	117,195千元	美金	3,324千元	註2	子公司
美金	125,813干元	美金	125,813干元	398,981,900	100	美金	116,620千元	美金	3,329千元	註2	子公司
美金	74,000干元	美金	74,000干元	74,000,000	21	美金	102,839干元	美金	7,478千元	註2	子公司
美金	1,000千元	美金	1,000千元	_	100	美金	9,191干元	美金	82千元	註2	子公司
\$	-	\$	8,370,606	-	_	\$	-	\$	586,787	註2	子公司
	_		298	-	-		-	(2)	註2	子公司
	8,370,606		_	255,856,840	100		45,805,518		1,552,527	註2	子公司
	_		_	-	_		-		1,046	註2	子公司
美金	3,000千元	美金	3,000千元	3,000,000	100	美金	9,133千元	(美金	46千元)	註2	子公司
美金	149,151干元	美金	149,151干元	149,151,000	100	美金	1,325,826干元	美金	71,385千元	註2	子公司
美金	28,125千元	美金	28,125千元	90,000,000	100	美金	13千元	(美金	1千元)	註2	子公司
美金	6,000千元	美金	6,000千元	6,000,000	100	美金	1,136千元	美金	4千元	註2	子公司
美金	2,000干元	美金	2,000干元	20,000	100	美金	151干元	美金	22千元	註2	子公司
美金	210,900千元	美金	210,900千元	210,900,000	98	美金	1,253,125千元	美金	75,710千元	註2	子公司
人民幣	₹324,185干元	人民幣	啓 324,185千元	390,000,000	100	人民幣	啓 1,421,145干元	人民幣	375,551干元	註2	子公司
美金	11,000千元	美金	11,000千元	85,800,000	100	美金	18,632千元	美金	1,036千元	註2	子公司
美金	30,400千元	美金	30,400千元	98,000,000	100	美金	83,745干元	美金	22,578千元	註2	子公司
美金	885千元		885千元	6,400	100	美金	751千元		25千元	註2	子公司
美金	-千元	美金	250千元	-	_	美金	-千元	美金	32千元	註2	子公司
美金	23,963干元	美金	23,963干元	281,085,325	100	美金	41,731干元	美金	4,414干元	註2	子公司
美金	9,500干元	美金	9,500千元	250,000	100	美金	5,365千元	美金	153千元	註2	子公司
美金	-千元	美金	-千元	1	_	美金	-千元	美金	4,414干元	註2	子公司

大陸投資資訊

民國104年1月1日至12月31日 附表力.

大陸被投資公司名稱	 主要營業項目	實收資本額	投資方式	本年年初自台灣	本年度匯出或收回投資金額			
八座版汉真公司石博	工女呂木県口	美权 其不识	1又員/ブン	匯出累積投資金額	匯出	收回		
日月光半導體(上海)有限公司	從事半導體材料製造業務	\$ 4,236,563	註1(1)	\$ 4,398,576	\$ -	\$		
		(美金 133,812千元)		137,800千元)				
			=+ . (=)					
日月光半導體(昆山)有限公司	從事半導體材料製造及半	8,350,204		6,843,004	1,507,200			
	導體產品之封裝測試業 務	(美金 268,000千元)		(美金 220,000千元)	(美金48,000千元)			
	375				(註10)			
日月光電子元器件(上海)有限	從事新型電子元器件產銷	383,640	註1(3)	383,640	_			
公司	及提供技術諮詢服務	(美金 12,000千元)		(美金 12,000千元)				
日月光封裝測試(上海)有限公	半導體產品封裝及測試業	6,501,336	註1(4)	5,792,530	_			
司	務	(美金 203,580千元)		(美金 180,000千元)				
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試及技	1,568,467	註1(5)	711,180	_			
	術諮詢服務等業務	(美金 48,672千元)		(美金 21,600千元)				
3月光半導體(威海)有限公司	一般類之分離式元器件封	4,507,081	註1(6)	1,295,307	_			
	裝及測試業務	(美金 152,200千元)		(美金 40,000千元)				
上海鼎匯房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及	16,345,070		_	_			
	商品房銷售物業管理	(人民幣 3,600,000千元)		(註2)				
上海鼎威房地產開發有限公司		6,908,089		_	-			
	商品房銷售物業管理	(人民幣 1,548,000千元)		(註2)				
上海鼎裕房地產開發有限公司		4,936,538		_	_			
	商品房銷售物業管理	(人民幣 1,100,000千元)		(詳2)				
昆山鼎泓房地產開發有限公司		3,139,662		_	_			
	商品房銷售物業管理	(人民幣 670,000千元)		(註2)				
昆山鼎悦房地產開發有限公司	房地產項目開發、建設及	1,546,415		_	_			
	商品房銷售物業管理	(人民幣 330,000千元)	1	(註2)				

								單位:	新台幣干元(除另予註明者外)
	F年底自台灣 累積投資金額		投資公司 丰度(損)益	本公司直接或間接 投資之持股比例(%)	本年度認	四列投資(損)益	年底	投資帳面價值	截至本年年底 已匯回投資收益
\$	4,398,576	\$	201,665	100	\$	201,665	\$	10,375,148	無
(美金	137,800干元)	(美金	6,425千元)		(美金	6,425干元)	美金	316,075千元)	
			(註5)			(註5)			
	8,350,204		230,901)	100	(230,901)		6,403,859	無
(美金	268,000千元)	(美金	-7,194千元)		美金	-7,194千元)	美金	195,091千元)	
			(註4)			(註4)			
	383,640		19,139	100		19,139		616,357	無
(美金	12,000千元)	美金	605千元)		(美金	605干元)	美金	18,777千元)	
			(註5)			(註5)		,	
	5,792,530		417,581	100		417,581		10,892,636	無
(美金	180,000干元)	(美金	13,177千元)		(美金	13,177干元)	美金	331,840千元)	
			(註4)			(註4)			
									400
	711,180		479,965	60		287,979		2,257,860	無
(美金	21,600千元)	美金	15,144干元)		(美金	9,086千元)	美金	68,785千元)	
			(註5)			(註5)			
	1,295,307	(245,190)	100	(245,190)		1,724,663	無
(美金	40,000干元)	(美金	-7,645干元)		(美金	-7,645千元)	美金	52,541干元)	
			(註5)			(註5)			
	-	(145,116)	100	(145,116)		19,869,203	無
	(註2))	(人民幣	-28,561千元)		(人民幣	-28,561千元)	(人民幣	3,930,622千元)	
			(註5)			(註5)			
	_	,	28,429)	100		28,429)		7,749,787	無
	(訓2))	(人民幣	-5,599千元)	100	(人民幣		(人民幣	1,533,100千元)	ATT.
	(P±=//	() (2011)	(註5)		15 (120)13	(註5)	() (1011)	1,555,100 1 76,	
	-	(5,468)	100	(5,468)		5,568,751	無
	(註2))	(人民幣	-1,074千元)		(人民幣	-1,074千元)	(人民幣	1,101,637千元)	
			(註5)			(註5)			
	-	(1,432)	100	(1,432)		3,380,883	無
	(話2))	(人民幣	-282千元)		(人民幣	-282千元)	(人民幣	668,823千元)	
			(註5)			(註5)			
	_		487	100		487		1,666,793	無
	(註2))	(人民幣	96干元)		(人民幣		(人民幣	329,733干元)	
			(註5)			(註5)			

+味证仍然八司夕郊	十	=	此咨 木宛	投資方式	Z	本年年初自台灣	本年度匯出或	(收回投資金額
大陸被投資公司名稱	主要營業項目	員	收資本額	投資刀式	進	出累積投資金額	匯出	收回
日月光集成電路製造(中國)有限公司	從事半導體封裝測試、售 後服務、諮詢及廠房出 租	(美金	3,149,000 100,000干元)	註1(7)	(美金	3,149,000 100,000干元)	\$ -	\$ -
日月光投資(昆山)有限公司	從事投資控股業務	美金	3,717,318 122,000干元)	註1(8)	(美金	2,210,118 74,000干元)	1,507,200 (美金48,000干元) (註10	-
無錫通芝微電子有限公司	半導體產品封裝及測試業務	(人民幣	356,682 73,461干元)	註2		— (註2)	-	-
日月光貿易(上海)有限公司	從事貨物及技術進出口等 業務	(人民幣	2,566 500干元)	註2		— (註2)	-	-
上海鼎祺物業管理有限公司	物業管理、房地產經紀等業務	(人民幣	5,078 1,000干元)	註2		— (註2)	-	-
環勝電子(深圳)有限公司	生產經營電腦主機板、其 他相關電腦周邊設備及 通訊工業控制等產品之 設計、製造及銷售	美金	2,270,625 75,000千元)	註1(9)		1,180,746	-	-
環旭電子公司	提供電子產品設計製造服 務,生產及加工新型電 子元器件、計算機高性 能主機板、無線網路通 信元器件等	(人民幣	10,649,110 2,175,924千元)	註1(9)		1,668,233	-	-
環詮電子(昆山)有限公司	生產計算機輔助系統及高 性能主板、無線網路通 訊卡等	(美金	383,201 12,000干元)	註1(9)		383,201	-	-
雲電貿易(上海)有限公司	電子產品及通訊產品批發	美金	147,450 5,000千元)	註1(11)		147,450	-	-
砂翔微機電系統(上海)有限公 司	氣體流量暨感測器之製造 及批發零售	美金	227,063 7,500千元)	註3		3,035	-	_
環鴻電子(昆山)有限公司	提供電子產品設計及製造服務	(人民幣	1,202,223 250,000干元)	註2		— (註2)	_	_

	F底自台灣 積投資金額		投資公司 丰度(損)益	本公司直接或間接投資之持股比例(%)	本年度認	3列投資(損)益	年底投	改資帳面價值		本年年底 回投資收益
\$	3,149,000	\$	83,753	100	\$	83,753	\$	3,332,245		無
(美金	100,000千元)	(美金	2,616干元)		(美金	2,616干元)	(美金	101,515干元)		
			(註4)			(≣主4)				
	3,717,318	(106,242)	100	(106,242)		2,913,283		無
(美金	122,000千元)	(美金	-3,312千元)		(美金	-3,312千元)	(美金	88,752千元)		
			(註4)			(註4)				
	-		25,990	100		25,990		454,969		無
	(註2)	(人民幣	5,113千元)		(人民幣	5,113千元)	(人民幣	90,004千元)		
			(註4)			(註4)				
	_	(255)	100	(255)		2,279		無
	(註2)	(人民幣	-49千元)		(人民幣	-49千元)	(人民幣	451千元)		
			(註4)			(註4)				
	_	(3,438)	100	(3,438)		1,623		無
	(註2)	(人民幣	-679千元)		(人民幣	-679千元)	(人民幣	321千元)		
			(註5)			(註5)				
	1,180,746		2,523,541	76		1,965,027		6,299,091	\$	1,196,256
		(人民幣	496,516千元)		(美金	62,086千元)	(美金	191,899千元)	(美金	41,243千元)
			(註6)			(註音)				
	1,668,233		3,468,871	76		2,658,906		26,127,903		無
		(美金	109,602千元)		(美金	84,010千元)	美金	795,976千元)		
			(註6)			(註音)				
	383,201	(86,993)	99	(86,271)		346,005		無
		(美金	-2,749千元)		(美金	-2,726千元)	美金	10,541千元)		
			(註6)			(註6)				
	147,450			_		-		_		無
								(註11)		
	3,035		-	_		_		_		無
	_		645,853	76		507,448		1,749,854		無
	(註2)	(人民幣	127,074千元)		(人民幣	99,842千元)	(人民幣	346,164千元)		
			(註6)			(註6)				

+味地机次八司夕延	十	東	京西	机次七十	本年年	三初自台灣	本年度匯	出ョ	以收回报	資金額	
大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本	积	投資方式	匯出累	積投資金額	匯出			收回	_
環維電子(上海)有限公司	電子產品的研發及製造,	\$ 6,6	652,140	註2	\$	-	\$	-	\$		_
	新型電子元器件、計算	(人民幣 1,330,0	00千元)			(≣主2)					
	機高性能主機板、無線										
	網絡通信元器件、移動										
	通信產品及模塊、零配										
	件的加工及維修,電子										
	產品、通訊產品及零配										
	件的銷售,第三方物流										
	服務,從事貨物及技術										
	的進出口業務										
環豪電子(上海)有限公司	電子元器件、計算機軟硬	2	240,850	註2		_		-			-
	件、通訊設備及配件的	(人民幣 50,0	00千元)			(註2)					
	銷售,第三方物流服										
	務,從事貨物及技術的										
	進出口業務,轉口貿										
	易,區内企業間貿易及										
	貿易代理										
雲湧電子(上海)有限公司	從事電子元件、計算機主		-	註1(10)		-		-			-
	板、無線網絡通信元器	(人民幣	-千元)								
	件、通訊及移動通信產										
	品及模塊及相關零配件										
	之批發、佣金代理等										

本年年底自台灣匯出累積投資金額		投資公司 丰度(損)益	本公司直接或間接 投資之持股比例(%)	本年度記	認列投資(損)益	年底投資帳面價值		截至本年年底 已匯回投資收益
\$ -	(\$	2,106,690)	76	(\$	1,644,175)	\$	2,782,943	無
(註2)	(人民幣	-414,499干元)		(人民幣	-323,497千元)	(人民幣	550,535千元)	
		(註6)			(註6)			
_		8,447	76		6,592		201,364	無
(註2)	(人民幣	1,662千元)		(人民幣	1,297干元)	(人民幣	39,835干元)	
		(註6)			(註6)			
-		17	-		17		-	無
	(美金	1千元)		(美金	1千元)	(美金	-千元)	
		(註6)			(註6)		(註12)	

投資公司名稱	本年年底累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額
本公司	\$ 15,203,097
	(美金 471,400千元)
台灣福雷電子公司	8,878,838
	(美金 288,000千元)
環電公司	3,382,665

- 註1:係透過第三地區再投資大陸公司,第三地區之投資公司如下:
 - (1) ASE Mauritius Inc. $^{\circ}$ ASE Corporation $^{\circ}$ Omniquest Industrial Limited $^{\circ}$ Innosource Limited $^{\circ}$ J&R Holding Limited $^{\circ}$
 - (2) ASE Mauritius Inc. Alto Enterprises Limited Innosource Limited ASE Corporation Omniquest Industrial Limited ASE Holding Limited •
 - (3) Innosource Limited •
 - (4) Global Advanced Packaging Technology Ltd. > J&R Holding Limited o
 - (5) J&R Holding Limited •
 - (6) ASE (Korea) Inc. \ ASE Test Limited \ ASE Investment (Labuan) Inc. \ ASE Holding Ltd. \ J&R Holding Limited \ \circ \
 - (7) Super Zone Holdings Limited \circ
 - (8) Alto Enterprises Limited
 - (9) Real Tech Holdings Limited \ Huntington Holdings International Co. Ltd. \
 - (10) Rise Accord Limited \ Huntington Holdings International Co. Ltd. \
 - (11) Rise Capital Investment Limited > Huntington Holdings International Co. Ltd. o
- 註2:係由大陸地區現有公司再投資。
- 註3:係由本公司之子公司Unitech Holdings International Co. Ltd.公司投資備供出售金融資產Asia Global Venture Co, Ltd.以自有資產間接投資大陸公司Asia Golbal Venture Co., Ltd於 102年10月處分矽翔微機電系統(上海)有限公司之股權,故截至104年12月31日止,Unitech Holdings International Co. Ltd.公司已無間接投資大陸公司。
- 註4:依經台灣母公司簽證會計師查核或核閱之財務報表揭露。
- 註5: 依經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核或核閱之財務報表揭露。
- 註6:依經台灣母公司簽證會計師所屬事務所之其他會計師查核或核閱之財務報表揭露。
- 註7:依經濟部投審會規定,本公司赴大陸地區投資投資限額係依經濟部97年8月29日經審字第09704604680號令修正發布並自同年8月1日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點,取得經經濟部工業局核發符合營運總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司,是以對大陸地區投資金額無上限之規定。
- 註8:茲將台灣福雷電子公司赴大陸地區投資投資限額計算如下:\$29,908,297×60% = 17,944,978
- 註9:經濟部投審會核准投資金額與累計自台灣匯出投資金額之差額總計美金105,000干元:其中美金80,000干元,係由子公司ASE(Korea)Inc.直接匯出。另美金25,000干元亦由 ASE(Korea)Inc.值予日月光半導體(威海)有限公司之債權轉作為股本。
- 註10:係同一筆資金由台灣福雷電子公司透過第三地區間接增資日月光投資(昆山)有限公司再轉增資日月光半導體(昆山)有限公司之投資金額。
- 註11:雲電貿易(上海)有限公司於102年12月完成清算。
- 註12:雲湧電子(上海)有限公司於104年7月完成清算。

經濟部投審會核准投資金額		本公司赴大陸地區投資限額	
\$	16,790,306	\$ -	(註7)
(美金	576,400千元)		
	(註9)		
(美金	8,878,838 288,000千元)	17,944,978	(註8)
(美金	32,402,340 1,027,236千元)	_	(註7)

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

母子公司間業務關係及重要交易往來情形

民國104年1月1日至12月31日 附表十

號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係
)	本公司	台灣福雷電子公司	母公司對子公司
		環隆電氣公司	母公司對子公司
			母公司對子公司
			母公司對子公司
		日月光半導體(上海)有限公司	母公司對子公司
			母公司對子公司
		ASE (U.S.) Inc.	母公司對子公司
		日月光電子公司	母公司對子公司
			母公司對子公司
			母公司對子公司
		J & R Holding Limited	母公司對子公司
		Omniquest Industrial Limited	母公司對子公司
		Innosource Limited	母公司對子公司
		ASE Test Limited	母公司對子公司
		Global Advanced Packaging	母公司對子公司
		Technology Limited, Cayman	
		Islands	
		日月瑞公司	母公司對子公司
		ASE (Korea)Inc.	母公司對子公司
		Huntington Holdings International Co., Ltd.	母公司對子公司
		USI Enterprise Limited	母公司對子公司
		Real Tech Holdings Limited	母公司對子公司
		ASE Corporation	母公司對子公司
		A.S.E. Holding Limited	母公司對子公司
		ASE Japan Co., Ltd	母公司對子公司
		ISE Labs, Inc.	母公司對子公司
ı	日月光半導體(上海)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	子公司對子公司
		日月光半導體(香港)有限公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
2	上海鼎匯房地產開發有限公司	昆山鼎泓房地產開發有限公司	子公司對子公司
3	A.S.E. Holding Limited	ASE Test Limited	子公司對子公司
			子公司對子公司
		ASE Singapore Pte. Ltd.	子公司對子公司
1	Omniquest Industrial Limited	ASE Test Limited	子公司對子公司
5	J & R Holding Limited	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	子公司對子公司
		Innosource Limited	子公司對子公司
		Anstock Limited	子公司對子公司
		Real Tech Holdings Limited	子公司對子公司

單位:新台幣干元(除另予註明者外)

		交易往來情形(註)		
科目	金額(註)	金額(註) 交易條件		
其他應付款	\$ 7,320,608		2	
應收帳款	2,220,182		1	
營業收入	9,083,160	與一般廠商相當	3	
營業外支出	604,226	與一般廠商相當	_	
應付帳款	433,581		_	
營業成本	1,713,266	與一般廠商相當	1	
營業費用	834,398	按所發生費用之約定比例計算,訂有費用上限	_	
應付帳款	475,673		_	
其他應付款	224,763		-	
營業成本	1,990,597	與一般廠商相當	1	
其他應付款	9,256,650		3	
其他應付款	1,641,250		_	
其他應付款	722,150		_	
其他應付款	4,037,475		1	
其他應付款	1,936,675		1	
其他應付款	100,000			
其他應付款	190,000		_	
	2,627,294		1	
其他應付款	1,805,375		_	
其他應付款	2,626,000		1	
其他應付款	3,939,000		1	
其他應付款	900,000		_	
其他應付款	2,757,300		1	
營業收入	116,993	 與一般廠商相當	<u>.</u>	
營業收入	121,374		_	
	121,374	Z ZZ Z		
營業收入	399 553	 與一般廠商相當	_	
應收帳款	306,358	JANGAT HE	_	
營業收入		與一般廠商相當	_	
	1,033,030	Z ZZ Z		
其他應收款	570,852		_	
- CILINA CAN	370,032			
其他負債	431,754		_	
其他應付款	1,231,786		_	
其他應付款	394,118		_	
子に同じる	334,110			
其他負債	1,644,277		_	
大心只順	1,044,277			
其他應收款	2 471 106		1	
共心版权利	2,471,186			
其他資產	723,447		_	
其他資產	801,897		_	
其他應收款	2,134,808		1	

 編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係
11HH 31/T	文物八石梅		
		ISE Labs, Inc.	子公司對子公司
		Anstock II Limited	子公司對子公司
		ASE Japan Co., Ltd.	子公司對子公司
		ASE Japan Co., Ltd. 日月光封裝測試(上海)有限公司	子公司對子公司
		日月光半導體(威海)有限公司	子公司對子公司
		USI Enterprise Limited	子公司對子公司
		OSI Emerprise Emilieu	2 ∆ □ ±13 ∆ □
6	Anstock II Limited	J & R Holding Limited	子公司對子公司
7	日月光電子公司	日月瑞公司	子公司對子公司
		ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	子公司對子公司
		Universal Global Technology Co.,	子公司對子公司
		Limited	子公司對子公司
8	台灣福雷電子公司	ASE (Korea) Inc.	子公司對子公司
		ASE Corporation	子公司對子公司
		ASE (U.S.) Inc.	子公司對子公司
9	日月光封裝測試(上海)有限公	日月光電子公司	子公司對子公司
	司	Anstock Limited	子公司對子公司
		1994D-7-7-0-7-	子公司對子公司
		環旭電子公司	子公司對子公司
10	ASE (U.S.) Inc.	ASE (Korea) Inc.	子公司對子公司
11	日月光半導體(威海)有限公司	ASE (Korea) Inc.	子公司對子公司
		日月光半導體(上海)有限公司	子公司對子公司
12	環隆電氣公司	環鴻科技公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
13	環電公司	USI Enterprise Limited	子公司對子公司
14	環旭電子公司	Universal Global Technology Co.,	子公司對子公司
		Limited	子公司對子公司
		環旭科技有限公司	子公司對子公司
		環勝電子(深圳)有限公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
		環維電子(上海)有限公司	子公司對子公司
15	環旭科技有限公司	環勝電子(深圳)有限公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
			子公司對子公司
			子公司對子公司
		環鴻科技公司	子公司對子公司
			子公司對子公司
		環鴻電子(昆山)有限公司	子公司對子公司
	•	•	

交易往來情形(註)							
科目	金額(註)	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率(%)				
其他應付款	\$ 984,941		_				
其他負債	525,371		_				
其他負債	9,749,025		3				
其他應付款	2,264,163		1				
其他資產	560,401		_				
其他應收款	1,380,065		_				
其他應付款	6,402,296		2				
利息收入	233,511		_				
其他應付款	190,000		_				
營業收入	380,496		_				
應收帳款	115,072		_				
營業收入	303,483	與一般廠商相當	_				
出售固定資產	104,913		_				
其他應收款	900,000		_				
營業費用	109,470	按所發生費用之約定比例計算,訂有費用上限	_				
營業成本	212,770		_				
其他應付款	3,293,743		1				
利息費用	147,441		_				
薪資費用	161,083		_				
營業收入	134,504	按所發生費用之約定比例計算,訂有費用上限	_				
其他應付款	1,643,994		_				
其他應付款	164,556		_				
營業成本	1,496,637		1				
應付帳款	329,214		_				
其他應付款	2,232,100		1				
營業成本	9,253,024		3				
應付帳款	4,564,733		1				
營業收入	181,875		_				
營業收入	177,762		_				
其他應收款	1,459,713		_				
其他應收款	1,987,520		_				
營業收入	3,419,070		1				
營業成本	13,193,279		5				
應收帳款	719,766		-				
應付帳款	3,285,468		1				
營業収入	17,214,934		6				
應收帳款	3,991,508		1				
營業收入	373,280		_				

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係
			子公司對子公司
			子公司對子公司
16	Universal Global Technology	環鴻電子(昆山)有限公司	子公司對子公司
	Co., Limited		子公司對子公司
		環勝電子(深圳)有限公司	子公司對子公司
17	環鴻科技公司	環旭電子公司	子公司對子公司
		環旭科技有限公司	子公司對子公司
		環勝電子(深圳)有限公司	子公司對子公司
18	環勝電子(深圳)有限公司	環維電子(上海)有限公司	子公司對子公司

註:已於編製合併報告時沖銷。

交易往來情形(註)								
科目	金額(註)	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率(%)					
營業成本	\$ 7,610,976		3					
應付帳款	1,036,495		_					
營業收入	4,330,764		2					
應收帳款	351,903		_					
應收股利	1,415,390		_					
營業收入	220,300		_					
營業收入	273,913		_					
營業收入	149,600		_					
其他應收款	1,319,361		_					

本公司自民國102年起依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則(以下簡稱Taiwan IFRS)編製合併財務報告並向臺灣證期局申報。另本公司自民國102年起依國際會計準則理事會發布之國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)編製英文年報 (20-F)並向美國證管會申報。

本公司適用Taiwan IFRS及IFRS編製之財務報告,其差異項目係未分配盈餘加徵10%營利事業所得稅會計處理。 詳細調節内容請參考本公司向美國證管會申報之2015英文年報(20-F)

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122411/000095010316012959/0000950103-16-012959-index.htm

單位:新台幣仟元

差異調節項目	Taiwan IFRS	IFRS
(1)歸屬於本公司業主之合併淨利	19,478,873	20,013,505
(2)歸屬於非控制權益之合併淨利	970,134	968,567
(3)歸屬於本公司業主之綜合損益總額	19,405,806	19,940,438
(4)歸屬於非控制權益之綜合損益總額	895,654	894,087
(5)基本每股盈餘(元)	2.55	2.62
(6)稀釋每股盈餘(元)	2.44	2.51
(7)資產總額	365,287,557	365,268,249
(8)負債總額	196,867,675	199,061,912
(9)非控制權益	11,503,878	11,492,545
(10)歸屬於本公司業主之權益	156,916,004	154,713,792

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告:

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒:

日月光半導體製造股份有限公司民國104年12月31日暨103年12月31日及1月1日之個體資產負債表,暨民國104及103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。列入上開個體財務報告中,有關採用權益法之被投資公司矽品精密工業公司(矽品)之財務報告係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中,有關矽品財務報告所列金額及揭露資訊,係依據其他會計師之查核報告。民國104年12月31日對矽品採用權益法之投資餘額為新台幣35,423,058千元,占資產總額之12%,民國104年度對矽品採用權益法認列之關聯企業損益份額為新台幣410,937千元,占該年度稅前淨利之2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達日月光半導體製造股份有限公司民國104年12月31日暨103年12月31日及1月1日之個體財務狀況,暨民國104及103年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

如個體財務報告附註三所述,日月光半導體製造股份有限公司自民國104年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之2013年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告,因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期個體財務報告受影響之項目。

日月光半導體製造股份有限公司民國104年度個體財務報告重要會計項目明細表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見,該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 陳珍麗





行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1010028123號

會計師 江佳玲





財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

日月光半導體製造股份有限公司

個體資產負債表

民國104年12月31日暨103年12月31日及1月1日

		104年12月3	1日	104年12月31日(記	周整後)	103年1月1日(調	整後)
代碼	資產	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產	-					
1100	現金(附註四及六)	\$ 8,533,346	3	\$ 11,254,517	4	\$ 14,959,268	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動						
	(附註四、五及七)	1,503,196	1	1,990,183	1	302,273	_
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及八)	_	_	400,007	_	2,312,147	1
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	14,030,441	5	16,473,504	6	12,061,441	6
1180	應收帳款-關係人(附註二七)	2,281,805	1	5,082,423	2	2,418,651	1
1200	其他應收款(附註四)	1,367,621	_	1,414,007	1	962,907	_
1210	其他應收款-關係人(附註二七)	161,080	_	36,699	_	46,202	_
1310	存貨(附註四、五及十)	3,769,108	1	4,323,668	2	3,642,616	2
1479	其他流動資產	485,422	_	508,010	_	303,545	_
11XX	流動資產合計	32,132,019	11	41,483,018	16	37,009,050	17
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)	473,107	-	542,147	_	592,557	-
1550	採用權益法之投資(附註三、四及十一)	189,994,170	62	139,053,527	53	117,942,583	53
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二、十九、						
	二三、二七及二九)	80,375,695	26	77,640,995	30	63,122,172	29
1805	商譽(附註四及五)	958,620	1	958,620	_	958,620	_
1821	其他無形資產(附註四、五、十三及十九)	655,689	_	486,192	_	393,759	_
1840	遞延所得稅資產(附註三、四及二十)	906,821	_	1,019,802	1	1,020,588	1
1980	其他金融資產-非流動(附註四)	209,817	_	215,784	_	214,803	_
1985	長期預付租金	80,887	_	195,879	_	19,141	_
1990	其他非流動資產	156,113	_	131,181	_	72,761	
15XX	非流動資產合計	273,810,919	89	220,244,127	84	184,336,984	83

單位:新台幣干元

	負債及股東權益		104年12月31日		104年12月31日(調整後)			單位: 新台幣十元 103年1月1日(調整後)		
代碼			金額		金額		%	金額	%	
1 VANS	流動負債		<u> </u>					_	<u> </u>	
2100	短期借款(附註十四)	\$	11,231,973	4	\$	11,636,241	4	\$	11,721,924	5
2110	應付短期票券(附註十四)	•	4,348,054	1	Ť	_	_	•	-	_
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		.,,							
	(附註四、五及七)		2,669,605	1		2,540,418	1		1,793,652	1
2170	應付帳款		6,801,383	2		6,965,763	3		6,239,588	3
2180	應付帳款-關係人(附註二七)		910,211	1		1,223,750	_		1,074,901	1
2200	其他應付款(附註十六及十七)		10,565,591	3		12,352,075	5		7,941,207	4
2220	其他應付款項-關係人(附註二七)		40,191,954	13		30,653,624	12		18,107,805	8
2230	本期所得稅負債(附註四及二十)		1,685,349	1		1,617,605	1		803,419	_
2321	一年内到期之應付公司債(附註四及十五)		12,162,192	4		_	_		_	_
2322	一年内到期之長期借款(附註十四)		_	_		1,085,143	_		1,028,571	_
2399	其他流動負債		738,805	_		493,126	_		448,069	_
21XX	流動負債合計		91,305,117	30		68,567,745	26		49,159,136	22
	非流動負債									
2530	應付公司債(附註四及十五)		13,938,894	5		19,270,613	8		18,152,195	8
2540	長期借款(附註十四)		37,424,607	12		18,355,554	7		25,787,145	12
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)		3,774,152	1		2,897,155	1		1,892,418	1
2610	長期應付款(附註十六)		_	_		_	_		894,150	_
2640	淨確定福利負債(附註三、四、五及十七)		2,287,072	1		2,415,654	1		2,496,350	1
2670	其他非流動負債		297,092	_		1,517	_		19,783	_
25XX	非流動負債合計		57,721,817	19		42,940,493	17		49,242,041	22
2XXX	負債總計		149,026,934	49		111,508,238	43		98,401,177	44
	權益(附註三、四及十八)									
	股本									
3110	普通股股本		79,029,290	26		78,525,378	30		77,560,040	35
3140	預收股本		156,370	_		189,801	_		620,218	_
3100	股本合計		79,185,660	26		78,715,179	30		78,180,258	35
3200	資本公積		23,757,099	8		16,013,058	6		7,920,220	4
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		12,649,145	4		10,289,878	4		8,720,971	4
3320	特別盈餘公積		3,353,938	_		3,353,938	1		3,663,930	2
3350	未分配盈餘		40,180,986	13		38,737,422	15		26,521,201	12
3300	保留盈餘合計		56,184,069	17		52,381,238	20		38,906,102	18
3400	其他權益		5,081,689	2		5,068,539	2	(102,616)	
3500	庫藏股票	(7,292,513)	(2)	(1,959,107)	(1)	(1,959,107)	(1)
3XXX	權益總計		156,916,004	51		150,218,907	57		122,944,857	56

負債及權益總計

 \$ 305,942,938
 100
 \$ 261,727,145
 100
 \$ 221,346,034

董事長:張虔生





會計主管:郭宏銘



日月光半導體製造股份有限公司 個體綜合損益表

民國104及103年1月1日至12月31日

單位:新台幣干元,惟每股盈餘為新台幣元

		104年度				103年度(調整後)		
代碼			金額	%		金額	%	
4000	營業收入(附註四)	\$	94,206,807	100	\$	96,678,100	100	
5000	營業成本(附註三、十、十七及十九)		69,059,001	73		67,301,431	70	
5900	營業毛利		25,147,806	27		29,376,669	30	
	營業費用(附註三、十七及十九)							
6100	推銷費用		1,100,826	1		1,110,054	1	
6200	管理費用		4,788,073	5		4,517,187	5	
6300	研究發展費用		5,366,121	6		5,470,440	5	
6000	營業費用合計		11,255,020	12		11,097,681	11	
6900	營業淨利		13,892,786	15		18,278,988	19	
	營業外收入及支出							
7010	其他收入(附註十九)		451,354	_		114,369	_	
7020	其他利益(附註十九)		722,437	1		8,043	_	
7050	財務成本(附註十九)	(1,166,632)	(1)	(1,001,974)	(1)	
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額(附註三及四)		8,533,407	9		8,761,700	9	
7000	營業外收入及支出合計		8,540,566	9		7,882,138	8	
7900	税前淨利		22,433,352	24		26,161,126	27	
7950	所得税費用(附註三、四、五及二十)		2,954,479	3		2,524,604	2	
8200	本年度淨利		19,478,873	21		23,636,522	25	
	其他綜合損益							
8310	不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫精算之再衡量數(附註十七)		39,710		(27,602)	_	
8320	採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(119,176)	_		17,528	_	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(6,751)			4,693	_	
8310		(86,217)		(5,381)		
8360	後續可能重分類至損益之項目							
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(36,166)	_		2,376	_	
8370	採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		49,316	-		5,168,779	5	
8360		-	13,150			5,171,155	5	
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(73,067)			5,165,774	5	
8500	本年度綜合損益總額	\$	19,405,806	21	\$	28,802,296	30	

代碼				
	每股盈餘(附註二一)			
9750	基本每股盈餘			
9850	稀釋每股盈餘			
後附之附註係本個體財務報告之一部分。				

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國105年3月16日查核報告)

	104年度		103年度(調整後)			
金額 %				金額	%	
\$	2.55		\$	3.07		
\$	2.44		\$	2.96		

董事長:張虔生



會計主管:郭宏銘



個體權益變動表

民國104及103年1月1日至12月31日

		股本					保留盈餘			
代碼		股數(千股)		金額		資本公積	法	定盈餘公積	特別	引盈餘公積
A1	103年1月1日餘額	7,787,827	\$	78,180,258	\$	7,908,870	\$	8,720,971	\$	3,663,930
А3	追溯適用及追溯調整之影響數	_		_		11,350		_		_
A5	103年1月1日調整後餘額	7,787,827		78,180,258		7,920,220		8,720,971		3,663,930
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	_		_		26,884		_		_
D1	103年度淨利(調整後)									_
D3	103年度稅後其他綜合損益(調整後)	_		_		_		_		_
D5	103年度綜合損益總額(調整後)	_		_		_		_		_
	102年度盈餘分配									
B1	提列法定盈餘公積	_		_		_		1,568,907		_
B5	普通股現金股利	_		_		_		_		_
B17	特別盈餘公積迴轉	_		_		_		_	(309,992)
								1,568,907	(309,992)
M1	發放予子公司股利調整資本公積	=				188,790		_		_
M7	對子公司所有權權益變動					6,877,099				_
N1	股份基礎給付交易	73,898		534,921		1,000,065				
Z1	103年12月31日餘額(調整後)	7,861,725		78,715,179		16,013,058		10,289,878		3,353,938
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分									
05	(附註十八)	-		_		214,022		_		_
C7	採用權益法認列子公司及關聯企業之資本公積 變動數	_		_		150		_		_
D1	104年度淨利		-							
D3	104年度稅後其他綜合損益	_		_		_		_		_
D5	104年度綜合損益總額				_					
	103年度盈餘分配									
В1	提列法定盈餘公積	_		_		_		2,359,267		
B5	普通股現金股利	-		_		_				_
								2,359,267		
L1	庫藏股買回									
M1	發放予子公司股利調整資本公積					292,351				
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 (附註十一)									
M7	•					7,197,510				
N1	對子公司所有權權益變動 	40.702		470 404		564,344)				
Z1	股份基礎給付交易	48,703	Φ.	470,481		604,352	Φ.	12.640.445	Φ.	2 252 022
<u>_</u> 1	104年12月31日餘額	7,910,428	\$	79,185,660	\$	23,757,099	\$	12,649,145	\$	3,353,938

後附之附註係本個體財務報告之一部分。 (參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國105年3月16日查核報告)

單位:新台幣干元

其他權益項目

				國	外營運機構										
	保留	盈餘		財	務報表換算	備供	出售金融資								
-	未分配盈餘		 合計	Ż	2兌換差額	產	卡實現損益	現金	金流量避險		合計		庫藏股票		權益總額
\$	26,608,253	\$	38,993,154	(\$	525,521)	\$	426,246	(\$	3,279)	(\$	102,554)	(\$	1,959,107)	\$	123,020,621
(87,052)	(87,052)	(62)					(62)			(75,764)
	26,521,201		38,906,102	(525,583)		426,246	(3,279)	(102,616)	(1,959,107)		122,944,857
	-		-		-		-		-		_		_		26,884
	23,636,522		23,636,522		-				-		_		_		23,636,522
(5,381)	(5,381)		5,067,344		100,532		3,279		5,171,155				5,165,774
	23,631,141		23,631,141		5,067,344		100,532		3,279		5,171,155				28,802,296
(1,568,907)		_		_		_		_		_		_		_
(10,156,005)	(10,156,005)		_		_		_		_		_	(10,156,005)
	309,992	_													
(11,414,920)	(10,156,005)											(10,156,005)
															188,790
															6,877,099
															1,534,986
	38,737,422		52,381,238		4,541,761		526,778				5,068,539	(1,959,107)		150,218,907
		_												_	214,022
	_		_		-		_		_		_		_		150
	19,478,873		19, 478,873												19,478,873
(86,217)	(86,217)	(48,191)		61,341		_		13,150		_	(73,067)
	19,392,656		19,392,656	(48,191)		61,341				13,150				19,405,806
(2,359,267)		_		_		_		_		_		_		_
(15,589,825)	(15,589,825)		-		_		_		-		_	(15,589,825)
(17,949,092)	(15,589,825)		_		_		_		_		_	(15,589,825)
	_		_		_		_		_		_	(5,333,406)	(5,333,406)
	_		_				_		_		_		_		292,351
_		_													7,197,510
_		_													564,344)
															1,074,833
\$	40,180,986	\$	56,184,069	\$	4,493,570	\$	588,119	\$		\$	5,081,689	(\$	7,292,513)	\$	156,916,004

董事長:張虔生



經理人:張洪本



金計士管:郭宏銘



日月光半導體製造股份有限公司

個體現金流量表

民國104及103年1月1日至12月31日

單位:新台幣干元

代碼	05年1月1日至12月31日	104年度		103年度(調整	2位:新古幣十九
1 4 4 4 9	營業活動之現金流量	101-12		103-722(1191	= ix/
A10000	本年度稅前淨利	\$	22,433,352	\$	26,161,126
A20000	調整項目	Ť	22, .33,332	•	20,101,120
A20010	不影響現金流量之收益費損項目				
A20100	折舊費用		14,630,862		12,667,954
A20200	攤銷費用		139,065		109,809
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(2,089,130)	(1,735,649)
A20900	財務成本		1,136,748		992,542
A21900	股份基礎給付酬勞成本		89,768		82,408
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	(8,533,407)	(8,761,700)
A23700	非金融資產減損損失		374,201		335,797
A29900	其他項目		1,014,001		1,414,695
A30000	營業資產及負債之淨變動				
A31110	持有供交易之金融資產		3,407,552		889,176
A31150	應收帳款		2,443,202	(4,412,063)
A31160	應收帳款-關係人		2,800,618	(2,663,772)
A31180	其他應收款		14,924	(419,790)
A31190	其他應收款-關係人	(27,049)	(2,856)
A31200	存 貨		279,328	(851,607)
A31240	其他流動資產	(47,362)	(230,071)
A32110	持有供交易之金融負債	(1,047,740)	(258,775)
A32150	應付帳款	(164,380)		726,175
A32160	應付帳款-關係人	(313,539)		148,849
A32180	其他應付款	(1,239,689)		1,865,052
A32190	其他應付款-關係人		9,176		312,412
A32230	其他流動負債		44,553		52,772
A32240	淨確定福利負債	(88,872)	(108,298)
A33000	營運產生之現金流入		35,266,182		26,314,186
A33200	收取之股利		456,044		87,030
A33300	支付之利息	(709,474)	(644,433)
A33500	支付之所得税	(1,903,810)		706,640)
AAAA	營業活動之淨現金流入		33,108,942		25,050,143
	投資活動之現金流量				
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,059,285)	(25,266,850)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產		22,404,777		25,430,954
B00300	取得備供出售金融資產	(1,322)	(1,941,283)
B00400	處分備供出售金融資產價款		433,165		3,809,325
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(35,673,097)	(100,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(18,106,610)	(25,859,051)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		114,976		187,058
B04500	取得無形資產	(308,562)	(202,242)
B09900	其他投資活動		18,842)		282,825)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(53,214,800)	(24,224,914)

代碼		104年度	103年度(調整後)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(\$ 404,268)	(\$ 85,683)
C00500	應付短期票券增加	4,347,406	_
C01200	發行公司債	6,136,425	_
C01600	舉借長期借款	36,638,397	28,718,192
C01700	償還長期借款	(19,237,092)	(36,739,806)
C03700	其他應付款-關係人增加	9,431,152	12,273,225
C04500	發放現金股利	(15,589,825)	(10,156,005)
C04900	購買庫藏股票	(5,333,406)	_
C04600	現金增資	_	_
C04800	員工執行認股權	1,003,789	1,458,088
C09900	其他籌資活動	392,109	2,009
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	17,384,687	(4,529,980)
EEEE	本年度現金淨減少	(2,721,171)	(3,704,751)
E00100	年初現金餘額	11,254,517	14,959,268
E00200	年底現金餘額	\$ 8,533,346	\$ 11,254,517

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國105年3月16日查核報告)







日月光半導體製造股份有限公司

個體財務報告附註

民國104及103年1月1日至12月31日

(除另註明外, 金額以新台幣干元為單位)

一、公司沿革

日月光半導體製造股份有限公司(以下稱本公司或日月光)於73年3月設立於高雄楠梓加工出口區;93年8月吸收合併子公司日月欣半導體公司及日月宏科技公司並設立中壢分公司,95年8月將材料事業部分割讓與日月光電子公司(日月光電子);100年1月經核准設立南投分公司;101年5月吸收合併子公司日月鴻科技公司;102年8月吸收合併子公司洋鼎科技公司。本公司所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司股票於78年7月在台灣證券交易所掛牌上市買賣,股票代碼為2311;另於89年9月發行美國存託憑證(ADR)在紐約證券交易所掛牌上市,代號為ASX。

本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告於105年3月16日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可之2013 年版國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)

依據金管會發布之金管證審字第1030029342號及金管證審字第1030010325號函,本公司自104年起開始適用業經國際會計準則理事會(IASB)發布且經金管會認可之2013年版IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下稱「IFRSs」)及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定。

除下列說明外,適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及2013年版IFRSs不致造成本公司會計政策之重大變動:

1. IFRS 12「對其他個體之權益之揭露」

IFRS 12針對子公司、聯合協議、關聯企業及未納入合併財務報告之結構型個體之權益規定應揭露内容。本公司適用 IFRS 12之揭露,請參閱附註十一。

2. IFRS 13「公允價值衡量」

IFRS 13提供公允價值衡量指引,該準則定義公允價值、建立衡量公允價值之架構,並規定公允價值衡量之揭露。此外,該準則規定之揭露內容較為廣泛,例如,適用IFRS 13前,準則僅要求以公允價值衡量之金融工具須按公允價值三層級揭露,而依照IFRS 13規定,適用該準則之所有資產及負債皆須提供前述揭露。

IFRS 13之衡量規定係自104年起推延適用。相關揭露請參閱附註二六。

3. IAS 1之修正「其他綜合損益項目之表達」

依修正之準則規定,其他綜合損益項目須按性質分類且分組為(1)不重分類至損益之項目及(2)後續可能重分類至損益之項目。相關所得稅亦按相同基礎分組。適用該修正規定前,並無上述分組之強制規定。

本公司於104年追溯適用上述修正規定,不重分類至損益之項目包含確定福利計畫之再衡量數及採權益法認列之子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫之再衡量數份額。後續可能重分類至損益之項目包含備供出售金融資產未實現損益暨採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額(除確定福利計畫之再衡量數外)。惟適用上述修正並不影響本年度淨利、本年度其他綜合損益(稅後淨額)及本年度綜合損益總額。

4. IAS 19「員工福利」

該修訂準則規定確定福利義務變動及計畫資產公允價值變動係於發生時認列,因而排除過去得按「緩衝區法」處理之選擇,並加速前期服務成本之認列。該修訂規定所有確定福利計畫之再衡量數立即認列於其他綜合損益,俾使已認列

之淨退休金資產或負債反映計畫短絀或剩餘之整體價值。

此外,「淨利息」取代適用修訂準則前之利息成本及計畫資產之預期報酬,並以淨確定福利負債(資產)乘以折現率決定 淨利息。修訂後IAS 19除了改變確定福利成本之表達,並規定更廣泛之揭露。

首次適用修訂後IAS 19時,因追溯適用產生102年12月31日(含)以前之累積員工福利成本變動數係調整103年1月1日遞 延所得稅資產、採用權益法之投資、淨確定福利負債、保留盈餘、資本公積及其他權益,惟不調整該日存貨之帳面金 額。此外,本公司選擇不予揭露103年度確定福利義務敏感度分析。

採用修訂之準則對本年度尚無重大影響,103年度影響彙總如下:

		調整前金額	首次	適用之調整		調整後金額
資產、負債及權益之影響						
103年12月31日						
遞延所得稅資產	\$	1,020,403	(\$	601)	\$	1,019,802
採用權益法之投資		139,054,506	(979)		139,053,527
淨確定福利負債		2,419,189	(3,535)		2,415,654
保留盈餘		52,397,278	(16,040)		52,381,238
資本公積		15,995,671		17,387		16,013,058
其他權益		5,067,931		608		5,068,539
103年1月1日						
遞延所得稅資產		1,019,230		1,358		1,020,588
採用權益法之投資		118,011,718	(69,135)		117,942,583
淨確定福利負債		2,488,363		7,987		2,496,350
保留盈餘		38,993,154	(87,052)		38,906,102
資本公積		7,908,870		11,350		7,920,220
其他權益	(102,554)	(62)	(102,616)
103年度綜合損益之影響						
營業成本		67,316,934	(15,503)		67,301,431
營業費用		11,105,108	(7,427)		11,097,681
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額		8,736,876		24,824		8,761,700
所得稅費用		2,520,705		3,899		2,524,604
本年度淨利		23,592,667		43,855		23,636,522
不重分類至損益之項目						
確定福利計畫之再衡量數	(16,194)	(11,408)	(27,602)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(19,097)		36,625		17,528
與不重分類之項目相關之所得稅		2,753		1,940		4,693
本年度其他綜合損益(稅後淨額)影響		5,137,947		27,827		5,165,774
本年度綜合損益總額影響		28,730,614		71,682		28,802,296

5. 「2009~2011週期之年度改善」

2009~2011週期之年度改善修正IFRS 1「首次採用IFRSs」、IAS 1「財務報表之表達」、IAS 16「不動產、廠房及設 備」、IAS 32「金融工具:表達」及IAS 34「期中財務報導」等準則。

IAS 1之修正係闡明,於追溯適用會計政策、追溯重編財務報表之項目,或重分類其財務報表之項目,且前述事項對前 一年年初之資產負債表資訊具重大影響時,本公司應列報前一年年初之資產負債表,但無須提供前一年年初之附註資 訊。

由於首次適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及2013年版IFRSs對103年1月1日個體資產負債表資訊具重大影 響,本公司已依上述IAS 1之修正列報103年1月1日個體資產負債表,並按IAS 8「會計政策、會計估計變動及錯誤」規 定揭露,惟無需額外揭露103年1月1日各單行項目之附註資訊。

(二) IASB已發布但尚未經金管會認可之IFRSs

本公司未適用下列業經IASB發布但未經金管會認可之IFRSs。金管會於105年3月10日公布自106年起開始適用之認可IFRSs 公報範圍,為IASB於105年1月1日前發布,並於106年1月1日生效之IFRSs(不含IFRS 9 「金融工具」及IFRS 15「客戶合約之收入」等尚未生效或尚未確定生效日期之IFRSs)。此外,金管會並宣布我國公開發行公司應自107年起開始適用IFRS 15。截至本個體財務報告通過發布日止,金管會尚未發布前述新發布/修正/修訂準則及解釋以外之其他準則生效日。

新發布/修正/修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)
「2010~2012週期之年度改善」	2014年7月1日或交易於2014年7月1日及以後
「2011~2013週期之年度改善」	2014年7月1日
「2012~2014週期之年度改善」	2016年1月1日(註2)
IFRS 9「金融工具」	2018年1月1日
IFRS 9及IFRS 7之修正「強制生效日及過渡揭露」	2018年1月1日
IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 12及IAS 28之修正「投資個體:合併報表例外規定之適用」	2016年1月1日
IFRS 11之修正「聯合營運權益之取得」	2016年1月1日
IFRS 14「管制遞延帳戶」	2016年1月1日
IFRS 15「客戶合約之收入」	2018年1月1日
IFRS 16「租賃」	2019年1月1日
IAS 1之修正「揭露倡議」	2016年1月1日
IAS 7之修正「揭露倡議」	2017年1月1日
IAS 12之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」	2017年1月1日
IAS 16及IAS 38之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	2016年1月1日
IAS 16及IAS 41之修正「農業:生產性植物」	2016年1月1日
IAS 19之修正「確定福利計畫:員工提撥金」	2014年7月1日
IAS 27之修正「單獨財務報表中之權益法」	2016年1月1日
IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	2014年1月1日
IAS 39之修正「衍生工具之合約更替及避險會計之繼續」	2014年1月1日
IFRIC 21「公課」	2014年1月1日

註1:除另註明外,上述新發布/修正/修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

除下列說明外,適用上述新發布/修正/修訂準則或解釋將不致造成本公司會計政策之重大變動:

1. IFRS 9「金融工具」

金融資產之認列及衡量

就金融資產方面,所有原屬於IAS 39「金融工具:認列與衡量」範圍内之金融資產後續衡量係以攤銷後成本衡量或以公允價值衡量。IFRS 9對金融資產之分類規定如下。

本公司投資之債務工具,若其合約現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息,分類及衡量如下:

- (1) 以收取合約現金流量為目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以攤銷後成本衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益認列於損益。
- (2) 藉由收取合約現金流量與出售金融資產而達成目的之經營模式而持有該金融資產,則該金融資產係以透過其他綜合 損益按公允價值衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益,並持續評估減損,減損損益與兌換損 益亦認列於損益,其他公允價值變動則認列於其他綜合損益。於該金融資產除列或重分類時,原先累積於其他綜合 損益之公允價值變動應重分類至損益。

本公司投資非屬前述條件之金融資產,係以公允價值衡量,公允價值變動認列於損益。惟本公司得選擇於原始認列時,將非持有供交易之權益投資指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產除股利收益認列於損益外,其他相關利益及損失係認列於其他綜合損益,後續無須評估減損,累積於其他綜合損益之公允價值變動亦不重分類至損益。

註2:除IFRS 5之修正推延適用於2016年1月1日以後開始之年度期間外,其餘修正係追溯適用於2016年1月1日以後開始之年度期間。

金融資產之減損

IFRS 9改採用「預期信用損失模式」認列金融資產之減損。以攤銷後成本衡量之金融資產、強制透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、應收租賃款、IFRS 15「客戶合約之收入」產生之合約資產或放款承諾及財務保證合約,係認列備抵信用損失。若前述金融資產之信用風險自原始認列後並未顯著增加,則其備抵信用損失係按未來12個月之預期信用損失衡量。若前述金融資產之信用風險自原始認列後已顯著增加且非低信用風險,則其備抵信用損失係按剩餘存續期間之預期信用損失衡量。但未包括重大財務組成部分之應收帳款必須按存續期間之預期信用損失衡量備抵信用損失失。

此外,原始認列時已有信用減損之金融資產,本公司考量原始認列時之預期信用損失以計算信用調整後之有效利率, 後續備抵信用損失則按後續預期信用損失累積變動數衡量。

一般避險會計

IFRS 9在一般避險會計之主要改變,係調整避險會計之適用條件,以使適用避險會計之財務報表更能反映企業實際進行的風險管理活動。與IAS 39相較,其主要修正內容包括:(1)增加可適用避險會計之交易型態,例如放寬非財務風險適用避險會計之條件;(2)修改避險衍生工具之損益認列方式,以減緩損益波動程度;及(3)避險有效性方面,以避險工具與被避險項目間的經濟關係取代實際有效性測試。

2. IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」

IASB於發布IFRS 13「公允價值衡量」時,同時修正IAS 36「資產減損」之揭露規定,導致本公司須於每一報導期間增加揭露資產或現金產生單位之可回收金額。本次IAS 36之修正係釐清本公司僅須於認列或迴轉減損損失當年度揭露該等可回收金額。此外,若可回收金額係以現值法計算之公允價值減處分成本衡量,本公司須增加揭露所採用之折現率。

3. IFRS 15「客戶合約之收入」

IFRS 15係規範來自客戶合約之收入認列原則,該準則將取代IAS 18「收入」、IAS 11「建造合約」及相關解釋。 本公司於適用IFRS 15時,係以下列步驟認列收入:

- (1) 辨認客戶合約;
- (2) 辨認合約中之履約義務;
- (3) 決定交易價格;
- (4) 將交易價格分攤至合約中之履約義務;及
- (5) 於滿足履約義務時認列收入。

IFRS 15生效時,本公司得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

4. IAS 28之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

該修正規定,若本公司出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本公司喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大 影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司符合IFRS 3「業務」之定義時,本公司係全數認列該等交易產生之損益。

此外,若本公司出售或投入資產予關聯企業(或合資),或本公司在與關聯企業(或合資)之交易中喪失對子公司之控制,但保留對該子公司之重大影響(或聯合控制),若前述資產或前子公司不符合IFRS 3「業務」之定義時,本公司僅在與投資者對該等關聯企業(或合資)無關之權益範圍內認列該交易所產生之損益,亦即,屬本公司對該損益之份額者應予以銷除。

5. IFRS 16「租賃」

IFRS 16係規範租賃之會計處理,該準則將取代IAS 17「租賃」及相關解釋。

於適用IFRS 16時,若本公司為承租人,除小額租賃及短期租賃得選擇採用類似IAS 17之營業租賃處理外,其他租賃皆應於資產負債表上認列使用權資產及租賃負債。綜合損益表應分別表達使用權資產之折舊費用及租賃負債按有效利息法所產生之利息費用。在現金流量表中,償付租賃負債之本金金額表達為籌資活動,支付利息部分則列為營業活動。對於本公司為出租人之會計處理預計無重大影響。

IFRS 16生效時,本公司得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

6. IAS 12之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」

IAS 12之修正主要係釐清,不論本公司預期透過出售或透過收取合約現金流量回收以公允價值衡量之債務工具投資,且不論該資產是否發生未實現損失,暫時性差異應按該資產公允價值及課稅基礎之差額決定。

此外,除非稅法限制可減除暫時性差異所能減除之收益類型而應就同類型可減除暫時性差異評估是否認列遞延所得稅資產,否則應就所有可減除暫時性差異一併評估。於評估是否認列遞延所得稅資產時,若有足夠證據顯示本公司很有可能以高於帳面金額回收資產,則估計未來課稅所得所考慮之資產回收金額不限於其帳面金額,且未來課稅所得之估計應排除因可減除暫時性差異迴轉所產生之影響。

除上述影響外,截至本個體財務報告通過發布日止,本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響,相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外,本個體財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第1等級至第3等級:

- 1. 第1等級輸入值:係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。
- 2. 第2等級輸入值:係指除第1等級之報價外,資產或負債直接(亦即價格)或間接(亦即由價格推導而得)之可觀察輸入值。
- 3. 第3等級輸入值:係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

本公司於編製個體財務報告時,對投資子公司、關聯企業及合資係採權益法處理。為使本個體財務報告之本年度損益、其他綜合損益及權益與本公司合併財務報告中歸屬於本公司業主之本年度損益、其他綜合損益及權益相同,個體基礎與合併基礎下若干會計處理差異係調整「採用權益法之投資」、「採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額」、「採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額」暨相關權益項目。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金、主要為交易目的而持有之資產及預期於資產負債表日後12個月內實現之資產,但不包括於資產負債表日後逾12個月用以交換或清償負債而受有其他限制者。流動負債包括主要為交易目的而持有之負債、預期於資產負債表日後12個月內到期清償之負債,以及不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少12個月之負債。非屬上述流動資產或流動負債者,係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外幣

本公司編製財務報告時,以本公司功能性貨幣以外之貨幣(外幣)交易者,依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額,於發生當年度認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算,所產生之兌換差額列為當年度損益,惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者,其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算,不再重新換算。

於編製個體財務報告時,本公司國外營運機構(包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司、關聯企業及合資) 之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當年度平均匯率換算,所產生之兌換差額列於 其他綜合指益。

(五) 存貨

存貨包括原料(不包括受託加工之晶圓)、物料、在製品、製成品及在途原物料。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量,比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入及完成出售所需之估計成本後之餘額。原料及物料成本按移動平均法計價,在製品及製成品成本按標準成本計價。

(六) 投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下,投資原始依成本認列,取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外,針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者,係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額,係直接認列為權益。

取得成本超過本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽,該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷:本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當年度收益。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於個體財務報告予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益,僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內,認列於個體財務報告。

(七) 投資關聯企業及合資

本公司對投資關聯企業及合資係採用權益法。

關聯企業係指本公司具有重大影響,但非屬子公司或合資權益之企業。合資係指本公司與他公司具有聯合控制且對淨資產 具有權利之聯合協議。

權益法下,投資關聯企業及合資原始依成本認列,取得日後帳面金額係隨本公司所享有之關聯企業及合資損益及其他綜合 損益份額與利潤分配而增減。此外,針對關聯企業權益及合資之變動係按持股比例認列。

取得成本超過本公司於取得日所享有關聯企業及合資可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽,該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷。

本公司與關聯企業及合資間之逆流、順流及側流交易所產生之損益,僅在與本公司對關聯企業權益及對合資權益無關之範圍內,認列於個體財務報告。

(八) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列,續後以成本減除累計折舊及累計減損後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時,分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

自有土地不提列折舊。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法 進行檢視,並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(九) 商譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本,後續以成本減除累計減損後之金額衡量。

為減損測試之目的,商譽分攤至本公司預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組(簡稱「現金產生單位」)。

受攤商譽之現金產生單位每年(及有跡象顯示該單位可能已減損時)藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較,進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得,則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額,減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額,次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當年度損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

(十) 其他無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量,後續係以成本減累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用 年限内按直線基礎進行攤銷,並且至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視,並推延適用會計估 計變動之影響。

無形資產除列時,淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當年度損益。

(十一) 有形及無形資產(商譽除外)之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產(商譽除外)可能已減損。若有任一減損跡象存在,則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額,本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者,個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時, 將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額,減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時,該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額,惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十二) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於個體資產負債表。原始認列時,若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者,係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本,則立即認列為損益。

金融資產

金融資產之慣例交易係採交割日會計認列及除列。

1. 衡量種類

本公司所持有之金融資產分類係於原始認列時視其性質及目的而決定。

(1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產包括持有供交易及指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

本公司於下列情況下,係將金融資產於原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量:

- A. 該指定可消除或重大減少衡量或認列不一致;或
- B. 一組金融資產、金融負債或兩者,依書面之風險管理或投資策略,以公允價值基礎管理並評估其績效,且本公司內部提供予管理階層之該投資組合資訊,亦以公允價值為基礎;或
- C. 將包含一個或多個嵌入式衍生工具之混合(結合)合約整體進行指定。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失(包含該金融資產所產生之任何 股利或利息)係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

(2) 備供出售金融資產

備供出售金融資產係非衍生金融資產被指定為備供出售,或未被分類為放款及應收款、持有至到期日投資或透過損益按公允價值衡量之金融資產。

備供出售金融資產係按公允價值衡量,備供出售貨幣性金融資產帳面金額之變動中屬外幣兌換損益與以有效利息法 計算之利息收入,以及備供出售權益投資之股利,係認列於損益。其餘備供出售金融資產帳面金額之變動係認列於 其他綜合損益,於投資處分或確定減損時重分類為損益。

備供出售權益投資之股利於本公司收款之權利確立時認列。

(3) 放款及應收款

放款及應收款主要包括現金、應收帳款、其他應收款及其他金融資產,係採用有效利息法按攤銷後成本減除減損損失後之金額衡量,惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

2. 金融資產之減損

除透過損益按公允價值衡量之金融資產外,本公司係於每一資產負債表日評估其他金融資產是否有減損客觀證據,當

有客觀證據顯示,因金融資產原始認列後發生之單一或多項事項,致使金融資產之估計未來現金流量受損失者,該金 融資產即已發生減損。

按攤銷後成本列報之金融資產,如應收帳款及其他應收款,該資產經個別評估未有客觀減損證據後,再以組合就過去收款經驗以及與應收款項違約有關之可觀察因素評估減損。

按攤銷後成本列報之金融資產之減損損失金額係該資產帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產原始有效利率折現之現值間之差額。於後續期間減損損失金額減少,且該減少客觀地與認列減損損失後發生之事項相連結,則先前認列之減損損失直接或藉由調整備抵帳戶予以迴轉認列於損益,惟該迴轉不得使金融資產帳面金額超過若未認列減損損失情況下於迴轉日應有之攤銷後成本。

當備供出售權益投資之公允價值低於成本且發生大幅或持久性下跌時,係為客觀減損證據。當備供出售金融資產發生減損時,原先已認列於其他綜合損益之累計損失金額將重分類至損益。備供出售權益工具投資已認列於損益之減損損失不得透過損益迴轉。任何認列減損損失後之公允價值回升金額係認列於其他綜合損益。備供出售債務工具之公允價值若於後續期間增加,而該增加能客觀地連結至減損損失認列於損益後發生之事項,則減損損失予以迴轉並認列於損益。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除,惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當判斷 應收帳款無法收回時,係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。除因應收帳款無法收回而沖 銷備抵帳戶外,備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

3. 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效,或已移轉金融資產目該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時,始將金融資產除列。除列時,其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。

權益工具

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

金融負債

金融負債係以有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係持有供交易之金融負債。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係按公允價值衡量,其再衡量產生之利益或損失係認列於損益,包含所支付之股利或利息。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

本公司僅於義務解除、取消或到期時,始將金融負債除列。除列時,其帳面金額與所支付對價間之差額認列為損益。

衍生工具

衍生工具於簽訂合約時,原始以公允價值認列,後續於資產負債表日按公允價值再衡量,後續衡量產生之利益或損失直接 列入損益。當衍生工具之公允價值為正值時,列為金融資產;公允價值為負值時,列為金融負債。

嵌入式衍生工具之風險及特性與主契約之風險及特性並非緊密關聯,且主契約非屬透過損益按公允價值衡量之金融資產或 金融負債時,該衍生工具係視為單獨衍生工具。

可轉換公司債

1. 可轉換公司債包含之轉換權屬權益性質

本公司發行之可轉換公司債於原始認列時將其組成部分分別分類至金融負債及權益。

原始認列時,負債組成部分之公允價值係以類似之不可轉換工具當時市場利率估算,並於執行轉換或到期日前,以有效利息法計算之攤銷後成本衡量。屬嵌入非權益衍生工具之負債組成部分則以公允價值衡量。

分類為權益之轉換權係等於該複合工具整體公允價值減除經單獨決定之負債組成部分公允價值之剩餘金額,經扣除所 得稅影響數後認列為權益,後續不再衡量。於該轉換權被執行時,其相關之負債組成部分及於權益之金額將轉列股本 及資本公積一發行溢價。可轉換公司債之轉換權若於到期日仍未被執行,該認列於權益之金額將轉列資本公積一發行 溢價。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按分攤總價款之比例分攤至該工具之負債(列入負債帳面金額)及權益組成部分(列入權益)。

2. 可轉換公司債包含之轉換權屬負債性質

本公司發行之可轉換公司債所含轉換權組成部分,如非透過以固定金額現金或其他金融資產交換固定數量之本公司之權益工具交割之轉換權,則分類為衍生性金融負債。

原始認列時,可轉換公司債之衍生性金融負債部分係以公允價值衡量,非衍生性金融負債部分之原始帳面金額則為分離嵌入式衍生工具後之餘額。於後續期間,非衍生性金融負債係採有效利息法按攤銷後成本衡量,衍生性金融負債係按公允價值衡量,且公允價值變動認列於損益。

發行可轉換公司債之相關交易成本,係按相對公允價值之比例分攤至該工具之非衍生性金融負債部分(列入負債帳面金額)及衍生性金融負債部分(列入損益)。

(十三) 收入認列

收入係按已收或應收對價之公允價值衡量,並扣除估計之客戶折扣及其他類似之折讓。

1. 商品之銷售

銷售商品係於下列條件完全滿足時認列收入:

- (1) 本公司已將商品所有權之重大風險及報酬移轉予買方;
- (2) 本公司對於已經出售之商品既不持續參與管理,亦未維持有效控制;
- (3) 收入金額能可靠衡量;
- (4) 與交易有關之經濟效益很有可能流入本公司;及
- (5) 與交易有關之已發生或將發生之成本能可靠衡量。
- 2. 勞務之提供

勞務收入係於勞務提供時予以認列。

3. 股利收入及利息收入

投資所產生之股利收入係於股東收款之權利確立時認列,惟前提係與交易有關之經濟效益很有可能流入本公司,且收入金額能可靠衡量。

金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本公司,且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(十四) 租賃

營業租賃之租賃收益或給付係按直線基礎於租賃期間内認列為收入或費用。

(十五) 借款成本

直接可歸屬於取得符合要件之資產之借款成本,係作為該資產成本之一部分,直到該資產達到預定使用狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

(十六) 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本(含服務成本、淨利息及再衡量數)係採預計單位福利法精算。服務成本(含當期服務成本 及前期服務成本)及淨確定福利負債(資產)淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數(含精算損益及扣除利息後之計畫 資產報酬)於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘,後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債(資產)係確定福利退休計畫之提撥短絀(剩餘)。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來 提撥金之現值。

(十七) 股份基礎給付協議

給與員工之認股權,係以給與日權益工具之公允價值與預期既得之最佳估計數量,於既得期間内以直線基礎認列費用,並同時調整資本公積一員工認股權。若其於給與日立即取得,係於給與日全數認列費用。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量,其影響數係認列為損益,使累計費用反映修正之估計數,並相對調整資本公積-員工認股權。

本公司給與子公司員工以本公司權益工具交割之員工認股權,係視為對子公司之資本投入,並以給與日權益工具之公允價 值衡量,於既得期間内認列為對子公司投資帳面金額之增加,並相對調整資本公積—員工認股權。

(十八) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵10%所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。 以前年度應付所得稅之調整,列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列,而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異或未使用投資抵減使用時認列。

與投資子公司相關之應課稅暫時性差異皆認列為遞延所得稅負債,惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點,且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視,並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收 所有或部分資產者,調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者,亦於每一資產負債表日予以重新檢視,並在未來 很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者,調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量,該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性 立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債 帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 本年度之當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益,惟與認列於其他綜合損益之項目相關之當期及遞延所得稅係認列於其他綜合損益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時,對於不易自其他來源取得相關資訊者,管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將持續檢視估計與基本假設。若會計估計之修正僅影響當年度,則於修正當年度認列。若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度,則於修正當年度及未來年度認列。

(一) 商譽減損評估

決定商譽是否減損時,須估計分攤到商譽之現金產生單位之使用價值。為計算使用價值,管理階層應估計預期自現金產生單位所產生之未來現金流量,並決定計算現值所使用之適當折現率。若實際現金流量少於預期,可能會產生重大減損損失。

(二) 有形資產及無形資產(商譽除外)減損評估

資產減損評估過程中,本公司需依賴主觀判斷並依據資產使用模式及半導體產業特性,決定特定資產群組之獨立現金流量、資產耐用年數及未來可能產生之收益與費損,任何由於經濟狀況之變遷或本公司策略所帶來的估計改變均可能在未來 造成重大減損。

(三) 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價,故本公司必須運用判斷及估計以決定資產負債表日存貨之淨變現價值。 由於科技或環境快速變遷,本公司評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額,並將存貨成本 沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎,故可能產生重大變動。

(四) 所得稅

遞延所得稅資產之可實現性主要視未來能否有足夠之獲利或應課稅暫時性差異而定。若未來實際產生之獲利少於預期,可能會產生重大遞延所得稅資產之迴轉,該等迴轉係於發生年度認列為損益。

(五)確定福利計畫之認列

確定福利退休計畫應認列之確定福利成本及淨確定福利負債係使用預計單位福利法進行精算評價,其採用之精算假設包括 折現率、員工離職率及薪資預期增加率等估計,若該等估計因市場與經濟情況之改變而有所變動,可能會重大影響應認列 之費用與負債金額。

(六) 公允價值衡量及評價流程

如附註二六所述,本公司管理階層運用判斷以選定用以估計於活絡市場無市場報價金融工具之適當評價技術。本公司係採用市場參與者所通用之評價技術。對衍生金融工具之假設係基於市場價格或利率並依該工具之特性予以調整。債務工具係採用現金流量折現方式估計,而所使用假設係基於可觀察之市場價格或利率(若可行)。未上市(櫃)權益工具之公允價值估計係基於對被投資者財務狀況與營運結果之分析、最近交易價格、相同權益工具於非活絡市場之報價、類似工具於活絡市場之報價及可比公司評價乘數等,包括非由可觀察市場價格或利率支持之假設。評價技術所使用之詳細假設係揭露於附註二六。本公司管理階層認為所選定之評價技術及假設可適當用以決定金融工具之公允價值。

六、現金

	104年12月3	:1日	103年12月3	31日
庫存現金	\$	1,657	\$	1,739
銀行支票及活期存款		8,531,689		11,252,778
	\$	8,533,346	\$	11,254,517

七、透過損益按公允價值衡量之金融工具

10	104年12月31日			103年12月31日			
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產							
上櫃公司私募可轉換公司債	\$	100,500		\$	100,500		
持有供交易之金融資產							
換匯合約		1,389,931			1,888,449		
遠期外匯合約		7,745			1,234		
外幣選擇權合約		5,020					
		1,402,696			1,889,683		
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	\$	1,503,196		\$	1,990,183		
持有供交易之金融負債							
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權(附註十五)	\$	2,632,565		\$	2,520,606		
遠期外匯合約		22,045			6,086		
換匯合約		14,876			13,726		
利率交換合約		119					
透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動	\$	2,669,605		\$	2,540,418		

(一) 本公司投資之私募可轉換公司債包括非與主契約緊密關聯之嵌入式衍生工具,於原始認列時將前述合約整 體指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

(二) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之換匯合約如下:

幣別	到期期間	合約金額(千元)
104年12月31日		
新台幣兌美金	105.01~105.12	NTD55,220,316 / USD1,731,334
美金兌新台幣	105.01	USD26,000 / NTD849,486
美金兌人民幣	105.03	USD53,734 / CNY 349,800
103年12月31日		
新台幣兌美金	104.01~104.12	NTD35,919,205 / USD1,200,000
美金兌新台幣	104.01	USD44,000 / NTD1,386,200

(三) 於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下:

幣別	到期期間	合約金額(千元)
104年12月31日		
美金兌日幣	105.01	USD14,000 / JPY1,713,388
美金兌新台幣	105.01~105.03	USD121,000 / NTD3,971,877
103年12月31日		
美金兌日幣	104.01	USD16,600 / JPY1,967,144

(四)於104年12月31日未適用避險會計旦尚未到期之外幣選擇權合約如下:

合約内容	到期期間	合約金額(千元)		
Buy USD Put / CNY Call	105.03	USD20,000 / CNY131,600		

(五)於104年12月31日未適用避險會計且尚未到期之利率交換合約如下:

名目本金(千元)	到期期間	支付利率區間	收取利率區間		
NTD1,000,000	105.10	4.6%	0%~5%		

八、備供出售金融資產

	104年12月31日	∃	103年12月31日			
有限合夥	\$	390,987	\$	438,953		
非上市(櫃)公司普通股		82,120		103,194		
基金受益憑證				400,007		
備供出售金融資產		473,107		942,154		
減:列為流動資產				400,007		
列為非流動資產	\$	473,107	\$	542,147		

九、應收帳款淨額

	104年12月3	1日	103年12月3	1日
應收帳款	\$	14,054,233	\$	16,497,435
減:備抵呆帳		23,792		23,931
	\$	14,030,441	\$	16,473,504

(一) 應收帳款

本公司之主要授信期間為30~90天。於評估應收帳款備抵呆帳時,本公司考量應收帳款之帳齡分析、歷史經驗及客戶財務 狀況等。

截至104及103年12月31日止,前五大客戶之應收帳款餘額占本公司應收帳款餘額之百分比分別為32%及38%,其餘應收帳款之信用集中風險相對並不重大。

應收帳款之帳齡分析如下:

	104年12月31日	103年12月31日
未逾期	\$ 12,0	774,151 \$ 14,695,089
1至30天	1,6	539,016 1,690,110
31至90天	2	231,365 87,382
91天以上	1	09,701 24,854
合計	\$ 14,0	54,233 \$ 16,497,435

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

已逾期但未減損應收帳款之逾期帳齡分析如下:

	104年12月3	103年1	<u> </u>		
30天以下	\$	1,636,231		\$	1,690,033
31至90天		192,339			58,588
合計	\$	1,828,570		\$	1,748,621

於資產負債表日已逾期但本公司尚未認列備抵呆帳之應收帳款,因其信用品質並未重大改變,本公司管理階層認為仍可回收其金額。本公司對該等應收帳款並未持有任何擔保品或其他信用增強保障:此外,本公司亦不具有將應收帳款及對相同交易對方之應付帳款互抵之法定抵銷權。

應收帳款之備抵呆帳變動資訊如下:

	個別評估 減損損失		群組評估 減損損失		合計
104年1月1日餘額	\$ 5,100	\$	18,831	\$	23,931
本年度提列(迴轉)減損損失	8,848	(8,826)		22
本年度實際沖銷		(161)	(161)
104年12月31日餘額	\$ 13,948	\$	9,844	\$	23,792
103年1月1日餘額	\$ 5,100	\$	18,831	\$	23,931
本年度提列呆帳費用	_		_		_
本年度實際沖銷	 				
103年12月31日餘額	\$ 5,100	\$	18,831	\$	23,931

(二) 金融資產之移轉

本公司讓售應收帳款之相關資訊如下:

交易對象	本年度讓	售金額(千元)	本年度已以	枚現金額(千元)	截至年底已預支金額(千元) 已預支金額年利率(%)		額度	₹(千元)	
104年度									
花旗銀行	USD	78,804	USD	36,955	USD	41,849	1.30	USD	92,000
103年度									
花旗銀行	USD	103,744	USD	103,744	USD	_	_	USD	92,000

上述額度可循環使用,另依讓售合約之規定,因商業糾紛(如銷貨退回或折讓等)而產生之損失由本公司承擔,因信用風險 而產生之損失則由該銀行承擔。本公司於104年及103年12月31日均已提供美金5,000千元之商業本票予銀行用以補償商業 糾紛損失。截至104年12月31日止,本公司並未發生重大商業糾紛,於可預見之未來亦預期不會發生重大商業糾紛。

十、存貨

	104年12月31日	103年12月31日				
製成品	\$	243,240	\$	245,301		
在製品		241,352		209,411		
原料		2,898,215		3,467,274		
物料		335,229		316,515		
在途原物料		51,072		85,167		
	\$	3,769,108	\$	4,323,668		

104及103年度與存貨相關之營業成本分別為69,059,001千元及67,301,431千元,其中分別包括存貨損失275,232千元及 170,555千元。

十一、採用權益法之投資

	104年12月3	103年12月31	整後)		
投資子公司	\$	152,571,261		\$	137,561,086
投資關聯企業		36,809,068			1,492,441
投資合資		613,841			_
	\$	189,994,170		\$	139,053,527

(一) 投資子公司

	104年12月31日				103年12月31日			
	帳面金額		股權%		帳面金額	股權%		
J & R Holding Limited(J&R Holding)	\$	47,271,666	100.0	\$	45,150,697	100.0		
環電公司(環電)		44,733,359	99.2		_	_		
台灣福雷電子公司(台灣福雷)		29,586,903	100.0		26,943,800	100.0		
A.S.E. Holding Limited(ASE Holding)		15,251,124	100.0		14,367,500	100.0		
Omniquest Industrial Limited (Omniquest)		11,140,252	70.6		11,045,479	70.6		
Innosource Limited(Innosource)		3,998,959	100.0		3,966,042	100.0		
陸竹開發公司(陸竹)		1,332,571	67.1		1,315,623	67.1		
環隆電氣公司(環隆電氣)		1,187,548	99.0		36,706,080	99.2		
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.(ASE MS Japan)		27,986	100.0		24,972	100.0		
		154,530,368			139,520,193			
減:轉列庫藏股票		1,959,107			1,959,107			
	\$	152,571,261		\$	137,561,086			

本公司之子公司環旭電子公司於103年11月辦理現金增資,本公司及子公司未依持股比例認購,致持股比例由88.6%降至82.1%。由於此項交易並未改變本公司對環旭電子公司之控制,本公司及子公司係採權益交易處理之,並認列資本公積增加6,877,099千元(調整後)。

為進行組織調整以提高營運彈性,本公司之子公司環隆電氣經董事會決議以104年4月1日為基準日,分割投資部門業務並辦理減資16,012,966千元,計銷除已發行股份1,601,297千股,減資比率為97.56%;並按環隆電氣被分割標的之營業價值,由新設立之環電發行普通股新股1,000,000千股予環隆電氣之股東。環隆電氣股東依分割基準日之持股比例,按每1千股換取環電普通股609.27股,環隆電氣已於104年4月17日完成減資變更登記,另環電亦於104年4月17日經核准登記設立。截至104年12月31日,本公司取得環電990,081千股,持股比例為99.2%。

104年4月本公司之子公司USI Enterprise Limited(環誠)以人民幣1,992,060千元出售其持有之環旭電子公司股權54,000千股,致本公司對環旭電子公司之持股比例由82.1%降至77.2%。此交易並未改變本公司對子公司環旭電子公司之控制,本公司及子公司係採權益交易處理之,並認列資本公積增加7,197,510千元。

本公司於104年9月經董事會決議預計以每股20元處分子公司環隆電氣股權39,603干股予本公司之子公司環鴻科技公司,交易總金額為792,064千元,該價款係參酌環隆電氣截至104年6月30日經會計師查核財務報表之每股淨值議定之。該股權處分案於105年2月經經濟部投資審議委員會核准。

104年12月本公司之子公司環誠經股東會決議,以每股美金18.82元買回已發行流通在外之普通股計4,500,820股,並於105年2月經董事會決議以105年2月17日為減資基準日,將其買回之股份予以註銷。

104及103年度採用權益法之子公司之損益及其他綜合損益份額,係依據各子公司同期間經會計師查核之財務報告認列。

(二) 投資關聯企業

1. 本公司採用權益法之關聯企業投資列示如下:

			帳面金額				
被投資公司名稱	主要業務	營運地點		104年12月31日		103年12月31日	
具重大性之關聯企業							
矽品精密工業公司(矽 品)	各項積體電路構裝之製造、加工、買賣及測試 等業務	台灣	\$	35,423,058	\$	-	
個別不重大之關聯企業							
宏璟建設公司(宏璟)	委託營造廠商興建大樓及出租業務等	台灣		1,313,499		1,351,400	
宏錦光公司(宏錦光)	經營辦公大樓及攤位出租業務	台灣		332,444		342,138	
元隆電子公司(元隆)	晶圓積體電路代工	台灣		40,216		99,052	
				37,109,217		1,792,590	
	減:以土地作價投資宏錦光之未實現利益			300,149		300,149	
			\$	36,809,068	\$	1,492,441	

2. 於資產負債表日對關聯企業持有之股權百分比如下:

被投資公司名稱	104年12月31日	103年12月31日
矽品	24.99%	_
宏璟	26.22%	26.22%
元隆	18.24%	18.24%
宏錦光	27.31%	27.31%

- 3. 本公司於104年9月以每股價格45元收購矽品普通股725,749千股及海外存託憑證10,650千單位(每單位表彰普通股5股),合計持股24.99%,對矽品具重大影響。另截至104年12月31日止,本公司尚未完成投資成本與所享有關聯企業可辨認資產及負債之淨公允價值份額間差額之辨識。另,本公司於104年12月經董事會決議自104年12月29日至105年2月16日止,以每股價格55元及等值275元之美元現金作為對價,公開收購矽品已發行之普通股及海外存託憑證(每單位表彰普通股5股)。預定之最高收購數量為矽品普通股770,000千股,約當於矽品已發行普通股股份總數之24.71%。因台灣公平交易委員會目前仍在審查本公司與矽品結合之申報案,本公司已延長公開收購日期至105年3月17日止。
- 4. 本公司於103年1月認購元隆私募之普通股並對元隆具重大影響。該普通股依相關法令規定於3年內不得轉讓。
- 5. 關聯企業具公開市場報價之第1級公允價值資訊如下:

	104年12月31日			103年12月	103年12月31日			
矽品		\$	40,741,700	\$		_		
宏璟	-	\$	1,149,549	\$		1,427,499		
元隆	-	\$	104,255	\$		184,862		

6. 本公司重大關聯企業之彙整性財務資訊

以下彙總性財務資訊係以矽品依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之IFRSs編製之合併財務報告為基礎編 製,並已反映採權益法時所做之調整。

		104年12月31日	
流動資產		\$	48,785,212
非流動資產			74,460,018
流動負債		(30,677,239)
非流動負債		(21,967,349)
權益		\$	70,600,642
本公司持股比例(%)			24.99
本公司享有之權益		\$	17,643,100
取得成本與股權淨値差額			17,779,958
投資帳面金額		\$	35,423,058
		104年度	
營業收入		\$	82,839,922
本年度淨利		\$	8,762,257
本年度其他綜合損益		(906,053)
本年度綜合損益總額		\$	7,856,204
7. 本公司個別不重大之關聯企業彙總資訊			
	104年度	103	年度

	104年度		103年度	
本公司享有之份額				_
本年度淨利	\$	115,857	\$	147,085
其他綜合損益	(2,916)		234,125
綜合損益總額	\$	112,941	\$	381,210

採用權益法之關聯企業之損益及其他綜合損益份額,係依據各關聯企業同期間經會計師查核之財務報告認列。

(三) 投資合資

1. 本公司採用權益法之個別不重大之合資投資列示如下:

			104年12月31日		
被投資公司名稱	主要業務	營運地點		金額	持股比例(%)
日月暘電子公司(日月暘)	電子零組件製造	台灣	\$	613,841	51.0

本公司於104年5月與日商TDK Corporation簽署合資協議共同出資成立日月暘,並於104年8月以現金投資618,097千元,取 得51.00%股權,然而,依據聯合協議,由出資雙方共同主導該公司相關營運活動,因此本公司對日月暘不具控制,對日月 暘之投資採用權益法。

2. 本公司個別不重大之合資彙總資訊如下:

	104年度	
本公司享有之份額		
本年度淨利	(\$	4,274)
其他綜合損益		
綜合損益總額	(\$	4,274)

採用權益法之合資之損益及其他綜合損益份額,係依據合資公司同期間經會計師查核之財務報告認列。

十二、不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備每一類別	之帳面金額如下:
---------------	----------

	104年12月31日		103年12月31日	
土地	\$	1,562,945	\$	1,562,945
建築物及附屬設備	3	80,722,699		25,952,734
機器設備	4	14,069,302		47,020,338
運輸設備		17,136		18,264
辦公設備		443,563		384,448
未完工程及待驗設備		3,560,050		2,702,266
	\$ 8	80,375,695	\$	77,640,995

104年度

	土地	建築物及 附屬設備	機器設備	迢	壓輸設備	辦公設備	未完工程及 待驗設備			合計
成本										
104年1月1日餘額	\$ 1,562,945	\$38,879,974	\$110,668,151	\$	81,014	\$ 1,348,053	\$:	2,709,430	\$	155,249,567
增添	_	(16,412)	103,847		3,750	28,899	1	7,531,501		17,651,585
處分	_	(115,669)	(3,111,192)	(16,004)	(20,717)	(12,032)	(3,275,614)
重分類		6,973,887	9,474,817		3,002	205,779 (16,657,485		,657,485)		
104年12月31日餘額	\$ 1,562,945	\$45,721,780	\$117,135,623	\$	71,762	\$ 1,562,014	\$:	3,571,414	\$	169,625,538
累計折舊及減損										
104年1月1日餘額	\$ -	\$12,927,240	\$63,647,813	\$	62,750	\$ 963,605	\$	7,164	\$	77,608,572
折舊費用	_	2,095,142	12,360,166		7,130	168,424		_		14,630,862
減損損失	_	76,792	15,977		_	_		4,200		96,969
處分	=	(100,093)	(2,957,635)	(15,254)	(13,578)		_	(3,086,560)
104年12月31日餘額	\$ -	\$14,999,081	\$73,066,321	\$	54,626	\$ 1,118,451	\$	11,364	\$	89,249,843
104年12月31日餘額	\$ -	\$14,999,081	\$73,066,321	\$	54,626	\$ 1,118,451	\$	11,364	\$	89,249,843

103年度

	土地	建築物及附屬設備	機器設備	迢	運輸設備 辦公設備		未完工程及		合計
成本									
103年1月1日餘額	\$ 1,562,945	\$30,805,750	\$95,019,106	\$	76,216	\$ 1,162,701	\$ 1,878,227	\$	130,504,945
增添	_	(7,955)	535,770		_	37,838	27,006,561		27,572,214
處分	_	(254,885)	(2,459,275)	(4,545)	(90,841)	(18,046)	(2,827,592)
重分類	_	8,337,064	17,572,550		9,343	238,355	(26,157,312)		_
103年12月31日餘額	\$ 1,562,945	\$38,879,974	\$110,668,151	\$	81,014	\$ 1,348,053	\$ 2,709,430	\$	155,249,567
累計折舊及減損									
103年1月1日餘額	\$ -	\$11,376,605	\$55,020,800	\$	60,619	\$ 924,749	\$ -	\$	67,382,773
折舊費用	_	1,715,421	10,816,943		5,946	129,644	_		12,667,954
減損損失	_	42,988	111,507		_	_	7,164		161,659
處分		(207,774)	(2,301,437)	(3,815)	(90,788)		(2,603,814)
103年12月31日餘額	\$ -	\$12,927,240	\$63,647,813	\$	62,750	\$ 963,605	\$ 7,164	\$	77,608,572

本公司之不動產、廠房及設備係以直線基礎按下列耐用年數計提折舊:

建	築物及附屬設備	
	廠房主建物	10至40年
	無塵室工程	10至20年
	其他	3至20年
機	器設備	2至10年
運	輸設備	2至5年
辦	公設備	2至8年

十三、其他無形資產

其他無形資產主係電腦軟體,變動如下:

104年度

		成本		累計攤銷及減損	 帳面金額
104年1月1日餘額	\$	1,500,492	\$	1,014,300	\$ 486,192
增添/攤銷		308,562		139,065	169,497
處分	(30)	(30)	_
104年12月31日餘額	\$	1,809,024	\$	1,153,335	\$ 655,689

103年度

		成本		累計攤銷及減損	帳面金額
103年1月1日餘額	\$	2,293,750	\$	1,899,991	\$ 393,759
增添/攤銷		202,242		109,809	92,433
處分	(995,500)	(995,500)	_
103年12月31日餘額	\$	1,500,492	\$	1,014,300	\$ 486,192

上述無形資產係以直線基礎按耐用年數2至5年計提攤銷費用。

十四、借款

(一) 短期借款

係無擔保之銀行週轉性借款,104年及103年12月31日年利率分別為0.68%~0.85%及0.82%~1.10%。

(二) 應付短期票券

104年12月31日尚未到期之應付短期票券係應付商業本票面額4,350,000千元減除未攤銷折價1,946千元後之餘額,年利率0.78%。保證機構為中華及兆豐票券金融公司。

(三)長期借款

銀行借款

本公司之長期借款均為週轉性借款且主係浮動利率,包括:

	104年12月31日	103年12月31日
銀行團聯貸-將陸續於105年7月至107年7月償還,年利率104年		
及103年12月31日分別為1.56%及0.90%~1.41%	\$ 11,160,500	\$ 9,155,893
其他-將陸續於106年2月至108年8月償還,年利率104年及103		
年12月31日分別為 0.90%~1.26%及1.03%~1.28%	24,283,112	10,315,500
	35,443,612	19,471,393
減:未攤銷遞延主辦費	17,994	30,696
一年内到期之長期借款	_	1,085,143
銀行借款	\$ 35,425,618	\$ 18,355,554

上述銀行團聯合融資合約,除其他有關規定外,尚規定本公司以經會計師查核或核閱之年度或半年度合併財務報告為計算基礎,於貸款存續期間內,應維持約定流動比率、負債比率、有形淨值金額及利息償付能力。本公司於104年及103年12月31日均符合上述規定。

本公司預計可將部分一年內到期之長期借款再融資至104年12月31日後至少12個月,是以截至104年12月31日尚有 2,105,883千元未列入一年內到期之部分。

應付票券-僅104年12月31日

係本公司與大慶票券公司簽訂發行3年期循環冤保證票券2,000,000千元,未攤銷折價1,011千元,年利率1.03%。

十五、應付公司債

	104年12月31日	103年12月31日
四内有擔保公司債-由銀行提供擔保,期間5年,將於105年8月 到期一次償還,每年付息,年利率1.45%	\$ 8,000,00	0 \$ 8,000,000
海外無擔保轉換公司債		
美金400,000千元	13,130,00	0 12,660,000
美金200,000千元(新台幣計價)	6,185,60	0
	27,315,60	0 20,660,000
減:應付公司債折價	1,214,51	4 1,389,387
一年内到期之應付公司債	12,162,19	2
應付公司債	\$ 13,938,89	\$ 19,270,613

本公司預計可將部分一年內到期之應付公司債8,000,000千元再融資至104年12月31日後至少12個月,是以仍列為非流動。

(一)本公司於102年9月發行海外第三次無擔保轉換公司債,發行總額計美金400,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限5年。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣29.956元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股。發行時轉換價格為33.085元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,104年及103年12月31日轉換價格分別為30.28元及31.93元。

發行滿3年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於此公司債發行屆滿3年當日:或本公司控制權發生變動:或本公司普通股下市時,要求本公司贖回 部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權、贖回權及賣回權(列入透過損益按公允價值衡量之金融負債項下),主債務契約原始認列之有效利率為3.16%,轉換權、贖回權與賣回權原始認列之公允價值為1,667,950千元。

(二) 本公司於104年7月發行海外第四次無擔保轉換公司債,發行總額計美金200,000千元,每張面額為美金200千元或其整數倍數,票面利率為0%,發行期限2.75年。償還、賣回及贖回金額將按固定匯率美金1元對新台幣30.928元換算為新台幣,並以該新台幣金額按償還、賣回及贖回當時之匯率換算為美金計算。每單位公司債持有人有權於發行日後第41日起至到期日前10日止,除依法令規定停止過戶期間外,請求按固定匯率美金1元對新台幣30.928元及轉換當時每股轉換價格轉換為本公司之普通股,本公司庫藏股可供轉換股權之用。發行時轉換價格為54.55元,後續轉換價格遇有本公司因反稀釋條款之情況,將依轉換辦法規定予以調整,104年12月31日轉換價格為51.73元。

發行滿2.72年後,如本公司普通股於台灣證券交易所連續30個營業日中有20個交易日之收盤價格依當時市場匯率換算 為美金後,均達轉換價格之130%;或90%之公司債業已贖回、買回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利;或因法 令變更致使本公司因此公司債負擔稅賦增加時,本公司得提前贖回部分或全部債券。

公司債持有人亦得於本公司控制權發生變動:或本公司普通股下市時,要求本公司贖回部分或全部債券。

於發行日此可轉換公司債包括主債務契約(列入應付公司債項下)及轉換權(列入資本公積項下)。主債務契約原始認列之 有效利率為1.58%,轉換權原始認列之金額為214,022千元。

十六、其他應付款

	104年12月31日		103年12月31日		
應付設備款	\$	2,888,533	\$	3,445,582	
應付薪資及獎金		2,379,823		2,388,850	
應付員工紅利及董監酬勞		2,218,000		2,548,130	
其他		3,079,235		3,969,513	
	\$	10,565,591	\$	12,352,075	

本公司及子公司ASE (U.S.) Inc.與美商Tessera Inc.之專利侵權訴訟於103年10月簽署最終和解協議書,並已撤銷美國加州地方法院之訴訟。103年12月31日之最終和解金為814,185千元(美金27,000千元),已於104年1月支付。

十七、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度,係屬政府管理之確定提撥退休計畫,依員工每月薪資6%提撥退休金至 勞工保險局之個人專戶。

(二)確定福利計畫

- 1. 本公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付,係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額之一定比率按月提撥員工退休基金,交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶,年度終了前,若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工,次年度3月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理,本公司並無影響投資管理策略之權利。
- 2. 本公司另提列委任經理人退休金準備,104及103年度分別認列退休金成本 1,180千元及5,297千元(列入淨確定福利負債項下),並支付經理人退休金分別為2,549千元及15,315千元,另自子公司台灣福雷轉入18,457千元。截至104年及103年12月31日止,屬委任經理人之淨確定福利負債分別為134,261千元及117,173千元。
- 3. 除經理人退休金外,本公司列入個體資產負債表之確定福利計畫金額列示如下:

	104年12月31日	∃	103年12月31日(調整後)		
確定福利義務現值	\$	3,634,267	\$	3,660,738	
計畫資產公允價值	(1,467,174)	(1,348,084)	
提撥短絀		2,167,093		2,312,654	
列入其他應付款	(14,282)	(14,173)	
淨確定福利負債	\$	2,152,811	\$	2,298,481	

4. 淨確定福利負債變動如下:

	確定福利義務現值		計畫資產公允價值		淨確定福利負債	
104年1月1日餘額	\$	3,660,738	(\$	1,348,084)	\$	2,312,654
服務成本						
當期服務成本		36,899		_		36,899
利息費用(收入)		81,249	(31,356)		49,893
認列於損益		118,148	(31,356)		86,792
再衡量數						
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)		_	(4,226)	(4,226)
精算損失-財務假設變動		152,319		_		152,319
精算利益-經驗調整	(168,955)		_	(168,955)
精算利益-人口統計假設變動	(18,848)		_	(18,848)
認列於其他綜合損益	(35,484)	(4,226)	(39,710)

	確定福利義務現值		計畫	計畫資產公允價值		淨確定福利負債	
雇主提撥	\$		(\$	192,643)	(\$	192,643)	
福利支付	(109,135)		109,135			
104年12月31日	\$	3,634,267	(\$	1,467,174)	\$	2,167,093	
103年1月1日餘額	\$	3,594,640	(\$	1,211,581)	\$	2,383,059	
服務成本							
當期服務成本		48,735		_		48,735	
前期服務成本	(10,796)		-	(10,796)	
利息費用(收入)		76,376	(27,076)		49,300	
認列於損益		114,315	(27,076)		87,239	
再衡量數							
計畫資產報酬(除包含於淨利息之金額外)		_	(1,594)	(1,594)	
精算利益-財務假設變動	(83,726)		_	(83,726)	
精算損失-經驗調整		112,922				112,922	
認列於其他綜合損益		29,196	(1,594)		27,602	
雇主提撥			(185,246)	(185,246)	
福利支付	(77,413)		77,413			
103年12月31日	\$	3,660,738	(\$	1,348,084)	\$	2,312,654	

5. 本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險:

(1) 投資風險

勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式,將勞工退休基金分別投資於國内(外)權益證券與債務證券及 銀行存款等標的,惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。

(2) 利率風險

政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加,惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加,兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

(3) 薪資風險

確定福利義務現値之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

6. 本公司之確定福利義務現值(不含經理人)係由合格精算師進行精算,衡量日之重大假設如下:

	104年12月31日	103年12月31日
折現率(%)	1.90	2.25
薪資預期增加率(%)	2.75~3.00	2.75~3.00

若重大精算假設分別發生合理可能之變動,在所有其他假設維持不變之情況下,將使確定福利義務現值增加(減少)之金額如下:

折現率		
增加0.5%	(\$	213,385)
减少0.5%	\$	236,088
薪資預期增加率		
增加0.5%	\$	232,856
减少0.5%	(\$	212,647)

由於精算假設可能彼此相關,僅單一假設變動之可能性不大,故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

- 7. 截至104年及103年12月31日,本公司確定福利義務平均到期期間均約為12年;另預期於一年内提撥金額分別為206,280千元及190,394千元。
- 8. 未折現之退休金福利支付到期分析如下:

	104年12月31日		103年12月31日	3
1年内	\$	100,459	\$	99,330
超過1年但未超過5年		533,315		522,113
超過5年		4,434,125		4,828,451
	\$	5,067,899	\$	5,449,894

十八、權益

(一) 股本

普通股股本

	104年12月31日	103年12月31日
額定股數(干股)	10,000,000	10,000,000
保留股數(干股)		
員工認股權	800,000	800,000
額定股本	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000
保留股本		
員工認股權	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000
已登記股數(千股)	7,902,929	7,852,538
預收股數(干股)	7,499	9,187
已發行且已收足股款之股數(干股)	7,910,428	7,861,725
登記股本	\$ 79,029,290	\$ 78,525,378
預收股本	156,370	189,801
已發行股本	\$ 79,185,660	\$ 78,715,179

本公司已發行之普通股每股面額為10元,每股享有一表決權(子公司持有之本公司股票除外)及收取股利之權利。104年及103年12月31日額定股數中尚有500,000千股暫無須辦理變更登記。

發行海外存託憑證

本公司發行ADR,每單位表彰本公司普通股5股,截至104年及103年12月31日止,流通在外之ADR分別為115,240千單位及125,731千單位,折合普通股分別約576,198千股及628,657千股。

(二) 資本公積

	104年12月31日		103年12月31日(調整後)		
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(註1)					
股票發行價格超過面額	\$	5,479,616	\$	4,946,308	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		7,197,510		-	
僅得用以彌補虧損					
認列對子公司所有權權益變動數(註2)		8,489,984		9,054,328	
庫藏股票交易		717,355		425,004	
員工認股權執行		544,112		375,448	
員工認股權失效		3,626		3,626	

	104年12月31日		103年12月31日(調]整後)
不得作為任何用途				
員工認股權	\$	1,080,590	\$	1,178,210
發行可轉換公司債認列權益組成部分		214,022		_
採權益法認列關聯企業資本公積之變動數		30,284		30,134
	\$	23,757,099	\$	16,013,058

註1:此類資本公積得用以彌補虧損,亦得於公司無虧損時,用以發放現金或撥充股本,惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

註2:此類資本公積係本公司未實際取得或處分子公司股權時,因子公司權益變動認列之權益交易影響數,或本公司採權益法認列子公司資本公積之調整數。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司於104年6月股東常會決議通過新修訂之章程規定,每年度有純益時,依下列順序分派之:

- 1. 彌補虧損。
- 2. 提存百分之十為法定盈餘公積。
- 3. 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 4. 長期投資採權益法計算之投資收益内屬於現金股利以外未實現部分,得就當年度盈餘項下轉列特別盈餘公積,俟實現 後再列入盈餘分配。
- 5. 加計或減除保留盈餘中屬已實現之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益。
- 6. 董事酬勞金係依1.至5.款規定數額後剩餘之數提撥百分之一(含)以下。
- 7. 員工紅利係依1.至5.款規定數額後剩餘之數提撥百分之七(含)以上,百分之十一(含)以下,其中百分之七部分係按員工紅利發放辦法分配予全體員工,另其超過百分之七部分則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。
- 8. 其餘由董事會擬定盈餘分派案,按股份總數比例分派之。

前述第7款所稱之員工,其對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件由董事會訂定之。

本公司正處於企業穩定成長階段,為因應目前及未來業務擴展之資金需求,並滿足股東對現金流入之需求,本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利,其中現金股利發放之比例不低於股利總額30%,餘額則配發股票股利,並由董事會擬具盈餘分配案,經股東會決議後辦理。

依104年5月公司法之修正,股息及紅利之分派限於股東,員工非屬盈餘分派之對象。本公司預計於105年度之股東常會配合上述法規修正公司章程。員工及董監事酬勞於104及103年度之估列基礎及103及102年度之實際配發情形,請參閱稅前淨利之員工福利費用(附註十九(五))。

本公司依金管證發字第1010012865號函、金管證發字第1010047490號函及「採用國際財務報導準則(IFRSs)後,提列特別盈餘公積之適用疑義問答」規定提列及迴轉特別盈餘公積。嗣後其他股東權益減項餘額有迴轉時,得就迴轉部分分派盈餘。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用於彌補虧損。公司無虧損時,法定盈餘公積 超過實收股本總額25%之部分除得撥充股本外,尚得以現金分配。

本公司分別於104年及103年6月舉行股東常會,分別決議通過103及102年度盈餘分配案如下:

	盈餘分配案			每股股利(元)					
	103年度		102年度		103年度		102年度		
法定盈餘公積	\$	2,359,267	\$	1,568,907					
特別盈餘公積迴轉		_	(309,992)					
現金股利		15,589,825		10,156,005	\$	2.00	\$		1.30
	\$	17,949,092	\$	11,414,920					

(四) 首次採用IFRSs應提列之特別盈餘公積

本公司因首次採用IFRSs帳列累積換算調整數轉入保留盈餘之金額為3,353,938千元,已於102年1月1日依金管會之規定提列相同數額之特別盈餘公積。

(五) 其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	104年度		103年度(調整	整後)
年初餘額	\$	4,541,761	(\$	525,583)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資之換算差額之份額	(48,191)		5,067,344
年底餘額	\$	4,493,570	\$	4,541,761

2. 備供出售金融資產未實現損益

	104年	度		103	年度	
年初餘額	;	\$	526,778		\$	426,246
備供出售金融資產未實現損失			4,304)		(142,418)
處分備供出售金融資產累計損益重分類至損益			10,827			9,561
採用權益法之關聯企業或合資之備供出售金融資產未實現利益						
之份額	_		54,818			233,389
年底餘額	<u>:</u>	\$	588,119		\$	526,778

3. 現金流量避險一僅103年度

	103年度	
年初餘額	(\$	3,279)
採用權益法之子公司現金流量避險之份額		3,279
年底餘額	\$	_

(六) 庫藏股票

	年初股數(千股)	本年度增加(千股)	本年度減少(千股)	年底股數(千股)
104年度				
子公司持有本公司股票	– 145,883	_	_	145,883
買回供轉換公司債股權轉換 之用	_	120,000	_	120,000
合計	145,883	120,000	_	265,883
103年度				
子公司持有本公司股票	145,883	_	_	145,883

本公司董事會於104年2月通過買回庫藏股120,000千股,俾供本公司海外無擔保轉換公司債轉換股權之用,並已於104年3月間執行完畢,實際買回股份占本公司已發行股份總數1.53%,實際買回平均價格為每股44.45元。

子公司於資產負債表日持有本公司股票之相關資訊如下:

	持有股數(千股)	帳面金額	公允價值
104年12月31日		 _	
ASE Test	88,200	\$ 1,380,721	\$ 3,351,618
J&R Holding	46,704	381,709	1,774,743
台灣福雷	10,979	196,677	417,193
	145,883	\$ 1,959,107	\$ 5,543,554
103年12月31日			
ASE Test	88,200	\$ 1,380,721	\$ 3,360,438
J&R Holding	46,704	381,709	1,779,413
台灣福雷	10,979	196,677	418,291
	145,883	\$ 1,959,107	\$ 5,558,142

上述公允價值係屬具公開市場報價之第1級公允價值。

子公司持有本公司股票係本公司因吸收合併及收購子公司,而將子公司持有本公司股票之帳面價值依本公司對子公司持股 比例計算之金額轉列庫藏股票。

本公司持有之庫藏股票,依證券交易法規定不得質押,亦不得享有股利之分派及表決權等權利。子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理,除不得參與本公司之現金增資及無表決權外,其餘與一般股東權利相同。

十九、 稅前淨利

(一) 其他收入

	104年度		103年度			
利息收入-主係銀行存款	\$	7,259	\$	6,848		
租金收入		90,996		75,395		
股利收入		353,099		32,126		
	\$	451,354	\$	114,369		

(二) 其他利益(損失)

	104年度		103年度	
持有供交易之金融工具利益	\$	1,743,638	\$	1,571,545
指定透過損益按公允價值衡量之金融工具利益		345,492		164,104
處分資產損失	(8,208)	(17,769)
外幣兌換損失	(750,179)	(1,759,676)
賠償損失	(604,587)	(92,959)
減損損失	(96,969)	(161,659)
其他		93,250		304,457
	\$	722,437	\$	8,043

(三) 財務成本

	104年度		103年度		
以攤銷後成本衡量之金融負債之利息費用總額	\$	1,171,258	\$	1,039,746	
減:列入不動產、廠房及設備項下	(34,510)	(47,204)	
		1,136,748	_	992,542	
其他財務成本		29,884		9,432	
	\$	1,166,632	\$	1,001,974	

104及103年度列入不動產、廠房及設備之利息資本化年利率分別為0.95%~1.26%及1.12%~1.98%。

(四) 折舊及攤銷

	104年度		103	年度	
不動產、廠房及設備	\$	14,630,862		\$	12,667,954
無形資產		139,065			109,809
合計	\$	14,769,927		\$	12,777,763
折舊費用依功能別彙總					
營業成本	\$	13,751,129		\$	11,824,860
營業費用		879,733			843,094
	\$	14,630,862		\$	12,667,954
攤銷費用依功能別彙總					
營業成本	\$	41,471		\$	22,419
推銷費用		63			109
管理費用		64,712			58,476
研發費用		32,819			28,805
	\$	139,065		\$	109,809

(五) 員工福利費用

	104年度		103年度(調整後)		
退職後福利(附註十七)					
確定提撥計畫	\$	788,519		\$	716,293
確定福利計畫		87,904			92,497
		876,423	_		808,790
權益交割之股份基礎給付		89,768			82,408
薪資、獎金及紅利		19,852,325			19,829,602
其他員工福利		2,414,150			2,258,744
員工福利費用合計	\$	23,232,666	=	\$	22,979,544
依功能別彙總					
營業成本	\$	16,634,736		\$	16,258,145
營業費用		6,597,930	_		6,721,399
	\$	23,232,666		\$	22,979,544

依現行章程規定,本公司係以當年度稅後可分配盈餘分別以7%~11%及不高於1%分派員工紅利及董監事酬勞(附註十八(三)保留盈餘及股利政策),103年度係分別按11%及1%估列員工紅利2,335,786千元及董監事酬勞212,344千元。

依104年5月修正後公司法及105年1月經董事會擬議之修正章程,本公司係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以5.25%~8.25%及0.75%以下提撥員工及董事酬勞。104年度佔列員工酬勞2,033,500千元及董事酬勞184,500千元,係分別按前述稅前利益之8.25%及0.75%估列,該等金額尚待董事會決議且經股東常會決議修正章程後,報告股東會。

年度個體財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原提列年度費用,年度個體財務報告 通過發布日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

本公司於104年及103年6月舉行股東常會,分別決議通過103及102年度員工紅利(以現金配發)及董監事酬勞如下:

	103年度		102年度		
員工紅利	\$	2,335,600	\$	1,587,300	
董監事酬勞		211,200		144,000	

上述103及102年度員工紅利及董監事酬勞與前一年度財務報表估列之員工紅利及董監事酬勞之差異分別為1,330千元及385千元,主要係因估計改變,分別調整為104及103年度之損益。

有關本公司董事會及股東會決議之員工酬勞(紅利)及董監事酬勞資訊,請至臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。 截至104年及103年12月31日止,本公司員工人數分別為28,921人及29,563人。

二十、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅主要組成項目

所得稅費用之主要組成項目如下:

	104年度		103年度(調整後	2)
當期所得稅				
當年度產生者	\$	1,995,861	\$	1,464,096
以前年度之調整	(24,609)		27,218
境外所得已繳納所得稅		_		23,074
		1,971,252		1,514,388
遞延所得稅				
當年度產生者		983,227		1,010,216
認列於損益之所得稅費用	\$	2,954,479	\$	2,524,604

會計所得與所得稅費用之調節如下:

	104年度			103年度(調整後)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$	22,433,352		\$	26,161,126	
税前淨利按法定稅率17%計算之所得稅費用	\$	3,813,670		\$	4,447,391	
稅上不可減除之費損		111,501			54,879	
暫時性差異之產生及迴轉	(1,952,154)		(2,346,012)	
 Rander Rander	(255,528)		(353,881)	
未分配盈餘加徵		561,104			462,781	
所得稅抵減	(282,732)		(801,062)	
遞延所得稅淨變動		983,227			1,010,216	
以前年度所得稅調整	(24,609)			27,218	
境外所得已繳納所得稅					23,074	
認列於損益之所得稅費用	\$	2,954,479		\$	2,524,604	

由於105年度股東會盈餘分配情形尚具不確定性,故104年度未分配盈餘加徵10%所得稅之潛在所得稅後果尚無法可靠決定。

(二) 認列於其他綜合損益之所得稅

	104年度		103年度(調	整後)
遞延所得稅				
確定福利計畫再衡量數	(\$	6,751)	\$	4,693

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下:

104年度

		年初餘額 認列於損益		認列於其他綜合損益		益 年底餘額		
遞延所得稅資產(負債)								
暫時性差異	-							
不動產、廠房及設備	(\$	2,724,143)	(\$	796,577)	\$	_	(\$	3,520,720)
確定福利退休計畫		382,007		15,974	(6,751)		391,230
其他		223,032		39,127				262,159
	(2,119,104)	(741,476)	(6,751)	(2,867,331)
投資抵減		241,751	(241,751)		-		_
	(\$	1,877,353)	(\$	983,227)	(\$	6,751)	(\$	2,867,331)

103年度(調整後)

		年初餘額	認列於損益		認列於其他綜合損益		認列於損益認列於其他綜			年底餘額
遞延所得稅資產(負債)										
暫時性差異										
不動產、廠房及設備	(\$	1,879,400)	(\$	844,743)	\$	_	(\$	2,724,143)		
確定福利退休計畫		415,519	(38,205)		4,693		382,007		
其他		114,744		108,288				223,032		
	(1,349,137)	(774,660)		4,693	(2,119,104)		
投資抵減		477,307	(235,556)				241,751		
	(\$	871,830)	(\$	1,010,216)	\$	4,693	(\$	1,877,353)		

截至104年12月31日止,下列增資擴展產生之所得可享受3年或5年冤稅:

增資擴展案	死稅期間
93年增資擴展案	101.01~105.12
94年增資擴展案	101.01~105.12
合併繼受日月鴻96年增資擴展案	102.01~104.12
96年增資擴展案	105.01~109.12
97年增資擴展案	103.01~107.12

(五) 與投資相關之未認列遞延所得稅負債

截至104年及103年12月31日止,與投資子公司有關且未認列為遞延所得稅負債之應課稅暫時性差異分別為7,729,422千元 及6,934,791千元。

(六) 兩稅合一資訊

104年及103年12月31日本公司之未分配盈餘均屬87年度(含)以後產生,股東可扣抵稅額帳戶餘額104年及103年12月31日分別為1,913,243千元及934,038千元。

104及103年度盈餘分配適用之稅額扣抵比率分別為8.66%(預計)及6.88%。

(七) 所得稅核定情形

本公司截至101年度之營利事業所得稅結算申報案件,業經稅捐稽徵機關核定。惟本公司對93至97年度核定内容不服,已 依法提起行政救濟並於104年第2季達成和解。上述相關所得稅影響數已分別估列於核定年度所得稅費用項下。

二一、每股盈餘

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下:

本年度淨利

	104年度		103年度(調整後)			
本年度淨利	\$	19,478,873	\$	23,636,522		
具稀釋作用潛在普通股之影響						
子公司發行員工認股權憑證	(210,126)	(260,925)		
可轉換公司債		901,187		931,344		
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	\$	20,169,934	\$	24,306,941		

股數

	單位:干股
104年度	103年度
7,652,773	7,687,930
455,671	375,271
86,994	101,850
54,626	55,643
8,250,064	8,220,694
	7,652,773 455,671 86,994 54,626

本公司得選擇以股票或現金發放員工紅利或酬勞,於計算稀釋每股盈餘時,須假設員工紅利或酬勞將採發放股票方式,並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數,以計算稀釋每股盈餘。於次年度股東會決議員工紅利或酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時,亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二二、股份基礎給付協議

(一) 員工認股權計畫

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才,激勵員工並提昇員工向心力,業經主管機關核准發行5次員工認股權憑證(其中104年4月核准發行100,000千單位),每單位得認購本公司普通股1股,並以等於或不低於給與日當日之普通股股票收盤價為行使價格。該認股權憑證給與對象包含本公司及子公司之全職正式員工,且存續期間為10年,不得轉讓,持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿2年才可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時,認股權行使價格依規定公式予以調整。

本公司發行之員工認股權憑證相關資訊如下:

		10	14年度		10	103年度		
認股權憑證	Ē	単位(千)	-) 加權平均行使價格(元)		單位(千)	加權平均行	使價格(元)	
年初流通在外		209,745	\$ 20.7		285,480	\$	20.5	
本年度給與		94,270	36.5		_		_	
本年度沒收	(1,975)	30.3	(1,515)		20.5	
本年度逾期失效	(730)	11.1	(322)		13.5	
本年度行使	(48,703)	20.6	_(73,898)		19.7	
年底流通在外		252,607	26.6	_	209,745		20.7	
年底可行使		158,103	20.8	_	189,240		20.7	
本年度給與之認股權加權平均公允價值(元)	\$	7.18~7.39		-	<u> </u>			

104及103年度執行之本公司員工認股權,其於執行日之加權平均股價分別為38.8元及35.1元。

截至資產負債表日止,本公司發行之流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下:

	執行價格之範圍(5	執行價格之範圍(元) 加權平均剩餘合約期限(年			
104年12月31日	\$	20.4~22.6		3.5	
		36.5		9.7	
103年12月31日		11.1~13.5		0.4	
		20.4~22.6		4.4	

子公司ASE Mauritius Inc.96年12月發行之員工認股權憑證,發行條件與本公司相同,並給與本公司員工19,265千單位,104及103年度均無行使。截至104年及103年12月31日止,可行使之員工認股權憑證均為19,265千單位,加權平均行使價格均為美金1.7元。

子公司環誠員工認股權憑證之發行條件與本公司相同,惟環誠分別於104年及103年12月修改96年度發行之員工認股權憑證辦法,將存續期間自11年延長至12年及自12年再延長為13年。因於既得日後修改,分別增額之公允價值8,289千元及5,952千元立即認列為104及103年度酬勞成本。環誠給與本公司員工20,718千單位,相關資訊如下:

	10	04年度	10	03年度
認股權憑證	單位(千)	加權平均行使價格(元)	單位(千)	加權平均行使價格(元)
年初流通在外	20,135	\$ 2.1	20,344	\$ 2.1
本年度沒收	(19)	2.8	_	
本年度行使	(1,803)	1.9	_	
子公司移轉	345	2.8	(209)	2.6
年底流通在外	18,658	2.1	20,135	2.1
年底可行使	18,239	2.1	18,446	2.0

(二) 認股權公允價值資訊

本公司104年度發行之員工認股權係採用Hull & White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型以估計給與日認股權之公允價值,評價模型所採用之參數分別如下:

	本公司
	36.5元
行使價格	36.5元
預期股價波動率	27.02%
合約期間	10年
預期股利率	4.00%
無風險利率	1.34%

預期股價波動率係基於本公司過去10年歷史股票價格波動情形,且在Hull & White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型下,為將提早執行之效果納入考量,係假設於既得期間屆滿後之股票價格為行使價格1.88倍時,員工將執行認股權。104及103年度本公司及子公司合計認列之員工認股權之酬勞成本分別為133,496千元及110,157千元。

二三、非現金交易

本公司於104及103年度進行下列非現金交易之投資活動:

	104年度		103年度	Į.
同時影響現金及非現金項目之投資活動				
不動產、廠房及設備增加數	\$	17,651,585	\$	27,572,214
支付之資本化利息	(34,510)	(47,204)
預付設備款增加		30,488		30,453
應付款項減少(增加)		459,047	(1,696,412)
支付現金數	\$	18,106,610	\$	25,859,051
出售不動產、廠房及設備價款	\$	180,846	\$	206,009
其他應收款增加	(65,870)	(18,951)
收取現金數	\$	114,976	\$	187,058

二四、營業租賃協議

本公司高雄廠之廠房用地係向政府租用,其租期將陸續於124年6月底前屆滿。租期屆滿時得予續約,但政府得於該土地公告地價增高時調整租金,並得於若干條件下終止租約。此外本公司亦簽有建築物及機器設備之營業租賃合約。 104及103年度認列之租金費用分別為604.360千元及479.838千元。

二五、 資本風險管理

本公司資本結構係由淨債務及權益組成,而資本管理的目標是保障本公司能夠持續經營,並進而藉由將債務及權益餘額最適化,以使股東報酬極大化,是以定期檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險,並藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

除附註十四所述外,本公司尚無須遵循之其他外部資本規定。

二六、 金融工具

(一) 公允價值之資訊-非按公允價值衡量之金融工具

1. 帳面金額與公允價值有重大差異之金融資產及金融負債

除以攤銷後成本衡量之應付公司債外,本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近 其公允價值。104年及103年12月31日應付公司債外之帳面金額及公允價值如下:

資產負債表日	資產負債表日帳面金額		公允價值
104年12月31日	\$	26,101,086	\$ 26,507,124
103年12月31日		19,270,613	19,828,076

2. 公允價值衡量層級

上述應付公司債之公允價值屬第3等級公允價值衡量,係按現金流量折現分析或最近一次交易價格決定之。

(二) 公允價值資訊-按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

104年12月31日

	第1等	級	第2等級	第3等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產					
私募可轉換公司債	\$	-	\$ 100,500	\$ _	\$ 100,500
衍生金融資產					
換匯合約		_	1,389,931	_	1,389,931
遠期外匯合約		-	7,745	_	7,745
外幣選擇權合約			5,020	_	 5,020
合計	\$		\$ 1,503,196	\$ _	\$ 1,503,196
備供出售金融資產					
有限合夥	\$	_	\$ _	\$ 390,987	\$ 390,987
非上市(櫃)公司股票		_	_	82,120	82,120
合計	\$		\$ _	\$ 473,107	\$ 473,107
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債					
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$	_	\$ 2,632,565	\$ _	\$ 2,632,565
遠期外匯合約		_	22,045	_	22,045
換匯合約		-	14,876	_	14,876
利率交換合約		_	119	-	119
合計	\$		\$ 2,669,605	\$ _	\$ 2,669,605
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·

103年12月31日

	第1等	第1等級		第2等級		第3等級		合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產								
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產								
私募可轉換公司債	\$	_	\$	100,500	\$	_	\$	100,500
衍生金融資產								
換匯合約		_		1,888,449		_		1,888,449
遠期外匯合約				1,234				1,234
合計	\$		\$	1,990,183	\$		\$	1,990,183

		第1等級		第1等級		第2等級		第3等級		合計	
備供出售金融資產											
基金受益憑證	\$	400,007	\$	_	\$	_	\$	400,007			
有限合夥		_		_		438,953		438,953			
非上市(櫃)公司股票						103,194		103,194			
合計	\$	400,007	\$	_	\$	542,147	\$	942,154			
透過損益按公允價值衡量之金融負債											
衍生金融負債											
可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	\$	-	\$	2,520,606	\$	_	\$	2,520,606			
換匯合約		-		13,726		_		13,726			
遠期外匯合約				6,086				6,086			
合計	\$		\$	2,540,418	\$		\$	2,540,418			

104及103年度尚無第1等級與第2等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 金融資產以第3等級公允價值衡量之調節

本公司以第3等級公允價值衡量之金融資產,係列入備供出售金融資產-非流動項下之無公開報價之權益工具投資,104 及103年度之調節如下:

	104年度	Į.	103年度	
年初餘額	\$	542,147	\$	522,902
購買		1,322		38,793
處分	(34,203)		_
認列於其他綜合損益	(36,159)	(19,548)
年底餘額	\$	473,107	\$	542,147

3. 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

(1) 第2等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具-換匯合約、遠期外匯合約、外幣選擇權合約及	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察遠期匯率或利率及合約所訂匯率或利率估計未來現金
利率交換合約	流量,並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。
衍生工具-可轉換公司債轉換、贖回與賣回權	選擇權定價模式:納入現值技術並反映選擇權之時間價值及內含價值。
私募可轉換公司債	現金流量折現法:按資產負債表日之可觀察股價,及合約所訂之轉換價格估計未來現金流量,並
	以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

(2) 第3等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

無活絡市場之非上市(櫃)公司股票係以市場法估計公允價值,其判定係參考公司近期籌資活動、技術發展情形、同種類公司評價、市場狀況及其他經濟指標等。

有限合夥投資係以現金流量折現法及類比成數技術估計公允價值。現金流量折現法下之重大不可觀察輸入值分別為 折現率12.34%及長期成長率2.50%。當折現率增加或長期成長率降低,將導致該等投資公允價值減少。而類比成數 技術下之重大不可觀察輸入值為EBITDA成數9.73。當EBITDA成數減少,將導致該等投資公允價值減少。

(三) 金融工具之種類

	104年12月31日		103年12月31日	
金融資產				
透過損益按公允價值衡量	_			
指定透過損益按公允價值衡量	\$	100,500	\$	100,500
持有供交易		1,402,696		1,889,683
備供出售金融資產		473,107		942,154
放款及應收款(註1)		26,584,110		34,476,934

		104年12月3	1日	103年12月31日	3
	金融負債				
	透過損益按公允價值衡量				
	持有供交易	\$	2,669,605	\$	2,540,418
	以攤銷後成本衡量(註2)		137,574,859		101,542,763

註1:餘額係包含現金、應收帳款(含關係人)、其他應收款(含關係人)、其他金融資產等以攤銷後成本衡量之放款及應收款。

註2:餘額係包含短期借款、應付短期票券、應付帳款(含關係人)、其他應付款(含關係人)、應付公司債、長期借款及長期應付款等以攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司從事衍生性商品交易之經營避險策略,主要係以確保公司穩健、安全經營為原則。從事衍生性金融商品交易時,應依其交易目的區分為「避險性」及「非避險性」兩種交易,除依規定分別適用不同部位限制外,以避險為目的之交易其商品的選擇應以規避本公司業務經營所產生之收入、支出、資產或負債等風險為主,持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。

風險管理部門係為專責監督風險以減輕暴險之單位,每月就持有部位、交易餘額及損益狀況對財務長提出報告。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險以及利率變動風險。從事各式衍生金融工具以管理所承擔之外幣匯率及利率風險,因此匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷,而利率風險亦因預期之資金成本已固定,故市場價格風險並不重大。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之進銷貨交易及融資活動,因而產生匯率變動暴險。為避免因匯率變動造成外幣資產或負債價值波動,本公司使用衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用,可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

本公司於資產負債表日具重大影響之非功能性貨幣計價之資產及負債,以及具匯率風險暴險之衍生工具外幣合約金額,參閱附註三一。

本公司主要受到美金及日幣兌新台幣匯率波動之影響。本公司内部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度 比率為1%,敏感度分析之範圍包括主要之金融資產及金融負債。當資產負債表日美金及日幣兌新台幣變動1%時, 104及103年度稅前淨利影響數將分別約為35,000千元及3,400千元。上述稅前淨利影響數業已考量避險合約及被避 險項目之影響,惟資產負債表日之外幣暴險無法反映年中暴險情形。

(2) 利率風險

本公司除發行固定利率之公司債及舉借固定利率借款外,主係以浮動利率借入資金,因而產生利率暴險,市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動,而產生未來現金流量之波動。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下:

	104年12月31	103年12月31日		
具公允價值利率風險				
金融負債	\$	7,981,190	\$	21,736,100
具現金流量利率風險				
金融資產		8,710,362		11,432,949
金融負債		75,431,163		57,040,407

對於浮動利率之資產及負債,本公司內部向主要管理階層報告利率風險時所使用之變動率為100個基點,若資產負債表日利率變動100個基點(1%),在所有其他變數維持不變之情況下,本公司104及103年度之稅前淨利將分別增減約677,000千元及456,000千元。

(3) 其他價格風險

本公司持有備供出售金融資產受權益價格暴險之影響。若資產負債表日權益價格變動1%,104及103年度稅前其他 綜合損益將分別增減約4,700千元及9,500千元。

此外,本公司發行於海外無擔保轉換公司債亦受本公司股票價格暴險之影響。本公司向主要管理階層報告價格風險時所使用之敏感度比率為7%。若資產負債表日本公司股票價格增加或減少7%,104及103年度稅前淨利將分別減少約605,000千元及651,000千元或分別增加約638,000千元及608,000千元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。本公司之信用風險,主要係來自於現金、應收款項及其他金融資產等。最大之信用風險暴險與個體資產負債表上之金融資產帳面價值相同。

本公司主係與信譽卓著之對象進行交易,並訂有授信政策及應收帳款管理程序以確保應收款項之回收及評價。另交易 對象涵蓋衆多客戶及銀行,並無重大集中的信用暴險。

3. 流動性風險

本公司透過管理適當之營運資金及融資額度以支應公司營運及資本支出之現金流量需求,另本公司流動負債之部分債權人為本公司之子公司,是以無被要求立即清償之風險,且本公司亦監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合約條款之遵循,故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

本公司可被要求立即清償之金融負債,係列於下表中最早之期間內,不考慮交易對手立即執行該權利之機率;其他非衍生性金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

以浮動利率支付之利息現金流量,其未折現之利息金額係依據資產負債表日之利率做為估計未來利息現金流量之基礎。

104年12月31日

	要求即	要求即付或短於1個月 1至3個月		3個月至1年		1至5年		超過5年		
非衍生金融負債										
無附息負債	\$	7,500,676	\$	7,819,035	\$	144,065	\$	_	\$	_
浮動利率工具		1,745,677		39,953,192		2,415,098		32,227,631		_
固定利率工具		12,344,873		3,028		27,535,656		3,830,690		
	\$	21,591,226	\$	47,775,255	\$	30,094,819	\$	36,058,321	\$	_

103年12月31日

	要求即付或短於1個月		1至3個月		3個月至1年		1至5年		超過5年	
非衍生金融負債										
無附息負債	\$	8,339,715	\$	8,817,318	\$	66,299	\$	_	\$	_
浮動利率工具		11,462,504		2,025,963		26,638,522		17,648,985		_
固定利率工具		582,373		778,550		568,920		21,862,951		
	\$	20,384,592	\$	11,621,831	\$	27,273,741	\$	39,511,936	\$	_

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額,將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

下表詳細說明本公司針對衍生性金融工具所作之流動性分析,就採淨額交割之衍生性金融工具,係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製:就採總額交割之衍生性金融工具,係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。當應付或應收金額不固定時,揭露之金額係依資產負債表日殖利率曲線所推估之預計利率決定。

104年12月31日

	要求即付或知	短於1個月	1至3個月	3個月至1年	超過1年
淨額交割					
遠期外匯合約	(\$	23)	\$ 75	\$ _	\$ _
外幣選擇權			8,735	_	
	(\$	23)	\$ 8,810	\$ 	\$

	要求即付或短於1個月		1至3個月		3個月至1年		超過1年	
總額交割								
遠期外匯合約								
流入	\$	467,241	\$	_	\$	_	\$	_
流出	(459,550)						
		7,691						
換匯合約								
流入		7,250,361		17,601,055		34,597,550		-
流出	(7,037,259)	(17,173,087)	(33,627,250)		
		213,102		427,968		970,300		
利率交換								
流入		12,603		12,466		25,069		-
流出	(11,595)	(11,469)	(23,063)		
		1,008		997	_	2,006		
	\$	221,801	\$	428,965	\$	972,306	\$	

103年12月31日

	要求即	要求即付或短於1個月		1至3個月		3個月至1年	超過1年	
總額交割								
遠期外匯合約								
流入	\$	520,506	\$	_	\$	-	\$	_
流出	(525,390)						
	(4,884)						
換匯合約								
流入		4,234,700		3,323,250		31,808,250		-
流出	(4,064,710)	(3,147,315)	(30,099,780)		
		169,990		175,935		1,708,470		
	\$	165,106	\$	175,935	\$	1,708,470	\$	_

二七、 關係人交易

本公司與關係人間之重大交易如下:

(一) 營業收入

關係人類別	104年度	103年度
子公司	\$ 9,394,518	\$ 9,375,056

(二) 進貨

	關係人類別	104年度	Ę	103年月	隻
子公司		\$	3,374,644	\$	4,840,949
合資			57	_	
		\$	3,374,701	\$	4,840,949

公司與關係人之交易條件與一般廠商及客戶相當,收付款條件主係月結60天。關係人交易產生之未實現銷貨毛利業已銷除。

(三) 應收關係人款項

帳列項目	關係人類別	104年12月31日	103年12月31日
應收帳款-關係人	子公司	\$ 2,281,805	\$ 5,082,423
其他應收款-關係人	子公司 合資	\$ 154,363 6,717	\$ 36,699
		\$ 161,080	\$ 36,699

應收關係人款項末收取保證。104及103年度之應收關係人款項並未提列呆帳費用。

(四) 應付關係人款項(不含向關係人借款)

帳列項目	關係人類別	104年12月31日		103年12月31	日
應付帳款-關係人	子公司	\$	910,150	\$	1,223,750
	合資		61		
		\$	910,211	\$	1,223,750
其他應付款-關係人	子公司	\$	1,912,834	\$	1,840,573
	關聯企業		41,245		6,328
		\$	1,954,079	\$	1,846,901

流通在外之應付關係人款項餘額係未提供擔保且將以現金清償之貨款、設備款及代收款等。

(五) 取得之不動產、廠房及設備

關係人類別	104年度	103年度
子公司	\$ 180,658	\$ 559,544
關聯企業	2,970,600	4,889,732
	\$ 3,151,258	\$ 5,449,276

(六) 處分不動產、廠房及設備

		104年度			103年度			
關係人類別	處分價款 處分利益		處分利益			處分利益		
子公司	\$	142,442	\$	922	\$	118,358	\$	1,299

(七) 向關係人借款

關係人類別		104年12月3	1日	103年12月31日		
- 子公司		\$	38,237,875	\$	28,806,723	

本公司向關係人借款之借款利率與市場利率相當。

(八) 背書保證

關係人類別	104年12月31日	103年12月31日		
子公司	\$ 12,900,154	\$ 12,905,228		

(九) 其他關係人交易

帳列項目	關係人類別	1043	年度		103	3年度	
服務費支出	子公司		\$	921,269		\$	920,727
捐贈	實質關係人			100,000			115,000
			\$	1,021,269		\$	1,035,727

(十) 對主要管理階層之薪酬

	104年度		103年	度
短期員工福利	\$	531,847	\$	632,920
退職後福利		1,017		1,404
股份基礎給付		10,368	_	29,125
	\$	543,232	\$	663,449

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、質抵押之資產

除附註九所述外,本公司104年及103年12月31日分別提供定期存單181,796千元及181,283千元作為進口原物料之關稅擔保及雇用外籍勞工之保證金。

二九、 重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註所述者外,本公司於資產負債表日之重大承諾事項及或有事項如下:

(一) 重大承諾

- 1. 截至104年及103年12月31日止,本公司已開立未使用之信用狀金額約0千元及59,300千元。
- 2. 截至104年及103年12月31日止,本公司已承諾購置之不動產、廠房及設備金額約5,781,000千元及5,564,000千元,其中已支付金額為1,369,971千元及641,684千元。
- 3. 本公司為善盡環境保護之社會責任,於102年12月經董事會決議通過預計未來將捐獻每年至少1億元、至少30年、總金額至少30億元以推動台灣環保相關工作。

本公司已分別於105及104年1月經董事會決議提撥100,000千元交由財團法人日月光文教基金會繼續執行環保相關捐贈作業,以持續協助國内環保相關工作之推動及公益活動。

(二) 不可取消之營業租賃承諾未來給付總額

	104年12月31日	
1年内	\$	104,804
超過1年但未超過5年		173,816
超過5年		198,090
	\$	476,710

三十、重大之期後事項

本公司於105年1月分別發行國内無擔保公司債5年期7,000,000千元及7年期2,000,000千元,票面利率分別為1.30%及1.50%,每年付息一次。

三一、外幣金融資產及負債之匯率資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下:

	外幣	匯率		帳面金	額
104年12月31日					
貨幣性金融資產					
美金	\$ 2	2,407,360	USD1=NTD32.825	\$	79,021,592
日幣	3	3,285,728	JPY1=NTD0.2727		896,018
貨幣性金融負債					
美金	2	2,512,262	USD1=NTD32.825		82,465,000
日幣	3	3,606,237	JPY1=NTD0.2727		983,421
103年12月31日					
貨幣性金融資產					
美金	\$ 2	2,119,319	USD1=NTD31.65	\$	67,076,446
日幣	3	3,319,802	JPY1=NTD0.2646		878,420
貨幣性金融負債					
美金	2	2,131,682	USD1=NTD31.65		67,467,735
日幣	3	3,111,135	JPY1=NTD0.2646		823,206

具重大影響之外幣未實現兌換捐益如下:

	104年度			103年度			
外幣	匯率		淨兌換損益	匯率	3	爭兌換損益	
美金	USD1=NTD32.825	(\$	2,279,778)	USD1=NTD31.65	(\$	2,095,242)	
日幣	JPY1=NTD0.2727	(6,981)	JPY1=NTD0.2646		36,965	
		(\$	2,286,759)		(\$	2,058,277)	

三二、其他

- (一)本公司於104年11月收到臺灣高雄地方法院所送達之起訴書狀,係矽品訴請法院確認本公司請求於矽品股東名簿記載 為股東之請求權不存在。本公司已委請律師研究矽品所提訴訟内容,並已依法向法院提出答辯,以維護本公司權益。 法院尚未開庭審理本件訴訟,本公司預計對合併財務狀況及財務績效並無重大影響。
- (二) 高雄市政府環境保護局(以下稱「環保局」)於102年12月20日以本公司違反水污染防治法作成「高市環局土字第 10243758100號函」暨「高市環局水處字第30-102-120022號裁處書」,科處本公司110,065千元(已列入102年度其他 利益(損失)項下)(以下稱「罰鍰處分」),嗣於103年4月7日將罰鍰更正為109,359千元,復於104年9月4日將罰鍰更正為102,014千元。本公司於103年1月17日委請律師依法對該罰鍰處分提起訴願,於訴願遭駁回後,委請律師依法提起行政訴訟,請求撤銷該罰鍰處分,案件現由高雄高等行政法院審理中。因前述事件,高雄地方法院檢察署於103年1月3日依違反廢棄物清理法等法對本公司提起公訴,高雄地方法院審理後於103年10月20日宣判,以本公司違反廢棄物清理法第47條規定判處新臺幣3,000千元罰金(已列入103年度其他利益(損失)項下)。嗣本公司依法向高雄高等法院提出上訴,高雄高等法院業於104年9月29日判決本公司無罪確定。

三三、 附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊:

- 1. 資金貸與他人:詳附表一。
- 2. 為他人背書保證:詳附表二。
- 3. 年底持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資部分): 詳附表三。
- 4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達3億元或實收資本額20%以上:詳附表四。
- 5. 取得不動產之金額達3億元或實收資本額20%以上:詳附表五。
- 6. 處分不動產之金額達3億元或實收資本額20%以上:無。
- 7. 與關係人進、銷貨之金額達1億元或實收資本額20%以上:詳附表六。
- 8. 應收關係人款項達1億元或實收資本額20%以上:詳附表七。
- 9. 從事衍生工具交易:詳附註七。
- 10. 被投資公司資訊(對非屬大陸地區之被投資公司直接或間接具重大影響、控制或合資權益者): 詳附表八。

(三) 大陸投資資訊

- 1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本年度損益及認列之投資損益、年底投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額:無。
- 2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項,及其價格、付款條件、未實現損益:
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比:詳附表六。
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比:無。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額:無重大交易。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的:無。
 - (5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當年度利息總額:無。
 - (6) 其他對當年度損益或財務狀況有重大影響之交易事項,如勞務之提供或收受等:無。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難之情事:無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 一、財務狀況:最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響,若影響重大者應 說明未來因應計畫。
- (一) 本公司資產報酬率、股東權益報酬率及純益率減少:主要係因本年度電子製造代工服務產品獲利下降致使 比率減少。
- (二) 資本公積增加,主要係本年度處分子公司環旭上海之部分股權,因採權益交易處理而將處分利得認列於資本公積項下所致。
- 二、財務績效:最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與 其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。
- (一) 營業外收入及支出:營業外收入增加,主要係因本年度操作透過損益按公允價值衡量之金融工具之獲利狀況較去年度增加所致。
- 三、現金流量:最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性 分析。
- (一) 最近年度現金流量分析

現金流量比率增加,主係業績持續成長,營業活動淨現金流入增加所致。

(二) 未來一年現金流動性分析

單位:新台幣仟元

年初現金餘額①	預計全年來自營業活動	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足	額之補救措施
- 竹児立 師領①	淨現金流量②	別引 土 牛 児 立 派 山 里 ③	1+2-3	投資計劃	理財計劃
\$55,251,181	\$43,377,611	\$58,612,352	\$40,016,440	-	-

^{1.}現金流量變動情形分析

(1)營業活動:預計105年度主係營業淨利增加、營業資產及負債淨變動所產生之淨現金流入增加所致。

(2)投資活動:預計105年度主係購置機器設備、擴建廠房及取得長期股權投資。

(3)融資活動:預計105年度主係舉借、償還長短期負債及支付盈餘分配。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位:新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形	
	貝际以识别之貝亚尔斯	貝际以识别元上口别	門而貝並秘訣	一〇五年度	
擴建廠房	營運資金及銀行借款	105.12	6,646,562	6,646,562	
購置機器設備	營運資金及銀行借款	105.12	21,763,122	21,763,122	

本公司截至目前為止對於未來二至五年之資本支出及預計可能產生效益情況尚無法合理估計。

(二)預計可能產生效益

A. 預計將增加之產銷量、值及毛利

單位:數量仟個/新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
一○五	半導體製造封裝	1,972,452	1,945,439	3,980,148	1,047,979
一○五	半導體製造測試	1,381,817	1,347,685	774,481	265,058

註:僅針對一〇五年度重大之資本支出於一〇五年度預計產生之效益估算。有關EMS部分,因資本支出比重較小及產業特性難以預估,故未列入。

B. 其他效益說明:無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫:

本公司最近年度之轉投資政策主要係以大陸投資事業之投資為主,並以核心競爭力為主要考量,對每一投資案皆經審慎評估後為之。

本公司轉投資事業獲利主因為轉投資事業之生產營運達經濟規模及管理制度落實,部份子公司虧損係處於發展擴充階段之故,本公司將持續輔導以加速子公司達到獲利目標。

六、風險事項分析評估:

(一) 最近年度及截至年報刊印日止之利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

1. 利率變動:本公司及子公司因應營運活動所需之現金部位,均已做適當的彈性調度調整,公司損益受利率變動衝擊之影響甚小。

未來仍將密切注意利率走勢,運用低利率之融資工具,採用有利之利率條件,以維持低融資成本及適足活絡之融資額度為主,規避營運上可能產生之利率風險。

2. 匯率變動:本公司及子公司之避險策略係採取自然避險為原則,配置低風險、安全且避險性高之投資標的,公司損益並無受匯率變動影響之疑慮。

未來將關注國際經濟事件及匯率變化,並以降低匯率變動風險為主要管理方向,同時亦審慎檢視公司資金配置,因 應匯率變動造成之影響,期達有效管理之目標。

3. 通貨膨脹情形:本公司及子公司未有因通貨膨脹而對損益產生重大影響之情事。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及 未來因應措施:

本公司及子公司均採取穩健保守操作策略,並未從事高風險、高槓桿之投資。本公司已依據證期局相關法令及規定, 訂定以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序,包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」 及「取得或處分資產處理程序」。

未來公司仍將嚴恪遵守程序規範,所有交易均依相關規定辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之進度與研發費用:

1. 未來研發計劃(包括正在進行中)

封裝技術

	新技術 (Advanced Technology)				
	1. 晶片-晶片、晶片-晶圓堆疊技術(Die-to-Die, Die-to-Wafer Stacking)				
	2. 微間距銅柱覆晶封裝技術(Fine Pitch Cu Pillar FC Solution)				
	3. 矽材基板系統封裝技術(Si Interposer SiPTechnology)				
	4. 矽材光基板系統封裝技術(Si Optical Bench SiP Technology)				
	5. 熱壓融接技術(Thermo-Compression Bonding Technology)				
	6. 晶圓級微機電封裝(Wafer Level MEMS Packaging)				
	7. 内引腳式Map PoP堆疊技術PoP (Fan-in Map PoP Technology)				
	8. 外引腳式Map PoP堆疊技術PoP (Fan-out Map PoPTechnology)				
	9. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoPTechnology)				
3D系統封裝	10. 整合被動元件封裝技術(Integrated Passive Device)				
(3D SiP)	11. 基板内埋被動元件技術(Embedded Passives Laminate Substrate)				
	12. 矽材基板内埋被動元件技術(Embedded Passive Si Substrate)				
	13. 矽材基板内埋主動元件技術(Embedded Active Si Substrate)				
	14. 異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP)				
	15. 微間距面對面堆疊系統封裝(Fine Pitch CoC SiP Solution)				
	16. 低頻分段式屏蔽技術(Compartment Shielding Technology)				
	17. 雙面選擇性區域封膠技術(Double Side Selective Molding Technology)				
	18. 2.nD微間距基板晶片堆疊封裝(2.nD Fine Line/Space Substrate Stacking)				
	19. 大板面外引腳式晶圓級封裝(Panel Level Fan-out/PoP Technology)				
	20. 可彎曲基板及封裝技術(Flexible Substrate & Assembly Technology)				
	1. 高功率、高亮度LED封裝方案(High Power/High Brightness LED Packaging Solution)				
光電封裝	2. 晶圓級白光LED封裝方案(Wafer Level White Light LED Packaging Solution)				
(OEP)	3. 光感測元件封裝技術(Optical Sensor Packaging Solution)				
	4. 光電整合傳導技術(Optical-Electronic Interconnection)				
	1. 晶圓穿導孔技術(Through Silicon Via)				
	2. 矽基板封裝技術(Silicon Substrate Technology)				
	3. 300mm二維外引腳式晶圓級封裝(300mm Wafer 2D Fan-out WLP)				
	4. 200mm三維外引腳式晶圓級封裝(200 mm Wafer 3D Fan-out WLP)				
	5. 細線RDL電鍍銅技術(Fine Line Cu-Plated RDLTechnology)				
	6. 4層Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(4-layer Polymer,Cu-Plated RDL Technology)				
晶圓級封裝	7. 低溫烘烤型Polymer 晶圓RDL電鍍鋼技術(LowTemperature Cure Polymer,Cu-Plated RDLTechnology)				
(WLCSP)	8. 晶圓級封裝切割再測試專案(Sawn Wafer Probing)				
	9. 多腳數/微型化之晶圓級晶片尺寸封裝產品技術開發計畫(High IO/Die Shrinkage WLCSP)				
	10. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL)				
	11. 線路重部製程與保護層疊層技術開發				
- - - -	12. 線路重佈製程線寬線距5um/5um技術開發				
	13. 薄片晶背貼合能力技術開發				
	14. 降低切割製成風險技術開發				
	14. 坪區切削表以風際以利用頭				

	1. 無核心層機板之覆晶封裝(Coreless Flip Chip Package)
	2. 20奈米超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(20 nm ELK Wafer Lead-Free FC)
	3. 300mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(300mm TSV Wafer 50 um CMP Technology)
	4. 超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術(SD Laser Technology on Thin ELK Wafer)
	5. 核心崁入式封膠製程封裝(Molded Core Embedded Package)
	6. 預切單顆成型封膠製程(Molded Pre-Singulated Package)
	7. 裸露晶體封裝(Exposed Mold UnderFill)
覆晶封裝 (Flip Chip)	8. 四方平面無引腳覆晶封裝(Flip Chip Quad Flat No Leads)
(i lip Grilp)	9. 覆晶封裝產品之極微距銅柱距離(Very Fine Pitch Cu Pillar Flip Chip Product)
	10. 高頻寬封裝堆疊技術開發(HBPOP Package Development)
	11. 銅凸塊於內埋式線路基板之開發應用(16奈米以下之覆晶封裝技術)
	12. 晶圓級20奈米覆晶封裝技術與微間距基板結構組合開發計畫(N20)
	13. 高階覆晶封裝型四方平面無引腳構裝開發計畫(FC QFN Development)
	14. 單層板内嵌式線路基版封裝研發(1L ETS (1 Layer Embeded Trace Substrate) Assembly)
	15. 2.5D 先進封裝製程(2.5D Advanced IC Assembly)
	1. MCU+BLE+AoP模組完整方案(MCU Wireless Connection Module Total Solution)
射頻模組 (RF Module)	2. 非圓柱覆晶式多模多類射頻前端模組完整方案(Irregular FC Cu-Pillar Multi-Band Multi-Mode SiP Module Solution)
(M. Module)	3. 基板内埋被動元件通訊模組(Embedded Passive Substrate Wireless Module)
	1. 14奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(14 nm Cu/ELK Wafer Wire Bond Solution)
	2. 15微米銅線製程開發(15 um Cu Wire Bond Technology Development)
	3. 新銅線材料製程開發(New Cu Wire Bonding Material Technology Development)
2014	4. 新打線材料製程開發(New Wire Bonding Material Technology Development)
銲線封裝 (Wire Bond Package)	5. 低成本、高效能aS3/aQFN封裝方案(Low Cost & High Performance aS3/aQFN)
(Wife Bolld Lackage)	6. 先進單層板的封裝技術開發(Single Layer Carrier Package Development)
	7. 四方平面無引腳產品於車用領域之應用(FC QFN for ATV Development)
	8. 高散熱材料評估 (High Thermal_HS Evaluation)
	9. 被動元件應用研發(Cap on Die)
無線通訊模組	1. 整合BB+RF(Multi-Bands)+DRAM+PMIC以及周邊被動元件複合式封裝SiP模組,偕同最新複合無線通訊技術通訊規格(Multiple
(Wireless Communication SiP	Mode Communication SiP Module Solution)
Module)	2. 超微小型高整合封裝功能模組(Highly Miniaturized and Integrated SiP Communication Function Module Solution)
	凸塊 (Bumping)
	1. 低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓為小型凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Micro Bump Plating Technology)
	2. 單層PI與單層銅 RDL 結構之晶圓級封裝技術(Single PI and Single RDL For WLCSP)
電鍍製程	3. 微小型銅柱凸塊技術(Micro Cu Pillar Bumping)
(Plating)	4. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程疊層技術開發(RDL+LF Bump)
	5. 線路重佈製程和銅柱製程疊層技術開發(RDL+Cu Pillar)
	6. 扇出型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(FOCoS_Cu Pillar)

測試技術

新測試技術 (New Test Technology)				
	1. 射頻晶圓測試技術(RF Wafer Probing Testing Technology)			
	2. 高密度多工並列測試技術(High Parallel Site Test Solution)			
	3. 晶圓級光通訊二極體老化測試(Wafer Level Photonic Laser Diode Burn-in Test)			
	4. 探針抗沾黏奈米層級鍍膜技術 (Pin Coating Technology For Probe Card)			
晶圓測試 (Wafer Probe)	5. 薄化晶圓晶粒復原測試技術 (Film Frame Probing Solution)			
(VVdici i lobe)	6. 多工溫度晶圓測試技術(Tri-Temp Wafer Probing)			
	7. 垂直銅柱晶圓針測技術(Copper Pillars Probing Solution)			
	8. 高密度多工並列測試技術(High Parallel Site Test Solution)			
	9. 超薄片晶圓測試技術(Thin-Wafer Test Solutions)			

	1. 802.11ac射頻系統晶片測試技術(802.11ac RF SOC Test Solution)
	2. 高速串列傳輸介面測試技術(USB3.0/PCIE Testing Technology)
	3. 重力感測器測試技術(G Sensor Testing Technology)
	4. 陀螺儀感測器測試技術(Gyro Sensor Testing Technology)
	5. 通用型無線通訊系統模組測試開發(Universal Wireless SiPTest System Development)
	6. 物聯網/穿戴式元件之低成本(non-ATE)測試技術開發(Low Cost Non-ATE Test Methodology For Low I/O Count Device Test, LoT/
	Wearable Devices)
	7. 高產出電源管理元件測試機開發(High UPH Power Management ICTester Development)
/	8. 多通道多功能多執行序之系統級封裝模組測試機開發(Multi-Channel Multi-Function, and Multi-Process SIP Tester Development)
後段封裝測試 (Final Test)	9. 高通道密度系統級晶片測試機開發(High Channel Density SOC Tester Development)
(i ilidi lest)	10. 硬體模組控制整合平台暨共用測試機介面開發(Hardware Module Controlled Platform and Common Tester User Interface
	Development)
	11. 光感元件測試技術(Optical Sensor Testing Solution)
	12. 感測器測試技術(Industrial/Consumer Sensing ICTesting Solution)
	13. 超高速介面元件測試技術(USB3.0 Type-C Testing Technology)
	14. 微機電產品測試技術(MEMS Testing Technology)
	15. 系統級封裝測試技術(SiP Testing Technology)
	16. 條狀封裝元件測試技術(Strip Device Testing Technology)
	17. 微小封裝型態測試(Tiny Package Testing Technology)
測試資料分析(Test Data Analysis)	巨量資料分析與探勘離型系統建置(Big Data Analysis/Mining Prototype System Build)

IPM模組製程技術

新製程技術 (New Process Technology)				
晶片印刷銲錫及LF組裝	1.5mm以上晶片焊錫In-Line組裝能力提高UPH。			
(Solder Paste Print Die Bond to Lead	2 (日 (日 (
Frame)	2.銲錫介面孔洞小於1%。			
被動元件印刷銲錫及LF組裝	1.銲錫一次性印刷及零件組裝至Lead-Frame提高UPH。			
(Solder Paste Print Passive	2.被動元件銲錫組裝至Lead-Frame技術。			
Component Bond to Lead Frame)	2.放動ルド・中級和农土Ledu-Flame放射。			
鋁打線LF組裝	 5mils以上鋁打線In-Line 網裝能力提高UPH。			
(Al Wire Bonding to Lead Frame)	STATE SHIP DIRECTION STATE STA			
LF背面銅散熱片露出及被動元件封裝	1.50µm間隙之被動元件封裝無空隙。			
(Passive Component & Expose Cu				
Heatsink Molding)	2.背面金屬散熟片露出之封裝技術。			

COB模組製程技術

新製程技術 (New Process Technology)				
焊線於軟性電路板	1.Ball bond在120µm板厚的軟性電路板之焊線技術。			
(Wire Bonding on FPC)	2.0.9 mil金線在軟性電路板上焊線良率提升。			

2. 預計再投入之進度與研發費用

封裝試產預計投入之研發費用為新台幣430,000仟元,另其他封裝研發費用預計投入新台幣3,864,000仟元。 測試試產預計投入之研發費用為新台幣48,000仟元,另其他測試研發費用預計投入新台幣5,000仟元。 模組製程技術測試試產預計投入之研發費用為新台幣37,000仟元。

- 3. 未來研發得以成功之主要影響因素
 - 先進封裝技術能力的建立並與現有封裝技術整合
 - 現有封裝及測試技術低成本最佳解決方案
 - 流程、製程標準化暨產業鏈整合
 - 關鍵新設備量產化驗證暨即時導入

- 封裝、測試、基板、模組、系統整合能力的建立與深耕
- 基板、元件、模組設計能力的建立與深耕
- 完善的產品研發流程及專案管理系統
- 結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本
- 客戶導向的組織設計與内部運作機制
- 充分掌握市場行銷之供需狀況,並依據市場動態與趨勢,先行開發先進封裝、基板與測試技術以確保技術領先地位, 適時提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案
- 研發人才培育機制之強化
- 知識管理系統之落實與強化
- 強化智慧財產權策略與管理
- 符合環保法規與綠色設計(Eco-design)之產品設計、研發與製造
- 研發效益、研發風險、時程及人員能夠有效管控
- 與標竿客戶策略聯盟、降低研發成本與風險
- 晶片-封裝-系統一元化設計(IC-package-system Co-design)
- 測試開發能力的建立與深根
- 研發核心技術能力的建立與深根

(四) 國内外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

- 1. 金據金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)發布之金管證審字第1030029342號及金管證審字第1030010325號函,本公司自104年起開始適用業經國際會計準則理事會(IASB)發布且經金管會認可之2013年版IFRS、IAS、IFRIC及SIC(以下稱「IFRSs」)及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定編製合併財務報告。另,業經IASB發布但未經金管會認可之IFRSs。對合併財務報告之影響,本公司將依照金管會時程持續評估並於預計時程完成。
- 2. 因應公司法及證券交易法之修訂,隨時檢視及修訂本公司管理辦法,以符合法令。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

- 1. 全球總體經濟的不確定性與不連續性為半導體產業的一大挑戰。因應措施是日月光透過與客戶及廠商的共同開發來符合客戶需求與降低成本及風險、持續觀察市場的脈動以及與客戶之間更緊密的互動來掌握客戶的需求與變化,並強化市場資訊的蒐集與分析來降低產品需求改變對科技所造成的影響。
- 2. 客戶市場競爭力與上市時程是新技術研發是否順利上市之關鍵。因應措施為充分掌握市場行銷趨勢與供需動態之狀況, 並依據市場趨勢方向與標竿客戶產品藍圖,先行開發關鍵技術暨專利以確保技術領先地位,結合產品開發和現有生產設 備相容性以降低研發成本,提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案。
- 3. 新技術研發創新的經驗中,開發經費與關鍵新設備扮演極為重要一環。因應措施為確保新技術和日月光未來藍圖發展一致,並積極和客戶策略聯盟,落實資源共享,以降低研發風險。日月光定期拜訪產業領先地位之客戶,透過技術研討會與標竿客戶共同規劃產品藍圖與產品規範,確保研發技術能符合客戶上市需求。
- 4. 日月光南投廠(ASENT)長期紮根於電力電子產品發展,生產軍用級和工業級的DCDC converter功率模組(Power Module)等產品,提供多項解決方案給高功率的電力電子工業應用,日月光透過與客戶的更密切互動來掌握客戶需求及其變化,並強化市場資訊的收集與分析來降低科技改變所帶來的影響。未來因應各國越來越重視智慧節能,運用我們長期紮根於電力電子產品經驗及資源,積極切入IGBT標準模組封裝及IPM智能模組為我們來發展的方向。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:

本公司一向秉持誠信、守法及善盡社會責任之永續經營理念,針對102年高雄廠廢水外洩的單一意外事件,公司勇於面對,積極處理並持續改善,為重塑企業形象盡最大的努力。有關本公司社會責任運作情形,請參閱本年報第22-24頁。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:

由於半導體市場成長前景樂觀,預計日月光集團2016年之成長幅度會超越2015年的成長率。至於投資部分,鑒於落實現有產能之充分及有效利用,日月光集團前幾年在產能上之擴充已能滿足部分成長之訂單,為提昇實質報酬率並降低投資風險,對於市場之成長乃以現有產能與設備為主,新設備之投資案,除因應新廠房之使用外,將以市場實際需求之必要性再做新投資的考量。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

- 1. 進貨過度集中容易因為供應端的生產異常或品質異常造成斷料,同時削減對供應端的議價能力。本公司對於設備與技術等供貨來源,訂定有分散供應來源的政策,針對少數供應集中的項透過技術交流與舉辦說明會等方式,集合供應鏈之共同努力,積極進行開發替代廠商(2nd Source);另外對於市場寡佔的國外供應來源,積極培植具技術研發潛力的國內協力廠商供貨,以達分散風險、降低成本的企業目標。
- 2. 本公司銷貨並無過度集中之情事。
- (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施: 無。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。

(十二) 訴訟或非訟事件:

- 高雄市政府環境保護局(以下稱「環保局」)於102年12月20日以本公司違反水污染防治法作成「高市環局土字第10243758100號函」暨「高市環局水處字第30-102-120022號裁處書」,科處本公司110,065千元(已列入102年度其他利益(損失)項下)(以下稱「罰鍰處分」),嗣於103年4月7日將罰鍰更正為109,359千元,復於104年9月4日將罰鍰更正為102,014千元。本公司於103年1月17日委請律師依法對該罰鍰處分提起訴願,於訴願遭駁回後,委請律師依法提起行政訴訟,請求撤銷該罰鍰處分,案件現由高雄高等行政法院審理中。
- 因前述事件,高雄地方法院檢察署於103年1月3日依違反廢棄物清理法等法對本公司提起公訴,高雄地方法院審理後於 103年10月20日宣判,以本公司違反廢棄物清理法第47條規定判處新臺幣3,000千元罰金(已列入103年度其他利益(損失) 項下)。嗣本公司依法向高雄高等法院提出上訴,高雄高等法院業於104年9月29日判決本公司無罪確定。
- 本公司於104年8月24日至9月22日依法向金融監督管理委員會申報公開收購矽品精密工業股份有限公司(下稱「矽品公司」)普通股779,000,000股,並於104年10月1日完成交割。嗣矽品公司於104年10月15日以本公司為被告,向高雄地方法院提起民事訴訟,請求法院確認本公司請求於股東名簿登載為矽品公司股東之請求權不存在。對此,本公司已委請律師處理本案進行答辯,以維權益。本件訴訟現尚由高雄地方法院審理中。

(十三) 其他重要風險及因應措施:無。

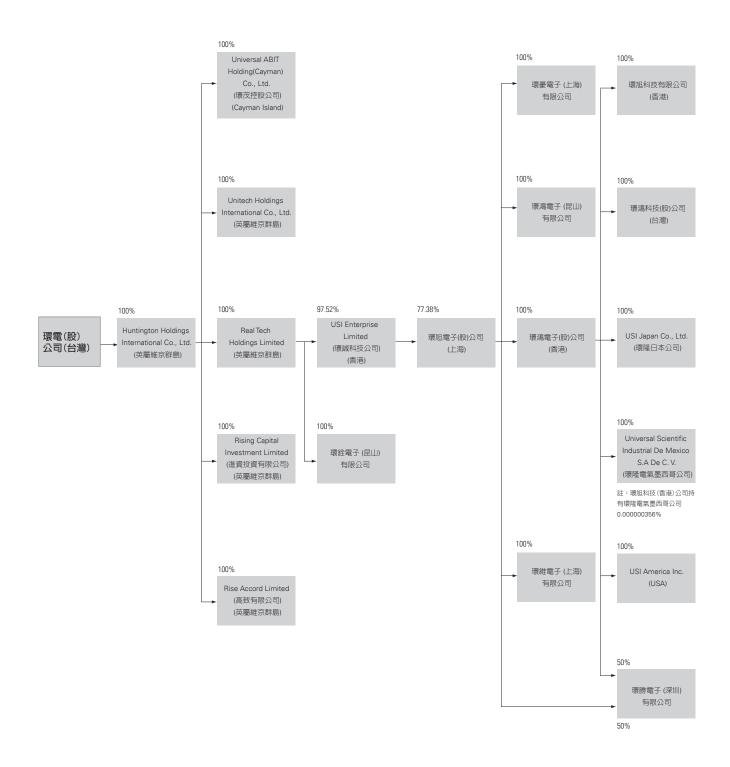
七、其他重要事項:無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖(104.12.31)





(二)各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
日月光半導體製造(股)公司	73年3月	高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號	NT\$79,029,290千元	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ASE Corporation	95年3月	Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, Grant Cayman, Cayman Islands	NT\$11,425,922干元 (US\$352,784干元)	從事專業性投資
日月光半導體(上海)有限公司	90年12月	上海張江高科技園區金科路2300號	NT\$4,236,563千元 (US\$133,812千元)	發光二極體、二極體顯器製造及印 刷電路板產銷
日月光電子股份有限公司	95年3月	高雄市楠梓加工出口區開發路73號	NT\$3,989,819干元	電子材料批發業、電子材料零售 業、國際貿易業
ASE Labuan Inc.	95年3月	Labuan F.T. Malaysia	NT\$4,099,954干元 (US\$126,184干元)	從事專業性投資
ASE Mauritius Inc.	95年4月	608, St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Republic of Mauritius.	NT\$7,046,629千元 (US\$217,800千元)	從事專業性投資
日月光半導體(香港)有限公司	97年4月	RMS 2702-3 ,27/F Bank of EAST ASIA Harbour view Centre, 56 Gloucester RD, Wan Chai ,HK	NT\$32,130千元 (US\$1,000千元)	從事貿易活動
ASE Test Limited (Singapore)	84年12月	1 Marina Boulevard #28-00 One Marina Boulevard, Singapore (018989)	NT\$659,075干元 (US\$27,356干元)	從事專業性投資
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	80年2月	Plot 20, Phase IV, Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang	NT\$2,019,907千元 (US\$62,260千元)	半導體產品封裝測試服務
ISE Labs,Inc.	72年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA94538, U.S.A	NT\$852干元 (US\$26干元)	半導體產品測試服務
ASE Singapore Pte. Ltd.	87年2月	2 Woodlands Loop Singapore 738074	NT\$984,851干元 (US\$30,056干元)	半導體產品封裝測試服務
ASETest Holdings, Ltd.	88年4月	Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.	NT\$162元 (US\$5元)	從事專業性投資
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	83年12月	10, Hoe Chiang Road, #17-02 Keppel Towers, Singapore	NT\$1,633,708千元 (SG\$71,429千元)	從事專業性投資
台灣福雷電子(股)公司	76年12月	高雄市楠梓加工出口區西五街十號	NT\$11,314,525干元	半導體產品測試服務
ASE (Korea) Inc.	56年3月	76, Saneopdanji-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea	NT\$3,031,771干元 (US\$97,976干元)	半導體產品封裝測試服務
ASE Japan Co., Ltd.	93年5月	1863, Iryuda,Takahata-machi, Higashiokitama- gun,Yamagata, 992-0324, Japan	NT\$105,802干元 (¥360,000干元)	半導體產品封裝測試服務
日月光電子元器件(上海)有限公司	94年1月	上海市張江高科技園區金科路2300號六號樓2層	NT\$383,640干元 (US\$12,000干元)	光電子器件等新型電子元器件、印 刷電路板產銷、提供技術諮詢服務
日月光封裝測試(上海)有限公司	89年12月	上海張江高科技園區郭守敬路669號	NT\$6,501,336干元 (US\$203,580干元)	半導體產品封裝測試服務
蘇州日月新半導體有限公司	90年5月	蘇州工業園區蘇虹西路188號	NT\$1,568,467千元 (US\$48,672千元)	半導體產品封裝測試服務
日月光半導體(威海)有限公司	90年12月	威海市經濟技術發展區出口加工區海南路16-1號	NT\$4,507,081千元 (US\$152,200千元)	半導體產品封裝測試服務
日月光集成電路製造(中國)有限公司	99年7月	上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室	NT\$3,149,000千元 (US\$100,000千元)	從事半導體封裝及測試之市場行銷 及客戶服務等業務
日月光半導體(昆山)有限公司	93年8月	江蘇省昆山市干燈鎖凇南路373號	NT\$8,350,204千元 (US\$268,000千元)	半導體產品封裝測試服務
無錫通芝微電子有限公司	99年3月	無錫市新區閩江路21號52地塊29-B廠房	NT\$356,682干元 (人民幣73,461干元)	半導體產品封裝及測試業務
Global Advanced Packaging Technology Ltd. (Cayman)	89年10月	Walkers House 87 Mary Street, Grand Cayman, KY1 – 9002, Cayman Islands	NT\$6,119,380千元 (US\$190,000千元)	從事專業性投資
A.S.E. Holding Limited(Bermuda)	79年2月	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda	NT\$7,915,000干元 (US\$243,966干元)	從事專業性投資
J&R Holding Limited (Bermuda)	84年12月	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda	NT\$13,907,259干元 (US\$435,128干元)	從事專業性投資
ASE Investment (Labuan) Inc.	88年6月	Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	NT\$7,277,867干元 (US\$240,947干元)	從事專業性投資
Omniquest Industrial Limited	89年9月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$11,457,298干元 (US\$354,704干元)	從事專業性投資

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目	
Innosource Limited	90年6月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road	NT\$2,770,696千元	 從事專業性投資	
IIIIOSOGIOO EIIIIIOG	30-0/3	Town, Tortola, British Virgin Islands	(US\$86,000千元)	R.F.F.A.LIX.Q	
日月瑞(股)公司	88年4月	高雄市楠梓加工出口區内環北路107號	NT\$1,700,000千元	從事租賃及投資業務	
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	92年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	NT\$18,298干元 (¥60,000干元)	從事市場行銷及顧客服務等業務	
ASE (U.S.) Inc.	72年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	NT\$649干元 (US\$20干元)	從事市場行銷及顧客服務等業務	
Super Zone Holdings Limited	97年6月	1408 World-Wide House,19 Des Voeux Road Central, Hong Kong	NT\$3,082,400千元 (US\$100,000千元)	從事專業性投資活動	
Alto Enterprises Limited	99年3月	P.O. Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$5,709,330千元 (US\$188,000千元)	從事專業性投資活動	
Anstock Limited	100年3月	Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Isaland	NT\$303千元 (US\$10千元)	從事專業性理財活動	
Anstock II Limited	103年7月	Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Isaland	NT\$300仟元 (US\$10干元)	從事專業性理財活動	
日月光貿易(上海)有限公司	104年1月	上海自由貿易試驗區華申路218號1幢樓5層504室	NT\$2,566仟元 (人民幣500千元)	從事貨物及技術進出口等業務	
日月光投資(昆山)有限公司	101年5月	江蘇省昆山市干燈淞南路373號	NT\$3,717,318千元 (US\$122,000千元)	從事專業性投資活動	
上海鼎匯房地產開發有限公司	94年8月	上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室	NT\$16,345,070干元 (人民幣3,600,000千元)	房地產項目開發、物業管理	
上海鼎威房地產開發有限公司	98年10月	上海市漕溪路270號1號樓338室	NT\$6,908,089干元 (人民幣1,548,000干元)	房地產開發經營、物業管理	
上海鼎裕房地產開發有限公司	99年3月	上海市寶山區錦秋路48號E192	NT\$4,936,538干元 (人民幣1,100,000千元)	房地產開發經營、物業管理	
昆山鼎泓房地產開發有限公司	101年2月	江蘇省昆山市干燈鎖聖祥東路25號2號房	NT\$3,139,662干元 (人民幣670,000千元)	房地產開發經營、物業管理	
昆山鼎悦房地產開發有限公司	101年2月	江蘇省昆山市干燈鎖聖祥東路25號2號房	NT\$1,546,415干元 (人民幣330,000千元)	房地產開發經營、物業管理	
上海鼎祺物業管理有限公司	104年1月	上海市徐滙區欽洲路772號160室	NT\$5,078干元 (人民幣1,000千元)	房地產經紀、物業管理	
陸竹開發(股)公司	93年12月	臺北市信義區基隆路1段333號19樓	NT\$1,966,344干元	房地產開發業務	
環隆電氣股份有限公司	63年2月	南投縣草屯鎖太平路一段351巷141號	NT\$400,000干元	各種電腦資訊之週邊設備、厚膜混合積體電路、無線區域網路設備、電子零件配件及個人電腦暨其零件之製造、加工與買賣	
環電(股)公司	104年4月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$9,983,223干元	從事專業性投資活動	
Huntington Holdings International Co., Ltd.	85年10月	Drake Chambers,Tortola, British Virgin Islands	NT\$8,370,606干元 (US\$255,857千元)	控股公司	
Universal ABIT Holding Co., Ltd.	95年2月	P.O. Box 30691 SMB, Grand Cayman.	NT\$906,249千元 (EUR3,800千元)	控股公司	
Unitech Holdings International Co., Ltd.	85年10月	P.O. Box 3321 Road Town Tortola BVI	NT\$93,495千元 (US\$3,000千元)	控股公司	
Rising Capital Investment Limited	99年11月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT\$176,940千元 (US\$6,000千元)	控股公司	
Rise Accord Limited	100年5月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT\$57,730干元 (US\$2,000千元)	控股公司	
Real Tech Holdings Litimted	89年3月	Trust Net Chambers, P.O. Box3444, Road Town, Tortola, B.V. I.	NT\$4,832,906干元 (US\$149,151干元)	控股公司	
環銓電子(昆山)有限公司	94年8月	江蘇省昆山市干燈鎖黃浦江路東側中央大道北側	NT\$383,201干元 (US\$12,000干元)	生產計算機輔助系統、無線網路通 訊卡、計算機高性能主機板及銷售 自產產品	
USI Enterprise Limited (環誠公司)	96年11月	Rooms 2702-3, 27th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	NT\$6,801,062千元 (US\$216,274千元)	投資諮詢服務及倉儲管理服務	

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
環旭電子公司 (環旭上海公司)	92年1月	上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號	NT\$10,649,110干元 (人民幣2,175,924干元)	提供電子產品設計製造服務、生產 加工新型電子元器件、計算機高性 能主機板、無線網路通信元器件暨 移動通訊產品及零配件,銷售自產 產品及提供相關技術諮詢服務:電 子、通訊產品及相關零配件的批 發、零售
環鴻電子(昆山)有限公司	100年8月	江蘇省昆山市干燈鎖黃浦路497號4棟	NT\$ 1,202,223干元 (人民幣250,000干元)	提供電子產品設計製造服務、生產 加工新型電子元器件、計算機高性 能主機板、無線網路通信元器件暨 移動通訊產品及零配件,銷售自產 產品及提供相關技術諮詢服務;電 子、通訊產品及相關零配件的批 發、零售
Universal Global Technology Co., Limited (環鴻公司)	97年3月	RMS 2702-3 27/F, BANK OFEAST ASIA HARBOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTERRD, WAN CHAI, HK	NT\$1,476,556干元 (US\$50,000干元)	控股公司
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V. (環隆墨西哥公司)	86年9月	Anillo Periferico Manuel Gomez Morin No 656 R.Santa Isabel C.P. 44290 Guadalajara, Jalisco, Mexico	NT\$776,221千元 (US\$23,963千元)	主機板及電腦系統組裝
USI Japan Co., Ltd.	89年3月	8F West Tower, Yokohama Business Park, 134 Godo- cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-0005	NT\$27,231干元 (¥ 95,000千元)	電腦資訊之週邊設備、積體電路、 電子零件等之製造買賣
環勝電子(深圳)公司	89年7月	深圳市南山區高新技術產業園北區環旭電子園	NT\$2,270,625千元 (US\$75,000千元)	生產經營電腦主機板、其他相關電 腦週邊設備及通訊工業控制等產品 之設計、製造及銷售
環旭科技有限公司	98年10月	RMS 2702-3 27/F, BANK OFEAST ASIA HARBOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTERRD, WAN CHAI, HK	NT\$330,960干元 (US\$11,000干元)	貿易及投資控股公司
環維電子(上海)有限公司	102年9月	上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號	NT\$6,652,140干元 (人民幣1,330,000干元)	電子產品的研發、製造,新型電子 元器件、計算機高性能主機板、無線網絡通信元器件、移動通信產品 及模塊、零配件的加工及維修,電子產品、通訊產品及零配件的銷售,第三方物流服務(除運輸),從事 負物及技術的進出口業務,以上相關業務的技術諮詢、技術服務
環豪電子(上海)有限公司	103年5月	中國(上海)自由貿易試驗區加楓路8號二層229室	NT\$240,850干元 (人民幣50,000干元)	電子元器件、計算機軟硬體(除計算機資訊系統安全專用產品)、通訊設備及配件(除地面衛星接收裝置)的銷售,第三方物流服務(除運輸),實業投資,從事貨物及技術的進出口業務,轉口貿易,區內企業間貿易及貿易代理
USI America, Inc.(註)	89年10月	3600 Peterson Way, Santa Clara, CA95054, USA	NT\$314,015干元 (US\$9,500干元)	電腦資訊設備之樣本製作、維修服 務
環鴻科技股份有限公司	98年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$980,000千元	有線及無線通信機械器材、電子零 組件、電腦及其週邊設備、汽車及 其零件製造業、產品設計業及研究 發展服務業

註:原名為USI Manufacturing Service, Inc.,於104年5月更名為USI America Inc.

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無此情形。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:

- 1. 本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業包括電子製造業、電子服務業、投資業、租賃業及建設業。
- 2. 日月光集團長久以來專注於提供半導體客戶完整之半導體封裝及測試服務,包括晶片前段測試及晶圓針測至後段之封裝材料及性能測試之服務。此外,客戶也可透過子公司環隆電氣(股)公司獲得完善的電子製造服務整體解決方案。
- 3. 大體而言本公司各關係企業間所經營業務互有關聯,其往來分工情形向以透過技術、產能、行銷以及服務之相互支援, 以發揮集團最大競爭實力,創造最大綜效,鞏固本公司在業界的領導地位。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份		
正木口冊	4FA 179	XI LIANI VECT	股數	持股比例	
	副董事長兼總經理	張洪本	104,414,941股	1.32%	
	董事	張能傑	1,779,708股	0.02%	
	董事	香港商微電子國際公司	1,327,202,773股	16.78%	
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-		
	董事(代表人)	吳田玉	-	=	
3月光半導體製造股份有限公司	董事(代表人)	董宏思	-	=	
1月九十等限表足成份 日似公司	董事(代表人)	羅瑞榮	_	=	
	董事(代表人)	陳昌益	-	=	
	董事(代表人)	陳天賜	-	-	
	獨立董事	游勝福	_	-	
	獨立董事	徐大麟	-	-	
	獨立董事	何美玥	_	=	
	董事	Jason C. S. Chang	_	=	
J&R Holding Limited (Bermuda)	董事	Richard H. P. Chang	_	_	
	董事	Joseph Tung	-	_	
	董事	J&R Holding Limited (Bermuda)	170,000,006股	100%	
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	-	
日月瑞股份有限公司	董事(代表人)	張洪本	_	_	
	董事(代表人)	董宏思	_	_	
	監察人(代表人)	馮美珍	-	_	
	董事	Jason C. S. Chang	_	_	
A.S.E. Holding Limited (Bermuda)	董事	Richard H. P. Chang	_	=	
	董事	Joseph Tung	_	_	
	董事	Richard H. P. Chang	_	=	
Omniquest Industrial Limited	董事	Joseph Tung	_	=	
	董事	Jeffrey Chen	_		
	董事	Jason C. S. Chang	_		
nnosource Limited	董事	Richard H. P. Chang	_	_	
	董事	Joseph Tung	_	_	
	董事	Jason Chang	_	_	
ASE Corporation	董事	Joseph Hung-Szu Tung	_		
	董事	Jason Chang	_		
	董事	Joseph Tung	_		
ASE Mauritius Inc.	董事	M. Aslam Koomar	_		
	董事	M. Shariff Golam Hossen	_		
	董事	Jason Chang	_		
ASE Labuan Inc.	董事	Joseph Hung-Szu Tung	_		
io E Edoddii iiio.	董事	Chau Siew Ha	_	_	
	董事兼董事長	張虔生			
	董事	張洪本			
3月光半導體(上海)有限公司	董事	張能傑	_		
	監事	張能超			
			_		
	董事兼董事長	張洪本			
日月光半導體(昆山)有限公司	董事	張虔生			
	董事	陳昌益	_	_	
	監事	Rutherford Chang	_		

企業名稱	職稱	姓名或代表人 姓名或代表人	持有股	份
正 木口間	4FW 173	X113/1/X	股數	持股比例
	董事兼董事長	張洪本	-	=
日月光電子元器件(上海)有限公司	董事	張虔生	-	-
	董事	陳昌益	-	-
	董事兼董事長	陳昌益	-	-
上海鼎匯房地產開發有限公司	董事	Rutherford Chang	-	=
工净所延历心生历及日际公司	董事		-	-
	監事	彭國強	-	-
	董事兼董事長	陳昌益	-	-
上海鼎威房地產開發有限公司	董事	Rutherford Chang	-	-
	董事		-	-
	監事	彭國強	-	=
	董事兼董事長	陳昌益	-	-
上海鼎裕房地產開發有限公司	董事	Rutherford Chang	-	-
工/母新作/方/追崖册级 月秋公司	董事	 俞旭濬	-	-
	監事	彭國強	-	-
	董事兼董事長	陳昌益	-	-
日山胆江后地玄明然左阳八日	董事	Rutherford Chang	-	=
昆山鼎泓房地產開發有限公司	董事		-	=
	監事	彭國強	-	-
	董事兼董事長	陳昌益	-	-
	董事	Rutherford Chang	-	-
昆山鼎悦房地產開發有限公司	董事		-	-
	監事	彭國強	-	-
	董事兼董事長	張洪本	-	-
日月光半導體(香港)有限公司	董事	陳昌益	-	-
	董事	鄭世欣	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
ASE Investment (Labuan) Inc.	董事	Jeffrey Chen	-	-
	董事	Mathew-Willie	-	-
	董事	Ung Bae	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
ASE (Korea) Inc.	董事	Richard H. P. Chang	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
	監察人	Alan Cheng	_	-
	董事長	Jason C.S. Chang	_	-
	董事	Richard H.P. Chang	_	=
ASE Test Limited (Singapore)	董事	Lee Kwai Mun	_	-
	董事	Jeffrey Chen	_	-
	董事&監察人	日月光半導體製造股份有限公司	1,131,452,502股	100.009
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	_	-
	董事(代表人)	張洪本	_	-
	董事(代表人)兼總經理	羅瑞榮	_	-
	董事(代表人)	潘士華	_	-
台灣福雷電子(股)公司	董事(代表人)	張能傑	_	
	董事(代表人)	陳天賜	_	-
	董事(代表人)	董宏思	_	-
	董事(代表人)	陳昌益	_	-
	董事(代表人)	曾元一	_	

企業名稱	職稱	姓名或代表人	名或代表人 持有股份	
正未·口冊	eri zak	XI 11-241 V2X/\	股數	持股比例
	董事(代表人)	張能超	-	
	董事(代表人)	李俊哲	-	
台灣福雷電子(股)公司	監察人(代表人)	鄭天正	-	
	監察人(代表人)	周家佩	-	
	監察人(代表人)	郭宏銘	-	
	董事	Jason C. S. Chang	-	
SETest Holdings, Ltd.	董事	David Pan	-	
OL lest Holdings, Ltd.	董事	Joseph Tung	-	
	董事	Jeffrey Chen	-	
	董事	Hsiang De Way	-	
SE Holdings (Singapore) Pte Ltd	董事	Choong Lai Heng	-	
	董事	Jeswant Singh s/o Darshan Singh	-	
	董事	Richard H. P. Chang	-	
	董事	Mei-Jean Chang	-	
CE Floatranica (M) Cdn Bhd	董事	Hsiang, De-Way	_	
OL LIECTIONICS (IVI) SUN, DNG.	董事	Joseph Tung	-	
	董事	Choong Lai Heng	-	
	董事	Lee Kwai Mun	-	
	董事	Jason C. S. Chang	_	
	董事	Tien Wu	-	
Labs, Inc.	董事	David Pan	_	
	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	_	
	董事	Jeffrey Chen	-	
E Singapore Pte. Ltd.	董事	Jason C. S. Chang	-	
SE Singapore Pte. Ltd.	董事	Kuo Hung-Ming	-	
	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	-	
	董事	Tien Wu	-	
	董事	David Pan	_	
E Electronics (M) Sdn,Bhd. E Labs, Inc. E Singapore Pte. Ltd. E Marketing & Service Japan Co., Ltd. E Japan Co., Ltd.	董事	Chih-Hsiao Chung	_	
	監察人	Joseph Tung	-	
	董事	Jason C.S. Chang	_	
	董事	Richard Chang	_	
	董事	Tien Wu	_	
ASE Japan Co., Ltd.	董事	David Pan	_	
	董事	Chih-Hsiao Chung	_	
	監察人	Joseph Tung	_	
ASE (U.S.) Inc.	董事	Kenneth Shih-Jye Hsiang	_	
	董事&監察人	ASE Labuan Inc.	398,981,900股	1
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	_	
日月光電子股份有限公司	董事(代表人)	董宏思	_	
	董事(代表人)	陳昌益	_	
	監察人(代表人)	潘士華	_	
	董事	張洪本	_	
APT-Cayman	董事	Chih-Chiang Lee	_	
,	董事	Tien-Yue Wu	_	
	董事	張洪本	_	
	董事	Tien-Yue Wu	_	
日月光封裝測試(上海)有限公司	董事			
	監事	Rutherford Chang 陳昌益	_	

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份			
止木口悟	月以 17节	**エロみ! \公八	股數	持股比例		
	董事	張能傑	-			
#锡泽芳微雪子有限公司	董事	鍾智孝	_			
Rid 芝微電子有限公司 Denterprises Limited Der Zone Holdings Limited Destock Limited Stock II Limited 日光投資(昆山)有限公司 日光集成電路製造(中國)有限公司 N日月新半導體有限公司 日光半導體(威海)有限公司	董事	吴田玉	-			
	監事	董宏思	-			
	董事	Jason Chang	-			
Alto Enterprises Limited	董事	Richard Chang	-			
	董事	Joseph Tung	-			
	董事	張虔生	-			
Super Zone Holdings Limited	董事	張洪本	-			
	董事	陳昌益	_			
	董事	Jason Chang	_			
anstock Limited	董事	Richard Chang	-			
	董事	Joseph Tung	-			
	董事	Jason C.S. Chang	-			
anstock II Limited	董事	Alan Li	-			
	董事	Murphy Kuo	-			
	董事兼董事長	張虔生	_			
	董事	Rutherford Chang	_			
日月光投資(昆山)有限公司	董事	許志安	_			
	監事	鄭世欣	_			
	董事	張虔生	_			
3月光集成電路製造(中國)有限公司	董事	張洪本	_			
	董事	Rutherford Chang	_			
	監事	鄭世欣	_			
	董事長		-			
	董事	吳田玉	_			
	董事	陳昌益	_			
· 	董事	David Damian French	-			
	董事	Sean Hunkler	_			
	監事	周宏康	_			
	監事	陳天賜	_			
	董事	吳田玉	_			
	董事	表態				
3月光半導體(威海)有限公司	董事	張能傑	_			
	監事	金首虎	_			
	董事	日月光半導體製造(股)公司	131,961,457股	67.		
	董事(代表人)兼董事長	潘士華	151,561,457112	37.		
	董事(代表人)	陳天賜				
	董事(代表人)	郭宏銘	_			
的開發股份有限公司	董事(代表人)	李柏練	_			
	董事(代表人)	董宏思				
	監察人					
	監察人	張聲華	_			
	董事兼董事長	陳昌益	_			
上海鼎祺物業管理有限公司	董事	馬同舟	_			
	董事		_			

	姓名或代表人	持有股份 段數	:份	
職稱	X111-2(1\02X/\	股數	持股比例	
董事	陳昌益	-		
董事	董宏思	-		
董事	李柏練	-		
董事	日月光半導體製造(股)公司	39,603,222股	99.01	
董事(代表人) 兼董事長	魏鎭炎			
董事	張虔生	-		
董事	張洪本	-		
董事(代表人)	魏振隆	-		
董事(代表人)	潘士華	-		
董事(代表人)	石孟國	-		
董事(代表人)	朱曙華	-		
董事(代表人)	李俊哲	-		
董事(代表人)	張能超	-		
董事(代表人)	張能傑	-		
董事(代表人)	吳田玉	-		
監察人	董宏思	_		
監察人		_		
監察人	陳昌益	_		
監察人	曾元一	_		
監察人		_		
		990.080.566段	99.17	
		_		
		_		
		-		
		-		
		_		
		_		
		_		
		-		
監察人	簡文祥	-		
董事	魏振隆	-		
董事 d.	魏鎖炎	-		
董事	石孟國	-		
董事	陳昌益	-		
董事	魏振隆	-		
董事	何弘	-		
i. 董事	吳國相	-		
董事	林大毅	-		
董事	石孟國	-		
董事	魏鎭炎	-		
	董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 (代表人) 董事 (代表人) 董事 (代表人) 董事 (代表人) 董事 (代表人) 董事 (代表人) 董察人 医察人 医察人 医察人 医察人 医察人 医察人 医察人 医	董事	■平	

職稱 董事 董事	姓名或代表人 石孟國 張洪本	股數	持股比例
董事			
	7E:++-		
董事	並	_	
	石孟國	-	
董事	魏鎭炎	-	
董事兼董事長	張洪本	-	
董事	魏鎖炎	-	
董事	魏振隆	-	
監事	石孟國	-	
董事	張洪本	-	
董事	石孟國	-	
董事	魏鎭炎	-	
董事兼董事長	張洪本	-	
董事	張虔生	_	
董事	Charles Chang	_	
董事	Rutherford Chang	_	
董事兼總經理	魏鎭炎	_	
董事	吳福輝	_	
		_	
		_	
		_	
		_	
		_	
	,		
		-	
		-	
		-	
		-	
董事	魏鎭炎	-	
董事	侯爵	-	
董事	鍾智孝	-	
監察人	石孟國	-	
董事兼董事長	張洪本	-	
董事	侯爵	-	
董事	魏振隆	-	
董事	魏鎭炎	-	
董事	林大毅	-	
監事	石孟國	-	
董事	張洪本	-	
董事	魏鎭炎	_	
	 監事 董事 董事<td> 監事 董事 董事 董事 董事 赞賞 董事 董事 董身 董夫本 董事 董章 董章 董章 董章 董章 董章 董章 董章 董事 董章 董章 董事 董章 董事 董章 董事 董章 董事 董章 董事 董事 董章 董事 董章 董事 董典 董事 董事<td> 監事 益共本 一 董事 金洪本 董事 西事務軍事長 張洪本 董事 公成は今 一 董事 公人のおけいのでは、 一 董事 日本財産事長 張洪本 一 董事 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事長 日本財産財産 日本財産事長 日本財産財産 日本財産 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産 日本財</td></td>	 監事 董事 董事 董事 董事 赞賞 董事 董事 董身 董夫本 董事 董章 董章 董章 董章 董章 董章 董章 董章 董事 董章 董章 董事 董章 董事 董章 董事 董章 董事 董章 董事 董事 董章 董事 董章 董事 董典 董事 董事<td> 監事 益共本 一 董事 金洪本 董事 西事務軍事長 張洪本 董事 公成は今 一 董事 公人のおけいのでは、 一 董事 日本財産事長 張洪本 一 董事 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事長 日本財産財産 日本財産事長 日本財産財産 日本財産 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産 日本財</td>	 監事 益共本 一 董事 金洪本 董事 西事務軍事長 張洪本 董事 公成は今 一 董事 公人のおけいのでは、 一 董事 日本財産事長 張洪本 一 董事 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事業 日本財産事長 日本財産事業 日本財産事長 日本財産財産 日本財産事長 日本財産財産 日本財産 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事長 日本財産事業 日本財産 日本財

A#47.00	Tith 24	サクゴルキー	持有	投份
企業名稱	職稱	姓名或代表人	股數	持股比例
	董事	魏鎭炎	-	_
USI America Inc.	董事	陳麗華	-	-
	董事	石孟國	-	-
	董事&監察人	環鴻電子股份有限公司	98,000,000股	100%
	董事(代表人)	張洪本	-	-
環鴻科技股份有限公司	董事(代表人)兼董事長	魏鎭炎	-	-
	董事(代表人)	石孟國	-	-
	監察人(代表人)	董宏思	-	_
	董事兼董事長	張洪本	-	_
19944-77-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	董事	魏鎭炎	-	-
環維電子(上海)有限公司	董事	魏振隆	-	_
	監事	石孟國	-	_
	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	魏鎭炎	-	-
環豪電子(上海)有限公司	董事	石孟國	-	-
	監事	劉丹陽	-	-

(六)各關係企業營運概況

單位:新台幣仟元/每股盈餘為新台幣元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
日月光半導體製造(股)公司	79,029,290	305,942,938	149,026,934	156,916,004	94,206,807	13,892,786	19,478,873	2.44
ASE Corporation	11,425,922	17,086,294	900,000	16,186,294	0	(434)	235,772	0.67
日月光半導體(上海)有限公司	4,236,563	15,541,488	5,166,340	10,375,148 4,391,216 152,393 201		201,665	不適用	
日月光電子股份有限公司	3,989,819	4,878,623	1,050,578	3,828,045	3,943,159	93,492	105,086	0.26
ASE Labuan Inc.	4,099,954	3,846,925	0	3,846,925	0	(88)	104,917	0.83
ASE Mauritius Inc.	7,046,629	12,335,895	128	12,335,767	0	(508)	131,777	0.61
日月光半導體(香港)有限公司	32,130	659,032	334,233	324,799	1,068,740	3,351	2,557	2.56
ASE Test Limited	659,075	30,299,257	1,630	30,297,627	0	(4,309)	1,822,696	16.66
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	2,019,907	4,991,838	745,216	4,246,622	4,614,591	726,225	702,486	4.40
ISE Labs, Inc.	852	2,792,757	204,670	2,588,087	1,041,516	7,479	17,685	0.67
ASE Singapore Pte. Ltd.	984,851	6,547,447	915,319	5,632,128	4,219,057	855,676	798,599	26.53
ASE Test Holdings, Ltd.	(註)0	3,265,806	0	3,265,806	0	0	17,685	3,536,956
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd	1,633,708	4,991,838	745,216	4,246,622	4,614,591	726,225	702,486	9.83
台灣福雷電子(股)公司	11,314,525	32,292,167	2,383,870	29,908,297	11,708,576	3,250,274	2,905,510	2.57
ASE (Korea) Inc.	3,031,771	18,418,948	2,480,973	15,937,975	14,898,848	994,712	432,837	20.87
ASE Japan Co., Ltd.	105,802	3,432,904	1,130,550	2,302,354	1,571,668	78,609	24,996	3,471.65
日月光電子元器件(上海)有限公司	383,640	617,926	1,569	616,357	0	(647)	19,139	不適用
日月光封裝測試(上海)有限公司	6,501,336	20,611,116	9,718,480	10,892,636	8,088,228	971,238	417,581	不適用
蘇州日月新半導體有限公司	1,568,467	5,655,781	1,892,681	3,763,100	4,596,934	511,342	479,965	不適用
日月光半導體(威海)有限公司	4,507,081	5,704,876	3,980,213	1,724,663	3,285,851	(20,113)	(245,190)	不適用
日月光集成電路製造(中國)有限公司	3,149,000	3,412,614	80,370	3,332,244	0	(86,254)	83,753	不適用
日月光半導體(昆山)有限公司	8,350,204	9,198,924	2,795,065	6,403,859	2,723,672	(84,675)	(230,901)	不適用
無錫通芝微電子有限公司	356,682	517,586	62,617	454,969	515,960	22,126	25,990	不適用
Global Advanced Packaging Technology LtdCayman	6,119,380	12,838,136	2,471,186	10,366,950	0	(206) 413,83		2.18
A.S.E. Holding Limited (Bermuda)	7,915,000	17,577,462	2,058,298	15,519,164	0	(5,830)	498,485	2,043.26
J&R Holding Limited (Bermuda)	13,907,259	76,289,128	26,325,855	49,963,273	0	(19,570)	2,304,578	5,296.32

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
ASE Investment (Labuan) Inc.	7,277,867	16,109,146	0	16,109,146	0	(88)	440,481	1.83
Omniquest Industrial Limited	11,457,298	17,835,069	1,652,448	16,182,621	0	0	233,728	0.66
Innosource Limited	2,770,696	4,715,918	723,447	3,992,471	0	0	67,639	0.79
日月瑞(股)公司	1,700,000	998,008	311	997,697	0	(1,756)	4,616	0.03
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	18,298	35,585	7,600	27,985	75,493	4,981	2,082	1,734.94
ASE (U.S) Inc.	649	428,677	50,206	378,471	1,414,343	68,854	34,562	34,561.89
Super Zone Holdings Limited	3,082,400	3,332,370	0	3,332,370	0	0	83,754	0.84
Alto Enterprises Limited	5,709,330	4,490,553	0	4,490,553	0	0	(163,043)	(0.87)
Anstock Limited	303	3,375,052	3,355,295	19,757	0	(109)	(635)	(63.47)
日月光投資(昆山)有限公司	3,717,318	2,915,400	2,117	2,913,283	0	(940)	(106,242)	不適用
Anstock II Limited	300	9,896,844	9,895,732	1,112	0	(184)	2,869	286.87
日月光貿易(上海)有限公司	2,566	2,279	0	2,279	0	(254)	(255)	不適用
上海鼎匯房地產開發有限公司	16,345,070	24,014,384	4,349,752	19,664,632	1,340	(205,198)	(145,116)	不適用
上海鼎威房地產開發有限公司	6,908,089	11,379,577	3,629,790	7,749,787	0	(28,192)	(28,429)	不適用
上海鼎裕房地產開發有限公司	4,936,538	5,724,313	155,562	5,568,751	0	(18,585)	(5,468)	不適用
昆山鼎泓房地產開發有限公司	3,139,662	4,029,491	648,608	3,380,883	0	(1,271)	(1,432)	不適用
昆山鼎悦房地產開發有限公司	1,546,415	1,668,070	1,277	1,666,793	0	(404)	487	不適用
上海鼎祺物業管理有限公司	5,078	1,977	354	1,623	0	(3,432)	(3,438)	不適用
陸竹開發股份有限公司	1,966,344	1,986,021	370	1,985,651	0	(3,141)	(2,276)	(0.01)
環隆電氣股份有限公司	400,000	7,389,575	6,703,695	685,880	31,665,115	561,970	904,292	22.61
環電(股)公司	9,983,223	45,821,268	2,342,358	43,478,910	0	(141,058)	1,427,299	1.43
Huntington Holdings International Co., Ltd.	8,370,606	45,855,585	49,174	45,806,411	0	(136,739)	2,143,740	8.38
Universal ABIT Holding (Cayman) Co., Ltd.	906,249	545	112,656	(112,111)	0	(42)	(42)	0
Unitech Holdings International Co., Ltd.	93,495	300,204	423	299,781	0	(5,060)	(1,585)	(0.53)
Rising Capital Investment Limited	176,940	37,293	0	37,293	0	(87)	126	0.02
Rise Accord Limited	57,730	4,941	0	4,941	0	(25)	682	34.10
Real Tech Holdings Limited	4,832,906	45,655,057	2,134,808	43,520,249	0	(210)	2,277,172	15.27
環銓電子(昆山)公司	383,201	349,536	635	348,901	0	(3,414)	(89,638)	不適用
環誠公司	6,801,062	42,474,110	294,217	42,179,893	18,346	1,963	2,418,059	11.18
環旭上海公司	10,649,110	45,618,128	11,086,939	34,531,189	47,720,912	1,754,749	3,501,996	3.22
環鴻電子(昆山)有限公司	1,202,223	4,829,112	2,509,591	2,319,521	11,473,636	655,754	645,381	不適用
環維電子(上海)有限公司	6,652,140	11,647,357	7,969,377	3,677,980	16,823,467	(2,541,732)	(2,106,167)	不適用
環豪電子(上海)有限公司	240,850	266,859	733	266,126	0	(446)	8,437	不適用
環鴻公司	1,476,556	15,538,883	8,353,253	7,185,630	13,601,194	(124,837)	1,910,806	4.90
環隆墨西哥公司	776,221	1,935,049	565,241	1,369,808	3,329,470	262,207	139,526	0.50
USI Japan Co., Ltd.	27,231	26,822	2,164	24,658	9,759	556	770	120.31
環勝電子(深圳)有限公司	2,270,625	18,164,901	9,826,545	8,338,356	24,619,545	2,535,936	2,521,198	不適用
環旭科技有限公司	330,960	6,407,750	5,796,142	611,608	24,624,098	31,276	32,467	0.38
USI America, Inc.	314,015	184,235	8,136	176,099	88,925	4,944	4,867	19.47
環鴻科技股份有限公司	980,000	9,699,058	6,950,139	2,748,919	22,695,127	728,656	711,932	7.26

註:設立資本額為美金5元。

(七) 關係企業合併財務報表

本公司民國一〇四年度(自104年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

- (八)本公司業已於本年報財務報告第124-129頁及第134-141頁揭露所有關係企業從事衍生性商品交易資訊、背書保證及資金貸與他人,其他未列示之關係企業即無從事上述之交易。
- 二、私募有價證券辦理情形:無。

三、子公司持有或處分本公司股票情形:

105年02月29日 單位:新台幣仟元(除另有註明者外);股:%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司 持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數 及金額	投資 (損)益	截至年報刊印日止 持有股數及金額	設定質權情形	本公司為 子公司背書 保證金額	本公司貸與子公司金額
台灣福雷電子	E 055 (52)	日月光合併日月宏及日日の一合	1000/	104年	-	-	_	10,978,776股 帳面金額\$417,193千元 轉列庫藏股金額 \$196,677	-	-	_
(股)公司 換服	月欣三合一 100% 換股及盈餘 分配取得	100%	本年度截 至年報刊 印日止	-	-	_	10,978,776股 帳面金額\$416,644干元 轉列庫藏股金額 \$196,677	-	-	-	
4057	650.035	日月光合併日月宏及日	4000/	104年	-	-	-	88,200,472股(註) 帳面金額\$3,351,618干元 轉列庫藏股金額 \$1,380,721	-	-	_
ASE lest Ltd.	ASE Test Ltd. 659,075 月欣三合— 1009 換股及盈餘 分配取得	100%	本年度截 至年報刊 印日止	-	-	-	88,200,472股(註) 帳面金額\$3,347,208千元 轉列庫藏股金額 \$1,380,721	-	-	-	
J&R	12,007,250	日月光合併日月宏及日月欣三合一	1000/	104年	-	-	-	46,703,763股 帳面金額\$1,774,743千元 轉列庫藏股金額 \$381,709	-	-	-
Holding Ltd. (Bermuda)	13,907,259	カバニュー 換股及盈餘 分配取得	100%	本年度截 至年報刊 印日止	-	-	_	46,703,763股 帳面金額\$1,772,408千元 轉列庫藏股金額 \$381,709	-	-	-

註: 為配合ASE Test Ltd.當地法令規定ASE Test Ltd.取得本公司之股票88,200,472股全數信託予中國信託商業銀行。

四、其他必要補充說明事項:無。

玖、其他事項

最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

日月光半導體製造股份有限公司

負責人 | 張虔生



日月光半導體製造股份有限公司

www.aseglobal.com

